创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

苏州冠礼科技股份有限公司

Suzhou Winmax Technology Co., Ltd.

（苏州高新区浒墅关开发区石林路 189 号）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（申报稿）

公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

东吴证券 SOOCHOW SECURITIES

（苏州工业园区星阳街 5 号）

致投资者的声明

一、本次上市目的

公司是国内领先的液态化学品整体解决方案供应商之一，自创立起恪守“诚、信、朴、实”的经营理念，坚持以客户需求为导向，以技术创新为驱动，以品质交付为根本，聚焦集成电路、显示面板及电子化学品等泛半导体产业链中液态化学品的全流程管理需求，提供高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备的研发、设计、生产与销售。公司深知，每一道工艺、每一套设备、每一次交付，都承载着客户的信任与产业发展的责任，因此始终坚持脚踏实地做好产品、精益求精做好服务，以长期主义精神推动企业稳健成长。

公司致力于推动高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备的技术进步，为国家战略性新兴产业发展提供支撑，助力产业链自主可控和高质量发展。随着我国集成电路产业快速发展、“新质生产力”战略深入实施以及半导体国产化进程加速，市场对高纯工艺介质供应系统及高阶湿制程工艺设备的需求持续旺盛，为公司未来发展提供了广阔空间。

本次申请在创业板上市，是公司发展历程中的重要里程碑。公司希望募集资金用于扩大产能、加大研发投入、完善供应链布局、提升核心竞争力，实现技术迭代与产业升级，同时拓宽融资渠道、完善公司治理、增强品牌影响力，更好地把握半导体产业国产化与全球供应链重构的历史机遇，推动公司高质量发展。

展望未来，公司将坚守实业发展路线，秉持诚信经营、行稳致远的经营准则，持续精进技术研发与综合服务实力，稳步提升综合竞争优势，力争成长为具备全球影响力的优质企业，依靠持续创新与踏实经营，促进行业协同高质量发展。

二、现代企业制度的建立健全情况

公司按照《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等制度，建立了由股东会、董事会和高级管理人员组成的权责明确、运作规范的法人治理结构，并设立了董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、

提名委员会等专门委员会，确保公司治理结构规范、决策程序科学、内部控制有效、风险管理到位。公司信息披露制度健全，注重投资者保护，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。

三、本次融资的必要性及募集资金使用规划

本次募集资金运用均围绕公司主营业务进行，将用于半导体高端装备产能升级与智造基地建设项目、高端电子化学品智能供应产线及半导体核心工艺装备研发项目、电子溶剂绿色再生高效系统研发项目、营销总部及营销网络建设项目、补充流动资金，上述募集资金投资项目的实施将对公司的主营业务产生积极影响，使公司核心竞争力得到进一步提升，有利于巩固公司在行业中的地位，做大做强主营业务，提升公司的业务能力、营销能力、研发能力以及服务能力，符合公司未来战略发展规划。

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已制定《苏州冠礼科技股份有限公司募集资金管理制度》并将严格执行。《苏州冠礼科技股份有限公司募集资金管理制度》明确了募集资金专户存储制度，并对募集资金的使用、变更、管理与监督等进行了规定。公司募集资金到位后，将严格按照该制度对募集资金的专项使用进行监督和管理。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

公司自成立以来持续深耕技术研发，围绕高纯工艺介质及湿法制程领域，构建了先进制程工艺适配、介质特性分析与流体仿真设计、高效自动化控制、湿法工艺高效控制、绿色化学品循环再生、结构设计与数据安全防护六大技术平台。基于上述技术平台，公司形成了多项核心技术，并已成熟应用于高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备等主要产品，实现技术成果向商业化应用的持续转化。

未来，公司将坚持“客户为本、技术创新、绿色共赢”的发展战略，以客户需求为核心，深化供应链整合，提升交付能力与服务质量；以技术创新为内核，持续加大研发投入，对标行业高端前沿需求，布局全球市场、提升国际竞争力；以绿色发展为导向，迭代优化节能环保产品。公司将以科技创新驱动发展，以卓越品质创造价值，持续为客户、股东、员工及社会创造长期回报，实现高质量、可持续发展。

（本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页）

董事长：

梁进利

苏州冠礼科技股份有限公司

2026 年 6 月 24 日

发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

本次发行概况

发行股票类型	境内上市的人民币普通股（A 股）
发行股数	本次拟公开发行股份数量不超过 7,000 万股，发行完成后公开发行股数占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。
每股面值	1.00 元
每股发行价格	【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块	深圳证券交易所创业板
发行后总股本	不超过 28,000 万股
保荐人、主承销商	东吴证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

目 录

致投资者的声明 1

发行人声明 4

本次发行概况 5

目 录 6

第一节 释义 10

第二节 概览 16

一、重大事项提示 16

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 19

三、本次发行概况 19

四、发行人主营业务情况 21

五、发行人板块定位情况 24

六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 27

七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 27

八、发行人选择的具体上市标准 28

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 28

十、募集资金运用与未来发展规划 28

十一、其他对发行人有重大影响的事项 29

第三节 风险因素 30

一、与发行人相关的风险 30

二、与行业相关的风险 31

三、其他风险 32

第四节 发行人基本情况 33

一、发行人基本情况 33

二、发行人设立情况 33

三、报告期内股本及股东变化情况 35

四、发行人设立以来涉及外商投资管理事项 37

五、公司报告期内重大资产重组情况 38

六、发行人在其他证券市场的上市和挂牌情况 41

七、发行人的股权结构.....42
八、发行人子公司、分公司情况.....42
九、主要股东、实际控制人和其他持股 5%以上股份主要股东的情况.....43
十、发行人特别表决权股份或类似安排.....46
十一、发行人协议控制架构.....47
十二、发行人控股股东报告期内重大违法行为.....47
十三、发行人股本情况.....47
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.....49
十五、发行人与董事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况.....54
十六、公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况.....55
十七、最近三年董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况...56
十八、董事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.....58
十九、董事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.....58
二十、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.....60
二十一、发行人员工及其社会保障情况.....69
第五节 业务与技术.....72
一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.....72
二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况.....88
三、发行人销售情况及主要客户.....119
四、发行人采购情况及主要供应商.....122
五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产.....125
六、发行人技术与研发情况.....132
七、安全生产和环境保护情况.....143
八、境外经营情况.....144
第六节 财务会计信息与管理层分析.....145
一、财务报表、会计师事务所的审计意见类型和关键审计事项.....145
二、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况.....153
三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....154

四、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.....185
五、主要税项及享受的税收优惠政策.....186
六、发行人报告期内主要财务指标.....188
七、经营成果分析.....189
八、资产质量分析.....211
九、偿债能力分析、流动性与持续经营能力分析.....230
十、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.....243
十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项对发行人的影响.243
十二、盈利预测.....244
第七节 募集资金运用与未来发展规划 245
一、本次募集资金运用概况.....245
二、本次募集资金具体用途的可行性及其与公司现有业务、核心技术的关系.....248
三、募集资金投资项目具体情况.....252
四、募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响和对业务创新、创造、创意性的支持作用.....252
五、未来发展规划.....253
第八节 公司治理与独立性 255
一、报告期内公司治理方面存在的缺陷及改进情况.....255
二、关于内部控制完整性、合理性和有效性的评估意见.....255
三、公司报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况.....255
四、发行人报告期内资金占用或提供担保的情况.....256
五、发行人独立运营情况.....256
六、同业竞争.....257
七、关联方与关联交易.....264
第九节 投资者保护 276
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.....276
二、本次发行前后股利分配政策及差异情况.....276
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.....280
四、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的公司关于依法落实保护投资者合法权

益规定的各项措施.....280
第十节 其他重要事项.....281
一、重大合同.....281
二、对外担保.....283
三、重大诉讼及仲裁事项.....283
第十一节 声明.....284
一、发行人及其全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明.....284
二、发行人控股股东声明.....285
二、发行人控股股东声明.....286
三、保荐人（主承销商）声明.....287
四、保荐人董事长、总经理声明.....288
五、发行人律师声明.....289
六、审计机构声明.....290
七、资产评估机构声明.....291
八、验资机构声明.....292
九、验资复核机构声明.....293
第十二节 附件.....294
一、备查文件目录.....294
二、查阅时间和查阅地点.....294
附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.....296
附件二：与投资者保护相关的承诺.....298
附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.....322
附件四：股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.....324
附件五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.....326
附件六：募集资金具体运用情况.....328
附件七：子公司、参股公司简要情况.....336
附件八：专利清单.....339

第一节 释义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：

普通释义		
冠礼科技、股份公司、公司、本公司、发行人	指	苏州冠礼科技股份有限公司
冠礼有限	指	苏州冠礼科技有限公司，曾用名“苏州冠博控制科技有限公司”，2025 年 10 月整体变更为“苏州冠礼科技股份有限公司”
台湾朋亿	指	朋亿股份有限公司，中国台湾上柜公司，系发行人直接控股股东
台湾圣晖	指	圣晖工程科技股份有限公司，中国台湾上柜公司，系发行人间接控股股东
上海竑圣晖	指	上海竑圣晖企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台
上海鼎振益	指	上海鼎振益企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台
苏州吉曜	指	苏州吉曜企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台
苏州百吉	指	苏州百吉企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台
上海冠礼	指	冠礼控制科技（上海）有限公司，系发行人全资子公司
新加坡冠礼	指	NOVATECH ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD.，系发行人全资子公司
马来西亚冠礼	指	WINMAX TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.，系新加坡冠礼子公司
冠礼科技上海分公司	指	苏州冠礼科技股份有限公司上海分公司，系发行人分公司
冠礼科技深圳分公司	指	苏州冠礼科技股份有限公司深圳分公司，系发行人分公司
冠礼科技无锡分公司	指	苏州冠礼科技股份有限公司无锡分公司，系发行人分公司
冠礼科技武汉分公司	指	苏州冠礼科技股份有限公司武汉分公司，系发行人分公司
冠礼科技西安分公司	指	苏州冠礼科技股份有限公司西安分公司，系发行人分公司
上海冠礼苏州分公司	指	冠礼控制科技（上海）有限公司苏州分公司，系上海冠礼分公司
宝韵科技	指	宝韵科技股份有限公司
锐泽实业	指	锐泽实业股份有限公司
日本锐泽	指	Rayzher Technology Co., Ltd.
新加坡锐泽	指	Rayzher Technology Singapore Pte. Ltd.
美国锐泽	指	Rayzher Technology USA Inc
锐泽投资	指	锐泽投资管理顾问股份有限公司
锐泽材料	指	锐泽材料股份有限公司
德国锐泽	指	Rayzher Technology Germany GmbH

锐拓科技	指	锐拓科技股份有限公司
绚富科技	指	绚富科技股份有限公司
达德设计	指	达德设计股份有限公司
理海技研	指	理海技研股份有限公司
和硕工程	指	和硕工程股份有限公司
丰泽工程	指	丰泽工程股份有限公司
印度圣晖	指	Sheng Huei Technology India Private Limited
美国圣晖	指	Acter Group USA Inc.
圣晖国际	指	Sheng Huei International CO. Ltd.
塞舌尔 New Point	指	New Point Group Limited
圣晖集成	指	圣晖系统集成集团股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 603163.SH
深圳鼎贸	指	深圳市鼎贸贸易有限公司
深圳圣晖	指	圣晖工程技术（深圳）有限公司
印尼合资	指	PT Acter Integration Technology Indonesia
新加坡 Acter	指	Acter Technology Singapore Pte. Ltd.
马来西亚 Acter	指	Acter Technology Malaysia Sdn Bhd
泰国 Acter	指	Acter Technology Company Limited
印尼 Acter	指	PT Acter Technology Indonesia
香港 Acter	指	Acter International Limited
越南圣晖	指	Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
九昌投资	指	九昌投资股份有限公司
全国人大	指	中华人民共和国全国人民代表大会
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家市场监督管理总局	指	中华人民共和国国家市场监督管理总局
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
国家能源局	指	中华人民共和国国家能源局

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
国务院办公厅	指	中华人民共和国国务院办公厅
工信部办公厅	指	中华人民共和国工业和信息化部办公厅
公安部办公厅	指	中华人民共和国公安部办公厅
交通运输部办公厅	指	中华人民共和国交通运输部办公厅
应急管理部办公厅	指	中华人民共和国应急管理部办公厅
国家市场监督管理总局办公厅	指	中华人民共和国国家市场监督管理总局办公厅
工信部装备工业发展中心	指	工业和信息化部装备工业发展中心
东吴证券、保荐机构	指	东吴证券股份有限公司
信永中和、会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
锦天城、发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
中盛评估	指	中盛评估咨询有限公司
报告期	指	2023 年度、2024 年度和 2025 年度
报告期各期末	指	2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司，合并口径包括：中芯南方集成电路制造有限公司、中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司、中芯京城集成电路制造（北京）有限公司、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司、中芯东方集成电路制造有限公司、中芯北方集成电路制造（北京）有限公司
华虹半导体	指	华虹半导体有限公司，合并口径包括：华虹半导体制造（无锡）有限公司、华虹半导体（无锡）有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司
合肥晶合	指	合肥晶合集成电路股份有限公司
长江存储	指	长江存储科技有限责任公司，合并口径包括：武汉新芯集成电路股份有限公司、长江存储科技有限责任公司
长鑫存储	指	长鑫存储技术有限公司，合并口径包括：长鑫集电（北京）存储技术有限公司、长鑫存储技术有限公司
住友化学、SCES Pte. Ltd.	指	住友化学株式会社，SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
正帆科技	指	上海正帆科技股份有限公司
至纯科技	指	上海至纯洁净系统科技股份有限公司
公司 B	指	合并口径包括：公司 B-1、公司 B-2
公司 E	指	合并口径包括：公司 E-1、公司 E-2、公司 E-3、公司 E-4
深圳市新凯来技术有限公司	指	合并口径包括：珠海基石科技有限公司、深圳市新凯来工业机器有限公司

苏州敏之熠	指	合并口径包括：苏州敏之熠系统集成有限公司、马鞍山柘和科技工程有限公司
阿斯麦	指	AdvancedSemiconductor Material Lithography，ASML，系荷兰半导体设备上市公司
应用材料	指	Applied Materials, Inc.，系材料工程解决方案的领先企业
泛林集团	指	Lam Research Corp.，系全球半导体产业创新晶圆制造设备及服务主要供应商
东京电子	指	TOKYO ELECTRON，系日本半导体设备制造商
科磊	指	KLA Corp.，系美国半导体设备公司
STI	指	STI 株式会社，系韩国的半导体设备和高性能陶瓷基板制造商
盛剑科技	指	上海盛剑科技股份有限公司
帆宣科技	指	帆宣系统科技股份有限公司
中国电子工程设计院股份有限公司	指	合并口径包括：世源科技工程有限公司、北京世源希达工程技术有限公司
TCL 科技	指	TCL 科技集团股份有限公司，合并口径包括：中环领先（徐州）半导体材料有限公司、广州华星光电半导体显示技术有限公司、TCL 华星光电技术有限公司、武汉华星光电技术有限公司、武汉华星光电半导体显示技术有限公司、中环领先半导体科技股份有限公司、天津中环领先材料技术有限公司、苏州华星光电技术有限公司、深圳市华星光电半导体显示技术有限公司、广州华星光电技术有限公司
德尔科技	指	福建德尔科技股份有限公司，合并口径包括：福建天甫电子材料有限公司、福建德尔科技股份有限公司
专业释义		
半导体	指	在常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，半导体产品主要包括集成电路、分立器件、光电子器件及传感器四大类
泛半导体	指	泛半导体产业是半导体技术跨领域延伸与应用形成的产业集群，通常包含集成电路、显示面板、光伏及半导体照明四大核心领域
集成电路	指	Integrated Circuit，指把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路
显示面板	指	指能够将电信号转换为可见图像的电子元器件，是现代电子设备（如电视、手机、电脑、平板等）中实现图像显示的核心部件
晶圆	指	硅（Si）等半导体材料制成的薄片，是制造集成电路（芯片）的基础载体
先进制程	指	Advanced Process，是半导体集成电路制造领域中，代表行业前沿技术水平、采用更小工艺节点与更先进器件结构的高端制造工艺总称，是衡量半导体制造技术能力的核心标志。业界普遍以 28nm 作为成熟制程与先进制程的分界线
高阶湿制程	指	Advanced Wet Processing，是泛半导体制造领域中，面向先进制程节点与高端产品场景的高精度、高洁净度、高管控要求的湿法工艺总称
湿法清洗	指	采用液体化学溶剂和去离子水对晶圆表面进行处理，通过溶解、剥离及置换等作用，有效去除颗粒、有机物、金属离子及氧化物等污染物的工艺过程
湿法显影	指	将曝光完成的晶圆进行成像的过程，通过这个过程，成像在光阻上的图形被显现出来
湿法刻蚀	指	通过酸、碱等化学溶液与材料表面发生化学反应，实现对薄膜或基底材料的选择性溶解与去除，从而形成特定结构或图形
湿法去胶	指	利用化学药液与光刻胶发生化学反应，将晶圆表面光刻胶层溶解、剥离并清洗去除的半导体制造技术
扩散	指	物质分子从高浓度区域向低浓度区域转移，直到均匀分布的现象， 其中，扩散的速率与物质的浓度梯度成正比

掺杂	指	将可控数量的所需杂质掺入晶圆的特定区域中，获得精确的杂质分 布，从而改变晶圆的电学性质
光刻	指	通过在晶圆表面涂覆光刻胶，并利用特定波长光源经掩模版曝光，将电路图形精确转移至晶圆，为后续刻蚀、沉积等工艺提供基础图形
化学气相沉积/CVD	指	将气态前驱物引入反应环境，在晶圆表面发生化学反应，生成固态薄膜并沉积于基底上的工艺技术
精馏	指	通过控制加热与冷凝过程，利用各组分沸点差异，实现混合液体中不同组分的分离与提纯
CMP	指	Chemical Mechanical Polishing，化学机械抛光，结合化学腐蚀与机械研磨，实现晶圆表面原子级平坦
电子级化学品	指	专用于集成电路、显示面板等泛半导体制造领域的超高纯度化学品，是光刻、蚀刻等核心制程的关键基础材料
研磨液	指	CMP 制程专用液态介质，由研磨颗粒（如二氧化硅、氧化铝）、化学添加剂、去离子水等组成，通过化学腐蚀与机械研磨的协同作用，实现晶圆表面全局平坦化
LORRY	指	化学品槽车，用于运输大宗化学品的专业货运车辆，负责将化学品由供应商安全运送至厂区
CCB	指	Clean Coupler Booth，槽车充填设备
Storage Tank 、 Mixing Tank、Supply Tank	指	储存罐、混合罐、供应罐
CTU	指	Chemical Transfer Unit，化学品传输单元
CMU	指	Chemical Mixing Unit，化学品混合单元
CDU	指	Chemical Dispense Unit，化学品供应单元
STU	指	Slurry Transfer Unit，研磨液传输单元
SBDU	指	Slurry Blending and Dispensing Unit，研磨液混合供应单元
VMB	指	Valve Manifold Box，分流阀箱，集成多组阀门的流体控制单元，用于对液体介质进行分配、切换及隔离，实现多路管线的集中控制
TBOX	指	Tee Box，三通分配箱
EBOX	指	End Box，末端分配箱
TOOL	指	工艺机台，泛半导体制造中执行具体工艺步骤的设备
ppt 级	指	杂质浓度单位，指万亿分之一的杂质体积浓度
ppb 级	指	杂质浓度单位，指十亿分之一的杂质体积浓度
ppm 级	指	杂质浓度单位，指百万分之一的杂质体积浓度
SEMI G4/G5	指	由国际半导体设备与材料协会（SEMI）制定的高纯化学品纯度等级标准，其中 G4 级要求金属杂质含量控制在 ppb 级，G5 级要求金属杂质含量控制在 ppt 级
Class 10/100	指	美国联邦标准 209E 的洁净室等级，指在每立方英尺的空气中，直径大于或等于 0.5μm 的悬浮颗粒总数不超过 10 个/100 个
晶圆制造	指	以单晶硅片为基底，通过光刻、蚀刻、沉积、离子注入、清洗、CMP 等一系列精密制程，在硅片上制备集成电路结构的制造过程，是半导体产业链的核心环节
先进封装	指	将多个芯片通过高密度连接或堆叠整合在一起，以提升性能并缩小体积的封装技术
3D NAND	指	3D Not-AND，通过三维垂直堆叠结构实现的非挥发性快闪记忆体，在断电情况下仍可保存数据，并通过多层堆叠显著提升存储密度与容量
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International 国际半导体设备与材料产业协会，是全球半导体设备与材料领域的重要行业组织，负责制定标准

		并推动产业发展
CSIA	指	China Semiconductor Industry Association 中国半导体行业协会
SIA	指	Semiconductor Industry Association 美国半导体行业协会
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics 世界半导体贸易统计组织
DRAM	指	动态随机存取存储器，是一种用于临时存储数据的半导体存储器，是计算机和电子设备中的主要内存类型
HBM	指	High Bandwidth Memory，是一种基于 3D 堆栈工艺的高性能 DRAM，通过在垂直方向上堆叠多个 DRAM 芯片，并结合先进的封装技术，实现高带宽、高容量和低 功耗的特性。HBM 被广泛应用于高性能计算、人工智能和图形 处理等领域
EDA	指	Electronic Design Automation 电子设计自动化，使用软件工具和方法对电子系统进行建模、设计、验证与实现的技术体系，主要应用于超大规模集成电路设计
PLC	指	Programmable Logic Controller 可编程逻辑控制器，是一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程
PID 控制	指	比例-积分-微分控制，根据给定值和实际输出值构成控制偏差，将偏差按比例、积分和微分通过线性组合构成控制量，对被控对象进行控制
SCADA	指	Supervisory Control and Data Acquisition 监控与数据采集系统，一种能够远距离收集和处理数据并应用操作控制的计算机化系统
Spin Dry 、IPA Vapor Dry、Marangoni Dry	指	晶圆干燥的主流方法，分别为旋转甩干、IPA 蒸汽干燥、马兰戈尼干燥

本招股说明书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

（一）发行人特别提醒投资者注意的风险因素

公司特别提请投资者注意公司及本次发行的以下重大事项及风险，并认真阅读本招股说明书正文内容。

1、行业需求波动与技术迭代风险

公司所属行业为半导体器件专用设备制造业，主要产品广泛应用于集成电路、显示面板及电子化学品等高端制造领域。报告期各期，公司主要产品收入占主营业务收入的比例分别为 98.57%、98.57%及 98.62%，其市场需求与下游行业景气度、资本开支规模高度相关，周期性特征较为显著。

集成电路、显示面板等行业作为电子信息产业的核心支柱，其发展节奏与宏观经济环境、国际贸易格局、终端消费市场需求、技术迭代进程、产业扶持政策等多重因素深度绑定，若未来全球半导体产业景气度进入下行周期，AI 算力、消费电子、新能源汽车等下游终端市场需求不及预期，将直接导致厂商收缩资本开支计划、放缓新建产线布局与现有产能扩张节奏，进而使得市场对公司核心产品的采购需求出现大幅波动。在此情形下，公司将面临新增订单获取不及预期、在手项目交付周期延长、营业收入与利润规模下滑的经营风险。

与此同时，下游行业技术迭代迅速，先进制程产线对配套设备的精度、稳定性、洁净度等核心指标要求持续升级。若公司未能紧跟下游行业技术迭代步伐，及时完成适配先进制程产线的技术研发与产品升级迭代，将无法持续满足下游客户的核心需求，进而面临市场份额下滑、核心竞争力弱化的不利局面，对公司持续盈利能力造成影响。

2、市场竞争加剧风险

公司所处行业是集成电路、显示面板及电子化学品生产环节的关键配套领域，公司产品性能直接决定下游产线的制程精度、运行稳定性与产品良率，具备技术

壁垒高、客户认证周期长、品牌粘性强的特征。全球市场范围内，该领域早期由国际巨头主导，该类企业凭借长期技术积累、全球化的供应链布局与服务网络、丰富的产品矩阵，与主流厂商建立了深度合作关系，具备较强的市场竞争优势。而随着半导体产业国产化进程的持续加速，国内市场亦涌现出多家具备技术研发能力与规模化交付能力的同行业企业，参与者持续增加使得市场竞争日趋激烈。国内同行业企业依托本土化服务优势、成本优势与政策扶持红利，在成熟制程领域快速实现技术突破与客户认证，逐步形成了自身的细分赛道优势与客户资源壁垒；更有部分企业通过产能扩张、产业链上下游协同布局等策略，持续抢占市场份额，进一步加剧了市场的竞争格局。

目前，公司在全品类产品覆盖、先进制程领域的技术储备等方面已形成差异化的竞争优势，整体业务规模与全球化市场布局亦处于稳步拓展阶段。但若未来国际龙头企业加码中国市场本土化布局与价格竞争，国内同行业企业亦通过技术突破、服务升级持续争夺市场份额，而公司未能通过技术创新、产品迭代、成本管控巩固核心竞争力，将面临市场竞争加剧的风险，进而出现市场份额萎缩、毛利率下滑及经营业绩不及预期的影响。

3、控股股东同业竞争风险

公司直接控股股东台湾朋亿经营高科技产业制程化学品供应系统销售与整合工程服务，属于与公司的主营业务存在相同或相似业务的情况。报告期内，公司与台湾朋亿在中国台湾以外地区存在不构成重大不利影响的同业竞争的情形。截至报告期末，双方已不存在同业竞争。除此以外，公司控股股东及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争的情况。台湾朋亿 2023 年和 2024 年竞争性业务产生的收入或毛利合计未超过公司主营业务收入或毛利的 30%，2025 年台湾朋亿不存在与公司产生竞争性业务的收入，其与公司的同业竞争未对公司经营产生重大不利影响。

若未来台湾朋亿在中国台湾以外市场的收入或毛利规模进一步扩大，且未能合理规划并修正其旗下经营主体的业务方向及细分市场领域，则可能构成对公司存在重大不利影响的同业竞争，进而对公司的业务发展构成一定的不利影响。

4、应收款项规模较大风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 20,346.46 万元、27,893.06 万元及 33,759.58 万元，占当期营业收入的比例分别为 24.13%、21.76%及 25.38%，整体呈增长趋势。公司已按照企业会计准则及会计政策要求，基于账龄组合对应收账款计提了相应的坏账准备，报告期各期末坏账准备余额分别为 2,802.63 万元、3,810.77 万元及 3,628.29 万元。

公司下游客户主要为国有企业、上市公司及行业龙头企业，资信状况整体良好，但该类客户内部付款审批流程较为复杂、结算周期相对较长，导致公司应收账款回收管理难度及工作量较大。若未来宏观经济环境发生不利变化，或部分客户因经营状况恶化、资金周转压力等因素导致支付能力下降，而公司未能及时识别风险并采取有效催收措施，则可能存在应收账款回收周期延长、坏账损失增加的风险，进而对公司现金流状况及经营业绩产生不利影响。

5、存货跌价风险

报告期内，随着公司业务规模持续增长，项目执行周期内累计投入的合同履约成本规模较大。报告期各期末，公司存货中合同履约成本账面余额分别为 93,901.11 万元、106,862.79 万元及 75,905.77 万元，占各期末流动资产的比例分别为 51.07%、50.23%及 45.04%，整体规模较大。

若未来出现半导体行业景气度下行、下游客户经营状况恶化或资金压力加剧等不利情形，可能导致部分项目执行进度放缓、合同范围调整或终止。在此情况下，公司存货可能存在跌价风险，且部分已发生的大额项目成本可能无法通过合同款项得到全额补偿，从而对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

（二）与本次发行相关的重要承诺

公司提示投资者认真阅读公司、公司股东、董事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺和未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺”和“附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。

（三）本次发行上市后的股利分配政策及分红回报规划

2026 年 3 月 12 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于制定公司上市后三年分红回报规划的议案》，对本次发行后的股利分配政策作出了相应规定，具体参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、本次发行前后股利分配政策及差异情况”之“（二）公司上市后的股利分配政策”。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况			
发行人名称	苏州冠礼科技股份有限公司	成立日期	2016 年 5 月 31 日
注册资本	21,000 万元	法定代表人	梁进利
注册地址	苏州高新区浒墅关开发区石林路 189 号	主要生产经营地址	苏州高新区浒墅关开发区石林路 189 号
控股股东	朋亿股份有限公司	实际控制人	无
行业分类	C35 专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
（二）本次发行的有关中介机构			
保荐人	东吴证券股份有限公司	主承销商	东吴证券股份有限公司
发行人律师	上海市锦天城律师事务所	其他承销机构	无
审计机构	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构	中盛评估咨询有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。	
（三）本次发行其他有关机构			
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	收款银行	【】
其他与本次发行有关的机构		无	

三、本次发行概况

（一）本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	7,000 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
其中：发行新股数量	7,000 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	无	占发行后总股本比例	不适用

发行后总股本	不超过 28,000 万股		
每股发行价格	人民币【】元		
发行市盈率	【】倍（以【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	【】元/股（以发行前一年度经审计的归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算）	发行前每股收益	【】元/股（以发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元/股（以发行前一年度经审计的归属于母公司股东的权益与本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算）	发行后每股收益	【】元/股（以发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）		
预测净利润	不适用		
发行方式	采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会认可的其他方式		
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板股票交易账户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	半导体高端装备产能升级与智造基地建设项目		
	高端电子化学品智能供应产线及半导体核心工艺装备研发项目		
	电子溶剂绿色再生高效系统研发项目		
	营销总部及营销网络建设项目		
	补充流动资金		
发行费用概算	本次发行预计费用总额为【】万元，包括：保荐及承销费【】万元，审计及验资费用【】万元，律师费用【】万元，信息披露及发行手续费等【】万元		
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况（如有）	【】		
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况（如有）	【】		
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则（如有）	不适用		
（二）本次发行上市的重要日期			
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日		
开始询价推介日期	【】年【】月【】日至【】年【】月【】日		

刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日和【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

四、发行人主营业务情况

（一）主营业务、主要产品及其用途

公司专注高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备的研发、设计、生产与销售，服务于集成电路、显示面板及电子化学品等泛半导体产业，围绕产业链液态化学品全流程管理需求，提供从系统设计、生产制造、现场安装调试、验收交付到后期运维管理的一站式整体解决方案。

公司主要产品包括高纯工艺介质系统、高阶湿制程工艺设备两大类。高纯工艺介质系统支持各类液态化学品的纯化、分装、混配、储存、输送及回收再生，通过对关键工艺参数的实时监控与精准调节，降低微污染风险，保障液态化学品在生产过程中的洁净度、稳定性与安全性，实现持续可靠供应；高阶湿制程工艺设备可应用于泛半导体制造中的清洗、显影、刻蚀及去胶等关键工艺环节，是晶圆制造过程中不可或缺的重要装备，其洁净度控制能力与工艺稳定性直接影响产品良率与制程一致性。报告期内，公司主营业务收入构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
高纯工艺介质系统	123,148.90	93.45%	123,561.78	97.35%	80,085.06	95.38%
高阶湿制程工艺设备	6,808.41	5.17%	1,543.05	1.22%	2,680.93	3.19%
其他	1,819.45	1.38%	1,816.93	1.43%	1,202.39	1.43%
合计	**131,776.76**	**100.00%**	**126,921.76**	**100.00%**	**83,968.39**	**100.00%**

注：其他主要系相关设备的维保及全面质量管理协议服务。

高纯工艺介质系统作为公司的核心收入来源，报告期内收入金额从 2023 年 80,085.06 万元增长至 2025 年 123,148.90 万元，年均复合增长率达 24.01%。该业务收入占主营业务比例终保持在 90%以上，占据主导地位。该类业务的产品主要应用于集成电路、显示面板等下游行业，为生产环节输送稳定、高纯的工艺介质。

高纯工艺介质系统根据具体用途又分为自动化化学品与研磨液供应系统、电

子级化学品纯化及分装系统、废化学品再生系统，其中自动化化学品与研磨液供应系统为公司营业收入的核心贡献产品，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自动化化学品与研磨液供应系统	106,720.57	86.66%	102,613.84	83.05%	62,602.37	78.17%
电子级化学品纯化及分装系统	11,917.33	9.68%	18,332.95	14.84%	14,488.41	18.09%
废化学品再生系统	4,511.00	3.66%	2,614.99	2.12%	2,994.28	3.74%
合计	**123,148.90**	**100.00%**	**123,561.78**	**100.00%**	**80,085.06**	**100.00%**

（二）主要原材料及重要供应商

公司主要原材料类别包括专用部件（如过滤器、泵浦、桶槽等）、管件类等。报告期内，公司的重要供应商包括应特格（上海）微电子贸易有限公司、上品兴业氟塑料（嘉兴）有限公司、上海宇灿国际贸易有限公司等。

（三）主要生产模式

公司采用计划驱动、以销定产的生产模式，构建集系统设计、生产制造、安装调试、验收交付于一体的完整服务体系，可深度适配客户在工艺路线、厂务条件、洁净等级及自动化控制程序等方面的差异化需求，通过工况匹配、参数优化、现场调试，为其提供全流程定制化解决方案与配套技术服务。

投标阶段，业务部门通过技术交流、现场勘查及招标文件审阅等方式明确客户需求，结合流体计算、化学药液特性、材料兼容性及工艺流程完成系统及设备、电气及自动化控制方案的初步设计，形成完整的投标技术方案。中标后，业务部门将进一步深化系统及关键设备设计，完成设备机械、现场施工及电气控制的图纸绘制以及 PLC 控制程序、监控软件程序的开发，相关技术资料将移交至生产部门及项目执行团队，为项目实施提供技术支撑。

生产部门依据相关技术资料、物料表等制定项目计划，明确各工序时间节点与人员配置，外壳、管路、电控等生产部门严格按照生产计划组织装配，后勤支援组同步做好物料核对与领用管理。生产过程中，品管部门执行来料、过程及成品的检验，生产人员开展自查自检，班组长进行过程抽检，形成“自检、互检、

专检”相结合的管控机制。针对紧急项目、物料异常、设计变更等情形，生产部门、品管部门与项目经理协同评估后动态调整计划，保障交付弹性。公司产品的部分腔体框架组装等非核心工序采用外协加工模式，公司完成设计后交由具备成熟加工能力的外协厂商进行工艺加工，经验收合格后用于产品装配；此外，公司通过劳务外包模式补充订单交付高峰期非核心工序的产能缺口。

设备制作完成后，将在客户现场完成安装工作，由公司项目执行团队统筹具备相应资质的劳务分包商，按照提供的施工图纸执行，完成设备与现场系统管路的对接，项目执行团队对安装过程实施全程管控，包括材料选备、技术交底、工序确认、安全监督、质量巡检等。此外，安装过程中及完成后，项目执行团队利用检测仪表搭配自控软件，依据实际情况开展系统性测试与调试，从工艺性能、安全管控、自动化控制、洁净度指标等多维度进行验证，确保系统运行稳定性、各项参数满足客户要求。

（四）销售方式和渠道及重要客户

公司销售模式为直销，主要通过招标邀标、协会信息、行业展会等渠道获取项目信息。公司已建立涵盖授信管理、订单审查、出货管控、账款催收及客诉处理在内的完整销售内控体系，确保销售流程规范、风险可控，切实保障项目的交付质量与履约效率。

公司通过企业合并发展、智能化生产转型及海外子公司布局，全面提升全球业务能力。公司持续深耕高纯工艺介质系统，并进一步强化在湿法制程领域的核心优势，目前已成功与中芯国际、华虹半导体、合肥晶合、长江存储、长鑫存储、住友化学等百余家国内外知名企业达成深度合作，成为泛半导体产业智能化升级与绿色制造的核心合作伙伴。

（五）行业竞争情况及公司竞争地位

1、行业竞争情况

高纯工艺介质系统于 20 世纪 70 年代在国外率先实现产业化发展，当时涌现出如 STI 株式会社等一批颇具行业影响力的知名供应商。这些企业凭借先发优势，与下游行业客户建立了深度合作关系。近年来，在政策扶持及内生需求的双重推动下，集成电路、显示面板及电子化学品等泛半导体产业链上下游行业在国内蓬

勃发展，新一批包括至纯科技、正帆科技、冠礼科技等本土供应商应运而生，凭借专业技术、性价比优势及高效服务响应，逐步成长为推动国内市场的中坚力量。

高阶湿制程工艺设备具有技术壁垒高、市场集中度高的特征，全球市场长期由日本、美国企业主导。国内厂商经过多年技术攻关，目前已形成多梯队竞争态势，部分企业在成熟制程领域已实现规模化替代，并向先进制程加速渗透。

2、公司竞争地位

公司是国内高纯工艺介质系统领域的标准制定者与核心参与者，作为该领域的早期入局者，公司长期深耕高纯工艺介质相关的技术研发，通过持续深化对各类化学品特性、制程适配要求、安全管控标准的深度理解，以自动化化学品与研磨液供应系统作为代表性产品，在该领域构筑了深厚的竞争优势，赢得了下游客户的广泛认可与信赖。根据弗若斯特沙利文统计，公司凭借全链条技术壁垒、头部晶圆厂客户的认证与深度合作以及在国产替代进程中的先发优势已成为该细分领域的行业领先企业，市场影响力持续提升。

五、发行人板块定位情况

（一）公司能够通过创新、创造、创意促进新质生产力发展

公司符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年修订）》第二、三条的规定，能够通过自身的创新、创造、创意促进新质生产力发展。公司自身的创新、创造、创意特征，以及与新技术、新产业、新业态、新模式融合情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品及变化情况”之“（九）发行人能够通过创新、创造、创意促进新质生产力发展的情况”。

（二）公司所属行业符合创业板行业领域

公司主要从事高纯工艺介质系统与高阶湿制程工艺设备的研发、设计、生产与销售。根据《国民经济行业分类 GB/T4754-2017》，公司所处行业为“C35 专用设备制造业”中“C3562 半导体器件专用设备制造”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“1 新一代信息技术产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

公司所属行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市或禁止类行业，也不属于禁止产能过剩行业、《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业，以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业。公司不存在主要依赖国家限制产业开展业务的情形。

（三）公司符合创业板定位相关指标

根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第四条规定，公司符合创业板定位相关指标二的要求，具体如下：

创业板定位相关指标二	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元	√是 □否	最近三年（2023 年度至 2025 年度），公司累计研发投入为 14,791.27 万元，超过 5,000 万元。
最近三年营业收入复合增长率不低于 25%，最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。	√是 □否	公司最近一年（2025 年度）营业收入为 133,030.71 万元，可不适用该指标关于营业收入复合增长率要求。

（四）公司主营业务具备成长性

1、公司业务规模及盈利能力稳定提升

报告期内，主营业务收入分别为 83,968.39 万元、126,921.76 万元及 131,776.76 万元，呈稳定增长态势。扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润由 2023 年度的 3,499.71 万元增至 2025 年度的 20,217.70 万元，复合增长率为 140.35%，报告期内业务规模及盈利能力稳定提升。

2、自动化化学品与研磨液供应系统技术优势加持助力公司业绩稳定增长

作为公司营业收入的核心贡献产品，公司的自动化化学品与研磨液供应系统以输送纯净与稳定的工艺介质为核心目标，依据不同化学特性选用不同的高洁净耐腐材料，从硬件端保障核心工艺指标的精准控制。在金属控制方面，公司该产品对金属杂质控制可达到 SEMI G5 等级；在颗粒控制方面，在 28nm 以下的先进制程中可实现颗粒≥0.02μm、＜10-20 个/mL 的控制，达到行业领先水平；在输送稳定性方面，系统搭载全自动流量监控与液气分离装置，配备带压差监测功能的安全通排风管道，全方位保障工艺安全与介质输送的稳定性连续保障生产方面，系统配备智能旁路（Bypass）功能与冗余泵组自动切换设计，可在泵组失效时自

动完成无缝切换，避免断液风险，保障下游产线连续稳定运行；在维护便捷性方面，产品采用管路与核心部件的快拆式连接设计，从而便利维护。

公司凭借长期积累的研发技术实力，形成可持续的市场竞争力，主要产品广泛应用于集成电路、显示面板及电子化学品等领域，为业绩稳健增长提供坚实支撑。

3、公司具有较强的市场竞争力

公司作为国内高纯工艺介质系统领域的先行者，凭借二十余年的深厚的技术积淀，始终引领行业技术发展，精准响应客户的差异化需求，并持续推动产品创新与迭代。

凭借对下游客户核心诉求的深刻理解，公司以高纯工艺介质系统为业务核心，成功将业务拓展至集成电路、显示面板及电子化学品等多元产业链，积累了丰富的客户资源。公司着力于维系与优质客户的合作，已覆盖多个关键下游行业的国内外头部企业，包括中芯国际、华虹半导体、合肥晶合、长江存储、长鑫存储等知名国内龙头企业，以及住友化学等具备全球影响力的国际客户。凭借可靠的产品质量与技术服务，公司多次被中芯国际等重要客户评为“优质供应商”，充分体现了客户对公司综合能力的高度认可。

根据弗若斯特沙利文统计，冠礼科技凭借全链条技术壁垒、头部晶圆厂客户的认证与深度合作以及在国产替代进程中的先发优势已跻身中国半导体液态化学品供应系统行业第一梯队，市场占有率居行业标杆地位，影响力持续提升。

4、公司所处行业的市场空间广阔

根据 SEMI 统计数据，2025 年全球半导体制造设备总销售规模达到 1,351 亿美元，同比增长 15%，创历史新高；预计 2026 年、2027 年，全球半导体设备总销售规模有望继续攀升至 1,520 亿美元和 1,660 亿美元。

晶圆厂设备领域（含晶圆加工、晶圆厂设施和掩模版设备）因 DRAM 及 HBM 投资强于预期及中国持续扩产，预计 2025 年将增长 11.0%至 1,157 亿美元，打破于 2024 年创下的 1,040 亿美元纪录；2026、2027 年预计再增 9.0%和 7.3%。后端设备领域 2025 年半导体测试设备销售额预计激增 48.1%至 112 亿美元，封装设备销售额增长 19.6%至 64 亿美元。2026、2027 年测试设备销售额预计继续增

长 12.0%和 7.1%，封装设备销售额预计增长 9.2%和 6.9%。

从产品结构来看，光刻设备、刻蚀设备、薄膜沉积设备作为晶圆制造环节的核心工艺装备，合计占全球半导体设备市场比例超过 60%，系行业内技术壁垒最高、投资规模最大的细分领域。与此同时，随着制程节点的演进，对表面洁净度、缺陷控制及掺杂精度的要求呈指数级提升，湿法清洗、量测检测、离子注入、热处理等设备的重要性持续上升，其中湿法设备成为近年来增长较快的细分领域之一，2025 年全球湿法设备市场规模同比增长超过 7%。

综上所述，公司能够通过自身的创新、创造、创意促进新质生产力发展，符合创业板所属行业和相关财务指标的要求，具备良好的成长性，符合创业板定位。

六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

项目	2025/12/31 2025 年度	2024/12/31 2024 年度	2023/12/31 2023 年度
资产总额（万元）	182,508.55	226,975.30	194,196.36
归属于母公司所有者权益（万元）	72,935.34	55,593.64	32,120.06
资产负债率（母公司）	42.11%	48.80%	53.90%
资产负债率（合并）	60.04%	75.51%	83.46%
营业收入（万元）	133,030.71	128,170.26	84,304.79
净利润（万元）	20,847.27	20,045.28	9,011.42
归属于母公司所有者的净利润（万元）	20,847.27	20,045.28	9,011.42
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	20,217.70	19,641.38	3,499.71
基本每股收益（元/股）	0.99	1.26	2.17
稀释每股收益（元/股）	0.99	1.26	2.17
加权平均净资产收益率（%）	32.44	44.65	42.98
经营活动产生的现金流量净额（万元）	6,685.62	35,934.35	3,002.32
现金分红（万元）	5,000.00	4,000.00	11,051.31
研发投入占营业收入的比例（%）	4.46	3.81	4.70

七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况

公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，发行人生产经营的内外部环境未发生重大变化，不存在影响发行条件的重大不利影响因素；公司所处的行

业产业政策未发生重大调整；公司所处行业发展趋势良好，业务模式及竞争趋势未发生重大不利变化；公司主要原材料的采购规模及价格不存在异常变动，主要产品的生产、销售规模及价格不存在异常变动；公司主要客户或供应商的构成未出现重大变化，重大合同条款及实际执行情况等方面均未发生重大不利变化；公司亦不存在对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项以及其他可能影响投资者判断的重大事项。

八、发行人选择的具体上市标准

发行人拟选取并适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第二章 2.1.2 中规定的第（一）条：最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元。

根据信永中和出具的《审计报告》（XYZH/2026SUAA1B0140），发行人 2024 年度和 2025 年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 19,641.38 万元和 20,217.70 万元，累计达到 39,859.08 万元。发行人最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元，符合上述上市标准。

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。

十、募集资金运用与未来发展规划

（一）募集资金运用

本次发行募集资金将在扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资
1	半导体高端装备产能升级与智造基地建设项目	52,995.89	52,000.00
2	高端电子化学品智能供应产线及半导体核心工艺装备研发项目	23,473.96	23,300.00
3	电子溶剂绿色再生高效系统研发项目	6,768.34	6,600.00
4	营销总部及营销网络建设项目	32,283.72	32,100.00
5	补充流动资金	36,000.00	36,000.00

合计	**151,521.91**	**150,000.00**

本次募集资金投资项目已经公司第一届董事会第三次会议和 2026 年第一次临时股东会审议通过。在募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，发行人将通过自筹资金解决。若实际募集资金超过募集资金投资项目投资额，超出部分发行人将根据中国证监会和深交所届时有效的规定履行内部审议程序后合理使用。

（二）未来发展规划

未来发展规划详情请参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”之“五、未来发展规划”。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

第三节 风险因素

投资者在评价公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。

一、与发行人相关的风险

（一）应收款项规模较大风险

参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）发行人特别提醒投资者注意的风险因素”之“3、应收款项规模较大风险”。

（二）存货跌价风险

参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）发行人特别提醒投资者注意的风险因素”之“4、存货跌价风险”。

（三）核心技术相关风险

公司掌握多项具有自有知识产权的核心技术，涵盖了公司主要产品的研发、设计及生产工艺等，是产品市场竞争力的关键依托。若因内部工作疏忽、管理不善、外界恶意窃取等情形导致公司核心技术泄露、知识产权遭受侵害，将会对公司的生产经营和技术创新造成不利影响。

稳定的研发团队是公司长期保持技术领先、市场竞争力及成长潜力的重要基础。公司将人才建设作为发展重点，优化激励机制与竞业约束条款，稳步扩充技术人员梯队，保障核心研发团队稳定。随着业务规模不断扩张，公司对高端技术人才的需求持续提升，若核心技术人员流失、高端人才引进滞后，不仅会延缓在研项目推进，还将加大核心技术泄露隐患，从而影响公司经营业绩。

（四）控股股东同业竞争风险

公司直接控股股东台湾朋亿经营高科技产业制程化学品供应系统销售与整合工程服务，属于与公司的主营业务存在相同或相似业务的情况。报告期内，公司与台湾朋亿在中国台湾以外地区存在不构成重大不利影响的同业竞争的情形。截至报告期末，双方已不存在同业竞争。除此以外，公司控股股东及其控制的其

他企业与公司不存在同业竞争的情况。台湾朋亿 2023 年和 2024 年竞争性业务产生的收入或毛利合计未超过公司主营业务收入或毛利的 30%，2025 年台湾朋亿不存在与公司产生竞争性业务的收入，其与公司的同业竞争未对公司经营产生重大不利影响。

若未来台湾朋亿在中国台湾以外市场的收入或毛利规模进一步扩大，且未能合理规划并修正其旗下经营主体的业务方向及细分市场领域，则可能构成对公司存在重大不利影响的同业竞争，进而对公司的业务发展构成一定的不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）行业需求波动与技术迭代风险

参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）发行人特别提醒投资者注意的风险因素”之“1、行业需求波动与技术迭代风险”。

（二）市场竞争加剧风险

参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）发行人特别提醒投资者注意的风险因素”之“2、市场竞争加剧风险”。

（三）原材料供应风险

公司主要产品主要应用于集成电路、显示面板等领域，对洁净度、耐腐蚀性及系统稳定性要求较高，其性能与阀门、过滤器、泵浦等专用部件密切相关，该类部件的核心技术及生产工艺长期由欧美、日本厂商掌握，短期内实现完全国产化替代的难度较大。因此，公司阀件、泵浦、管件等核心部件较大比例采用进口品牌，存在对进口原材料的依赖。

同时，报告期内公司原材料成本占主营业务成本的比例较高，原材料价格波动对公司盈利能力影响显著。若未来因国际贸易政策调整、地缘政治因素、物流管制或供应链扰动等情形，导致核心零部件采购价格大幅上涨、交付周期延长或供应稳定性下降，公司可能面临生产成本上升、项目交付延迟及毛利率承压等风险，进而对经营业绩产生不利影响。

三、其他风险

（一）汇率波动风险

报告期内，公司主营业务中外销收入分别为 5,652.57 万元、10,391.19 万元和 6,921.57 万元，占主营业务收入的比例分别为 6.73%、8.19%和 5.25%。公司外销业务主要以新加坡元和美元结算，报告期内公司汇兑收益分别为 5.69 万元、6.74 万元和-27.31 万元。未来，若境外经济环境、货币政策等发生变化，汇率波动幅度加大，可能导致公司汇兑损益波动增大，从而对经营业绩产生影响。

（二）募集资金投资项目风险

公司募集资金主要投向半导体高端装备产能升级与智造基地建设项目、高端电子化学品智能供应产线及半导体核心工艺装备研发项目、电子溶剂绿色再生高效系统研发项目、营销总部及营销网络建设项目。上述项目的实施将进一步提高公司的市场竞争力，扩大公司产能，提升经营业绩，优化公司财务结构。上述项目经过公司详细的市场调研及可行性论证并结合公司实际经营状况和技术条件而最终确定，由于在募集资金投资项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响项目的完工进度和经济效益，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

（三）所得税优惠政策变化的风险

报告期内，公司及子公司上海冠礼享受高新技术企业 15%的企业所得税税率。若公司未来期间不能通过高新技术企业评审，或者国家所得税优惠政策发生变化，公司存在无法享受所得税优惠政策的风险，公司经营业绩将受到不利影响。

（四）控股股东不当控制的风险

公司直接控股股东台湾朋亿持有公司发行前 86.59%股权，虽然公司已建立较为完善的公司治理结构及内部控制制度，但是控股股东仍能够通过所控制的表决权控制公司的重大经营决策，形成有利于控股股东但有可能损害公司及其他股东利益的决策。如果相关内部控制制度不能得到有效执行，存在公司控股股东利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。虽然公司已经建立了较为完善的内部决策及管理制度，但若控股股东通过行使表决权、管理职能等方式对公司人事任免安排、对外投资、资产处置等方面产生控制不当的行为，可能对公司及其他股东的权益产生不利影响。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	苏州冠礼科技股份有限公司
英文名称	Suzhou Winmax Technology Co., Ltd.
注册资本	21,000万元
法定代表人	梁进利
有限责任公司成立日期	2016年05月31日
整体变更为股份公司日期	2025年10月22日
住所	苏州高新区浒墅关开发区石林路189号
邮政编码	215151
联系电话	0512-88169099
联系传真	0512-88169099
互联网网址	www.winmaxtech.com
电子信箱	invest@winmaxtech.com
信息披露与投资者关系部门	董秘办
部门负责人	梁闵杰
部门联系方式	0512-88169099

二、发行人设立情况

（一）有限公司设立情况

2016 年 4 月 29 日，江苏省人民政府核发《外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2016]104604 号），同意台湾朋亿设立冠礼有限，注册资本 100.00 万美元。

2016 年 5 月 31 日，苏州市虎丘区市场监督管理局核准冠礼有限的设立登记并颁发《营业执照》。冠礼有限设立时的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	台湾朋亿	100.00	100.00
合计		**100.00**	**100.00**

（二）股份公司设立情况

信永中和以 2025 年 5 月 31 日为基准日对冠礼有限进行了审计。根据信永中和于 2025 年 8 月 30 日出具的编号为“XYZH/2025SUAA1B0224”《审计报告》，经审计的冠礼有限账面净资产为 45,134.63 万元。

中盛评估以 2025 年 5 月 31 日为基准日对冠礼有限进行了资产评估。根据中盛评估于 2025 年 9 月 5 日出具“中盛评报字【2025】第 0153 号”《资产评估报告》，冠礼有限净资产的评估值为 57,706.00 万元。

2025 年 10 月 14 日，冠礼有限全体股东订立《发起人协议》，约定共同发起设立股份有限公司。

2025 年 10 月 14 日，冠礼有限召开临时股东会，决议同意以截至 2025 年 5 月 31 日经审计的净资产账面价值 451,346,314.92 元扣除分红金额 50,000,000.00 元后剩余净资产 401,346,314.92 元折股，整体变更设立股份有限公司。折股后股份公司总股本为 210,000,000.00 股，剩余净资产 191,346,314.92 元计入资本公积，公司名称变更为“苏州冠礼科技股份有限公司”。

信永中和于 2025 年 10 月 23 日出具编号为“XYZH/2025SUAA1B0256”《验资报告》，已收到全体股东以冠礼有限扣除分红后净资产折合的股本 21,000.00 万元。

2025 年 10 月 22 日，苏州市市场监督管理局核准了本次变更登记并颁发变更后《营业执照》。

股份公司整体变更设立后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	台湾朋亿	181,846,506	86.59
2	梁进利	14,992,713	7.14
3	上海竑圣晖	3,795,110	1.81
4	简建至	3,422,450	1.63
5	上海鼎振益	2,552,891	1.22
6	苏州吉曜	1,806,078	0.86

7	苏州百吉	1,584,252	0.75
合计		**210,000,000**	**100.00**

鉴于公司在整体变更为股份公司前存在会计差错事项，公司相应调整整体变更为股份公司基准日相关资产和负债的账面价值。截至 2025 年 5 月 31 日，公司净资产由 451,346,314.92 元调整为 460,463,456.45 元，同时，冠礼有限以更正后的净资产扣除分红 50,000,000.00 元后的净资产人民币 410,463,456.45 元，按 1:0.5116 的比例折合为冠礼科技的股本 210,000,000 股，各股东按照各自在冠礼有限的出资比例持有相应数额的冠礼科技股份；以更正后的净资产扣除分红净额并折股后的余额人民币 200,463,456.45 元计入冠礼有限资本公积。

前述调整股改基准日净资产及折股方案事宜分别经第一届审计委员会第三次会议、第一届董事会第四次会议、2025 年年度股东会审议通过。公司发起人签署了《发起人协议之补充协议》，对上述调整予以确认。2026 年 5 月 14 日，信永中和出具《关于苏州冠礼科技股份有限公司前期会计差错更正事项对股改基准日净资产影响的专项鉴证报告》（XYZH/2026SUAA1B0163），对股改基准日净资产调整情况进行了专项鉴证。

2026 年 6 月 6 日，信永中和出具《苏州冠礼科技股份有限公司历次验资报告的专项复核报告》（XYZH/2026SUAA1B0170）对历次验资情况进行复核。

公司股改基准日净资产调整不影响股改后的股本总额，对发行人整体改制未产生实质影响，不影响股份公司设立的有效性，未损害公司、股东和债权人利益。

三、报告期内股本及股东变化情况

（一）报告期初股本及股东情况

报告期期初，公司为台湾朋亿全资子公司，注册资本 300.00 万美元。

（二）报告期内历次变化情况

发行人报告期内的历次股本及股东变化情况如下：

序号	时间	事件	注册资本	具体事项
1	2023年11月	增资	2,020万美元	台湾朋亿以其持有的上海冠礼股权出资，新增注册资本1,720万美元。

2	2024年3月	增资	2,332.7366万美元	（1）梁进利认缴166.5431万美元； （2）简建至认缴38.0175万美元； （3）上海竑圣晖认缴42.1571万美元； （4）上海鼎振益认缴28.3582万美元； （5）苏州吉曜认缴20.0624万美元； （6）苏州百吉认缴17.5983万美元。
3	2025年10月	整体变更设立股份公司	21,000万人民币	冠礼有限整体变更设立为股份有限公司

1、2023 年 11 月，冠礼有限报告期内第一次增资

2023 年 8 月 29 日，冠礼有限唯一股东台湾朋亿作出股东决定，公司注册资本由 300.00 万美元增加至 2,020.00 万美元，新增注册资本 1,720.00 万美元由台湾朋亿以其持有的上海冠礼股权出资。根据上海东洲资产评估有限公司于 2023 年 7 月 19 日出具的编号“东洲评报字【2023】第 1597 号”《资产评估报告》，该股权评估价值为 278,254,946.97 元。因本次交易构成同一控制下的企业合并，冠礼有限按取得上海冠礼净资产账面价值确认长期股权投资成本，其中 1,720.00 万美元计入注册资本，上海冠礼净资产账面价值与新增注册资本的差额计入资本公积。

2023 年 12 月 29 日，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“鹏盛验字[2024]00001 号”《验资报告》，对该次增资情况进行审验。

2023 年 11 月 2 日，苏州市虎丘区市场监督管理局核准了本次变更登记并颁发变更后《营业执照》。

本次增加注册资本后，冠礼有限的出资及持股比例情况如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	持股比例（%）
1	台湾朋亿	2,020.00	100.00
合计		**2,020.00**	**100.00**

2、2024 年 3 月，冠礼有限报告期内第二次增资

2024 年 3 月 4 日，冠礼有限召开股东会，决议通过公司注册资本由 2,020 万美元增加至 2,332.7366 万美元，新增注册资本 312.7366 万美元由苏州吉曜、苏州百吉、上海竑圣晖、上海鼎振益、梁进利、简建至以货币方式认缴。

2024 年 5 月 27 日，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“鹏盛验字[2024]00026 号”《验资报告》，对该次出资情况进行审验。

2024 年 3 月 13 日，苏州市虎丘区市场监督管理局核准了本次变更登记并颁发变更后《营业执照》。

本次增加注册资本后，冠礼有限的出资及持股比例情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万美元）	持股比例（%）
1	台湾朋亿	2,020.00	86.59
2	梁进利	166.54	7.14
3	上海竑圣晖	42.16	1.81
4	简建至	38.02	1.63
5	上海鼎振益	28.36	1.22
6	苏州吉曜	20.06	0.86
7	苏州百吉	17.60	0.75
合计		**2,332.74**	**100.00**

3、2025 年 10 月，整体变更设立为股份有限公司

参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、（二）股份公司设立情况”。

四、发行人设立以来涉及外商投资管理事项

发行人设立以来不涉及国有资产、集体资产事项。发行人自设立以来历次股权变动均按照相关规定取得了外商投资管理的审批文件，具体如下：

序号	时间	事件	相关批准或备案	编号
1	2016年4月	冠礼有限设立	《外商投资企业批准证书》	商外资苏府资字[2016]104604号
2	2022年11月	冠礼有限第一次增资	已通过企业登记系统以及国家企业信用信息公示系统向商务主管部门报送投资信息	不适用
3	2023年11月	冠礼有限第二次增资	已通过企业登记系统以及国家企业信用信息公示系统向商务主管部门报送投资信息	不适用
4	2024年3月	冠礼有限第三次增资	已通过企业登记系统以及国家企业信用信息公示系统向商务主管部门报送投资信息	不适用
5	2025年10月	冠礼科技设立	已通过企业登记系统以及国家企业信用信息公示系统向商务主管部门报送投资信息	不适用

注：根据 2019 年 12 月 19 日，经国家商务部、国家市场监督管理总局令第二号公布，《外商投资信息报告办法》替代《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》，并于 2020 年 1 月 1 日正式施行。

五、公司报告期内重大资产重组情况

（一）重大资产重组情况

1、台湾朋亿以上海冠礼股权对冠礼有限出资

2023 年 11 月公司自控股股东台湾朋亿收购其全资子公司上海冠礼 100%股权。交易完成后，上海冠礼成为冠礼有限的全资子公司，该项交易构成同一控制下的重大资产重组。

（1）收购上海冠礼的背景及原因

上海冠礼主要从事高纯工艺介质系统与高阶湿制程工艺设备的研发、设计、生产和销售。为了避免同业竞争、减少关联交易，同时更好地降低管理成本、发挥业务协同优势、提高规模经济效应，公司控股股东台湾朋亿以其持有的上海冠礼 100%股权作价出资认购冠礼有限增资。本次股权变动完成后，上海冠礼成为冠礼有限的全资子公司。

（2）本次收购的基本情况

①本次收购履行程序情况

2023 年 8 月 29 日，冠礼有限作出股东决定，同意注册资本由 300.00 万美元变更为 2,020.00 万美元，增加的 1,720.00 万美元由股东台湾朋亿以其持有的上海冠礼股权出资。

②本次收购的定价依据

根据上海东洲资产评估有限公司于 2023 年 7 月 19 日出具的编号“东洲评报字【2023】第 1597 号”《资产评估报告》，上海冠礼经资产评估法评估的股东全部权益价值为 278,254,946.97 元。冠礼有限与台湾朋亿协商确定台湾朋亿出资金额为 273,163,253.84 元，其中 119,092,800.00 元（折合为 1,720 万美元）计入公司注册资本。因本次交易构成同一控制下的企业合并，冠礼有限按取得上海冠礼净资产账面价值确认长期股权投资成本，上海冠礼净资产账面价值其与新增注册资本的差额计入资本公积。

③协议签署及资产交割

2023 年 8 月 29 日，台湾朋亿、冠礼有限和上海冠礼签署《重组协议》。2023 年 11 月 16 日，上海冠礼完成上述股权变更的工商变更登记。2023 年 11 月 2 日，苏州市虎丘区市场监督管理局核准了本次变更登记并颁发变更后《营业执照》。

（3）报告期内重大资产重组符合《证券期货法律适用意见第 3 号》的相关规定

上海冠礼被收购前一个会计年度资产总额、营业收入、利润总额占冠礼有限相应项目的比例如下：

单位：万元

项目	资产总额	营业收入	利润总额
上海冠礼	99,549.16	49,572.77	5,594.92
冠礼有限	32,090.25	15,115.69	879.06
占比	**310.22%**	**327.96%**	**636.47%**

注：以上财务数据已经信永中和审计，已剔除双方关联交易金额

收购前最近一个会计年度被重组方上海冠礼的营业收入占冠礼有限资产总额、营业收入、利润总额的比例均超过 100%，属于“被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 100%”的情形，发行人重组后须运行一个会计年度后方可申请发行。公司本次资产重组于 2023 年 11 月完成，申报基准日为 2025 年 12 月 31 日，距重组完成时点已运行超过一个会计年度，满足《证券期货法律适用意见第 3 号》规定的申报条件。

（4）资产重组对发行人业务和经营业绩的影响

上海冠礼的主要产品为高纯工艺介质系统与高阶湿制程工艺设备。通过完成对上海冠礼的收购，发行人将其研发、设计、生产和销售职能纳入自身体系之中，从而充分发挥规模优势，增强盈利能力，提升发行人综合竞争实力。

（5）资产重组对发行人管理层和实际控制人的影响

本次重组前后，公司直接控股股东均为台湾朋亿，间接控股股东均为台湾圣晖，未发生变化，公司无实际控制人，公司管理层没有发生重大变化。因此，本

次资产重组对公司管理层和无实际控制人的情况未产生重大影响。

2、冠礼有限收购台湾朋亿持有的新加坡冠礼股权

2023 年 11 月，公司自控股股东台湾朋亿收购新加坡冠礼。交易完成后，新加坡冠礼成为冠礼有限的全资子公司，该项股权变动构成同一控制下的重大资产重组。

（1）收购新加坡冠礼的背景及原因

新加坡冠礼主要从事境外业务的承揽与实施。为了避免同业竞争、减少关联交易并更好地降低管理成本、发挥与发行人业务协同优势、提高企业规模经济效应，冠礼有限收购了控股股东台湾朋亿持有的新加坡冠礼 100%股权。本次收购完成后，新加坡冠礼成为冠礼有限的全资子公司。

（2）本次收购的基本情况

①本次收购履行程序情况

2023 年 8 月 29 日，冠礼有限作出股东决定，同意购买控股股东台湾朋亿持有的新加坡冠礼 100%股权。

②本次收购的定价依据

根据上海东洲资产评估有限公司于 2023 年 7 月 25 日出具的评估报告，以 2023 年 4 月 30 日为评估基准日，新加坡冠礼经评估的股东全部权益价值约为 13,567,665.69 元，公司与台湾朋亿以前述评估价值为基础，确定本次出售的价格为 13,567,665.69 元。

③协议签署及资产交割

2023 年 8 月 29 日，台湾朋亿与冠礼有限签署了《股权转让协议》，约定台湾朋亿将其持有的新加坡冠礼 100%股权以评估价值 13,567,665.69 元转让给冠礼有限。2023 年 11 月 24 日，冠礼有限完成了转让价款支付。

（3）报告期内重大资产重组符合《证券期货法律适用意见第 3 号》的相关规定

新加坡冠礼被收购前一个会计年度资产总额、营业收入和利润总额占冠礼有

限相应项目的比例如下：

单位：万元

项目	资产总额	营业收入	利润总额
新加坡冠礼	2,873.51	3,322.57	716.00
冠礼有限	32,163.60	17,023.31	1,095.97
占比	**8.93%**	**19.52%**	**65.33%**

注：以上财务数据已经信永中和审计

收购前最近一个会计年度被重组方新加坡冠礼的利润总额占冠礼有限利润总额的比例为 65.33%，属于“被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 50%，但不超过 100%”的情形，根据《证券期货法律适用意见第 3 号》，保荐机构和发行人律师应按照相关法律法规对首次公开发行主体的要求，将被重组方纳入尽职调查范围并发表相关意见，同时提交会计师关于被重组方的有关文件以及与财务会计资料相关的其他文件。本次发行的有关中介机构已经按照《证券期货法律适用意见第 3 号》的规定进行了相关操作。

（4）资产重组对发行人业务和经营业绩的影响

新加坡冠礼的主营业务为境外业务的承揽与实施。出于公司业务资源整合、股权架构调整以及推进国际市场战略布局的考量，公司收购了新加坡冠礼 100%股权。通过收购新加坡冠礼，发行人将其境外业务承揽及实施的职能纳入自身体系之中，从而充分发挥规模优势，增强盈利能力，提升发行人综合竞争实力。

（5）资产重组对发行人管理层和实际控制人的影响

本次重组前后，公司直接控股股东均为台湾朋亿，间接控股股东均为台湾圣晖，未发生变化，公司无实际控制人，公司管理层没有发生重大变化。因此，本次资产重组对公司管理层和无实际控制人的情况未产生重大影响。

（二）其他资产整合情况

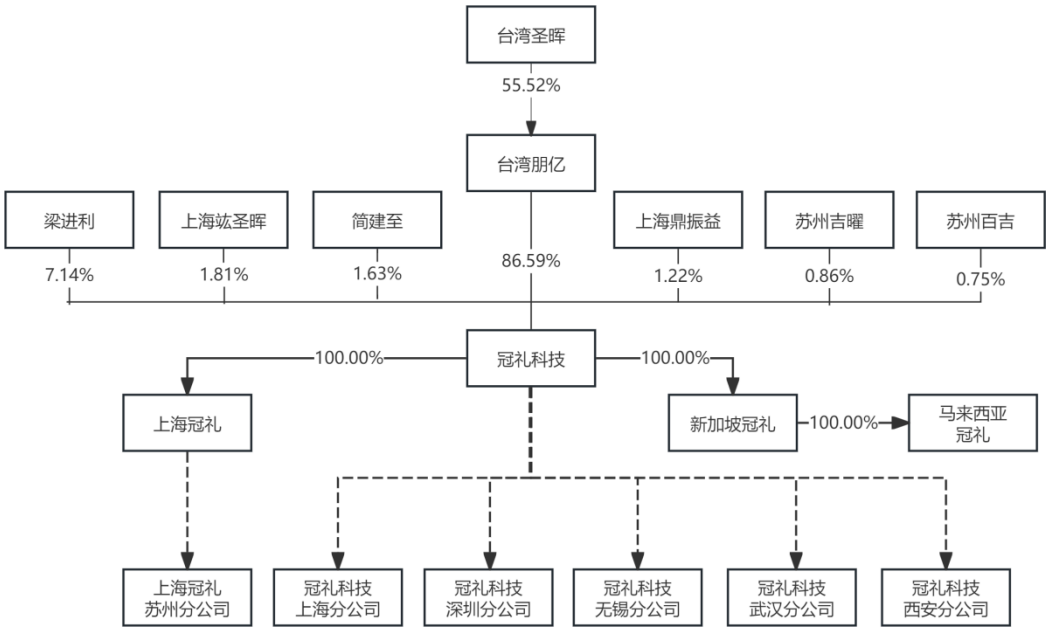
除前述事项外，公司不存在其他资产整合的情况。

六、发行人在其他证券市场的上市和挂牌情况

公司自成立至今，未在其他证券市场上市或挂牌。

七、发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下：



八、发行人子公司、分公司情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有 3 家全资子公司，分别为上海冠礼、新加坡冠礼和马来西亚冠礼；共有 6 家分公司，分别冠礼科技上海分公司、冠礼科技无锡分公司、冠礼科技深圳分公司、冠礼科技武汉分公司、冠礼科技西安分公司、上海冠礼苏州分公司；无参股公司。

公司将最近一期经审计营业收入、净利润、总资产、净资产中任一财务指标占最近一期经审计合并报表相应财务指标 10%以上，且经营业务、未来发展战略、持有资质或证照对公司具有重要影响的子公司视为重要子公司。根据上述标准综合认定重要子公司为上海冠礼，基本情况如下：

（一）重要子公司

公司全称	冠礼控制科技（上海）有限公司
成立时间	2002 年 06 月 13 日
注册资本	3,317.4255 万元人民币
实收资本	3,317.4255 万元人民币

注册地址	中国（上海）自由贸易试验区荷丹路 126 号一层			
主要生产经营地	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 34 号 10 楼			
主营业务及其在发行人业务板块中定位	负责公司主要产品的研发、设计、生产和销售			
法定代表人	梁进利			
股东构成	**序号**	**股东**	**出资额（万元）**	**出资比例**
	1	冠礼科技	3,317.4255	100.00%
主要财务数据（单位：万元）	**项目**		**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**	
	总资产		123,022.55	
	净资产		45,606.22	
	营业收入		102,101.84	
	净利润		19,503.35	
	审计情况		以上财务数据已经信永中和审计	

（二）其他子公司及分公司情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他子公司及分公司的基本情况如下：

序号	公司名称	股权结构	发行人认缴出资总额	入股时间/设立时间	主营业务
1	新加坡冠礼	冠礼科技持股 100.00%	100万新加坡元	2023年11月	负责境外业务的承揽、实施与维护
2	马来西亚冠礼	新加坡冠礼持股 100.00%	100万马来西亚林吉特	2024年11月	定位于马来西亚业务的承揽、实施，报告期内尚未实际开展业务
3	冠礼科技上海分公司	-	-	2023年3月	无实际经营业务，主要作为异地员工社保缴纳主体
4	冠礼科技无锡分公司	-	-	2023年8月	
5	冠礼科技深圳分公司	-	-	2023年8月	
6	冠礼科技武汉分公司	-	-	2023年8月	
7	冠礼科技西安分公司	-	-	2023年8月	
8	上海冠礼苏州分公司	-	-	2025年7月	

九、主要股东、实际控制人和其他持股 5%以上股份主要股东的情况

（一）控股股东和实际控制人

截至 2025 年 12 月 31 日，台湾朋亿直接持有公司 86.59%的股份，为公司直接控股股东，台湾圣晖直接持有台湾朋亿 55.52%的股份，为公司间接控股股东。

台湾圣晖为中国台湾上柜公司（5536.TWO），报告期内股权结构稳定且较为分散，任何单一股东及其关联方无法控制台湾圣晖股东会或董事会。台湾圣晖已建立了完善的现代法人治理结构，经理人主要是市场化招聘的人员，通过董事会聘任或者解聘，按照相关规则行使其职责，无法对台湾圣晖形成控制。因此，台湾圣晖无实际控制人，公司亦无实际控制人。

1、台湾朋亿

截至 2025 年 12 月 31 日，台湾朋亿持有公司 86.59%的股份，为公司直接控股股东。台湾朋亿系在中国台湾证券柜台买卖中心挂牌的上柜公司（6613.TWO），台湾朋亿持有本公司的股份不存在被质押或其他有争议的情况。

台湾朋亿的基本情况如下：

公司名称	朋亿股份有限公司			
成立时间	1997年6月13日			
注册资本	5亿新台币			
实收资本	3.8901亿新台币			
注册地址	新竹县竹北市嘉丰南路二段76号10楼之1			
主要生产经营场所	新竹县竹北市嘉丰南路二段76号10楼之1			
主营业务及其与发行人主营业务的关系	向中国台湾高科技产业客户提供化学品供应系统销售与整合工程服务			
主要股东构成	**序号**	**股东**	**持股数量（万股）**	**出资比例**
	1	台湾圣晖	4,319.64	55.52%
	2	汇丰（台湾）商业银行股份有限公司受托保管摩根士丹利国际有限公司投资专户	66.69	0.86%
	3	马蔚	61.80	0.79%
	4	梁进利	57.60	0.74%
	5	易水堂投资股份有限公司	41.60	0.53%
	小计		**4,547.32**	**58.45%**
主要财务数据（单位：新台币亿元）	**项目**		**2025年12月31日/2025年度**	
	总资产		70.22	
	净资产		53.35	
	营业收入		13.83	

	净利润	10.40
	审计情况	经中国台湾安侯建业联合会计师事务所审计

注：股东信息取自 2026 年 1 月 13 日股东名册

2、台湾圣晖

截至 2025 年 12 月 31 日，台湾圣晖持有台湾朋亿 55.52%的股份，为发行人间接控股股东。台湾圣晖系在中国台湾证券柜台买卖中心挂牌的上柜公司（5536.TWO），其基本情况如下：

公司名称	圣晖工程科技股份有限公司			
成立时间	1979年2月19日			
注册资本	7.2亿新台币			
实收资本	6.204亿新台币			
注册地址	台中市西屯区文心路二段201号19楼之1			
主要生产经营场所	台中市西屯区文心路二段201号19楼之1			
主营业务及其与发行人主营业务的关系	无尘室工程，与发行人主营业务无关			
主要股东构成	**序号**	**股东**	**持股数量（万股）**	**出资比例**
	1	翔晖开发股份有限公司	539.58	4.35%
	2	九昌投资	490.96	3.96%
	3	台北富邦商业银行股份有限公司受托保管户	465.60	3.75%
	4	梁进利	460.97	3.72%
	5	花旗托管挪威中央银行投资专户	414.62	3.34%
	小计		**2,371.73**	**19.11%**
主要财务数据（单位：新台币亿元）	**项目**		**2025年12月31日/2025年度**	
	总资产		234.60	
	净资产		131.19	
	营业收入		185.14	
	净利润		35.27	
	审计情况		经中国台湾安侯建业联合会计师事务所审计	

注：股东信息取自 2026 年 1 月 21 日股东名册

（二）控股股东、实际控制人持有股份的质押、冻结或其他争议情况

截至本招股说明书签署日，公司无实际控制人，公司控股股东直接或间接持有的发行人股份不存在质押、冻结或其他争议的情况。

（三）其他持有 5%以上股份股东

除台湾朋亿外，其他持有公司 5%以上股份股东为自然人梁进利，其基本情况具体如下：

梁进利先生，1962 年 10 月出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，台湾居民来往大陆通行证号码：0333****，EMBA 硕士学历。1985 年 5 月至 1993 年 8 月任贡山空调冷冻股份有限公司工程经理；1993 年 8 月至今历任台湾圣晖经理、副总经理、执行长兼董事长；1998 年 4 月至今任和硕工程董事长；2005 年 6 月至今任深圳圣晖董事；2007 年 11 月至今任香港 Acter 董事；2008 年 3 月至今任塞舌尔 New Point 董事；2008 年 5 月至今任圣晖国际董事；2009 年 3 月至今任台湾朋亿董事长；2009 年 6 月至 2019 年 6 月历任圣晖工程技术（苏州）有限公司董事、董事长；2009 年 11 月至今任新加坡 Acter 董事；2011 年 12 月至今任马来西亚 Acter 董事；2012 年 10 月至今任深圳鼎贸董事；2014 年 6 月至今任丰泽工程董事、执行长；2014 年 7 月至今任宝韵科技董事长；2016 年 5 月至 2023 年 5 月任冠礼有限监事；2016 年 6 月至今任新加坡冠礼董事；2016 年 10 月至 2023 年 5 月任上海冠礼监事；2018 年 9 月至今任越南圣晖董事；2018 年 4 月至今任苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 7 月至今任圣晖集成董事长；2019 年 9 月至今任泰国 Acter 董事长；2019 年 10 月至今任卫司特科技股份有限公司董事；2021 年 6 月至今任锐泽实业董事长；2023 年 5 月至 2024 年 8 月任恒吉建设股份有限公司董事长；2023 年 4 月至今任印尼合资董事；2023 年 5 月至今任上海冠礼董事长；2023 年 5 月至 2025 年 10 月任冠礼有限董事长；2024 年 11 月至今任马来西亚冠礼董事；2025 年 10 月至今任冠礼科技董事长。

十、发行人特别表决权股份或类似安排

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排。

十一、发行人协议控制架构

截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构。

十二、发行人控股股东报告期内重大违法行为

报告期内，公司控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，也不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

十三、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本结构

发行人本次发行前总股本为 21,000.00 万股，本次拟发行普通股不低于 7,000.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及老股东公开发售股份情形。本次发行前后公司股本结构如下：

序号	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
		持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	台湾朋亿	18,184.6506	86.59	18,184.6506	64.95
2	梁进利	1,499.2713	7.14	1,499.2713	5.35
3	上海竑圣晖	379.5110	1.81	379.5110	1.36
4	简建至	342.2450	1.63	342.2450	1.22
5	上海鼎振益	255.2891	1.22	255.2891	0.91
6	苏州吉曜	180.6078	0.86	180.6078	0.65
7	苏州百吉	158.4252	0.75	158.4252	0.57
本次发行流通股		-	-	7,000.00	25.00
合计		**21,000.0000**	**100.00**	**28,000.0000**	**100.00**

（二）本次发行前的前十名股东

本次发行前，公司共有 7 名股东，其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	台湾朋亿	18,184.65	86.59
2	梁进利	1,499.27	7.14
3	上海竑圣晖	379.51	1.81
4	简建至	342.25	1.63
5	上海鼎振益	255.29	1.22
6	苏州吉曜	180.61	0.86
7	苏州百吉	158.43	0.75
合计		**21,000.00**	**100.00**

（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

本次发行前，公司共有两名自然人直接持有股份，具体情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	在发行人处担任职务
1	梁进利	1,499.27	7.14	董事长
2	简建至	342.25	1.63	董事、总经理

（四）发行人股本中国有股份或外资股份情况

截至本招股说明书签署日，公司无国有股份。台湾朋亿持有发行人的18,184.6506万股为外资法人股，占本次发行前总股本的86.59%。梁进利和简建至直接持有的发行人的股份为外资自然人股，合计1,841.5163万股，占本次发行前总股本的8.77%。

（五）申报前十二个月新增股东情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在申报前十二个月新增股东。

（六）本次发行前各股东之间的关联关系、一致行动关系及关联股东各自持股比例

截至本招股说明书签署日，公司各股东之间的关联关系、一致行动关系及各自持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持有冠礼科技股数（万股）	持股比例（%）	持股方式	关系情况
1	台湾朋亿	18,184.6506	86.59	直接持股	梁进利与梁闵杰系父子关

	梁进利	1,499.2713	7.14	直接持股	系，梁进利担任台湾朋亿、台湾圣晖董事长。台湾朋亿、台湾圣晖分别系发行人直接控股股东和间接控股股东
	梁闵杰	5.0703	0.02	通过上海竑圣晖间接持股	
		3.4224	0.02	通过苏州百吉间接持股	
		2.5351	0.01	通过苏州吉曜间接持股	
2	简建至	342.2450	1.63	直接持股	二人系兄弟关系
		9.7603	0.05	通过上海鼎振益间接持股	
	简建伟	7.6054	0.04	通过苏州百吉间接持股	

发行人董事长梁进利兼任发行人间接控股股东台湾圣晖董事长兼执行长、发行人直接控股股东台湾朋亿董事长，梁进利与梁闵杰系父子关系。发行人董事、总经理简建至与员工持股平台苏州百吉合伙人简建伟系兄弟关系。本次发行前，各股东之间不存在签署一致行动人协议的情况。

除上述情况之外，发行人直接股东之间不存在其他关联关系。

（七）发行人股东公开发售股份情况

本次发行全部为公开发行新股，不涉及发行人股东公开发售股份。

十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

（一）董事会成员

公司董事会由 7 人组成，其中独立董事 3 名，除职工董事外，全部由股东会选举产生，基本情况如下：

序号	姓名	任职	任期	提名人
1	梁进利	董事长	2025年10月-2028年10月	董事会
2	简建至	董事	2025年10月-2028年10月	董事会
3	梁闵杰	董事	2025年10月-2028年10月	董事会
4	宋玉宝	职工董事	2025年10月-2028年7月	职工代表大会
5	薛伶伶	独立董事	2026年5月-2028年10月	董事会
6	雷丹丹	独立董事	2025年10月-2028年10月	董事会
7	许叶枚	独立董事	2025年10月-2028年10月	董事会

注：职工董事宋玉宝由公司 2025 年 7 月 31 日职工代表大会选任

梁进利先生，简历参见本招股说明书本节之“九、主要股东、实际控制人和其他持股 5%以上股份主要股东的情况”之“（三）其他持有 5%以上股份股东”。

简建至先生，1973 年 2 月生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 8 月至 2002 年 6 月历任台湾朋亿职员、经理；2002 年 6 月至今历任上海冠礼经理、总经理；2017 年 1 月至今任上海冠礼董事；2017 年 2 月至 2025 年 10 月任冠礼有限董事；2018 年 3 月至 2025 年 10 月任冠礼有限总经理；2025 年 10 月至今任公司董事、总经理。

梁闵杰先生，1993 年 10 月生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士学历。2019 年 8 月至 2021 年 7 月任中国台湾交通大学研究员；2021 年 8 月至 2024 年 8 月就读于美国宾州州立大学；2024 年 7 月至 2025 年 1 月任台湾朋亿董事长特别助理；2025 年 1 月至 2025 年 10 月任冠礼有限董事长特别助理；2025 年 9 月至今任新加坡冠礼董事；2025 年 10 月至今任公司董事、董事会秘书；2025 年 11 月至今任上海冠礼董事。

宋玉宝先生，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 8 月至 1999 年 7 月任中国电子系统工程第二建设公司职工；1999 年 8 月至 2009 年 8 月任上海茂华电子工程技术有限公司课长；2009 年 9 月至 2023 年 12 月任上海冠礼业务副总经理；2024 年 1 月至 2025 年 10 月任冠礼有限业务副总经理；2025 年 7 月至 2025 年 10 月任冠礼有限职工董事；2025 年 10 月至今任公司业务副总经理、职工董事。

薛伶伶先生，1986 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业会员）、税务师，具有法律职业资格。2008 年 7 月至 2011 年 2 月任东丽合成纤维（南通）有限公司生产制造部品质管理兼统计员；2011 年 3 月至 2012 年 2 月任江苏中瑞华会计师事务所有限公司审计部项目经理；2012 年 3 月至 2015 年 6 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理；2015 年 7 月至 2018 年 3 月任南京证券股份有限公司投行部高级项目经理；2018 年 3 月至 2021 年 3 月任江苏启东农村商业银行股份有限公司财务部办事员；2021 年 4 月至 2022 年 8 月任苏州信诺维医药科技股份有限公司财务部经理；2022 年 9 月至 2025 年 5 月任苏州斯普锐智能系统股份有限公司财务总监、董事会秘书；2025 年 6 月至今任江阴市赛英电子股份有限公司财务总监、董事会秘书；2025

年 9 月至今任苏州卓兆点胶股份有限公司独立董事；2026 年 5 月至今任公司独立董事。

雷丹丹女士，1986 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年 7 月至今，历任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人；2025 年 10 月至今任公司独立董事。

许叶枚女士，1970 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年 8 月至今历任苏州大学商学院讲师、副教授；2022 年 12 月至 2025 年 3 月任苏州易昇光学材料股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今任苏试试验集团股份有限公司独立董事；2025 年 10 月至今任公司独立董事。

（二）监事

公司未设立监事会，股改前公司设立一名监事，报告期末公司无监事会成员。根据《公司章程》的规定，公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员为 3 名，为许叶枚、梁进利、雷丹丹，由许叶枚担任召集人。前述董事的简历参见本节“十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员名单及任期如下：

序号	姓名	任职	任期
1	简建至	总经理	2025年10月-2028年10月
2	梁闵杰	董事会秘书	2025年10月-2028年10月
3	王駸典	财务负责人	2025年10月-2028年10月

简建至先生，简历参见本招股说明书本节之“十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。

梁闵杰先生，简历参见本招股说明书本节之“十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。

王駸典先生，1982 年 8 月生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国台湾注册会计师。2009 年 8 月至 2010 年 7 月任逢甲大学国际贸易所研究助

理；2011 年 1 月至 2014 年 1 月历任勤业众信会计师事务所审计员、组长；2014 年 2 月至 2023 年 2 月历任台湾圣晖职员、课长；2023 年 3 月至 2025 年 10 月历任冠礼有限经理、财务负责人；2025 年 10 月至今任冠礼科技财务负责人。

（四）核心技术人员

公司共有核心技术人员 4 名，具体情况如下：

序号	姓名	任职
1	简建至	董事、总经理
2	林裕哲	研发经理
3	陈祖胜	研发经理
4	黄自柯	研发经理

简建至先生，简历参见本招股说明书本节之“十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。

林裕哲先生，1977 年 1 月生，中国台湾籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 6 月至 2000 年 1 月任鸿程印刷有限公司作业员；2000 年 2 月至 2003 年 3 月任台湾朋亿设计工程师；2003 年 4 月至 2004 年 2 月任三星科技有限公司助理工程师；2004 年 3 月至 2005 年 4 月任大亿交通工业制造股份有限公司助理工程师；2005 年 5 月至 2007 年 8 月任信纮科技股份有限公司办事处主任；2007 年 9 月至 2013 年 5 月任台湾朋亿课长；2013 年 6 月至 2014 年 5 月任信纮科技股份有限公司办事处副理；2014 年 6 月至 2014 年 8 月任美吕净水技术（上海）有限公司销售设计岗；2014 年 8 月至今任上海冠礼研发经理。

陈祖胜先生，1981 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 3 月任河南思维自动化设备有限公司职员；2005 年 4 月至今任上海冠礼研发经理。

黄自柯先生，1983 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年 7 月至 2006 年 3 月任上海航天设备制造总厂数控程序员；2006 年 4 月至 2007 年 7 月任上海涂装工程有限公司技术员；2007 年 7 月至 2008 年 8 月在同济大学德语系脱产学习；2008 年 8 月至 2009 年 11 月任盖勒普工程咨询（上海）有限公司项目工程师；2009 年 12 月至 2010 年 3 月待业；2010 年 4 月至 2014 年

12 月任上海冠礼工程师；2014 年 12 月至 2019 年 12 月任上海 ABB 工程有限公司机械工程师；2020 年 1 月至 2025 年 10 月任冠礼有限研发副理；2025 年 10 月至今历任冠礼科技研发副理、经理。

（五）兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下：

姓名	序号	兼职公司名称	所任职务	与公司关系
梁进利	1	台湾圣晖	执行长兼董事长	间接控股股东
	2	台湾朋亿	董事长	直接控股股东
	3	上海冠礼	董事长	发行人全资子公司
	4	新加坡冠礼	董事	发行人全资子公司
	5	马来西亚冠礼	董事	发行人全资子公司
	6	深圳圣晖	董事	台湾圣晖控制的其他公司
	7	和硕工程	董事长	台湾圣晖控制的其他公司
	8	香港Acter	董事	台湾圣晖控制的其他公司
	9	塞舌尔New Point	董事	台湾圣晖控制的其他公司
	10	圣晖国际	董事	台湾圣晖控制的其他公司
	11	新加坡Acter	董事	台湾圣晖控制的其他公司
	12	马来西亚Acter	董事	台湾圣晖控制的其他公司
	13	深圳鼎贸	董事	台湾圣晖控制的其他公司
	14	丰泽工程	董事、执行长	台湾圣晖控制的其他公司
	15	宝韵科技	董事长	台湾朋亿控制的其他公司
	16	苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	圣晖集成员工持股平台
	17	越南圣晖	董事	台湾圣晖控制的其他公司
	18	圣晖集成	董事长	台湾圣晖控制的其他公司
	19	泰国Acter	董事	台湾圣晖控制的其他公司
	20	卫司特科技股份有限公司	董事	梁进利担任董事的企业
	21	锐泽实业	董事长	台湾朋亿持有41.47%股份的企业
	22	印尼合资	董事	台湾圣晖控制的其他公司

梁闵杰	1	上海冠礼	董事	发行人全资子公司
	2	新加坡冠礼	董事	发行人全资子公司
宋玉宝	1	上海竑圣晖	执行事务合伙人	发行人员工持股平台
薛伶伶	1	江阴市赛英电子股份有限公司	财务总监、董事会秘书	独立董事的任职单位
	2	苏州卓兆点胶股份有限公司	独立董事	独立董事担任独立董事的企业
雷丹丹	1	国浩律师（上海）事务所	合伙人	独立董事担任合伙人的企业
许叶枚	1	苏州大学商学院	副教授	独立董事的任职单位
	2	苏试试验集团股份有限公司	独立董事	独立董事担任独立董事的企业
王骏典	1	苏州吉曜	执行事务合伙人	发行人员工持股平台

（六）董事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司现任董事、高级管理人员及其他核心技术人员之间存在的亲属关系如下：

序号	姓名	本公司职务	亲属关系
1	梁进利	董事长	梁进利与梁闵杰系父子关系
2	梁闵杰	董事、董事会秘书	

除此之外，公司现任董事、高级管理人员及其他核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

（七）合规情况

公司董事、高级管理人员及核心技术人员最近三年不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

十五、发行人与董事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况

公司与在公司任职并领薪的董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心技术人员均签订了《劳动合同》《保密及竞业限制协议》，与独立董事签订了《独立董事聘任协议》。截至本招股说明书签署日，上述有关合同和协议履行正常，

不存在违约情形。

十六、公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

（一）持股情况

截至 2026 年 1 月 21 日，公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属（配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶）持有发行人股份的情况如下：

1、直接持股情况

单位：万股

序号	股东名称	职务/身份	直接持股数量	持股比例（%）
1	梁进利	董事长	1,499.27	7.14
2	简建至	董事、总经理	342.25	1.63

2、间接持股情况

单位：万股

姓名	身份	持股主体	间接持有发行人股份	
			数量	比例
梁进利	董事长	台湾朋亿	134.62	0.64%
		台湾圣晖	375.09	1.79%
		九昌投资	24.01	0.11%
王逸华	梁进利配偶	台湾朋亿	1.16	0.01%
		台湾圣晖	19.92	0.09%
		九昌投资	24.01	0.11%
梁钧帏	梁进利子女	台湾朋亿	13.05	0.06%
		台湾圣晖	31.90	0.15%
		九昌投资	144.08	0.69%
梁乔茵	梁进利子女	台湾朋亿	10.48	0.05%
		台湾圣晖	20.68	0.10%
		九昌投资	144.08	0.69%
梁闵杰	梁进利子女	台湾朋亿	12.04	0.06%
		台湾圣晖	28.10	0.13%

		九昌投资	144.08	0.69%
		上海竑圣晖	5.07	0.02%
		苏州吉曜	2.54	0.01%
		苏州百吉	3.42	0.02%
简建至	董事、总经理	上海鼎振益	9.76	0.05%
		台湾圣晖	0.49	0.01%
		台湾朋亿	14.25	0.07%
宋玉宝	职工董事	上海竑圣晖	88.73	0.42%
王駿典	财务负责人	苏州吉曜	67.92	0.32%
		台湾朋亿	1.17	0.01%
林裕哲	核心技术人员	苏州百吉	6.97	0.03%
陈祖胜	核心技术人员	上海竑圣晖	10.77	0.05%

（二）所持股份质押或冻结情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有的公司股份不存在质押或冻结情况。

十七、最近三年董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况

（一）董事变动情况

最近三年，公司董事变动情况如下：

期间	人数	董事会成员	具体情况
2023年1月-2023年5月	3	许宗政、简建至、马蔚	-
2023年5月-2023年7月	4	梁进利、许宗政、简建至、马蔚	经股东决定，公司董事会成员由3人增至4人，增设副董事长1人，由股东委派产生。委派梁进利担任公司董事及董事长，委派许宗政担任公司副董事长。
2023年7月-2025年7月	3	梁进利、许宗政、简建至	因公司经营发展需要，马蔚不再担任董事
2025年7月-2025年10月	4	梁进利、许宗政、简建至、宋玉宝	为完善公司治理结构，新增职工代表董事。
2025年10月-2026年5月	7	梁进利、简建至、梁闵杰、宋玉宝、胡亮、雷丹丹、许叶枚	整体变更为股份公司，为优化管理层架构，健全公司治理体系，新增梁闵杰为董事，新增胡亮、雷丹丹、许叶枚为公司独立董事。

2026年5月至今	7	梁进利、简建至、梁闵杰、宋玉宝、薛伶伶、雷丹丹、许叶枚	胡亮因个人原因辞任，补选薛伶伶为独立董事

（二）监事变动情况

冠礼有限未设立监事会，仅设置一名监事，符合《公司法》关于有限责任公司治理结构的相关规定。

报告期内，公司曾任监事变动情况如下：

期间	人数	曾任监事	具体情况
2023年1月-2023年5月	1	梁进利	仅设置一名监事
2023年5月-2025年10月	1	赵晗	梁进利改任董事会成员，监事变更
2025年10月后	-	-	整体变更为股份公司，根据最新法律法规，未设置监事会

2025 年 10 月 22 日，公司完成股改，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件规定，股份公司未设立监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。

（三）高级管理人员变动情况

最近三年，公司高级管理人员变动情况如下：

期间	人数	高级管理人员	具体情况
2023年1月-2023年3月	1	简建至	-
2023年3月-2025年10月	2	简建至、王骏典	完善公司治理结构
2025年10月至今	3	简建至、王骏典、梁闵杰	整体变更为股份公司，为优化管理层架构，健全公司治理体系，聘任梁闵杰为公司董事会秘书

（四）核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生过变动，具体情况如下：

期间	人数	核心技术人员	具体情况
2023年1月至今	4	简建至、林裕哲、陈祖胜、黄自柯	报告期内未发生变动

综上所述，最近三年公司董事、监事、高级管理人员变动的原因主要包括：个人原因辞任、完善治理结构及满足业务发展需求。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的选举或聘任符合相关法律法规的要求，未构成重大不利变

化，未对公司经营造成重大不利影响。

十八、董事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况

截至 2025 年 12 月 31 日，除直接或间接持有公司股份外，公司董事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况如下：

姓名	序号	投资公司名称	出资金额（万元）/持有股数（万股）	持股比例（%）
梁进利	1	台湾圣晖	460.97	3.72
	2	台湾朋亿	57.60	0.74
	3	苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	665.94	53.17
	4	九昌投资	2.50	5.00
	5	锐泽实业	6.20	0.18
梁闵杰	1	九昌投资	15.00	30.00
薛伶伶	1	江阴市赛英投资管理企业（有限合伙）	18.00	1.50
	2	苏州俊码荣华投资咨询合伙企业（有限合伙）	2.23	1.14

注：上述对外投资不包含通过二级市场购买上市公司股票

台湾朋亿、台湾圣晖为中国台湾证券柜台买卖中心挂牌的上柜公司，股票可通过二级市场交易买卖。公司部分董事、高级管理人员存在持有台湾圣晖、台湾朋亿公司股票的情况，穿透后间接持有发行人股份情况参见本节“十六、公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况”。

除上述情况外，公司董事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他与发行人及其业务相关的对外投资，上述对外投资与发行人不存在利益冲突情况。

十九、董事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

（一）薪酬组成及确定依据

参与公司具体经营事务的董事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬系根据其工作经历、任职情况、对公司贡献程度等由基本工资和奖金等构成。包括基本薪资、职务工资、住房津贴等组成。

公司向独立董事提供津贴，津贴标准系结合公司所处地区及经营情况、同行业公司薪酬水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用确定。

（二）履行的程序

公司董事的薪酬方案由股东会审议批准，高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，核心技术人员的薪酬方案由经营管理层按照《公司章程》等治理制度根据实际情况进行确定。

（三）薪酬占利润总额的比例

2023 年度至 2025 年度，公司董事、历史监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额占公司当年合并报表利润总额的比例如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
薪酬总额	890.42	849.33	637.46
利润总额	23,822.74	23,346.41	10,051.68
占比	3.74%	3.64%	6.34%

注：相关董事、历史监事、高级管理人员、核心技术人员就任、离任当月的相关薪酬/津贴计入统计范围

（四）最近一年从发行人及其关联企业领取薪酬的情况

2025 年，公司董事、历史监事、高级管理人员及核心技术人员从发行人及其控股子公司领取薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	薪酬（万元）
1	梁进利	董事长	103.38
2	简建至	董事、总经理、核心技术人员	198.80
3	梁闵杰	董事、董事会秘书	92.13
4	宋玉宝	职工董事	103.55
5	胡亮	历史独立董事（2026年5月离任）	1.84
6	雷丹丹	独立董事	1.89
7	许叶枚	独立董事	1.84
8	王駸典	财务负责人	70.28
9	林裕哲	研发经理、核心技术人员	66.45
10	陈祖胜	研发经理、核心技术人员	69.00
11	黄自柯	研发经理、核心技术人员	63.31

12	许宗政	历史董事（2025年10月离任）	69.54
13	赵晗	历史监事（2025年10月离任）	48.40

注：此处薪酬计算时除考虑相关董事、历史监事、高级管理人员、核心技术人员就职期间领取薪酬/津贴外，亦将就任/卸任相关职务当月薪酬计入。

报告期内除上述薪酬外，公司董事、历史监事、高级管理人员及核心技术人员未享受其他待遇。

梁进利除在公司领薪外，基于其担任关联方董事长、执行长、董事等身份，自台湾圣晖、台湾朋亿等关联方领薪。除上述情况外，报告期内公司其他董事、历史监事、高级管理人员在公司任职期间未在公司关联企业处领取薪酬。

二十、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排

截至本招股说明书签署日，公司未设置期权激励计划。2023 年底，为调动公司治理层和核心员工的积极性，提升公司凝聚力，公司向梁进利、简建至两名自然人进行了股权激励，并通过上海竑圣晖、上海鼎振益、苏州吉曜、苏州百吉四个员工持股平台制定并实施了员工股权激励计划。

（一）股权激励基本情况

1、股权激励对象

本激励计划的激励对象根据《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，结合公司实际情况确定，职务层面为公司及控股子公司的在册人员，包括高级管理人员、核心技术人员及做出突出贡献的人员等，以及经公司董事会批准的其他人员；除公司董事外，其他激励对象原则上与公司或控股子公司建立劳动关系。

2、股权激励方式

被激励对象中，梁进利通过直接持股方式参与股权激励，简建至除直接持股外，另通过持股平台上海鼎振益间接持股参与股权激励，其余员工通过上海竑圣晖、上海鼎振益、苏州吉曜、苏州百吉四个员工持股平台间接持股，四个持股平台的情况如下：

（1）上海竑圣晖

上海竑圣晖系发行人员工持股平台，基本情况如下：

公司名称	上海竑圣晖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2023年10月30日
注册资本	838.32万元人民币
实收资本	838.32万元人民币
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号（上海泰和经济发展区）
主要生产经营场所	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号（上海泰和经济发展区）
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务为股权投资管理，系发行人员工持股平台
执行事务合伙人	宋玉宝

上海竑圣晖的出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	任职公司	任职部门
1	宋玉宝	196.00	23.38	冠礼科技	绿能环保事业群
2	黄丙军	56.00	6.68	上海冠礼	科技产品事业群
3	蒋陈峰	42.00	5.01	冠礼科技	科技产品事业群
4	王志勇	35.56	4.24	冠礼科技	制造中心
5	李芳	28.00	3.34	冠礼科技	董秘办
6	宋传生	23.80	2.84	上海冠礼	专案处
7	陈祖胜	23.80	2.84	上海冠礼	技术研发中心
8	汪业成	19.60	2.34	上海冠礼	专案处
9	张燕辉	19.60	2.34	冠礼科技	总经理室
10	刘庆军	18.20	2.17	冠礼科技	制造中心
11	陈辉军	18.20	2.17	上海冠礼	绿能环保事业群
12	陆建国	18.20	2.17	冠礼科技	制造中心
13	李辉领	16.80	2.00	冠礼科技	科技产品事业群
14	董浩	16.80	2.00	冠礼科技	工艺设备事业群
15	胡国栋	16.80	2.00	上海冠礼	专案处
16	纪宝玉	15.40	1.84	冠礼科技	制造中心

17	李洁	15.40	1.84	上海冠礼	科技产品事业群
18	吴玉明	14.70	1.75	上海冠礼	技术研发中心
19	汤海银	14.70	1.75	上海冠礼	技术研发中心
20	孙晓明	14.00	1.67	冠礼科技	采购处
21	单荣	14.00	1.67	冠礼科技	全面品质管理处
22	周结兵	14.00	1.67	冠礼科技	制造中心
23	燕永	14.00	1.67	上海冠礼	技术研发中心
24	张久华	14.00	1.67	上海冠礼	绿能环保事业群
25	薛贝贝	12.60	1.50	上海冠礼	技术研发中心
26	蒋平永	11.76	1.40	上海冠礼	科技产品事业群
27	梁闵杰	11.20	1.34	冠礼科技	董秘办
28	赵龙山	11.20	1.34	上海冠礼	技术研发中心
29	陈传章	11.20	1.34	冠礼科技	制造中心
30	喻泽喜	8.40	1.00	上海冠礼	技术研发中心
31	马瑞晟	8.40	1.00	上海冠礼	支援中心
32	孙晓琦	7.56	0.90	上海冠礼	技术研发中心
33	温秀富	7.56	0.90	上海冠礼	技术研发中心
34	叶东	7.28	0.87	上海冠礼	科技产品事业群
35	王文建	7.00	0.84	冠礼科技	制造中心
36	张善旺	7.00	0.84	冠礼科技	制造中心
37	张应树	6.16	0.73	冠礼科技	制造中心
38	王启军	6.16	0.73	冠礼科技	制造中心
39	邵艳荣	6.16	0.73	上海冠礼	技术研发中心
40	方银华	6.16	0.73	冠礼科技	制造中心
41	张应柱	6.16	0.73	冠礼科技	制造中心
42	陶星	5.60	0.67	上海冠礼	科技产品事业群
43	卓小华	5.60	0.67	冠礼科技	制造中心
44	韦小民	5.60	0.67	冠礼科技	制造中心
合计		**838.32**	**100.00**	/	/

（2）上海鼎振益

上海鼎振益系发行人员工持股平台，基本情况如下：

公司名称	上海鼎振益企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2023年10月30日
注册资本	563.92万元人民币
实收资本	563.92万元人民币
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号（上海泰和经济发展区）
主要生产经营场所	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号（上海泰和经济发展区）
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务为股权投资管理，系发行人员工持股平台
执行事务合伙人	赵晗

上海鼎振益的出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	任职公司	任职部门
1	李桂江	56.00	9.93	上海冠礼	绿能环保事业群
2	张久华	42.00	7.45	上海冠礼	绿能环保事业群
3	赵晗	25.20	4.47	冠礼科技	技术研发中心
4	顾吉亚	25.20	4.47	冠礼科技	科技产品事业群
5	杜连梅	22.40	3.97	上海冠礼	科技产品事业群
6	简建至	21.56	3.82	冠礼科技	总经理室
7	余为超	21.00	3.72	上海冠礼	绿能环保事业群
8	陈昌喜	21.00	3.72	冠礼科技	制造中心
9	王松涛	21.00	3.72	上海冠礼	绿能环保事业群
10	周磊	18.20	3.23	上海冠礼	绿能环保事业群
11	陶世风	16.80	2.98	冠礼科技	科技产品事业群
12	张威	16.80	2.98	冠礼科技	科技产品事业群
13	徐龙	14.00	2.48	上海冠礼	专案处
14	俞晨静	14.00	2.48	冠礼科技	支援中心
15	张仕成	14.00	2.48	上海冠礼	技术研发中心
16	何晓明	14.00	2.48	上海冠礼	支援中心

17	王振亚	11.76	2.09	上海冠礼	科技产品事业群
18	颜石	10.64	1.89	上海冠礼	技术研发中心
19	刘多凤	9.80	1.74	冠礼科技	科技产品事业群
20	聂军军	9.80	1.74	上海冠礼	技术研发中心
21	赵晓伟	9.80	1.74	上海冠礼	绿能环保事业群
22	代金宇	8.40	1.49	上海冠礼	科技产品事业群
23	周建华	8.40	1.49	冠礼科技	制造中心
24	顾静萍	7.00	1.24	上海冠礼	科技产品事业群
25	凌晨华	7.00	1.24	上海冠礼	科技产品事业群
26	贺红涛	7.00	1.24	上海冠礼	科技产品事业群
27	张雷	6.16	1.09	上海冠礼	科技产品事业群
28	王伟川	6.16	1.09	上海冠礼	绿能环保事业群
29	李国群	6.16	1.09	冠礼科技	制造中心
30	殷杨壹	6.16	1.09	冠礼科技	制造中心
31	姚辉	6.16	1.09	上海冠礼	科技产品事业群
32	王晶	6.16	1.09	上海冠礼	支援中心
33	王慧芳	5.60	0.99	上海冠礼	支援中心
34	郭忠信	5.60	0.99	冠礼科技	科技产品事业群
35	杨超伟	5.60	0.99	冠礼科技	制造中心
36	蒋虎	5.60	0.99	上海冠礼	科技产品事业群
37	周晓晶	5.60	0.99	冠礼科技	科技产品事业群
38	徐晓燕	5.60	0.99	冠礼科技	采购处
39	黄山	5.60	0.99	上海冠礼	采购处
40	董顺鑫	5.60	0.99	上海冠礼	科技产品事业群
41	马媛媛	5.60	0.99	上海冠礼	支援中心
42	智月健	4.20	0.74	冠礼科技	科技产品事业群
43	代娇艳	4.20	0.74	上海冠礼	全面品质管理处
44	邵长鸣	4.20	0.74	上海冠礼	专案处
45	曹晓林	2.80	0.50	上海冠礼	科技产品事业群

46	马雨	2.80	0.50	冠礼科技	工安环保部
47	欧瑞玲	2.80	0.50	冠礼科技	绿能环保事业群
48	赵长丰	2.80	0.50	上海冠礼	科技产品事业群
合计		**563.92**	**100.00**	/	/

（3）苏州吉曜

苏州吉曜益系发行人员工持股平台，基本情况如下：

公司名称	苏州吉曜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2024年1月15日
注册资本	398.95296万元人民币
实收资本	398.95296万元人民币
注册地址	苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心6幢
主要生产经营场所	苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心6幢
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务为股权投资管理，系发行人员工持股平台
执行事务合伙人	王駸典

苏州吉曜的出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	任职公司	任职部门
1	王駸典	150.03	37.61	冠礼科技	支援中心
2	黄宏伟	56.00	14.04	上海冠礼	绿能环保事业群
3	黄振华	28.00	7.02	冠礼科技	系统整合处
4	张台生	28.00	7.02	冠礼科技	总经理室
5	POHCHEE MENG（FU ZIMING）	19.60	4.91	新加坡冠礼	工程部
6	蔡嘉哲	12.60	3.16	冠礼科技	技术研发中心
7	高自强	11.20	2.81	冠礼科技	技术研发中心
8	陆昶纬	8.40	2.11	冠礼科技	工艺设备事业群
9	王炳耀	8.40	2.11	冠礼科技	系统整合处
10	李斯林	7.28	1.82	上海冠礼	技术研发中心
11	袁杰	6.16	1.54	上海冠礼	技术研发中心
12	刘长云	5.60	1.40	冠礼科技	制造中心

13	金伟刚	5.60	1.40	冠礼科技	科技产品事业群
14	张志华	5.60	1.40	上海冠礼	科技产品事业群
15	龚新亮	5.60	1.40	上海冠礼	技术研发中心
16	YAP YEE MUN	5.60	1.40	新加坡冠礼	财务部
17	梁闵杰	5.60	1.40	冠礼科技	董秘办
18	谢龙善	5.60	1.40	冠礼科技	科技产品事业群
19	宋有江	5.60	1.40	冠礼科技	制造中心
20	卓春华	5.60	1.40	冠礼科技	制造中心
21	赵呈龙	4.20	1.05	上海冠礼	绿能环保事业群
22	DONG BI OU	2.80	0.70	新加坡冠礼	工程部
23	周佳奇	2.80	0.70	上海冠礼	支援中心
24	孙晓琦	1.12	0.28	上海冠礼	技术研发中心
25	刘娟	1.12	0.28	冠礼科技	制造中心
26	张燕辉	0.84	0.21	冠礼科技	总经理室
合计		**398.95**	**100.00**	/	/

（4）苏州百吉

苏州百吉系发行人员工持股平台，基本情况如下：

公司名称	苏州百吉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2024年1月15日
注册资本	349.95324万元人民币
实收资本	349.95324万元人民币
注册地址	苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心6幢
主要生产经营场所	苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心6幢
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务为股权投资管理，系发行人员工持股平台
执行事务合伙人	简水村

苏州百吉的出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	任职公司	任职部门
1	简水村	136.03	38.87	上海冠礼	科技产品事业群

2	郭家宏	56.00	16.00	上海冠礼	专案处
3	江献茂	33.60	9.60	冠礼科技	工艺设备事业群
4	简建伟	16.80	4.80	上海冠礼	专案处
5	洪家发	16.80	4.80	上海冠礼	科技产品事业群
6	林裕哲	15.40	4.40	上海冠礼	技术研发中心
7	林生海	12.60	3.60	冠礼科技	技术研发中心
8	毛威	8.96	2.56	冠礼科技	制造中心
9	毛彬	8.96	2.56	冠礼科技	制造中心
10	孙伟伟	7.56	2.16	冠礼科技	技术研发中心
11	梁闵杰	7.56	2.16	冠礼科技	董秘办
12	刘娟	6.16	1.76	冠礼科技	制造中心
13	岳祥付	6.16	1.76	冠礼科技	制造中心
14	崔树棠	6.16	1.76	冠礼科技	制造中心
15	苏彦	5.60	1.60	上海冠礼	支援中心
16	邹海洋	5.60	1.60	冠礼科技	科技产品事业群
合计		**349.95**	**100.00**	**/**	**/**

3、激励股权的锁定与解除锁定安排

（1）整体锁定期

根据股权激励计划，激励对象获授激励股权的锁定期为公司完成首次公开发行股票并上市（IPO）之日起第 48 个月末，锁定期满后一次性解除锁定，全部激励对象适用相同锁定期安排。若届时法律法规、规范性文件及中国证监会指导意见对激励股份的限售另有规定或监管部门另有要求的，激励对象所持公司股份的限售应符合该等规定及要求；相关法律法规、规范性文件及指导意见发生调整的，前述锁定期限相应调整。

（2）解除锁定程序

锁定期届满之日起，持股平台普通合伙人每 6 个月向全体激励对象发出《限制性股票解除整体锁定通知书》，确认可出售的激励股权数量及出售窗口期。拟出售的激励对象应在收到通知书 10 日内书面回复，逾期未回复视为同意在该窗

口期内不要求出售。在符合解除锁定约定且不违反相关法律法规及监管要求的前提下，激励对象通过持股平台出售间接持有的公司股份，出售后持股平台在依法扣除相关税费后将收入支付给激励对象。

4、激励对象异动处理

根据《股权激励计划》等约定，激励对象异动处理的有关规定如下：

（1）一类情形

激励对象因公司业务出售、并购整合、商业模式转型导致非自身过错的职务变更/被动离职、正式退休、死亡/被宣告死亡、疾病/伤残丧失劳动能力，或经持股平台普通合伙人同意的其他个人原因不再符合激励对象资格的，已获授激励份额仍归属激励对象，且需遵守限售期相关约定；激励对象死亡的，其继承人有权按前述规定持有激励份额。

（2）二类情形

本激励计划约定的一类、三类情形之外的激励对象异动情形，按激励计划关于激励股权回购的相关约定处理。

（3）三类情形

激励对象出现严重损害公司利益的情形，按激励计划关于激励股权返还及回购的相关约定处理，公司保留追究其法律责任的权利。

（4）锁定期满后异动

整体锁定安排届满后，激励对象因前述一类、二类情形或其他变更/退出情形异动的，按本激励计划售出安排及上市公司相关减持规定执行；因三类情形或其他损害公司利益情形异动的，公司仍有权要求其返还全部激励份额及收益，并保留追究法律责任的权利。

（二）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响及上市后的行权安排

公司通过实施上述股权激励计划，建立、健全了激励机制，充分调动了核心管理人员及技术骨干的积极性，有利于增强核心人员的稳定性，提升公司的经营效率及盈利能力，促进公司的长期可持续发展。股权激励实施前后，公司控股股

东未发生变化。上述股权激励对公司的经营状况、财务状况、控制权无重大不利影响。

截至本招股说明书签署日，上述股权激励计划尚在执行中，激励份额均已授予完毕，无预留份额；公司不存在上市后的行权安排。

二十一、发行人员工及其社会保障情况

（一）员工人数及构成情况

1、员工人数和变化情况

报告期各期末，发行人及其子公司员工人数及变化情况如下：

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
人数	542	538	506

2、员工构成情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工的构成情况如下：

项目	类别	人数	占比
专业结构	项目人员	237	43.73%
	生产人员	125	23.06%
	研发人员	99	18.27%
	行政管理人员	67	12.36%
	销售人员	14	2.58%
	合计	**542**	**100.00%**
受教育程度	硕士及以上	11	2.03%
	本科	213	39.30%
	专科	178	32.84%
	专科以下	140	25.83%
	合计	**542**	**100.00%**
年龄结构	30岁及以下	204	37.64%
	31-40岁	190	35.06%
	41-50岁	105	19.37%

	51岁及以上	43	7.93%
	合计	**542**	**100.00%**

（二）社会保障制度、住房公积金制度执行情况

1、报告期内社会保险、住房公积金的缴纳情况

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》及国家和地方相关规定，与员工签订劳动合同并按规定缴纳社会保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等，具体标准依当地政府的有关规定执行。

报告期各期末，公司及其境内子公司员工缴纳社会保险及住房公积金的具体情况如下：

缴纳类别	项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
社会保险	在职员工人数	542	538	506
	其中：境外子公司员工人数	19	19	20
	境内员工人数	523	519	486
	其中：缴纳人数	521	517	483
	未缴纳人数	2	2	3
公积金	在职员工人数	542	538	506
	其中：境外子公司员工人数	19	19	20
	境内员工人数	523	519	486
	其中：缴纳人数	500	498	464
	未缴纳人数	23	21	22

报告期各期末，公司员工未全员缴纳社会保险和住房公积金的原因如下：

单位：人数

缴纳类别	原因	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
未缴纳社会保障情形	入职当月已在原单位缴纳，次月起在公司缴纳	1	-	-
	退休返聘	1	2	3
	合计	**2**	**2**	**3**
未缴纳住房	退休返聘	1	2	3

公积金情形	中国台湾籍员工	22	19	19
	合计	**23**	**21**	**22**

报告期各期末，公司社会保险缴纳比例分别为 95.45%、96.10%及 96.13%，住房公积金缴纳比例分别为 91.70%、92.57%及 92.25%，整体缴纳比例较高。未缴纳原因主要包括新员工入职当月已在原单位缴纳，次月起在公司缴纳、退休返聘员工无需缴纳、部分员工系中国台湾籍员工等。根据《关于在内地（大陆）就业的港澳台同胞享有住房公积金待遇有关问题的意见》，港澳台籍员工在大陆地区工作，员工可自愿选择是否缴存住房公积金，部分中国台湾籍员工未有在大陆地区购房计划，故未参与缴纳住房公积金。

2、发行人社保和公积金合法合规情况

根据江苏省公共信用信息中心出具的《江苏省专项公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》、信用上海出具的《专用信用报告（替代有无违法记录证明专用版）》、信用中国（陕西）出具的《陕西省法人和非法人组织公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》、信用中国（湖北武汉）出具的《法人和非法人组织公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》和信用中国（广东）出具的《无违法违规证明公共信用信息报告》，发行人及其境内子公司、分公司在报告期内均不存在因违反劳动保障、社会保险相关法律法规而受到行政处罚的情形，亦不存在因违反住房公积金相关法律法规而受到行政处罚的情形。

（三）劳务派遣情况

报告期内，发行人不存在劳务派遣的情况。

第五节 业务与技术

一、发行人主营业务、主要产品及变化情况

（一）发行人主营业务及主要产品情况

1、主营业务情况

公司专注高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备的研发、设计、生产与销售，服务于集成电路、显示面板及电子化学品等泛半导体产业，围绕产业链液态化学品全流程管理需求，提供从系统设计、生产制造、现场安装调试、验收交付到后期运维管理的一站式整体解决方案。公司高纯工艺介质系统支持各类液态化学品的纯化、分装、混配、储存、输送及回收再生，通过调节关键工艺参数对微污染物进行精密控制，保障液态化学品在生产过程中的洁净度、稳定性与安全性，实现持续可靠的供应；公司高阶湿制程工艺设备可应用于泛半导体制造中清洗、显影、刻蚀及去胶等关键工艺环节，是晶圆制造过程中不可或缺的重要装备，其洁净度控制能力与工艺稳定性直接影响产品良率与制程一致性。

作为国内高纯工艺介质系统领域的先行者，公司潜心耕耘二十余载，依托长期积累的工艺理解与系统交付经验，构建起覆盖自动化化学品与研磨液供应系统、电子级化学品纯化及分装系统、废化学品再生系统以及高阶湿制程工艺设备的产品体系，形成支撑先进制造并推动资源循环利用的业务布局。公司主要产品在各领域的应用示意图如下：



公司始终秉承自主创新、技术深耕的研发理念，历经持续攻关与实践，取得了丰硕的积累。公司是国家级专精特新重点“小巨人”企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、江苏省企业技术中心、江苏省高新区瞪羚企业，并荣获国家优质工程金奖、江苏省高阶湿制程清洗设备工程技术研究中心、“三首两新”认定技术产品企业等多项国家级及省级认证荣誉，亦是国家标准《电子工厂化学品系统工程技术规范》（GB 50781-2012）的主要参编单位。截至报告期末，公司已获得发明专利 64 项，实用新型专利 112 项、外观设计专利 18 项，并拥有计算机软件著作权 51 项，为业务拓展奠定坚实的技术基础。

公司以多学科交叉创新为驱动，以自主知识产权体系为依托，形成具备迭代能力的核心竞争优势。凭借扎实的技术积累、可靠的产品性能及完善的服务体系，公司赢得了众多优质客户的认可与信赖，已与中芯国际、华虹半导体、合肥晶合、长江存储、长鑫存储等国内行业头部企业建立起稳固的合作关系；报告期内，亦收获了深圳市新凯来技术有限公司等行业新兴企业的青睐。同时，公司积极推动全球化布局，通过新加坡、马来西亚海外子公司搭建国际运营服务网络，成功开

拓增长新空间，与住友化学等国际知名客户达成合作。未来，公司将继续聚焦技术创新与产品升级，以高品质产品供给与专业化服务保障为支撑精准匹配客户需求，把握产业发展机遇，稳步拓展市场，巩固业务基础并提升核心竞争力。

2、发行人主要产品

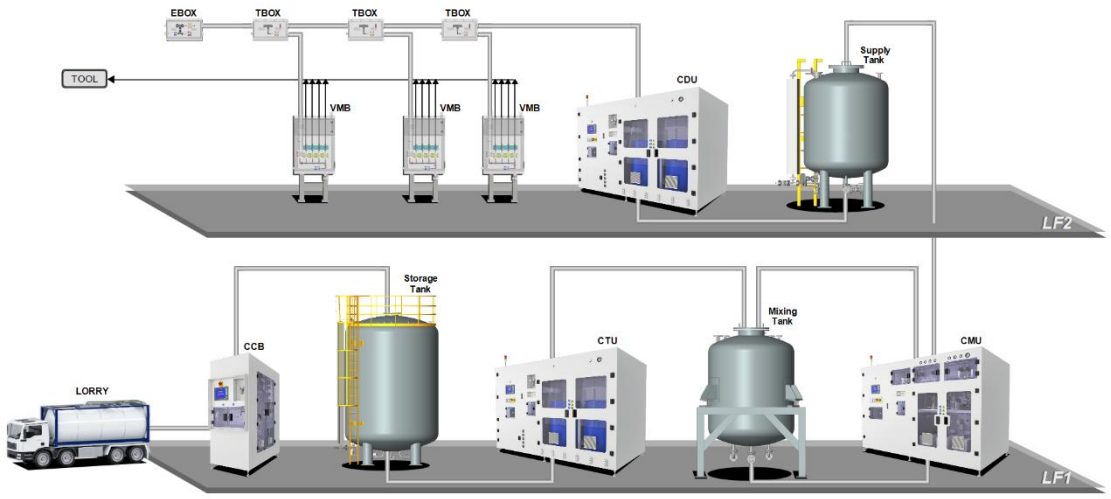
公司产品主要服务于集成电路、显示面板及电子化学品等泛半导体产业链中的关键材料领域及核心制造环节。前述行业对生产过程中的精度、洁净度、稳定性、环保性以及流程可控性均提出了较为严苛的要求。为协同客户实现器件性能、生产良率、环保合规与成本效益的平衡，公司聚焦关键环节，依托自主研发能力和丰富项目经验，提供高标准、定制化的综合解决方案，具体包括高纯工艺介质系统、高阶湿制程工艺设备两大品类，其中高纯工艺介质系统又分为自动化化学品与研磨液供应系统、电子级化学品纯化及分装系统、废化学品再生系统。

（1）高纯工艺介质系统

①自动化化学品与研磨液供应系统

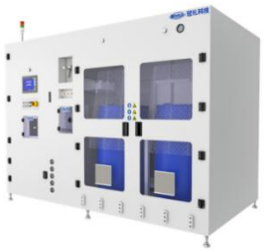
随着以集成电路为代表的泛半导体产业技术节点持续演进，各关键环节对工艺介质的纯度控制、洁净度保障及输送稳定性提出更高要求，而相关工艺介质通常具有强腐蚀性、高危险性或易挥发等特性，其质量一致性直接影响终端产品性能与良率。在此背景下，自动化化学品与研磨液供应系统成为连接储存装置与工艺设备的重要基础设施。

公司自动化化学品与研磨液供应系统主要应用于集成电路、显示面板等行业，将生产所需的酸碱性化学品、有机溶剂及研磨液等高纯工艺介质，由储存装置连续、安全、稳定地输送至各类工艺设备使用点。系统可通过智能软件对流速、流量、温度、压力、浓度等关键参数进行调节，并对微污染物进行精密控制，以满足光刻显影、芯片清洗、湿法刻蚀、薄膜沉积及化学机械抛光等环节对工艺介质纯度、洁净度与稳定性的严格要求。以自动化化学品供应系统为例，其使用场景示意图如下：



系统架构通常由介质接收与储存单元、混配或稀释模块、循环输送系统、精密过滤模块及自动化精密控制与监控系统五大功能部分组成，通过多级精密过滤与在线监控技术，可实现 ppt（万亿分之一）级杂质控制，并具备 0.02μm 级颗粒控制能力。公司自动化化学品与研磨液供应系统中各主要组成部分介绍如下：

功能类别	组成部分	图示	功能介绍
介质接收与储存单元	槽车充填设备		储有超净高纯工艺介质的槽车运送至厂区后，通过密闭、安全、快速的方式输送至厂内储罐,有效防止污染，确保纯度、洁净度与品质稳定性。
混配或稀释模块、精密过滤模块	化学品混合单元（CMU）		分为批次式与在线式两种类型，适配不同制程需求。可自动调整浓度比例，并搭配高精度浓度计进行实时监测，确保操作安全与稀释浓度的一致性。
混配或稀释模块、精密过滤模块	研磨液混合供应单元（SBDU）		依据工艺配方自动混配磨料、溶剂及氧化剂，经循环搅拌并对关键参数检测合格后，将研磨液稳定供应至 CMP 工艺设备。采用高洁净管路与阀件，结合磁悬浮泵与 PID 控制，实现压力与流量的调节，并通过多槽冗余设计与在线传感器监控，提升稳定性与容错能力。

循环输送系统、精密过滤模块	化学品传输单元（CTU）/化学品供应单元（CDU）		采用高洁净管路设计,具备优异的耐腐蚀性能。根据客户的化学品使用需求及使用点分布，提供泵送或氮气压送等输送方式，确保化学品供应的连续、安全与稳定，并严格保障其纯度、洁净度与一致性。
循环输送系统、精密过滤模块	研磨液传输单元（STU）		通过泵将研磨液持续循环并均匀搅拌后，稳定输送至下一道混合制程设备。配备氮气加湿、管路自动清洗、接头与 Dip-tube（桶内插管）清洁等防结晶功能，有效确保液体质量与运行可靠性。
循环输送系统	分流阀箱（VMB）		将主管路中的高纯化学品或研磨液分配至多个工艺设备，通过阀件实现支路控制与隔离。采用高洁净材料与模块化设计，可在不影响其他设备运行的情况下灵活扩展或维护，并在发生泄漏时快速切断对应端口，确保安全稳定运行。
自动化精密控制与监控系统	控制系统与数据监控系统		系统以 PLC（可编程逻辑控制器）为核心，实现工艺介质供应过程的自动化控制与运行逻辑管理，并通过 HMI（人机界面）提供可视化操作。各子系统 PLC 通过以太网连接至主控系统，实现信号与运行数据的集中管理。所有数据统一接入 SCADA（监控与数据采集系统），实现状态实时监控、药液用量管理及异常数据分析，提升系统自动化水平并支持预防性维护与制程优化。

在系统运行过程中，高纯工艺介质由槽车运送至厂区，通过槽车充填系统以氮气加压方式安全卸载并输送至厂内大型储罐。随后，输送泵组将高纯工艺介质经过滤模组输送至日用储罐，由混配或稀释单元进行处理，其中各类化学品通过重量或容积配比技术实现浓度的精密控制，研磨液则需经过混配及持续均质处理。经处理后，合格的高纯工艺介质再从分流阀箱稳定输送至各工艺设备。供应过程中，多级精密过滤装置用于保障介质洁净度，控制系统通过监测压力、流量等关键参数实现过程闭环控制与安全联锁，数据监控系统则负责运行数据的集中监视、状态可视化及分析支持。

公司自动化化学品与研磨液供应系统可基于不同介质特性与客户工艺需求，提供定制化解决方案，通过高精度智能控制技术，实时响应并动态匹配工艺参数要求，保障生产全程的稳定与一致。目前，公司集安全输送、精准控制与智能监

控于一体的供应系统，已规模化应用于多条 12 英寸晶圆先进制程产线，可为 28nm 以下节点的稳定量产提供可靠支撑，并为更先进节点的研发与未来量产奠定基础。

②电子级化学品纯化及分装系统

电子级化学品是泛半导体产业链中的关键基础材料之一，其“超净高纯”属性对生产流程的环境洁净度、污染控制与质量一致性提出了极致要求，直接决定了下游集成电路、显示面板等产品的制程良率、电性能与长期可靠性。因此，电子级化学品的质量管控已成为保障终端产品品质与竞争力的核心环节。

公司电子级化学品纯化及分装系统是实现基础化工原料向电子级化学品高效转化、稳定量产的核心整线装备，主要服务于电子化学品行业客户。系统搭载公司自主研发的定制化智能控制软件，能够根据客户对不同种类化学品多维度的指标需求，提供集整厂设计规划、容器超净清洗、多级在线纯化、自动化定量灌装、取样分析与数据追溯于一体的解决方案。系统包括清洗、自动充填、锁盖贴标、流水作业、倾倒测试以及码垛等环节，并可搭配实验室取样与分析仪器机柜，实现自动化生产、智能化监控管理与全流程追溯。其使用场景示意图如下：



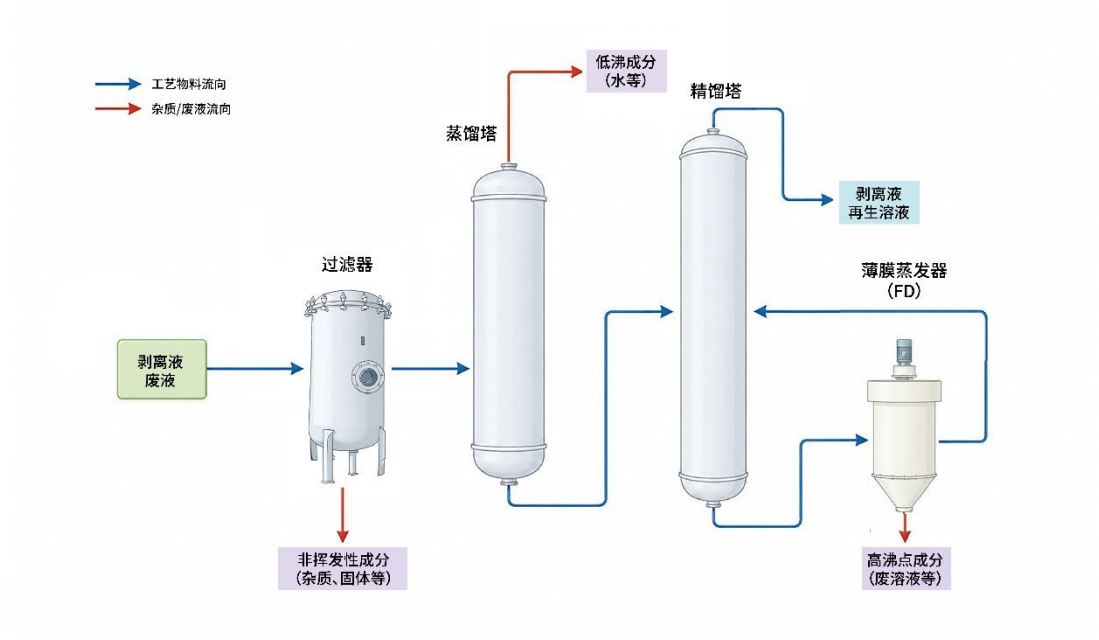
系统采用标准化、模块化、全密闭的流程设计，通过软硬件深度融合与协同控制，实现了从原料接收到成品包装的全流程洁净工艺。该系统最高可实现对亚微米级颗粒物的有效控制，并将金属杂质含量控制在 ppb（十亿分之一）乃至 ppt（万亿分之一）级别，确保最终产品不仅能够满足 SEMI G5 级的高纯度指标，更能稳定适配 12 英寸晶圆制造及 28nm 以下先进制程的苛刻要求。该系统各主

要组成部分如下表所示：

组成部分	图示	功能介绍
槽车充填设备		专为电子级化学品充填作业设计，充填区域满足 Class 100 洁净等级。通过流量计或电子秤以实现精准充填，并配置残液收集排放功能、反压取样及在线颗粒检测功能。设备中的 ACQC（自动洁净快速接头）采用公司专利技术，能够全面适配先进制程需求。
桶清洗设备	 4L&20L 桶清洗&充填设备  200L Drum 在线清洗设备	桶清洗设备分为 4L&20L 与 200L 两种适用规格，采用在线式清洗设计，有效减少人工操作，配置 FFU（风机过滤单元），满足 Class 100 洁净等级。 设备可根据客户需求灵活定制清洗数量与形式，清洗时桶体可自动倾斜调整角度，采用超纯水逆冲洗与氮气吹扫相结合，配合 360°旋转喷头及桶口螺牙清洗专利技术，实现最佳清洗效果。 设备可配置定制化的 Dip-tube（桶内插管）装置，采用半导体硅片级清洗技术，通过超声波与溢流结合的清洗工艺，实现桶内配件的同步清洗。此外，设备还配置有高浓度残酸收集与控制系统，可保障废液安全处置。
充填设备	 4L&20L 桶清洗&充填设备  200L Drum 自动充填设备  IBC/1000L 充填设备	充填设备分为 4L&20L、200L、IBC/1000L 三种适用规格，充填区域满足 Class 100 洁净等级，可依客户需求弹性配置功能模块及自动化程度，满足多元应用场景。 设备可定制充填数量（一次一桶或两桶），采用高精度全密闭电子秤，确保充填过程稳定、计量精准。充填枪与阀门均配备防呆保护，充填枪另设排气功能。支持充填前及充填后取样，并具备取样后自动补液功能，以满足品质检测需求。
实验室取样分析仪柜台设备		专为电子级化学品分析需求设计，取样区域满足 Class 100 洁净等级，可选配在线式分析仪系统，实现取样品质的快速精准监测。 设备管路采用直连设计，有效防止污染与残留；操作柜配置防晃结构，桌面采用防静电、耐腐蚀板材，可稳固承载精密分析仪器。设备还配置有清洗与配药专属工位，并可根据客户需求定制其他功能模块。

③废化学品再生系统

随着国内绿色环保意识的不断增强及相关政策要求的日趋严格，国家高度重视高端制造业规模化生产所带来的环境污染与能源损耗问题。在“双碳”目标的引领下，国家积极推动泛半导体产业加大对绿能环保工艺设备的投入，鼓励环保技术升级与创新，构建循环经济体系，以系统解决高产过程中产生的污染与资源浪费。废化学品再生系统是从线性消耗转向循环共生的重要路径，深度融合化学工程、材料科学和自动化控制技术，在创造经济价值的同时，也是先进制造业绿色与可持续发展水平的重要体现。



废化学品再生系统原理示意图-剥离液

公司废化学品再生系统专为处理泛半导体行业生产过程中持续产生的废化学品而设计，集成自动监控与精密控制模块，可根据废化学品的成分特性采用差异化再生工艺，对有效成分进行回收与提纯，使再生液品质达到原液使用标准，实现循环利用。以较为典型的剥离液为例，该强腐蚀性的碱性混合溶剂在使用过程中会混入水分、光刻胶分解产物、金属离子及高沸点杂质。公司的废化学品再生系统通过过滤、脱水、精馏、薄膜蒸发的组合工艺对其进行处理，有效成分回收率可达 90%以上，再生液纯度满足 SEMI G4/G5 级标准，有效推动泛半导体行业降低能源消耗、构建绿色制造体系。

（2）高阶湿制程工艺设备

晶圆制造涉及数百道精密工序，每道工序均可能引入颗粒、金属离子及有机残留等新污染物，若未及时清除，将在后续制程中持续累积并放大缺陷，因此，在关键工艺节点间设置多道清洗工序，是保障产品良率与可靠性的刚性需求。公司高阶湿制程工艺设备聚焦泛半导体行业清洗、显影、刻蚀、去胶四大核心湿法制程，搭载高精度混酸控制系统、多层反应腔体架构及在线光学检测模块等核心技术，可兼容硅、碳化硅、氮化镓等主流半导体材料，具备高工艺均匀性、低液体交叉污染、高药液回收率等优势，可依据不同制程节点、技术路线及产能规模，向客户提供高度定制化的湿法工艺解决方案。

目前，公司湿制程工艺设备已规模化应用于集成电路领域，并通过持续推动产品技术迭代，逐步向磷化铟、玻璃基板等新型工艺场景延伸。公司高阶湿制程工艺设备兼顾批量处理与精密控制需求，可分为单片式设备及槽式设备两大类，主要类型如下：

产品名称	单片刻蚀/清洗设备	单片高压清洗设备	槽式设备
产品图示			
产品介绍	满足 Class 10 级洁净要求； 防交叉污染多层腔体； 高回收率管路系统； 智能化自动运行与数据追溯。	满足 Class 10 级洁净要求； 防飞溅清洗腔体； 高转速低振动精密定制主轴； 可调式高压喷射控制系统； 智能化自动运行与数据追溯。	满足 Class 10 级洁净要求； 全自动载具/晶圆传输系统； 高精度流量/温度控制系统； 内置 Marangoni 干燥系统； 智能化自动运行与数据追溯； 模组化设备结构。
产品定位	专注先进封装及 12 寸大硅片相关制程，采用单腔多药液刻蚀技术，具备高均匀性、高稳定性、低药液使用量及低能耗等特点。	先进封装专用晶圆表面清洗设备，采用高耐久性高压管路系统，具备高去除率、高产出率等特点。	适用于泛半导体成熟制程及大规模生产场景，配置全自动载具循环系统及晶圆自动并批系统，兼具高可靠性、高稳定性及低能耗等特点。
工艺应用	晶圆湿法刻蚀 晶圆表面精密清洗	表面颗粒去除 助焊剂去除 有机去胶工艺	薄膜沉积前 RCA 表面清洗 薄膜材料刻蚀 SPM 清洗工艺

（二）主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
高纯工艺介质系统	123,148.90	93.45%	123,561.78	97.35%	80,085.06	95.38%
高阶湿制程工艺设备	6,808.41	5.17%	1,543.05	1.22%	2,680.93	3.19%
其他	1,819.45	1.38%	1,816.93	1.43%	1,202.39	1.43%
合计	**131,776.76**	**100.00%**	**126,921.76**	**100.00%**	**83,968.39**	**100.00%**

注：其他主要系相关设备的维保及全面质量管理协议服务。

报告期各期，公司高纯工艺介质系统收入占比分别为 95.38%、97.35%及93.45%。高纯工艺介质系统分为自动化化学品与研磨液供应系统、电子级化学品纯化及分装系统及废化学品再生系统，其中自动化化学品与研磨液供应系统为公司营业收入的核心贡献产品，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自动化化学品与研磨液供应系统	106,720.57	86.66%	102,613.84	83.05%	62,602.37	78.17%
电子级化学品纯化及分装系统	11,917.33	9.68%	18,332.95	14.84%	14,488.41	18.09%
废化学品再生系统	4,511.00	3.66%	2,614.99	2.12%	2,994.28	3.74%
合计	**123,148.90**	**100.00%**	**123,561.78**	**100.00%**	**80,085.06**	**100.00%**

（三）主要经营模式

1、研发模式

公司采取市场需求导向与前瞻性技术布局相结合的研发模式。一方面，公司紧密围绕市场需求开展技术研究，不断积累材料、工艺及系统设计等方面的核心技术，通过技术方案的持续优化，稳步提升技术成熟度与工程化应用能力，有效推动技术成果转化。另一方面，公司紧跟行业技术发展趋势，积极布局前沿技术领域，为未来业务发展储备技术能力。

公司以技术研发中心为核心，建立了标准化的研发作业流程，遵循“技术方案设计—样机或模块试制—测试验证—优化迭代”的研发流程，统筹开展新技术与新产品相关的研发项目。在研发项目管理方面，公司建立了从研发项目立项到

验收全流程管理体系，依托信息化系统对研发预算控制、物料管理及工时归集等关键环节实施精细化管控，持续提升研发管理的规范化水平与运营效率。同时，公司深化产学研协作，通过技术协同与资源互补，共同推进技术成果的产业化应用。

2、采购模式

公司采用以产定购为主、策略储备为辅的混合采购模式，以实现采购与生产、销售计划的高效协同。对于直接用于具体项目的物料，公司严格依据项目实际需求启动请购流程，按需采购、按单执行，有效控制库存风险；针对多项目间通用的标准物料，公司建立通用品库存管理机制，依据月度需求量滚动备货，并结合历史使用数据动态调整安全库存，兼顾交付弹性与库存管理效率。

公司通过 ERP 系统实现采购流程的数字化管控，覆盖请购、询比议价、订单下达、异动管理、收验及请款等关键环节。针对不同采购种类与应用场景，制定差异化采购流程与专属单别管理规范；针对指定品牌、定制加工件等特殊情形，通过成本分析、多轮议价实现成本优化。

同时，公司配套建立供应商管理、仓储管理、不合格品控制等机制，与仓储、品管、生产等部门精密协同，确保采购工作合规开展，为公司提供稳定的物料与服务支撑。

3、生产模式

公司生产模式参见本招股说明书“第二节 概览”之“四、发行人主营业务情况”之“（三）主要生产模式”。

4、销售模式

公司销售模式为直销，主要通过招标邀标、协会信息、行业展会等渠道获取项目信息。业务人员充分了解客户需求后，在工程部的协同下对施工条件、技术能力、成本结构及交付周期等因素进行综合评估；经内部核价程序并经权责主管核准后，业务部门依据项目属性通过公开招标、邀请招标或商务谈判等方式与客户订立合约，明确交易价格、付款方式、工期要求、验收条件及保固条款等核心条款；业务人员依据客户指示开立出货单，产品经检验合格后，由仓储部办理出库及货运安排。

公司已建立涵盖授信管理、订单审查、出货管控、账款催收及客诉处理在内的完整销售内控体系，确保销售流程规范、风险可控，切实保障项目的交付质量与履约效率。

5、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司经营模式是经过多年发展并在长期管理实践中逐步形成的，符合自身业务特征和行业惯例。影响公司经营模式的关键因素主要包括宏观经济环境、国家产业政策、行业发展趋势、上下游市场供需情况、公司自身产品及技术特征和业务水平等因素。报告期内，公司经营模式未发生重大变化，影响公司经营模式的关键因素未出现重大变化，在可预见的未来一定期间内公司经营模式亦不会发生重大变化。

（四）成立以来主营业务、主要产品或服务的演变情况

公司成立于 2002 年，围绕以集成电路为核心的泛半导体产业链上下游协同发展需求及化学品全生命周期，从提供介质供应系统出发，向后端延伸至回收再生以构建经济循环，向前端发展纯化分装以支撑源头纯净，并最终深入核心的湿制程设备领域，逐步构建覆盖全链条的业务体系。

1、基础奠基期（2002 年至 2005 年）

公司以自动化化学品与研磨液供应系统为核心，以上海中芯国际为起点开展全国业务，并成功承接北京、天津、成都等多地分厂项目，初步确立了在自动化化学品与研磨液供应系统领域的市场地位，为后续业务拓展奠定了坚实基础。

2、业务成长期（2006 年至 2009 年）

公司聚焦品牌建设，实现了核心设备的国内自主生产，通过了 ISO 认证及半导体行业专项认证，并持续积累专利与发明成果。同时，公司引入绿能环保概念，将业务延伸至废化学品再生系统领域，形成了供应及再生的初步闭环，显著提升了在行业内的技术影响力与品牌认可度。

3、稳定扩展期（2010 年至 2015 年）

公司被认定为高新技术企业，业务进入稳定增长阶段。在此期间，公司重点

引入湿法制程工艺设备及电子级化学品纯化与分装系统，将业务从工艺介质供应与再生，进一步完善至覆盖前、中、后端的链条。同时，公司成功进入新加坡市场，实现了从国内领先到初步国际化的跨越。

4、多元发展期（2016 年至 2020 年）

在此期间，公司实现了市场的重大突破，业务成功贯通集成电路、显示面板及电子化学品多元产业链，从单一的半导体工艺服务商，成长为覆盖泛半导体全产业链的综合解决方案提供商。这一阶段，公司主要产品在多领域得到广泛应用，形成了协同发展的业务格局。

5、智能发展期（2021 年至今）

2021 年至今，公司进入智能发展新阶段，通过企业合并发展、智能化生产转型及海外子公司布局，全面提升全球业务能力。公司在巩固高纯工艺介质系统领域领先地位的同时，进一步强化在高阶湿制程工艺设备领域的竞争力，成功与中芯国际、住友化学等百余家国内外知名企业达成深度合作，成为泛半导体产业智能化升级与绿色制造的核心合作伙伴。

（五）主要业务经营情况和核心技术产业化情况

公司自成立以来始终专注技术研发，围绕高纯工艺介质及湿法制程领域，构建了覆盖先进制程工艺适配、介质特性分析与流体仿真设计、高效自动化控制、湿法工艺高效控制、绿色化学品循环再生以及结构设计与数据安全防护在内的六大技术平台。基于上述技术平台，公司形成了多项核心技术，并已成熟应用于主要产品，实现了技术成果向商业化应用的持续转化。

报告期内，公司核心技术产品收入及占主营业务收入比例情况具体如下：

单位：万元

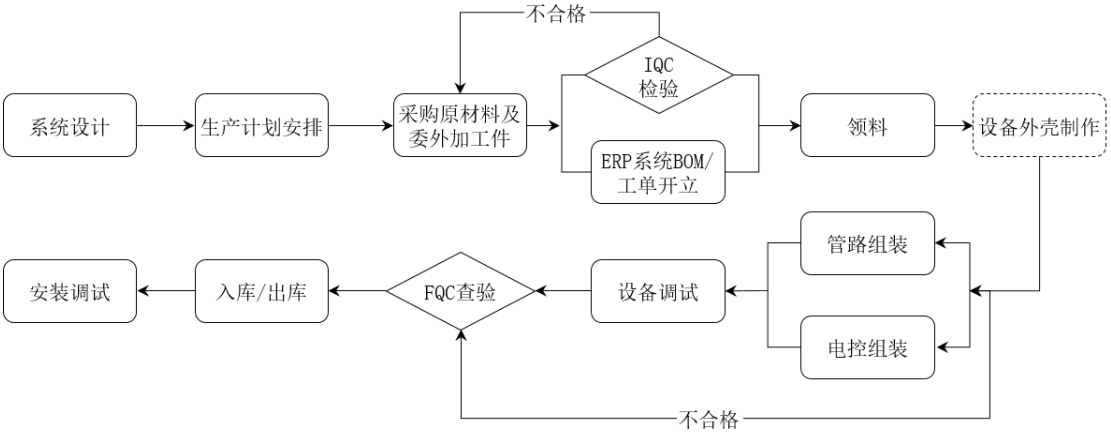
项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术产品收入	129,957.31	125,104.83	82,766.00
主营业务收入	131,776.76	126,921.76	83,968.39
占比	**98.62%**	**98.57%**	**98.57%**

报告期各期，公司核心技术产品收入占主营业务收入比例分别为 98.57%、98.57%及 98.62%，核心技术产品收入占比始终保持较高水平，公司核心技术已

实现产业化。

（六）主要产品的工艺流程图

公司主要产品为高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备，针对客户差异化需求，公司为其提供覆盖整体设计、物料采购、生产制造及安装调试的综合解决方案。在整体设计阶段，公司明确系统架构、工艺参数及设备选型；随后依据设计方案进行物料采购，通常选用符合超高纯度要求的氟塑料或高纯不锈钢，以及精密控制部件；在生产车间完成核心设备的管路及电控组装，严格执行过程检验与质量控制；设备出厂前进行功能测试与性能验证，确保关键指标满足设计要求；最终在客户现场完成安装、调试及试运行，并提供持续的技术支持与运维服务。主要工艺流程图如下：



（七）主要业务指标变动情况及原因

公司主要业务指标如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	133,030.71	128,170.26	84,304.79
净利润	20,847.27	20,045.28	9,011.42
归属于母公司所有者的净利润	20,847.27	20,045.28	9,011.42

报告期内，随着客户订单持续增加及产品结构的丰富，公司净利润快速增长，营业收入及净利润的复合增长率分别为 25.62%、52.10%。

（八）主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略情况

公司主营业务为高纯工艺介质系统与高阶湿制程工艺设备的研发、设计、生产与销售。近年来，国家相关部门已陆续出台多项泛半导体产业政策和经济发展战略，参见本招股说明书本节之“二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况”之“（二）行业主管部门、监管体制及主要法律法规政策”，公司主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略。

（九）发行人能够通过创新、创造、创意促进新质生产力发展的情况

公司长期深耕集成电路、显示面板及电子化学品等泛半导体领域，围绕液态化学品全流程管理需求，布局从前端材料纯化与分装、中端精准供应与工艺实现，到末端废液资源化再生的全链条产品体系，打造出安全可控、降本增效、绿色环保的运营生态，深度契合相关产业的发展方向。公司的创新、创造、创意特征主要体现在以下方面：

1、以技术创新为引领，构建全流程业务新生态

在泛半导体产业向更高精度与绿色制造持续演进的背景下，公司始终以技术创新作为核心驱动力，持续完善研发与工程化能力。公司已组建一支超百人的多学科研发团队，专业覆盖化学工程、机械设计、自动化控制及系统工程等领域，并在苏州、上海等地设立研发中心，形成跨学科协同的技术研发体系。

公司搭建了以平台化为基石的研发体系，重点开展三个方向的研究：一是聚焦相关产业“高纯度、高稳定、低能耗”的核心需求，持续推进材料特性、工艺机理及系统设计等关键技术研究；二是依托成熟技术平台，以市场趋势为导向，针对产线兼容性、制程升级及工艺差异化需求开展技术优化与迭代；三是基于技术平台储备，探索前沿技术方向，为未来技术发展奠定基础。

通过持续的技术积累与研发投入，公司在相关技术领域取得多项突破，并形成较为完善的知识产权体系。截至报告期末，公司已获得发明专利 64 项，实用新型专利 112 项、外观设计专利 18 项，并拥有计算机软件著作权 51 项，为公司技术发展与业务拓展提供了重要支撑。

2、以产品创新为驱动，铸就全链条发展新格局

依托二十余年行业积累与对产业发展的深入理解，公司持续推动产品创新与迭代升级。围绕液态化学品全流程管理需求，构建覆盖前、中、后端的全链条产品矩阵，将业务版图扩展至集成电路、显示面板及电子化学品等多元产业领域。

电子级化学品是泛半导体制造中不可或缺的“血液”，其在生产与流转过程中需达到“超净高纯”标准，以确保其在泛半导体产业中的工艺可靠性。凭借在电子级化学品领域的技术积淀，公司于 2012 年参与了国家标准《电子工厂化学品系统工程技术规范》（GB 50781-2012）的编制，将自身经验转化为通用标准，为电子工厂化学品系统的规范化建设提供关键技术支撑。

同时，公司也积极将行业认知转化为实践应用。公司成立初期即能够为 8 英寸晶圆厂生产线提供其所需的自动化化学品供应系统，此后数年与多家国内外知名晶圆制造企业展开合作，为其实现工艺介质的稳定供应，高效赋能从成熟制程到先进制程产业链的持续发展。2011 年，公司为国内首条自主建设的最高世代 TFT-LCD 生产线交付剥离液回收再生处理系统，该套系统通过高精度纯化再生工艺，可将废弃剥离液的资源化利用率提升至 90%以上，有效减少废液、显著优化成本结构，引领面板行业的绿色制造升级；2013 年，公司为国内首个 ppt 电子级氢氟酸生产项目交付精馏纯化与分装系统，助推国内电子级氢氟酸供给能力的提升。基于对产线工艺流程、化学介质特性与污染控制的深刻洞察，公司突破产品边界，实现了向高阶湿制程工艺设备的创新延伸。至 2020 年，公司已可实现单片式机台的量产，标志着在高阶湿制程工艺设备领域的关键突破；2025 年，公司全自动单片式晶圆蚀刻设备入选苏锡常首台（套）重大装备名单，验证了公司具备攻克先进制程关键工艺所需的技术竞争力。

截至目前，公司已与国内外众多知名厂商建立长期稳定的战略合作关系，产品深度融入多条 12 英寸晶圆代工先进制程产线，展现了公司在高端制造领域的产品适配能力与客户认可度。未来，公司将持续加大研发投入，深化与产业链上下游的协同创新，为产业高质量发展提供更有力的支撑，充分发挥资本市场对科技创新的赋能作用。

综上，公司始终以创新作为核心发展动力，构建起技术、产品、业态协同联

动的创新体系，在实现自身成长的过程中，通过推动相关行业的产业化突破与绿色低碳转型，有力促进了新质生产力的培育与发展。公司的业务契合创业板“创新驱动、服务成长型创新企业”的定位要求，具备“创新、创造、创意”与“新技术、新产业、新业态、新模式”的典型特征。

二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

公司主要从事高纯工艺介质系统与高阶湿制程工艺设备的研发、设计、生产与销售。根据《国民经济行业分类 GB/T4754-2017》，公司所处行业为“C35 专用设备制造业”中“C3562 半导体器件专用设备制造”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“1 新一代信息技术产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

（二）行业主管部门、监管体制及主要法律法规政策

1、行业主管部门、监管体制

公司所处行业的主管部门包括国家发改委、工信部和国家市场监督管理总局，行业自律组织包括中国半导体行业协会和中国电子专用设备工业协会，其主要职能如下：

部门/协会	主要职能
国家发改委	拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，汇总分析财政、金融等方面的情况等。
工信部	提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息等。
科技部	拟订中国创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施;牵头建立统一的中国科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制;拟订中国基础研究规划、政策和标准并组织实施;编制中国重大科技项目规划并监督实施;拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施等。
中国半导体行业协会	聚焦半导体行业发展，为政府提供决策支撑；开展行业数据统计分析并发布相关信息；组织行业交流及国际合作活动，助力企业市场拓展与产业国际化；为企业提供咨询服务，推进行业质量与标准化建设；组织编辑出版行业专业刊物，提供有关半导体行业政策、技术、业务、产品、市场等动态和信息等。
中国电子专用设备工业协会	认真贯彻国家各项方针政策和法律、法规，维护整个行业和会员的合法权益及经济利益，推动中国电子专用设备行业的发展。

2、行业主要法律法规

法律法规名称	施行日期	颁布部门
《中华人民共和国特种设备安全法》	2014 年 1 月 1 日	全国人大常委会
《特种设备安全监察条例》（2009）	2009 年 5 月 1 日	国务院
《中华人民共和国建筑法》（2019）	2019 年 4 月 23 日	全国人大常委会
《建设工程质量管理条例》（2019）	2019 年 4 月 23 日	国务院

3、行业主要政策

政策名称	发文时间	发文单位	相关内容
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	2026 年 3 月	第十四届全国人大四次会议	以高质量发展为主题，核心聚焦科技自立自强，将集成电路列为关键核心技术攻关首位，全链条推动产业链自主可控，统筹发展与安全，加快建设现代化产业体系，夯实实体经济根基。
《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》	2025 年 8 月	工业和信息化部、国家市场监督管理总局	聚焦关键核心技术的持续提升与产业链供应链枢纽的强化，着力推动芯片、模块等技术攻关，持续支持集成电路、先进计算、未来显示等领域科技创新，支持人工智能、先进存储、三维异构集成芯片等前沿技术方向基础研究。
《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》	2024 年 7 月	中共中央、国务院	对经济社会全面绿色转型进行系统部署，以双碳工作为引领，聚焦产业、能源、交通、城乡建设等重点领域转型，配套财税、市场化等支持政策，明确 2030 年、2035 年两阶段发展目标。
《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》	2024 年 7 月	二十届中央委员会第三次全体会议	抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。
《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》	2024 年 2 月	国务院办公厅	构建废弃物循环利用体系是实施全面节约战略、保障国家资源安全、推进碳达峰碳中和、加快发展方式绿色转型的重要举措，计划到到 2030 年，建成覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系。
《关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见》	2024 年 1 月	国家市场监督管理总局、国家发展和改革委员会、科学技术部、农业农村部、商务部	深入开展质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升行动，充分释放质量基础设施效能，实现上中下游各环节质量联动发展，点线面各层级质量协同共进，加快新能源汽车、集成电路、人工智能、量子信息等领域关键技术标准研制，推动产业变革。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	2021 年 3 月	第十三届全国人大四次会议	将集成电路列为科技前沿攻关与战略性新兴产业核心方向，明确提出重点突破集成电路设计工具、重点装备、关键材料研发，以及集成电路先进工艺和 IGBT、MEMS 等特色工艺，同时将高端芯片作为关键数字技术创新重点，全面提升产业链自主可控水平。

4、法律法规、行业政策对发行人经营资质、准入门槛、运营模式和行业竞争格局的影响

近年来，中共中央、国务院、工信部、国家发改委、市场监管总局等主管部门密集出台了一系列产业扶持政策、中长期发展规划、行业指导意见与国家标准，为半导体全产业链构建了良好的政策发展环境，有力推动了行业的高质量发展与技术突破进程。公司主要产品广泛应用于集成电路晶圆制造、先进封装等核心领域，公司将紧抓重大发展机遇，积极顺应政策导向，持续深耕主业。相关法律法规与产业政策在提升行业准入门槛、加速行业优胜劣汰的同时，有利于具备自主核心技术的业内优质企业进一步巩固并扩大竞争优势，相关政策要求对公司的经营资质、运营模式不存在重大不利影响。

（三）公司所属行业概况

1、半导体产业概况

（1）半导体与泛半导体概念定义

半导体产业是围绕芯片与电子器件研发制造形成的高新技术产业，是整个电子信息行业的核心支撑。它以硅材料为产业主流基础，同时覆盖碳化硅、氮化镓、砷化镓等化合物半导体材料体系，通过光刻、刻蚀、薄膜沉积、离子注入、清洗等核心精密工艺，生产可实现信息处理、功率控制、光电转换、信号感测等功能的各类器件。按照国际通用分类，半导体产品主要包括集成电路、分立器件、光电子器件、传感器四大类。其中集成电路是产业核心组成部分，长期占全球半导体市场规模的 80%以上，是半导体产业增长的主要驱动力。

泛半导体产业是半导体技术跨领域延伸应用形成的广义产业集群，以集成电路为核心，同时涵盖显示面板、光伏等与半导体制造技术同源、工艺共通的关联产业领域。

（2）半导体制造的严苛要求

半导体制造是指利用半导体材料，通过一系列精密的物理和化学工艺，在晶圆上制造出微型电子元件并将其集成为具备特定功能的集成电路芯片的工业过程，其核心目标是在极小的硅片上构建出包含数十亿甚至上百亿个晶体管的复杂电路，实现计算机、手机、汽车等各类电子设备的核心运算与信号处理功能。

半导体制造对纯净的严苛要求，是贯穿材料制备、介质输送、制程环境与工艺流程的准则，主要体现在纯度与洁净度两个维度，旨在避免微量杂质与颗粒污染对芯片电学性能、可靠性及制造良率造成影响，目前 7nm 及以下先进制程的控制标准已趋近原子级尺度。上述要求在各环节的主要体现如下：

①材料制备：从源头实现极致控制

半导体基础材料是半导体制造中纯度与洁净度管控的首要环节，各类材料均有分级量化标准，原料中微量杂质或颗粒都会导致芯片晶格缺陷、电路短路或性能衰减。半导体制造的核心基础材料主要包括硅片、电子气体、电子化学品、抛光材料、溅射靶材、光掩模、光刻材料和封装材料，各类别对纯度与洁净度要求与制程高度绑定。其中，与公司产品相关度较高的材料具体要求如下：

材料类别	定义与用途	具体要求
硅片	以电子级多晶硅为原料，经拉晶、切片、研磨、抛光、清洗等工序制成晶圆片，是集成电路、分立器件、光电子器件等所有半导体产品的制造基底，芯片的所有制程工艺均在硅片表面完成。	根据 GB/T 12963-2022《电子级多晶硅》标准，主要用于半导体器件制造的电子级多晶硅根据等级不同，纯度要求有所差异。其中特品级和电子 1 级的纯度需达到 9N 至 11N 级别；基体金属杂质总含量控制在≤0.1ppbw 至≤0.3ppbw，表面金属杂质总含量≤0.1ppbw 至≤0.5ppbw。
电子化学品	半导体制造用各类超净高纯化学试剂，以湿电子化学品为核心，主要包括通用型（氢氟酸、双氧水、氨水、异丙醇等）和功能型（显影液、电镀液、刻蚀液等），广泛用于湿法清洗、刻蚀、显影、去胶、剥离等工艺环节。	按照国际 SEMI 标准化组织分类，湿电子化学品按产品等级由低到高分为 G1-G5 级。其中，28nm 成熟制程通常适配 G4 级标准，而 28nm 以下先进制程则适配更高的 G5 级标准，金属杂质含量≤0.01μg/L。除对金属杂质含量、颗粒粒径及数量有着最低要求外，对纯度以及微量有机杂质、水分含量、阴离子残留等都有着严苛的要求。
抛光材料	CMP 材料主要包括抛光液和抛光垫。抛光液由纳米级研磨颗粒与功能性化学试剂复配而成，抛光垫多为聚氨酯基高分子多孔复合材料。抛光材料用于晶圆表面平坦化、层间介质抛光、金属布线抛光等工序，保障后续光刻工序的图案转移精度。	抛光液需达到电子级标准，严格控制金属离子及其他杂质含量，其颗粒平均粒径直接影响抛光速率与表面质量，常用磨料粒径通常在 50-250nm 之间，先进制程抛光液磨粒粒径已进入亚 50nm 级别。
封装材料	半导体封装环节专用材料主要包括封装基板、环氧塑封料、引线框架、键合丝、底部填充胶等。该类材料对制造完成的芯片进行封装保护、电气连接、散热传导，提升芯片的机械稳定性、环境耐受性和电性能可靠性，分为传统封装和先进封装配套材料。	要求封装基板、引线框架杂质含量极低，保证性能稳定可靠；环氧塑封料超高纯度控制，离子控制达最高到 ppb 级；键合丝（如金基键合丝）的纯度达到 99.99%（4N）及以上，具备极致的化学稳定性。

②介质输送：纯度零降级与洁净度保障

在半导体制造过程中，直接参与湿法清洗、显影、刻蚀和 CMP 等环节的工艺介质，其初始纯度与洁净度由上游材料制备环节保障，但从储存到工艺设备使用点的输送过程中，输送系统的质量控制直接决定了介质抵达制程设备时能否保

持与源头一致的品质。若输送环节出现杂质引入、介质参数波动或发生泄漏，不仅会破坏介质的高纯属性，导致工艺稳定性下降，还可能引发芯片良率大幅降低，严重时甚至会腐蚀或损坏精密制程设备。

因此，半导体制造对工艺介质输送环节的核心要求在于确保介质在抵达工艺设备时，其化学纯度、颗粒洁净度及关键物理参数均与源头保持高度一致。任何维度的偏差均可能成为制约良率提升的瓶颈，具体体现在以下方面：

维度	具体要求	对制程的影响
材料化学惰性与零析出	金属离子析出量控制 ppt 级别，阴离子、TOC（总有机碳）析出量控制在 ppt 级别，EP 不锈钢内表面粗糙度 Ra≤0.25μm，PFA 内壁光滑无缺陷。	金属离子进入介质会扩散至器件有源区，导致漏电流增加、少数载流子寿命衰减；阴离子超标易造成氧化物过度刻蚀或界面态密度增加；有机污染物影响光刻胶粘附性、改变刻蚀选择比；脱落颗粒则会成为图形缺陷或薄膜夹杂物。
密封性与零泄漏	气体密封泄漏率≤1×10⁻⁹ Pa·m³/s（氦质谱检漏法）；液体采用无死区设计、隔膜阀隔离。	外界水分、氧气、二氧化碳渗入会导致敏感介质纯度下降（水解、氧化、pH 改变）；液体泄漏可能腐蚀设备或污染环境。
颗粒与微生物洁净度	颗粒粒径控制要求在先进制程关键工序中，在线拦截粒径≥0.02μm 的颗粒；微生物含量趋近于零；避免湍流、压力波动及温度变化引发气泡析出。	颗粒会遮挡光刻图形、造成薄膜夹杂物或机械划伤；生物膜及其代谢产物增加 TOC（总有机碳），脱落菌体形成大尺寸颗粒污染；介质气泡易造成清洗残留、刻蚀速率局部不均或涂胶缺陷。
参数稳定性	在先进制程中，要求流量控制精度在±0.5%FS 以内；压力控制保持高度稳定；快速响应≤100ms。 对于温度敏感的介质如研磨液，需要将温度控制精度维持在±0.1℃以内；刻蚀液、研磨液等需要混合的介质，其混合浓度/配比保持高度精确。	流量波动导致刻蚀深度不均、CMP 速率变化；压力波动影响薄膜生长均匀性、气流冲击损伤晶圆；温度波动改变光刻胶粘度或刻蚀选择比；配比偏差导致刻蚀选择性失效或沉积膜质劣化。

③制程环境：超洁净空间的多维管控

半导体制造需在专用洁净室中完成，其洁净度等级远超医药、食品等常规行业。制程环境作为晶圆完成数百道工艺步骤的载体，任何环境参数的偏离都可能直接作用于晶圆表面，引发缺陷、性能劣化甚至整批报废。因此，制程环境对空气洁净度、温湿度、压差气流、静电、微振动及空气分子污染物等都具有严格量化标准。

以空气洁净度为例，根据国际标准化组织（ISO）发布的标准，洁净室及洁净区悬浮粒子洁净度等级由低到高分为 ISO 9 级至 1 级。光刻区、刻蚀区、薄膜沉积区等前端制造核心区域通常要求达到 ISO 3 级，即≥0.1μm 粒径的粒子浓度≤1000 个/m³；最先进晶圆制造环节的要求甚至达到 ISO 1 级，即≥0.1μm 粒径的粒子浓度≤10 个/m³。

④工艺流程：精密执行与洁净作业

半导体制造的核心在于通过数百道精密工序，在硅片上构建包含数十亿晶体管的微观电路。每一道工序都会在晶圆表面留下特定的反应产物或残留物，若未及时清除，将在后续工序中持续累积、放大缺陷，最终导致器件失效。因此，工艺流程的洁净度要求晶圆表面在每一道工序完成后，都能以洁净状态进入下一道工序，这需要通过清洗、去胶等过程工艺来实现。以先进制程为例，半导体制造中的主要工艺流程对技术与洁净度的要求如下：

工艺	污染类型	具体要求
薄膜沉积前	自然氧化层	去除硅片表面形成的薄氧化层，表面金属杂质残留控制在ppt级。
	颗粒	去除来自上一道工序或环境引入的附着颗粒，对晶圆表面≥0.02μm的颗粒数量严格控制。
光刻工序	有机残留	去除涂胶前的有机污染物，如有机碳残留控制在亚单分子层水平。
	颗粒	去除涂胶环境引入的微尘颗粒，对晶圆表面≥0.02μm的颗粒数量严格控制。
刻蚀工序	聚合物残留	去除刻蚀过程中生成的难溶性侧壁聚合物，实现纳米级残留厚度精准管控。
	金属污染物	去除刻蚀引入的金属离子（如Al、Cu、W等），金属残留低于1×10^{9} atoms/cm^{2}。
离子注入后	光刻胶残留	去除作为注入掩膜的光刻胶层，无可见残留。
	损伤层	去除注入造成的表面晶格损伤层，精准控制去除深度。
化学机械抛光后	研磨颗粒	去严格控制工艺后晶圆表面残留的二氧化硅、氧化铈等纳米级抛光磨粒颗粒的数量。
	化学试剂	去除抛光液中的氧化剂、络合剂等，试剂残留浓度控制在ppt级。
层间互联	通孔残留	去除通孔刻蚀后的底部聚合物和氧化物残留。
金属化后	金属残留	去除金属沉积后的边缘珠状物、桥连等缺陷。

2、半导体设备行业概况

（1）半导体设备的分类与定义

半导体设备是半导体制造的关键支撑，依据在应用环节的差异，通常可分为前道工艺设备（晶圆制造）、后道工艺设备（封装测试）以及厂务配套设备（支撑设施）三大类。

前道工艺设备服务于晶圆制造环节，主要包括光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗、离子注入、化学机械抛光、热处理、量测检测等品类，覆盖晶圆制造的主要工艺步骤。根据 SEMI 测算数据，光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为市场规模最大的

三类，分别约占半导体设备市场的 24%、20%和 20%；后道工艺设备聚焦封装测试环节，主要包括划片设备、贴片/键合设备、塑封设备、测试机、探针台等；厂务配套设备则是保障晶圆厂稳定运行的支撑性基础设施，主要包括超纯水系统（UPW）、化学品供应与回收系统（CDS）、特种气体供应系统、电力与动力系统（含备用电源）、洁净厂务系统（HVAC）及厂务自动化控制系统等。这类设备虽不直接参与晶圆表面的物理化学反应，但其稳定运行直接关系到晶圆制造的良率与一致性，是晶圆厂建设和生产运行不可或缺的核心设施。

从市场结构来看，前道工艺设备约占半导体设备市场的 70%-80%，后道工艺设备约占 10%-20%，厂务配套设备约占 3%-8%。从国产替代进程看，各细分赛道存在明显差异，光刻设备仍基本依赖进口；而根据中国半导体工业协会在 2026 年 1 月发布的数据显示，刻蚀设备、薄膜沉积系统等关键工具的国内替代率已超过 40%；厂务配套设备领域，国产企业已具备较强竞争力。

（2）公司产品在半导体设备行业中的定位

公司主要产品包括自动化化学品与研磨液供应系统、电子级化学品纯化及分装系统、废化学品再生系统以及高阶湿制程工艺设备，全方位覆盖液态化学品的纯化、分装、混配、存储、输送及回收再生配套场景，同时以湿制程工艺设备切入晶圆制造核心工序，实现液态化学品配套及晶圆湿加工相关领域的系统性全覆盖。

电子级化学品纯化及分装系统属于半导体上游材料制备环节的关键设备。该系统能将工业级化学品最高提纯至 SEMI G5 级标准，并通过自动化充填确保最终交付晶圆厂使用的电子化学品品质可控，从源头上保障工艺介质的纯净度；自动化化学品与研磨液供应系统和废化学品再生系统同属于厂务配套设备。供应系统通过精密管道网络与智能控制模块，将高纯化学品及研磨液等工艺介质稳定、精准地输送至工艺设备使用点，确保介质在输送过程中无二次污染、参数稳定受控；再生系统则专注于剥离液等高价值工艺介质的回收再生，通过过滤、脱水、精馏、薄膜蒸发等组合工艺使再生液达到新液标准，助力客户实现绿色制造与降本增效。高阶湿制程工艺设备属于半导体晶圆制造及先进封装领域的专用工艺设备，主要应用于分立器件、光电子器件、传感器等特色半导体产品的晶圆制造环节，同时可拓展应用于先进封装中的湿法工序。

公司产品的核心技术源于半导体制造对纯净的极致追求，同时凭借“工艺同源、设备通用、需求协同”的特征，亦能广泛应用于显示面板等泛半导体行业，深度契合泛多元化的制造需求。公司隶属于半导体设备行业，以四类产品共同服务于以集成电路为核心、涵盖显示面板及电子化学品等领域的泛半导体产业，为产业链的高效运转、稳定制造与绿色可持续发展提供关键支撑。

3、半导体液态化学品供应系统行业概况

公司核心产品为自动化化学品与研磨液供应系统，属于半导体液态化学品供应系统行业，是集成电路等泛半导体高端制造环节的关键配套设施。在半导体制造中，液态化学品的纯度与洁净度是决定芯片良率、性能与可靠性的前提，在先进制程下，化学品杂质容忍度已降至 ppt 级，微量污染便可能引发产品缺陷甚至批量报废；同时，高纯化学品也是光刻、蚀刻等关键制程精准执行的基础，是突破先进制程瓶颈的重要支撑。

液态化学品供应系统是实现化学介质安全存储、精准计量与稳定输送至工艺机台的关键设备，通过专用管路网络与智能控制模块，完成制程用液从存储区到生产设备的全流程管控。按功能结构可分为基础供应系统及复合功能系统，基础供应系统依托管路与控制单元，直接完成化学品、研磨液的常规输送供给；复合功能系统则在输送前集成稀释混配、温控、搅拌等工艺处理功能，使药液参数精准匹配制程要求，适配复杂工艺场景。按工艺介质类型，可分为化学药液供应系统与研磨液供应系统，二者技术核心各有侧重，化学药液供应系统以全流程污染防控为核心，通过高洁净耐腐蚀管路与防污染结构设计，保障化学品输送全程的纯度稳定；研磨液供应系统聚焦供液稳定性，因研磨液含二氧化硅、氧化铝等固体研磨颗粒，系统需在精准控流的同时，通过专项设计防控颗粒沉降、保障粒径均一，确保研磨液配比精准、品质稳定。

4、所属行业在产业链中的作用及上下游关联性

公司所处行业在半导体制造产业链中发挥着承上启下的关键作用，上承泵浦、阀门、过滤器、管道、传感器及仪器仪表等关键零部件，通过工程化设计与系统化整合，构建高可靠性的厂务及工艺设备体系；下接晶圆制造及先进封装等核心生产环节，将高纯化学品与研磨液等工艺介质以稳定、洁净、可控的方式输送至

各类制程设备，实现对湿法清洗、刻蚀及 CMP 等关键工艺的精准支撑。与此同时，公司湿法设备直接参与晶圆加工过程，废液回收系统对生产过程中产生的废液进行回收处理与再生利用，构建从化学品供给、工艺处理到资源回收的一体化闭环体系，有效提升制程良率与资源利用效率。产业链下游覆盖集成电路、显示面板及电子化学品等高端制造领域，其中集成电路为最核心应用方向。随着先进制程持续演进及国产替代需求加速释放，公司产品在保障产线稳定运行与提升良率方面的重要性持续提升，具备良好的成长性与市场空间，助力国内集成电路产业链自主可控与高质量发展。

（四）公司所属行业发展态势

半导体产业作为数字经济发展的核心基础，是高端制造、人工智能及新能源汽车等战略性新兴产业实现技术突破的重要支撑。在全球数字化转型加速、人工智能规模化应用及产业链重构持续推进的背景下，全球半导体产业逐步走出周期波动，进入以技术升级与结构优化为特征的新一轮高质量发展阶段；中国凭借庞大的终端市场需求、持续的产业政策支持及本土企业技术能力的不断提升，已成为全球半导体产业增长的重要引擎。

在此背景下，半导体设备及配套系统作为晶圆制造的关键基础设施，市场需求随先进制程推进与产能扩张持续增长。本土设备企业加速实现由“跟跑”向“并跑”甚至“局部领先”的转变，国产替代进程不断深化。同时，上游电子化学品及关键材料国产化进入关键阶段，下游集成电路、显示面板等领域对高纯工艺介质及工艺稳定性的要求持续提升，推动化学品供应系统、湿法工艺设备及废液回收等细分领域加速发展。

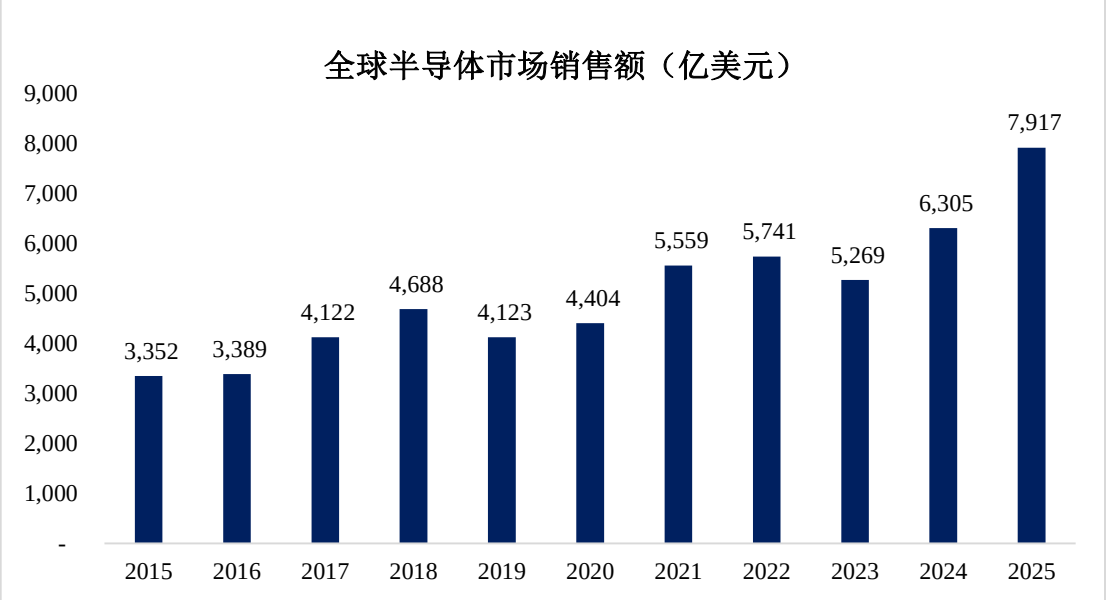
公司所处的高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备领域，正处于产业链升级与国产替代双重驱动的交汇点，具备较高技术壁垒与客户粘性。随着先进制程持续演进及环保与成本约束趋严，对高纯输送、精准控制及资源循环利用的需求不断提升，公司业务迎来良好的发展机遇，具备持续成长空间。

1、半导体产业发展态势

（1）全球市场进入新一轮增长周期

当前，全球半导体产业正处于人工智能算力驱动、后摩尔技术创新、全球供

应链重构三重趋势深度叠加的关键发展阶段，产业规模、技术路线与竞争格局均呈现出历史性变革特征。根据 WSTS 统计数据，2025 年是近十年全球半导体市场实现突破性增长的一年，销售总额达到 7,917 亿美元，同比大幅增长 25.6%，增速创下近十年以来最高水平。WSTS 预计，全球半导体销售总额在 2026 年将继续增长 26.3%，逼近 1 万亿美元关卡。



数据来源：WSTS 统计数据

从发展动力来看，本轮半导体产业增长并非传统周期下的短期反弹，而是由下游应用主导带来的根本性变革。人工智能应用与数据中心建设成为本轮产业增长的核心引擎，根据 WSTS 于 2025 年 12 月发布的预测数据，2025 年度，逻辑芯片营收有望迎来 37.1%的同比增长；存储芯片则以 27.8%的同比增速紧随其后；传感器、微处理器、模拟芯片、光电子元件将分别实现 10.4%、7.9%、7.5%、3.7%的同比增长。可以看出，以处理器、HBM、网络组件为代表的人工智能半导体正成为推动市场增长的核心力量，使产业增长逻辑打破了过往由消费电子主导的传统周期波动规律。同时，汽车电动化与工业数字化的深入推进，进一步拓宽了半导体应用场景，共同为产业增长提供了长期稳定的支撑。

半导体产业在后摩尔定律时代形成了两条并行发展的技术路径：一是在延续摩尔定律的方向上，持续推进 2nm 及以下先进制程的研发，通过微缩晶体管尺寸提升芯片集成度；二是在超越摩尔定律的方向上，将先进封装作为提升系统性能的核心路径，其中 Chiplet、3D 堆叠、异构集成等关键技术已快速实现规模化应用。此外，以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体材料，凭借其在高压、高

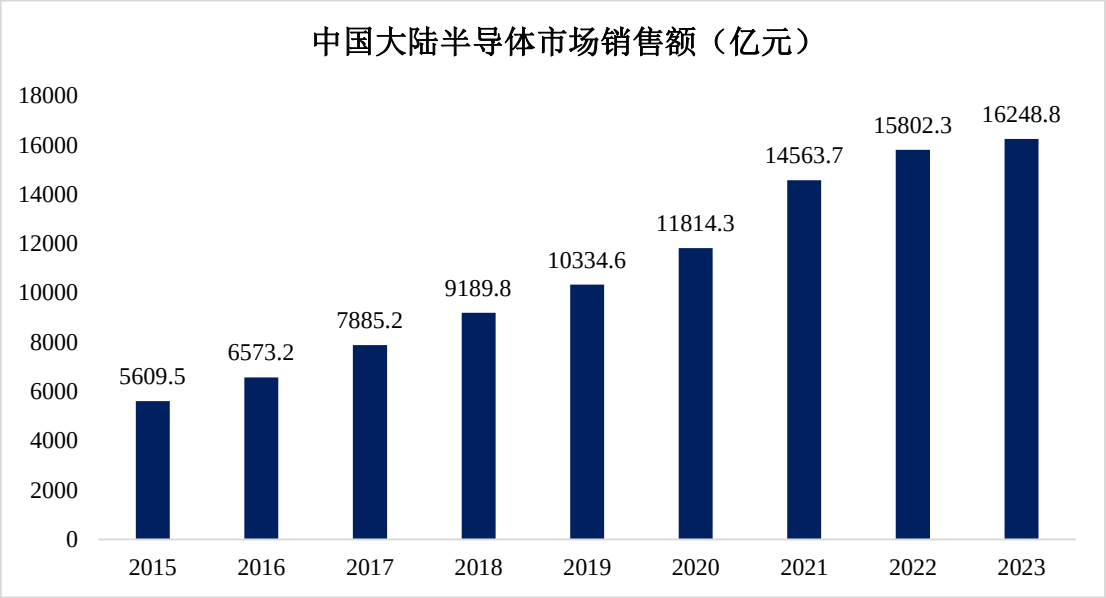
频、高温场景下的优异性能，在新能源、通信等领域渗透率持续提升，成为半导体技术创新的重要增量方向。

在全球地缘政治格局复杂化背景下，半导体产业的供应链正经历根本性重塑，从效率优先的全球化分工转向安全优先的区域化布局。国家间科技竞争加剧、贸易管制升级等外部因素，使各国意识到过度依赖单一地区的供应链存在断链风险。为此，主要经济体纷纷加大政策支持与资金投入，围绕芯片设计、制造、封测及上游设备、材料、软件等核心环节构建具备自主韧性和区域协同能力的供应链体系，使关键环节的战略价值愈发凸显。

整体而言，全球半导体产业需求正从周期性波动向长期战略性成长转型，在需求升级、技术创新与供应链重构的共同作用下，产业发展迈入高质量、可持续的全新增长阶段。

（2）中国市场增速领跑，核心支撑作用凸显

过去数年间，中国半导体产业实现了跨越式发展，规模持续扩大，已成为全球半导体产业中不可或缺的组成部分。根据 CSIA 统计数据，2015 年至 2023 年，中国大陆半导体市场销售额从 5,609.5 亿元攀升至 16,248.8 亿元，扩大了近 3 倍，年均复合增长率达 14.22%，增速显著高于全球同期约 5.82%的平均水平。



数据来源：CSIA 统计数据

依托全球半导体产业三重趋势的深度叠加，中国半导体产业正摆脱“规模扩张”的初级阶段，迈入高质量发展新时期，根据 SIA 统计数据，2024 年及 2025

年，中国半导体市场销售额分别达到 1,829.3 亿美元及 2,111.6 亿美元，截至 2025 年，中国半导体市场占全球比重已达 26.67%。在此背景下，中国半导体产业在政策扶持、技术突破及市场需求等多重合力下，向“自主可控、全链协同”的发展路径逐步转型。

半导体作为国家战略性、基础性、先导性的产业，已成为实现科技强国、产业强国的关键。《财政部 税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》等文件的相继出台，构建了覆盖财税优惠、研发补助、进出口便利的政策体系，伴随国家集成电路产业投资基金的持续投入，以市场化方式撬动社会资本协同发力，为半导体产业发展提供了坚实的资金保障。“十五五”开局之年，国家进一步明确“科技自立自强水平大幅提高”的发展目标，强调加强原始创新和关键核心技术攻关，全链条推动集成电路等重点领域突破。工信部 2026 年重点工作部署明确提出打造集成电路、新型显示、新材料等新兴支柱产业，并推进“人工智能+制造”专项行动，培育一批重点行业智能体。这一系列精准化政策导向，为中国半导体产业高质量发展提供了清晰的顶层设计。

在政策体系精准赋能及全球供应链重构背景下，中国半导体产业的技术突破正从单点技术攻坚加速转向全环节突围。一方面，产业链系统化推进，芯片设计、晶圆制造、封装测试等环节不断突破，上游设备、材料、软件等薄弱环节加快攻关，本土产品与技术逐步从低端替代向中高端渗透；另一方面，产业摆脱单一先进制程竞争路径，重点布局先进封装领域，同时大力推进第三代半导体的研发与规模化应用，以多元化布局构筑差异化优势。国内各区域也基于产业基础形成特色发展路径，如北京聚焦集成电路底层架构创新及 EDA 工具攻坚，上海牵头长三角推动集成电路全产业链突破，深圳则着力颠覆性技术研发。随着设计、制造、封测等环节间的协同验证与批量应用节奏显著加快，产业链上下游逐步形成“研发、验证、量产”的高效闭环，既保障了产业供应链的安全稳定，也为产业持续成长注入了内生动力，进而为中国半导体在技术迭代与市场竞争中开辟了新的增长空间。

中国是全球最大的单一国家半导体市场，规模远超美国、日本等其他主要经济体。从需求结构来看，中国半导体市场实现了全场景全覆盖，既有消费电子、

工业控制等成熟稳定的存量需求，也有人工智能算力、智能网联汽车、新能源等爆发式增量需求。中商产业研究院数据显示，中国 AI 计算加速芯片市场规模从2021年的301.28亿元增长至2024年的1425.37亿元，年均复合增长率达67.87%，预计 2025 年、2026 年将分别达到 2,398.00 亿元、3,813.9 亿元；2024 年中国车规级 SoC 市场规模达 381 亿元，同比增长 42.7%，预计 2025 年、2026 年将分别达到 536 亿元、643 亿元。此种“存量托底、增量拉升”的需求结构，为产业链各环节企业提供了差异化的落地路径，避免了某一领域波动带来的风险，同时构建了“需求定义产品、场景验证技术、规模反哺研发”的正向闭环，形成了中国半导体产业区别于全球其他地区的核心发展优势。此外，中国也是全球最大的终端产品制造基地。2025 年，中国贡献了全球约 60%以上的新能源汽车、约 70%以上的智能手机及约 80%以上的光伏逆变器产能，庞大的终端制造能力把全球半导体产业需求转化为本土供应链的落地机会，给中国半导体产业提供了稳定的发展基础与广阔的成长空间。

2、半导体设备行业发展态势

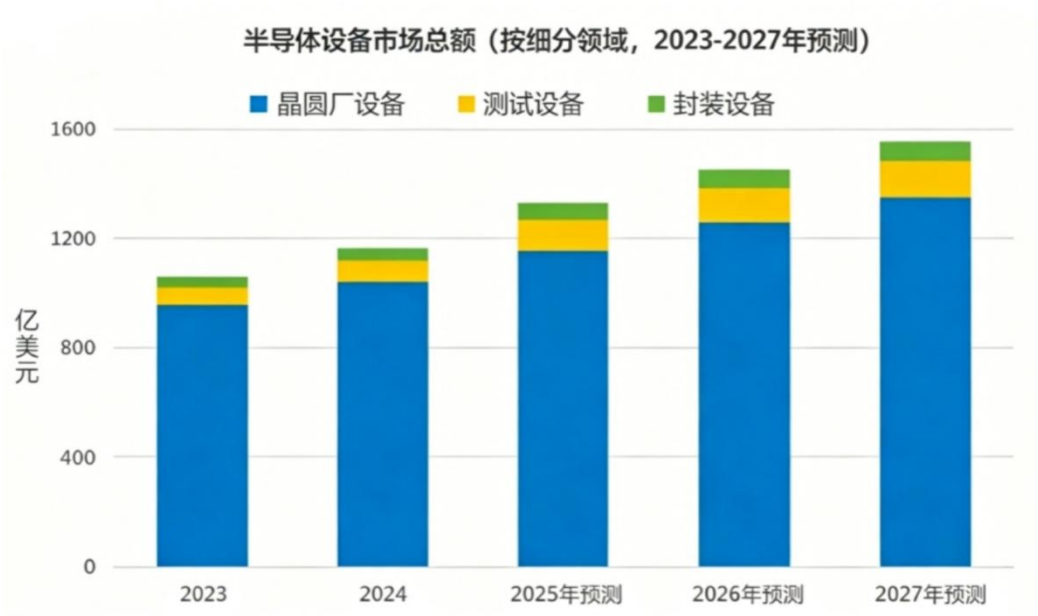
①全球市场稳步增长，技术持续向高阶演进

半导体设备按照应用环节可划分为前道工艺设备、后道工艺设备以及厂务配套设备三大类。其中，前道工艺设备通过光刻、刻蚀、薄膜沉积、离子注入等核心工艺，在晶圆表面构建芯片的微观结构，是决定芯片制程精度与性能的关键；后道工艺设备则通过减薄、划片、贴片、引线键合、塑封及测试等环节，完成芯片的电气互联、物理封装与功能验证，保障芯片的可靠性与最终性能；厂务配套设备虽不直接参与晶圆加工，但其运行状态直接关系晶圆制造的良率水平与生产连续性，是稳定运行的基础保障。除直接参与半导体制造环节的设备外，上游材料制备设备亦是半导体产业链前端不可缺少的重要配套，主要包括硅片制备设备、电子化学品制备与分装设备、光掩模与光刻材料制备设备、外延设备、检测与测试设备等。这些设备服务于半导体材料的制造过程，是确保各类材料达到制程所需纯度与性能的关键支撑。

根据 SEMI 统计数据，2025 年全球半导体制造设备总销售规模达到 1,351 亿美元，同比增长 15%，创历史新高；预计 2026 年、2027 年，全球半导体设备总销售规模有望继续攀升至 1,520 亿美元和 1,660 亿美元。本轮行业增长主要由人

工智能算力芯片需求快速释放、先进逻辑制程持续迭代、3D NAND 与高带宽存储芯片产能扩张及先进封装技术规模化应用共同驱动。

根据 SEMI 在 2025 年 12 月的预测，从细分领域看，晶圆厂设备领域（含晶圆加工、晶圆厂设施和掩模版设备）因 DRAM 及 HBM 投资强于预期及中国持续扩产，预计 2025 年将增长 11.0%至 1,157 亿美元，打破于 2024 年创下的 1,040 亿美元纪录；2026、2027 年预计再增 9.0%和 7.3%。后端设备领域 2025 年半导体测试设备销售额预计激增 48.1%至 112 亿美元，封装设备销售额增长 19.6%至 64 亿美元。2026、2027 年测试设备销售额预计继续增长 12.0%和 7.1%，封装设备销售额预计增长 9.2%和 6.9%，动力主要来自器件架构复杂度提升、先进及异构封装加速渗透，以及 AI 与 HBM 对性能的严苛要求。



数据来源：SEMI，《年终总半导体设备预测报告》（Year-End Total Semiconductor Equipment Forecast – OEM Perspective）

从产品结构来看，光刻设备、刻蚀设备、薄膜沉积设备作为晶圆制造环节的核心工艺装备，合计占全球半导体设备市场比例超过 60%，系行业内技术壁垒最高、投资规模最大的细分领域。与此同时，随着制程节点的演进，对表面洁净度、缺陷控制及掺杂精度的要求呈指数级提升，湿法清洗、量测检测、离子注入、热处理等设备的重要性持续上升，其中湿法设备成为近年来增长较快的细分领域之一，2025 年全球湿法设备市场规模同比增长超过 7%。

全球半导体设备正持续向高精度、高稳定性、智能化及绿色低碳方向升级。

随着制程节点向 3nm、2nm 及以下迈进，设备控制精度已提升至原子尺度，设备与人工智能、物联网技术的深度融合也显著提升了产线运行效率与稳定性，药液回收、水循环利用及低能耗设计已成为行业新风向，有效降低制造环节的资源消耗与环境负荷。此外，依托工艺同源性与设备通用性，半导体设备技术正加速向显示面板、光伏、功率器件等泛半导体领域延伸应用，开辟了新的业务增长空间。

目前，全球半导体设备市场仍保持着由美国、荷兰及日本主导的寡头竞争格局，阿斯麦、应用材料、泛林集团、东京电子、科磊五大国际龙头企业长期占据行业领先地位。根据 CINNO Research 统计数据，2025 年上半年，上述企业的半导体业务营收合计占全球前十大设备商总营收的 85%以上，已在各自优势领域构筑起显著的技术壁垒与稳固的客户基础。近年来，以中国企业为代表的新兴市场参与者已在刻蚀、清洗、薄膜沉积、热处理、厂务配套及材料制备等领域实现技术突破，部分产品已成功切入国际主流晶圆厂供应体系，推动全球半导体设备产业格局由高度垄断向多元化方向稳步演进。

②中国市场势头强劲，国产替代向纵深推进

中国凭借全球规模最大、应用场景最为丰富的半导体终端市场，叠加持续扩张的晶圆制造产能，已成为全球半导体设备行业最重要的增长助力。根据 SEMI 统计数据，得益于积极的产能扩张和政府支持，2025 年中国大陆市场半导体设备销售额达到 493 亿美元，较上年微降 0.5%，占全球半导体设备销售额的比例约为 36.51%，连续第六年位居全球第一；2026 年，AI 算力需求驱动半导体设备行业的扩产持续推进，中国大陆半导体设备销售额在第一季度同比增长 7%，达到 109.9 亿美元。

根据 SEMI 在 2025 年 1 月的预测，基于对全球在建及规划中晶圆厂产能的持续追踪，2024 年为全球晶圆厂建设的阶段性高点；2025 年增长态势仍将延续，全球启动新建的晶圆厂数量预计为 18 个，其中中国大陆新建数量为 3 个；至 2026 年底，中国 12 英寸芯片制造企业的工厂数量将超过 70 个。这一轮晶圆厂建设将为中国半导体设备带来更多验证机会与明确增量空间，推动国产替代进程向纵深发展。

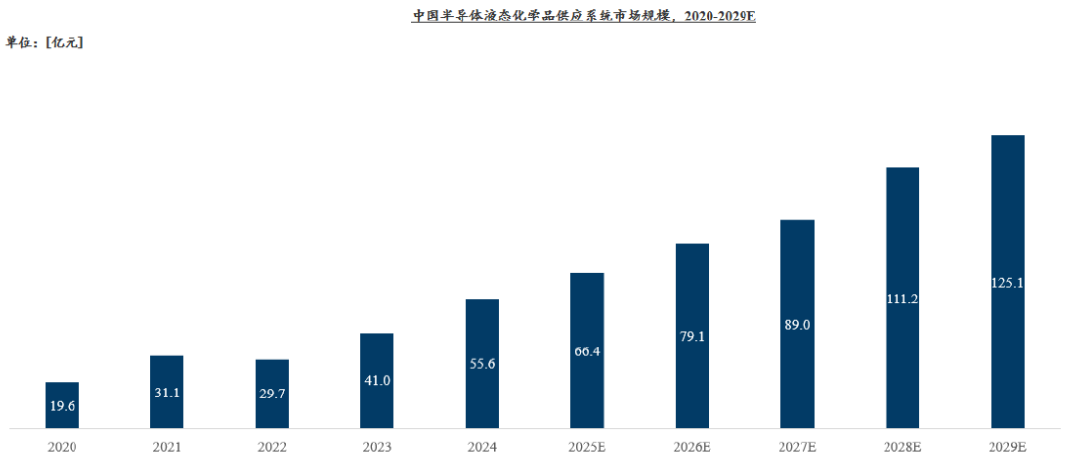
中国半导体设备行业遵循“先成熟、后先进，先单点、后体系”的发展路径，

目前已取得阶段性成果。在 28nm 及以上成熟制程领域，清洗、刻蚀、薄膜沉积、氧化退火、封装检测等设备国产化率已超过 50%，去胶、清洗等部分环节达 70%至 80%，成为晶圆产线的重要配套力量。在 14nm 及以下先进制程领域，中国已实现关键设备的单点突破，刻蚀、薄膜沉积等设备已进入 5nm 产线验证或实现小批量供货。厂务配套设备作为晶圆厂稳定运行的关键支撑，其技术路径清晰，与本土产线适配度高，且中国企业在服务响应速度和供应链稳定性等方面已形成差异化优势，已成为国产替代推进速度较快的品类。

中国半导体设备在高端制程、关键零部件、核心工艺等环节仍存在较大提升空间与广阔发展机遇。未来，随着产业链协同能力不断增强、研发投入持续加大、工艺验证条件日益完善，中国半导体设备行业将在巩固成熟制程领域优势的同时，稳步向先进制程设备及高端配套系统突破。

3、半导体液态化学品供应系统行业发展态势

半导体液态化学品供应系统是保障晶圆制造过程中化学品纯度与稳定供给的关键配套设施，其市场规模的增长与全球半导体产业向国内转移、本土晶圆厂持续扩产的进程紧密相关。2020 年，中国半导体液态化学品供应系统市场规模为19.6亿元人民币，至2024年已增长至55.6亿元人民币，年复合增长率达29.7%。预计 2029 年市场规模将进一步扩大至 125.1 亿元人民币，2025 年至 2029 年的年复合增长率为 17.2%。



数据来源：弗若斯特沙利文《半导体液态化学品供应系统行业独立研究》

其中，高洁净度液态化学品供应系统作为满足先进制程需求的关键组成部分，

2020 年其市场规模为 15.7 亿元人民币，2024 年增长至 45.1 亿元人民币，年复合增长率达 30.2%。预计 2029 年市场规模将达到 93.8 亿元人民币，2025 年至 2029 年的年复合增长率为 16.6%。研磨液供应系统 2020 年市场规模为 3.9 亿元人民币，2024 年已攀升至 10.4 亿元人民币，年复合增长率为 27.6%。预计 2029 年市场规模将达到 31.3 亿元人民币，2025 年至 2029 年的年复合增长率为 19.0%。

（五）半导体设备行业的技术水平特点

1、自动化化学品与研磨液供应系统

自动化化学品与研磨液供应系统是主要面向于半导体制造的核心厂务配套设备，承担着将化学品及研磨液等高纯工艺介质稳定、精准、安全地输送至各类工艺设备使用点的关键功能。随着半导体技术节点持续演进，器件尺寸进入纳米量级且广泛采用 FinFET、GAA 等立体结构，对该系统的要求呈指数化升级，主要体现在杂质管控，以及对流量、浓度等参数的精准控制，在不同制程中的技术水平要求具体如下：

自动化化学品供应系统		
核心参数	**成熟制程（28nm 及以上）**	**先进制程（28nm 以下）**
金属杂质控制	0.1μg/L（或0.1ppb）及以下等级（对标SEMI G4等级）	0.01μg/L（或10ppt）及以下等级（对标SEMI G5等级）
颗粒控制	≥0.05μm颗粒<15个/mL	≥0.02μm 颗粒<30个/mL
自动化研磨液供应系统		
核心参数	**成熟制程（28nm及以上）**	**先进制程（28nm以下）**
pH值控制	±0.1	±0.05
流量控制精度	±2%FS	±1%FS
浓度控制精度	以双氧水为例，±0.05%-0.1%	以双氧水为例，±0.05%-0.1%

资料来源：弗若斯特沙利文《半导体液态化学品供应系统行业独立研究》

为满足上述严苛要求，供应系统需从材料选型、密封工艺、颗粒控制、参数稳定性及智能监控等维度实现系统性技术升级，具体表现为：

维度	关键实现手段
材料化学惰性与零析出	与工艺介质接触的部件必须采用高纯耐腐蚀材料，从材质层面杜绝二次污染。接触液体的核心部件需选用 PFA 全氟聚合物，该材料具有优异的化学惰性，在强酸、强碱、强氧化剂环境下可长期稳定运行。 对于非腐蚀性介质或对机械强度要求更高的场景，需采用电抛光（EP）级 316L 不锈钢，其杂质元素含量远低于普通不锈钢。金属管道内壁需经电解抛光处理，

	将表面粗糙度控制达到镜面级别。
密封性与零泄漏	输送管路采用洁净焊接与高精度密封技术，有效避免微泄漏与颗粒产生。管道连接通过精密控制的焊接参数（电流、电压、氩气流量、焊接速度），实现管道连接的标准化和可重复性。 对于需要频繁拆装的连接点，需采用 VCR 金属垫片面密封结构，通过金属对金属的硬密封，消除弹性体密封件可能带来的老化、析出风险。
颗粒与微生物洁净度	对于化学品供应系统需采用分级过滤策略，储罐出口设预过滤器拦截大颗粒，主循环回路配置高精度过滤器，终端使用点前串联超滤膜，确保抵达工艺设备的介质中颗粒数满足先进制程要求。系统配备在线颗粒计数器实时监测，当颗粒数超标时自动报警或切换备用管路。 由于研磨液含固体磨粒，因此研磨液供应系统的颗粒控制需兼顾过滤与均质化。系统需采用多级过滤设计确保磨粒粒径分布均匀无团聚，同时通过桶底喷流搅拌等方式实现均质混料，避免沉降。系统通常搭载湿氮气装置防止研磨液干燥硬化。采用低有机碳析出、抗生物膜形成的管道材料，从源头抑制微生物滋生。
参数稳定性	化学品供应系统的参数控制以精密计量与闭环反馈为核心，使用高精度光学传感器实时监测浓度数据，通过软件动态调节计量泵转速或阀门开度，质量流量控制器配合变频调速技术，压力控制采用压力传感器与背压调节阀组合，维持系统压力稳定。温度控制通过传感器与换热装置联动，结合内置温度校准功能，消除温度波动对浓度测量的干扰。 研磨液供应系统的参数控制更注重均质化与实时补正。科里奥利质量流量计为敏感处理的研磨液提供高精度质量流量、密度、温度和粘度测量。系统采用 PID 控制器根据回路压力反馈自动调整泵速，确保适量压力在规定时间内稳定分配到工艺工具。循环模式持续运行，防止研磨液颗粒产生沉积和聚集，确保均质和高质量的研磨液随时可用。品质分析模组实时补正浓度与颗粒分布，热交换模组精确控制温度，确保研磨液在最佳状态下输送至工艺设备。

2、电子级化学品纯化及分装系统

电子化学品纯化及分装系统是半导体产业上游材料制备环节的关键核心设备，其制备的电子化学品最终应用于半导体制造流程中。该类系统的研发与设计需严格契合半导体制造的要求，全面满足半导体级洁净度、材料兼容性和工艺稳定性要求，系统依托多级精馏、精准吸附、离子交换、膜分离等核心纯化技术，实现对颗粒、金属杂质等的精准管控，可将常规工业级化学品提纯至 SEMI G5 级标准，从材料制备源头保障工艺介质的纯净度，为半导体制造环节提供符合先进制程要求的工艺介质。

作为化学品从工业级原料提纯后、进入制造前的关键工序，分装环节的洁净度控制至关重要，因此该行业的技术发展始终围绕“杜绝二次污染、精准控制微颗粒、适配下游场景差异化洁净标准”方向，在核心工艺、监测防控、材料适配等维度持续突破，逐步构建起从事后检测到全程可控的完整技术体系，主要表现为：

维度	关键实现手段	
多级联合纯化工艺	精馏技术	利用组分间沸点差异实现分离，适用于有机溶剂类化学品的提纯。针对热敏性物料，采用减压精馏或分子蒸馏，避免高温导致热分解产生副产物杂质，可将再生有机溶剂提纯至电子级超

		高纯度。
	吸附技术	采用高选择性吸附剂去除痕量金属离子和有机杂质，适用于对金属杂质要求极为严苛的化学品。
	离子交换技术	通过离子交换树脂选择性吸附目标离子，去除精度可达 ppt 级，适用于电镀液、掺杂液等对金属杂质敏感的化学品深度纯化。
	膜分离技术	利用纳米级多孔膜选择性透过目标组分，适用于颗粒、胶体的高效去除，尤其适配含固体杂质的复杂体系。
全流程实时洁净度监测	一是在分装舱、灌装管路、容器入口等核心位置，嵌入式安装在线颗粒仪，可精准监测粒径≥0.02μm 的微小颗粒，精准捕捉痕量超细颗粒；二是搭载智能化监测系统，实时采集颗粒数量、粒径分布等数据，接入设备中控系统，当颗粒浓度超出预设阈值时，立即触发报警，同时自动暂停灌装流程，避免不合格产品产出。	
包装容器洁净度控制	材料纯度	包装材料需采用超高纯度含氟聚合物（如 PFA），其金属离子析出、阴离子析出及总有机碳析出量、表面粗糙度等指标满足 SEMI F57 管控要求。
	洁净清洗	包装容器在灌装前需经过严格的洁净清洗流程，包括超纯水冲洗、异丙醇脱水、超纯氮气吹扫等，确保内壁无颗粒、无金属残留。
	密封性验证	灌装后需进行氦质谱检漏测试，确保包装密封性满足长途运输和长期储存的要求。对于 SEMI G4/G5 级超高纯化学品，包装可采用主密封加辅助密封的双层密封设计。

3、废化学品再生系统

废化学品再生系统是泛半导体制造中实现资源循环利用与绿色制造的关键厂务配套设备。该系统主要服务于集成电路、显示面板、光伏等行业，前述行业因制程工艺区别，产生的废化学品种类各不相同：集成电路主要需处理晶圆厂产生的含重金属刻蚀液、显影液等废液；显示面板行业主要需处理 LCD、OLED 高世代线产生的剥离液、显影液等废液；光伏行业主要需处理晶硅、异质结、钙钛矿等电池生产过程中产生的硅片刻蚀废酸、清洗废碱等废液。再生系统需处理的废化学品种类繁多且成分复杂。面对废化学品的高度多元性与复杂性，再生系统需针对不同构成采用差异化的技术路径，通过多技术融合实现高价值化学品的高效回收与循环复用。现阶段，再生系统的核心技术包括了精馏技术、电渗析技术、离子交换树脂技术以及膜分离技术等，其原理、应用及优势分别如下：

精馏技术	
原理	利用废化学品中不同物质沸点或者挥发能力的不同，通过反复加热汽化、冷却冷凝以及气液逆流接触，把混合液体里的各类成分高效分开、提纯出高纯度物质的核心分离技术。
应用	有机废液：IPA 异丙醇、PGME 光刻胶溶剂、NMP 剥离液、乙醇、丙酮、甲苯等高纯有机溶剂回收。
优势	分离精度极致，满足电子级高纯要求：可将有机溶剂提纯至 99.9%以上满足电子级高纯度需求，金属离子、颗粒、水分等杂质控制在 ppb 级，完全匹配光刻、清洗、剥离等先进制程的化学品纯度标准。 回收率高，降本增效显著：废有机溶剂的回收率较高（可以达到 80%及以上），大幅度减少半导体生产厂商对于新高纯溶剂的采购量，同时减少危废处置量，兼顾经济性与环保性。 连续化自动化，适配半导体生产节奏：可实现连续稳定运行，配合 PLC 自动化控制系统，精准调节回流比、加热量、真空度，保证再生产品纯度恒定，与半导体晶圆生产线的连续化生产完美匹配。

电渗析技术	
原理	电渗析的核心是通过电场以及膜的选择性，实现离子从淡水室向浓水室定向转移，完成脱盐、离子分离、净化，无相变、无需大量化学药剂。
应用	碱性废液：TMAH 废显影液再生、氨性废清洗液再生。 含金属离子废液：针对半导体含微量金属离子的废酸或者废碱，通过电渗析选择性分离金属阳离子，实现酸碱纯化及金属离子分离。 含盐废酸以及废碱：针对半导体高盐废酸、高盐废碱，通过常规电渗析脱除无机盐离子，提升再生酸碱纯度。
优势	无相变、低能耗，低碳环保：仅靠电场驱动离子迁移，无加热或冷凝相变过程，能耗远低于蒸发浓缩，无蒸汽消耗、无冷凝水排放，契合“双碳”目标。 离子级精准分离，选择性极强：依靠离子交换膜的选择性以及电场定向驱动，可实现对特定阳离子或者阴离子的精准分离，例如四甲基铵阳离子 TMA^+与氢氧根阴离子 OH^-，分离精度达离子级别，是其他技术难以实现的。 高纯再生，适配电子级标准：再生的 TMAH、氨水、酸液，金属离子可控制在 ppb-ppt 级，无颗粒、无有机残留，满足半导体先进制程对高纯化学品的严苛要求，是碱性废液高纯再生的核心技术。
离子交换树脂技术	
原理	树脂通过自身带电官能团，与溶液中带相反电荷的杂质离子发生可逆的等价置换，把杂质离子吸附去除，实现溶液提纯，饱和树脂可通过再生剂恢复能力，循环使用。
应用	废酸、废碱深度脱金属：半导体废酸例如BOE刻蚀液、硫酸清洗液、磷酸刻蚀液、废碱清洗液，在经过膜分离、电渗析、精馏等主体工艺分离后，仍然存在含ppb级的金属离子，存有这些金属离子的回收产品在先进制程中是绝对禁止应用的，离子交换树脂技术可对于这些金属离子进行脱离，使其满足先进制程的应用需求。
优势	精准除杂，不影响目标化学品成分：树脂仅吸附杂质离子，不会与再生酸、碱、有机溶剂发生反应，不改变目标化学品的浓度和成分，确保再生化学品的工艺性能与新料一致。 与其他工艺无缝耦合，适配再生全流程：离子交换树脂技术不做主体分离，仅做深度除杂，可与膜分离、电渗析、精馏、蒸发等所有半导体废液再生工艺串联，形成完整工艺，适配酸、碱、有机所有废液类型。
膜分离技术	
原理	膜分离是以功能化选择性分离膜为核心分离介质，在膜两侧压力差、浓度差、电位差、蒸汽压差等传质推动力作用下，基于混合物各组分与膜之间的筛分效应、电荷排斥效应、溶解扩散效应、离子选择性效应以及理化性质差异，使目标组分有选择性的透过膜、杂质组分被截留，从而实现流体体系分离、提纯、浓缩、脱杂的物理分离技术。
应用	强腐蚀废酸提纯：对于BOE缓冲氢氟酸、DHF稀氢氟酸废液等强腐蚀废酸，膜分离技术可以选择性透过HF以及NH_4F，截留氟硅酸盐、金属氟化物杂质，实现废酸直接回用。 高纯碱液回收：对于TMAH废显影液、SC1氨性废清洗液，截留光刻胶降解大分子、有机杂质，允许TMA^+、NH_4^+等小分子离子透过，在维持体系化学组成基本稳定的前提下，实现碱液的纯化回收，并为后续深度提纯提供基础。
优势	物理无相变分离，能耗极低：无加热以及冷凝相变过程，能耗显著低于蒸发及精馏，整体回收过程低碳节能。 高纯无溶出污染：电子级膜材料无金属离子溶出，分离过程不产生颗粒以及离子污染，保障再生化学品达ppb以及ppt级高纯标准。

4、高阶湿制程工艺设备

湿制程工艺设备是指以化学液体或去离子水为核心介质，通过化学作用与物理作用相结合的方式，在半导体晶圆制造及封装测试环节中实现晶圆表面清洁、图形化加工、材料剥离与去除等工艺目标的专用工艺设备。与采用等离子体、激光等干式介质的干法工艺设备不同，湿法工艺具有成本较低、操作相对温和、对晶圆损伤小等特点，是半导体制造流程中不可或缺的。

湿制程工艺设备的技术能力直接决定了芯片量产良率与落地可行性。在制程向先进节点持续升级的背景下，设备面临的技术壁垒与工艺挑战不断加剧，已成为半导体产业进阶的重要制约环节。目前，行业中具备代表性的技术主要体现在以下方面：

技术名称	应对问题	技术特点
单片高温 SPM 技术	针对 28nm 以下先进制程中光刻胶残留及有机污染物难以去除的问题，通过高温 SPM 的强氧化性和脱水作用，有效分解并去除致密聚合物残留，提升晶圆表面洁净度。	以硫酸与双氧水为核心混合药液，采用“单片独立处理”模式，突破传统 SPM 常规温度上限，在高温工况下实现刻蚀及离子注入工序后晶圆表面有机物的高效精准去除。
兆声波非接触清洗技术	3D NAND 堆叠层数突破 500 层、逻辑器件进入 GAA 时代，存储阵列深孔、深沟槽等结构的深宽比可达 10:1 甚至 20:1。常规清洗工艺已无法实现结构内部药液的充分置换，颗粒、聚合物残胶易被困在深层死角。	借助微射流作用穿透深孔及深沟槽结构，在无基底损伤的前提下有效剥离深层颗粒与污染物。与传统的超声波清洗相比，兆声波具有更小的空化效应，能避免对精细图形结构的破坏，是目前高深宽比结构清洗的主流方案。

（六）进入本行业主要壁垒

1、技术壁垒

公司所处半导体设备行业为典型的技术密集型、多学科交叉领域，其核心技术涉及化工工艺、流体力学、精密机械、自动控制及材料科学等基础学科与工程实践的综合应用，形成了天然的专业门槛。随着下游半导体制程持续向先进节点演进，对高纯介质杂质管控精度已提升至 ppt 级，对纳米级颗粒控制、强腐蚀介质兼容适配、全流程防交叉污染、高精度流体与温度控制等核心技术要求日益严格，相关底层技术与工艺诀窍高度依赖长期项目迭代与量产经验积累，通常需要长期的持续深耕。同时，下游客户基于自身制程节点、产能规划和产线布局，对设备提出高度定制化的要求，要求供应商深度理解客户工艺逻辑，完成从方案设计、设备制造到现场安装调试的完整交付。基于上述特征，行业新进入者难以通过短期研发投入实现快速突破，多学科知识融合、极致技术指标、长期经验积累与定制化交付能力四者叠加，共同构成了较高的技术壁垒。

2、客户认证壁垒

公司所处行业下游客户主要为集成电路、显示面板、电子化学品等行业的高端科技型制造企业，该类企业对与生产工艺紧密相关的设备供应商普遍建立了高标准的准入认证体系，构成了行业新进入者面临的首要壁垒。下游客户针对该类产品的准入认证，并非仅局限于设备静态性能参数的达标，更会围绕设备长期运

行可靠性、批次间一致性、对产品良率的影响程度、全生命周期技术支持与应急响应服务能力等维度开展系统性审核。

以公司核心产品自动化化学品与研磨液供应系统为例，其直接与下游客户生产线上的核心工艺设备连接，系统的冗余设计、故障自愈能力、运行稳定性都至关重要。一方面，若因系统故障引发介质纯度失控、交叉污染或供液中断等问题，轻则导致晶圆报废、产线停机，重则可能对工艺设备造成不可逆损伤，单次事故带来的直接与间接损失可达数百万元乃至上千万元；另一方面，供应系统的可靠性与适配性无法通过单次或短期的验证完成全面评估，通常需要经过长期的连续运行以完成数据积累与工况测试，才能验证其在真实产线环境下的表现。因此，具备成熟项目落地经验及长期合作历史的供应商能够显著缩短客户的设备导入周期，助力产线更快达到稳定量产状态，从而降低客户的技术风险与试错成本。

3、资金与人才壁垒

公司所处行业具有重研发、投入大、回收周期长的特征，对参与者的资金实力与人才储备均提出了极高要求，构成行业新进入者需同步突破的综合壁垒。

半导体设备行业对参与者的资金实力要求较高。一方面，行业内参与者需持续保持较高的研发投入，用于技术迭代、与新产品研发，同时需配套建设洁净车间、购置超精密加工设备与测试平台等设施，固定资产投入规模较大；另一方面，下游客户的建设周期较长，参与者在投标、设计阶段需自行垫付运营及人工成本，在设备制造、安装调试环节需向上游供应商支付采购款项，而下游客户普遍采用分阶段付款的结算方式，项目终验收后仍保留一定比例的质保金。上述因素导致从产品研发、客户验证到最终全部回款的全周期较长，对参与者的资金周转能力、持续垫付能力和抗风险能力形成了持续考验，构成了行业较高的资金壁垒。

从人才维度看，半导体设备行业对人才的需求主要体现在技术复合性与经验依赖性两个方面。技术复合性体现在知识结构的多元融合，要求参与人员不仅需要掌握流体输送、材质兼容、自动控制等专业知识，还需深刻理解下游客户生产的具体工艺逻辑，实现设备功能与客户工艺的耦合，才能为客户提供真正满足其需求的系统解决方案；经验依赖性则贯穿于项目实施全过程，从管路布局优化到洁净度控制，从进度协调到异常应急处置，每一个环节都高度依赖于项目参与人

员在以往积累的经验与判断。上述两重因素叠加，构成了行业稳固的人才壁垒。

（七）细分行业竞争格局

1、竞争格局概况

高纯工艺介质系统于 20 世纪 70 年代在国外率先实现产业化发展，当时涌现出一批颇具行业影响力的知名供应商，这些企业凭借先发优势，与下游行业客户建立了深度合作关系。近年来，在政策扶持及内生需求的双重推动下，集成电路、显示面板及电子化学品等泛半导体产业链上下游行业在国内蓬勃发展，新一批本土供应商应运而生，凭借专业技术、性价比优势及高效服务响应，逐步成长为完善产业链配套体系的中坚力量。

高阶湿制程工艺设备具有技术壁垒高、市场集中度高的特征，全球市场长期由日本、美国企业主导。国内厂商经过多年技术攻关，目前已形成多梯队竞争态势，部分企业在成熟制程领域已实现规模化替代，并向先进制程加速渗透。

2、行业内主要企业

（1）高纯工艺介质系统

从事高纯工艺介质系统业务的主要企业介绍如下：

公司名称	简要介绍
正帆科技 688596.SH	正帆科技成立于 2009 年，主要业务为向集成电路、泛半导体、生物制药等高科技产业及先进制造业客户提供设备类（CAPEX）业务和非设备类（OPEX）业务。产品的市场需求主要来自于集成电路、泛半导体以及生物制药等高端制造产业的固定资产投资支出和运营支出。
至纯科技 603690.SH	至纯科技成立于 2000 年，核心业务紧紧围绕为晶圆厂提供从前期建设到稳定运营阶段全生命周期的产品和服务，提供的产品主要包括制程设备、高纯工艺设备及系统、电子材料、零部件及专业服务。
盛剑科技 603324.SH	盛剑科技成立于 2012 年，是中国高科技制造产业知名的绿色科技服务商，主要下游行业为集成电路、半导体显示等半导体产业领域以及新能源领域，已形成“绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车。
帆宣科技 6196.TW	帆宣科技成立于 1988 年，主要业务分为高科技设备材料销售与服务业务、自动化供应系统业务、整合系统业务与客制化设备研发制造业务四大类。
STI 039440.KS	STI 成立于 1997 年，为半导体与显示行业提供中央化学品供应系统、湿法系统、喷墨设备等高质量的设备。其中中央化学品供应系统是为半导体、显示器和 IT 行业，通过供应管道，远程向生产设备提供各种化学品的自动化设备。

注：上述资料来源于公开披露信息或官方网站。

（2）高阶湿制程工艺设备

从事高阶湿制程工艺设备业务的主要企业介绍如下：

公司名称	简要介绍
盛美上海 688082.SH	盛美上海成立于 2005 年，从事对集成电路制造与先进晶圆级封装制造行业至关重要的单晶圆及槽式湿法清洗设备、电镀设备、无应力抛光设备、立式炉管设备和前道涂胶显影设备和等离子体增强化学气相沉积设备等的研发、制造和销售。
至纯科技 603690.SH	至纯科技成立于 2000 年，核心业务紧紧围绕为晶圆厂提供从前期建设到稳定运营阶段全生命周期的产品和服务，提供的产品主要包括制程设备、高纯工艺设备及系统、电子材料、零部件及专业服务。
北方华创 002371.SZ	北方华创成立于 2001 年，专注于半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件，电子工艺装备包括半导体装备、真空及新能源装备。电子元器件包括电阻、电容、晶体器件、模块电源、微波组件等。
芯源微 688037.SH	芯源微成立于 2002 年，主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品主要包括光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备。
SCREEN 7735.T	SCREEN 成立于 1943 年，主要产品为全球领先的清洁设备，还提供广泛的支持半导体生产的解决方案，包括光刻退火和检测测量设备等。
TEL 8035.T	TEL 成立于 1963 年，是一家全球领先的半导体设备制造商，主要产品覆盖涂布显影、刻蚀、沉积、清洗、键合等制程。
Lam Research LRCX.O	Lam Research 成立于 1980 年，是一家全球领先的创新晶圆制造设备和服务供应商，主要产品为集成电路制造所需的刻蚀设备、气相沉积设备、湿法清洗设备等。

注：上述资料来源于公开披露信息或官方网站。

除上述上市（上柜）公司外，主要从事高纯工艺介质系统业务的公司还包括阳坤工业管道系统（上海）有限公司、上海脉纯机电工程有限公司等；主要从事高阶湿制程工艺设备业务的公司还包括江苏亚电科技股份有限公司、上海提牛科技股份有限公司等。

3、发行人产品和服务的市场地位

公司是国内高纯工艺介质系统领域的标准制定者与核心参与者，作为该领域的早期入局者，公司长期深耕高纯工艺介质相关的技术研发，通过持续深化对各类化学品特性、制程适配要求、安全管控标准的深度理解，以自动化化学品与研磨液供应系统作为代表性产品，在该领域构筑了深厚的竞争优势，赢得了下游客户的广泛认可与信赖。

根据弗若斯特沙利文统计，按 2024 年企业营收计算，中国半导体液态化学品供应系统市场的主要参与者包括冠礼科技、正帆科技、至纯科技、帆宣科技、STI 等。冠礼科技、正帆科技、至纯科技凭借技术壁垒、头部晶圆厂客户的认证与深度合作以及在国产替代进程中的先发优势已跻身该领域第一梯队，市场占有率位于 10%-15%区间，其中冠礼科技以 14.4%的市场占有率居行业首位，市场影响力持续提升。

4、发行人竞争优势

（1）技术优势

作为高纯工艺介质系统领域的先行者，公司深耕行业二十余年，逐步形成系统级设计与交付、软件开发与优化以及成熟的方案落地能力，始终引领行业技术发展，精准响应客户的差异化需求，并持续推动产品创新与创意、创造迭代升级，现已发展出自动化化学品与研磨液供应系统、电子级化学品纯化及分装系统、废化学品再生系统及高阶湿制程工艺设备等多元化产品。

作为公司营业收入的核心贡献产品，公司的自动化化学品与研磨液供应系统全面兼容 PLC/SCADA/FMCS 半导体设备通信标准，可与生产机台实现无缝对接。该系统以工艺介质输送的纯净与稳定为核心目标，依据不同化学特性选用 PFA 或 316 不锈钢等高洁净耐腐材料，从硬件端保障核心工艺指标的精准控制。公司该产品对金属杂质控制可达到 SEMI G5 等级；在颗粒控制方面，目前在 28nm 及以上成熟制程中可实现颗粒≥0.05μm、＜10-15 个/mL 的控制，在 28nm 以下的先进制程中可实现颗粒≥0.02μm、＜10-20 个/mL 的控制，已达到行业领先水平。系统搭载全自动流量监控与液气分离装置，配备带压差监测功能的安全通排风管道，全方位保障工艺安全与介质输送的稳定性。维护便捷性方面，产品采用管路与核心部件的快拆式连接设计；连续生产保障方面，系统配备智能旁路（Bypass）功能与冗余泵组自动切换设计，可在泵组失效时自动完成无缝切换，避免断液风险，保障下游产线连续稳定运行，朝向先进制程迭代开发。

（2）客户优势

公司凭借对下游客户核心诉求的深刻理解，以高纯工艺介质系统为业务核心，成功将业务拓展至集成电路、显示面板、电子化学品等多元产业链，积累了丰富的客户资源与客户认证资格。公司着力于维系与优质客户的合作，已覆盖多个关键下游行业的国内外头部企业，包括中芯国际、华虹半导体、合肥晶合、长江存储、长鑫存储等知名国内龙头企业，以及住友化学等具备全球影响力的国际客户，凭借可靠的产品质量与技术服务，多次被中芯国际等重要客户评为“优质供应商”，充分体现了客户对公司综合能力的高度认可。

在此基础上，公司积累了规模可观且黏性较强的存量客户资源，为业务的拓展奠定了坚实基础。相较于国际竞争对手，公司凭借本土化服务优势，能够更贴近客户需求并提供快速响应，通过完善的营销网络和专业的服务团队，为客户提供从售前方案咨询、售中项目管理到售后持续运维的全周期服务。这种深度服务

能力不仅能保障客户项目的稳定运行，也进一步巩固客户关系，为公司形成清晰且可持续的增长路径：一是原有客户新增产线或扩产项目带来的采购需求；二是依托既有客户带来的行业口碑引荐获得的新客户资源；三是对已投入运营的系统开展的改造升级、运营维护与技术服务等后市场业务。上述增长路径相互协同，共同构筑了公司稳健且多元化的发展动力。

（3）项目经验优势

公司下游客户普遍投资规模大、工艺要求高、安全管控严格，对供应商的技术实力、项目经验及工程管理能力均提出较高要求。客户通常需对供应商开展多轮技术与商务评审，综合考察其项目业绩、企业资质、核心团队经验及项目交付、风险管控等能力，审核通过后方可纳入合格供应商体系。

公司作为行业国家标准参编单位，同时也是国内较早布局高纯工艺介质系统领域的供应商，深度洞悉产业应用习惯与各细分行业差异化需求，积累了丰富的贴合行业特性的项目经验与成熟的本土化服务能力。深厚的项目储备构筑起公司突出的市场竞争优势；持续落地的项目又不断充实案例积累、提升团队实战水平，由此形成经验获取、能力升级、市场拓展的良性循环，持续增强公司在国内外市场的渗透力与品牌影响力。

（4）管理优势

公司始终将优质的供应链整合能力、卓越的客户服务水平以及精细化的成本管控体系视为保持市场竞争力的核心支柱。

凭借在行业中多年的深耕，公司与产业链中的主要供应商建立了稳定、互信的战略合作关系，不仅保障了关键原材料与核心部件的稳定供应与品质可控，更增强了整体供应链的协同性与抗风险能力。同时，公司高度重视客户关系的持续维护与深度服务，通过与客户的紧密沟通，不断深化对客户工艺需求与生产场景的理解，从而提供更精准、高效的定制化解决方案，以赢得客户长期信任。在成本控制方面，公司通过技术优化与流程再造，持续推动设计标准化与模块化，减少冗余施工环节，并通过深度融合信息化管理系统与自动化设备，从材料采购、生产实施到项目管理全流程实现精益化成本管控，显著提升运营效率。

凭借贯穿供应链、客户服务与内部控制的系统化高效管理，公司构建起安全、

稳定、高效的市场品牌形象，为实现较高毛利率水平奠定了坚实基础。

5、发行人竞争劣势

（1）融资渠道相对单一

公司所处的半导体设备行业属于典型的技术密集型领域，同时对参与者的资金实力也提出了极高要求。作为处于成长期的企业，公司目前主要依赖自身经营积累和银行信贷满足研发投入、产能建设及日常运营所需的资金，融资渠道相对有限。与已上市的同行业公司相比，公司尚不具备股权融资、债券融资等多元化资本补充手段。随着下游集成电路、显示面板等行业快速发展，客户对设备交付能力、技术迭代速度及产能保障能力将提出更高要求，公司面临的资金压力日益凸显。融资渠道单一不仅制约了公司在新技术研发、高端人才引进及产能扩充方面的投入规模，也在一定程度上影响了公司把握市场机遇、拓展业务布局的灵活性，可能会对公司未来的持续快速发展形成一定挑战。

（2）经营规模相对较小

公司历经多年发展，已形成了较强的技术竞争力、品牌影响力与客户积淀，但相对于国内外行业龙头企业及国内已上市的同行业头部企业，公司目前聚焦于自身核心技术优势领域，整体经营规模仍然较小，但在细分方向具备较强的技术积累与专业化竞争优势。随着下游行业市场需求持续扩容，为增强抗风险能力、提升在重大项目中的综合竞争能力，公司经营规模有待进一步提高，为后续发展奠定更坚实的基础。

6、与同行业可比公司的比较情况

（1）选取同行业可比公司的依据及可比程度

公司专注于高纯工艺介质系统与高阶湿制程工艺设备的研发、设计、生产与销售，主要产品包括高纯工艺介质系统、高阶湿制程工艺设备两大品类，其中高纯工艺介质系统又分为自动化化学品与研磨液供应系统、电子级化学品纯化及分装系统及废化学品再生系统。考虑到信息的可获取性，并结合产品结构、产品功能、客户类型等因素综合考量，公司选取正帆科技、至纯科技作为高纯工艺介质系统业务的可比公司，选取至纯科技作为高阶湿制程工艺设备业务的可比公司。

公司名称	可比业务类型	主要可比产品类型
正帆科技 688596.SH	正帆科技的设备类（CAPEX）业务主要提供制程关键系统与装备，根据服务客户所处下游行业的不同主要分为电子工艺设备和生物制药设备两大类。 其中电子工艺装备主要应用于半导体和泛半导体行业，包括高纯气体和湿化学品供应系统（简称：高纯介质供应系统）、LDS 输送系统，同时提供 Scrubber（半导体工艺尾气处理设备）、Chiller（半导体精确温控设备）。	湿化学品供应系统
至纯科技 603690.SH	至纯科技为集成电路制造企业及泛半导体产业提供高纯工艺系统的设计、安装、测试调试服务。在集成电路领域，高纯工艺系统主要包括高纯特气系统、大宗气体系统、高纯化学品系统、研磨液供应及回收系统、前驱体工艺介质系统等。 至纯科技旗下至微科技是国内湿法设备主要供应商之一，提供湿法清洗设备，包括湿法槽式清洗设备及湿法单片式清洗设备。	高纯化学品系统、研磨液供应及回收系统；湿法槽式清洗设备、湿法单片式清洗设备

注：上述资料来源于公开披露信息或官方网站，与公司主要可比产品类型以各同行业公司披露的名称列示。

（2）与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面对比

①经营情况与核心财务指标对比

公司与同行业可比公司在营业收入、归属于母公司股东的净利润、毛利率、资产周转指标、偿债指标等关键财务指标上的对比情况详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”。

②市场地位、技术实力、核心竞争力对比

公司与同行业可比公司在市场地位、技术实力、核心竞争力方面的对比如下：

公司名称	市场地位	技术实力	核心竞争力
正帆科技 688596.SH	正帆科技是国内泛半导体行业综合服务领域的第一梯队供应商，其高纯介质供应系统在国内处于领先地位，已经完全具备与国际一流供应商同台竞争的能力，长期服务国内包括中芯国际、长江存储、长鑫、京东方、华灿、晶科、隆基等在内的头部泛半导体行业客户。	正帆科技经过自主研发，围绕下游行业对电子特种气体和化学品的使用需求，形成了六项底层核心技术，即介质供应系统微污染控制技术、流体系统设计与模拟仿真技术、生命安全保障与工艺监控技术、高纯材料合成与分离提纯技术、材料成分分析与痕量检测技术以及关键工艺材料再生与循环技术。截至 2025 年 12 月 31 日，已获得知识产权数量合计 560 项，其中发明专利 107 项，实用新型专利 339 项，外观专利 29 项，软件著作权 85 项。	制程关键系统、核心工艺材料和专业运维管理“三位一体”的特有商业模式；同源技术外溢带来多行业市场应用，并不断获取新技术的优势；同时，正帆科技具备流体系统设计和仿真技术、先进材料的合成与提纯技术，是多年来形成的核心技术；员工激励机制助推高潜质人才快速成长。
至纯科技 603690.SH	至纯科技在高纯领域具备领先地位，核心客户均为行业一线集成电路制造企业如中芯国际、华虹公司、上海华力、长江存储、长鑫科技、士兰微	至纯科技积累了深厚的技术储备，始终沿着国内先进制造业的发展方向，持续高水平的研发投入，追踪最新的技术趋势和客户需求进	经过二十多年的发展，至纯科技已从最初的高纯工艺系统集成服务商，演进为能够为晶圆制造客户提供“工艺—设备—材料”一体化解决方案的综合

	等。 至纯科技旗下至微科技是国内湿法设备主要供应商之一，先。核心客户均为行业一线集成电路制造企业如中芯国际、华虹公司、长鑫科技、燕东微、润鹏半导体以及 H 系等。	行产品开发和优化。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已授权专利 679 件（其中中国发明授权 224 件，涉外发明授权 12 件），软件著作权 208 件，注册商标 163 件。	性服务商。其核心竞争力并非来自单一产品或技术的领先，而是源于战略布局的前瞻性、客户资源的深厚积累以及核心技术能力圈的持续扩展三者之间形成的协同效应。这种系统性竞争优势，使至纯科技能够在半导体产业的不同周期阶段保持相对稳定的业务贡献，并持续受益于国产替代与产业链自主可控的时代趋势。
冠礼科技	公司是国内液态化学品供应系统领域的领先企业，凭借成熟的技术方案与稳定的产品交付能力，相关设备已成功应用于中芯国际、华虹半导体、合肥晶合、长江存储、长鑫存储等国内头部企业，以及住友化学等国际知名企业，是国内少数能为先进制程半导体产线提供自动化化学品与研磨液供应系统的供应商之一。	公司致力于通过多学科融合构建覆盖化学品全生命周期管理的技术体系。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已获得发明专利 64 项，实用新型专利 112 项、外观设计专利 18 项，并拥有计算机软件著作权 51 项，为业务持续拓展奠定了坚实的技术基础。	公司深耕高纯工艺介质系统领域二十余年，核心产品技术性能已达行业领先水平；客户覆盖国内外龙头企业，业绩增长路径清晰；积累了丰富的行业项目经验，形成良性发展循环；供应链整合、成本管控等管理能力突出，构筑了坚实的核心竞争力与可持续发展动力。

（八）行业周期性特征

公司所处半导体设备行业是典型的技术密集型产业，其发展既受技术创新驱动，也受下游市场需求周期影响。随着制程微缩、先进封装、新材料应用等技术持续突破，以及人工智能、高性能计算、汽车电子等新兴应用快速发展，全球半导体产业长期保持向前发展的趋势，并持续推动设备技术迭代与需求升级。

与此同时，半导体设备行业亦呈现出与宏观经济、地缘政治、下游需求、技术迭代高度相关的周期性波动特征。宏观经济走势奠定行业整体需求基调，经济上行期企业资本开支意愿增强，衰退期则会收缩设备投资；地缘政治冲突会进一步加剧全球供应链格局的区域性重构；下游需求的繁荣与低迷直接导致晶圆厂扩产或减产决策，进而影响设备采购需求；技术迭代则主导着周期特征的转变，行业正从依赖产能扩张的强周期模式，向结构性成长逐步转型。

（九）行业面临的机遇与风险及上述情况变化趋势

1、行业面临的机遇

（1）全球产业链重构与国内政策扶持双重驱动

近年来，在地缘政治冲突加剧与全球贸易保护主义抬头的背景下，半导体产业链正处于加速重构阶段。美国强化技术管制，欧盟聚力本土生态，日本重金布局 AI 与先进制程，上述政策共同推动全球半导体产业从全球化分工转向区域化

布局。全球产业链格局的变化，使得供应链安全成为中国半导体产业发展的战略考量，相关企业对核心设备、配套系统的国产替代需求，从过往的降本备选升级为保障供应链长期稳定的刚性需求。为应对由此带来的机遇与挑战，保障以集成电路为主导的半导体产业链供应链自主可控，国家从顶层战略设计到细分领域落地，出台了一系列支持性专项政策。

2025 年 12 月召开的全国工业和信息化工作会议明确将“打造集成电路、新型显示、新材料等新兴支柱产业”列为 2026 年重点工作，并提出支持人工智能攻关、推进“人工智能+制造”专项行动等具体举措。此前，第十三届全国人民代表大会第四次会议表决通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，将集成电路列为科技前沿领域攻关重点，明确提出补齐芯片、核心元器件等产业链短板，提升产业链供应链自主可控能力。面向“十五五”时期，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》进一步提出，“全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破”，为产业向高质量发展迈进指明了方向。此外，国家通过财税优惠、产业资本投入及项目资金引导等多维度政策工具，持续落实研发费用加计扣除等优惠政策，通过战略增资助力国产企业技术研发与产能扩张。

上述政策形成了从战略引导到市场应用的完整扶持体系，为公司所处行业提供了长期稳定的发展空间，也为具备核心技术、成熟项目交付能力与头部客户资源的本土企业创造了加速实现国产替代突破的良好发展机遇。

（2）技术迭代与市场需求双向驱动

公司所处行业受技术迭代与市场需求的双向驱动影响，形成技术突破打开需求边界、需求扩容驱动技术升级的增长格局，使行业迎来双重发展机遇。

一方面，AI 芯片、先进制程、3D NAND 及 HBM 存储等前沿技术的加速突破，对半导体制造提出了前所未有的严苛要求，不仅催生了存量产线的大规模技改替换需求，更推动新建产线采用更高标准的系统方案，为行业发展打开增长空间；另一方面，全球晶圆产能扩张为行业带来确定性增长红利。根据 SEMI 预测数据，2026 年至 2028 年全球 12 英寸晶圆厂设备支出总额将达 3,740 亿美元，其

中中国大陆以 940 亿美元的投资规模持续领跑。同时，显示面板、光伏、新能源电池等细分行业加速高端化制造升级，也创造了跨应用领域的增量市场空间。市场的需求升级还为国产设备提供了清晰的研发导向，并提供充足的量产落地与工艺验证场景，持续推动行业技术体系优化与产品性能提升，形成双向促进的良性循环。

2、行业面临的风险

（1）行业周期性波动风险

公司所处行业具有显著的周期性特征，其景气度受宏观经济环境、地缘政治格局、终端消费需求及技术迭代节奏等多重因素综合影响，行业规模与下游集成电路及其他泛半导体制造企业的资本开支节奏高度相关。

当进入下行周期时，终端市场需求萎缩，下游行业客户普遍缩减、暂缓甚至取消资本开支计划，将直接减少行业内企业的订单获取机会，同时可能伴随产能利用率下滑、议价能力减弱、盈利水平承压等问题。此外，下行周期中行业内的竞争格局将加剧分化，对行业内企业的经营稳定性将造成不利影响，对企业的抗风险能力构成系统性考验。

（2）地缘政治风险

公司所处半导体设备行业产业链上游，关键零部件有较高比例来源于进口，其中耐腐蚀阀门、精密泵体、高精度过滤器等品类，主要供应商均为欧美日等国的龙头企业。若全球地缘政治冲突持续加剧，海外国家或地区出台或升级出口管制、贸易壁垒等限制性措施，将可能导致相关零部件出现供应中断、采购周期延长、采购成本上涨等情况，直接影响行业内企业的正常生产交付节奏与盈利水平。与此同时，全球贸易争端持续升级，也会对行业内企业的全球化市场布局、国际客户供应链体系切入形成阻碍，带来市场拓展不及预期的相关风险。

（3）技术迭代不及预期的风险

半导体制造领域技术迭代快，相关行业具备技术密集、研发投入力度大、下游工艺适配要求严苛、产品验证周期长的显著特征。随着制程缩短、封装演进及配套技术的更新，下游客户对其配套设备的加工精度、过程控制、运行稳定性与良率保障水平的要求持续升级，行业内企业需持续投入大量资金用于前沿技术攻

关、产品迭代与工艺适配，方能紧跟产业升级节奏，保持市场竞争力。若企业对技术路线判断失误、核心攻关不及预期或研发成果无法适配下游工艺，将导致产品竞争力弱化，前期投入难以实现回报，错失市场机遇，进而对企业的持续经营与长期发展产生不利影响。

3、上述情况的变化趋势

公司所属细分行业的技术水平及特点、进入本行业主要壁垒、行业发展态势、面临机遇与风险、行业周期性特征，在报告期内未发生重大变化。随着公司产品技术水平的提高和市场地位的提升，将进一步强化公司的竞争优势，同时公司也在积极加强产品研发、市场开拓和完善融资渠道，弥补自身的竞争劣势。

三、发行人销售情况及主要客户

（一）主要产品的销售收入

报告期内，公司主营业务收入按照产品类别划分情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
高纯工艺介质系统	123,148.90	93.45%	123,561.78	97.35%	80,085.06	95.38%
高阶湿制程工艺设备	6,808.41	5.17%	1,543.05	1.22%	2,680.93	3.19%
其他	1,819.45	1.38%	1,816.93	1.43%	1,202.39	1.43%
合计	**131,776.76**	**100.00%**	**126,921.76**	**100.00%**	**83,968.39**	**100.00%**

注：其他主要系相关设备的维保及全面质量管理协议服务。

（二）主要产品的规模

报告期内，公司所从事的高纯工艺介质系统业务、高阶湿制程工艺设备业务均具备显著的非标准化特征，基于下游不同行业客户的需求，各项目中系统、设备配置存在较大差异，不适用于传统的产能、产量与销量的量化概念。

公司产品生产过程主要包括设备外壳制作、管路组装、电控组装、设备气密性测试、设备仪电测试及全流程质量检验，非由流水线批量生产。公司可结合项目需求、生产周期、作业状态等灵活调整生产人员的工时投入，整体产能具备较强的弹性。

报告期内，公司主要产品的产销率为 100%。公司采用以销定产的生产模式，以项目为单位组织生产、并完成整体交付与验收。报告期内，公司产品完工交付后不存在因验收不合格退换货的情形，因此产量与销量一致。

（三）销售价格的总体变动情况

报告期内，公司主要产品为高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备，销售价格受客户差异化需求、项目复杂程度等诸多因素影响，各项目间的销售价格不具备可比性。

（四）报告期各期的前五名客户

报告期内，公司对前五名客户的销售情况如下：

单位：万元

年度	序号	客户名称	销售内容	销售金额	占营业收入比例
2025 年度	1	公司 B	高纯工艺介质系统	24,376.08	18.32%
	2	公司 C	高纯工艺介质系统	20,219.42	15.20%
	3	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	高纯工艺介质系统	15,227.40	11.45%
	4	公司 D	高纯工艺介质系统	8,687.02	6.53%
	5	SCES Pte. Ltd.	高纯工艺介质系统	6,755.61	5.08%
	合计			**75,265.54**	**56.58%**
2024 年度	1	公司 E	高纯工艺介质系统	27,434.14	21.40%
	2	杭州积海半导体有限公司	高纯工艺介质系统	11,000.00	8.58%
	3	SCES Pte. Ltd.	高纯工艺介质系统	10,395.62	8.11%
	4	深圳市新凯来技术有限公司	高纯工艺介质系统	8,672.57	6.77%
	5	中国电子工程设计院股份有限公司	高纯工艺介质系统	7,900.74	6.16%
	合计			**65,403.07**	**51.03%**
2023 年度	1	TCL 科技	高纯工艺介质系统	14,831.41	17.59%
	2	中国电子工程设计院股份有限公司	高纯工艺介质系统	12,229.73	14.51%
	3	中芯国际	高纯工艺介质系统	7,600.46	9.02%
	4	德尔科技	高纯工艺介质系统	6,629.29	7.86%
	5	公司 F	高纯工艺介质系统	5,805.84	6.89%

	合计	**47,096.74**	**55.86%**

注：受同一实际控制人控制的客户，已合并计算销售额。

2024 年度，公司新增前五大客户为公司 E、杭州积海半导体有限公司、SCES Pte. Ltd.、深圳市新凯来技术有限公司；2025 年度，公司新增前五大客户为公司 B、公司 C、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、公司 D。报告期内，公司致力于产品性能迭代与全流程服务升级，市场知名度稳步提升，成功开发多家新客户并实现产品交付，存量客户对公司产品认可度亦持续加深，年采购规模持续增长。前述新增前五大客户的简要情况如下：

客户名称（同一控制口径）	客户名称（单体口径）	成立时间	开始合作时间	股权结构
公司 B	公司 B-1	具体情况已申请信息豁免		
	公司 B-2	具体情况已申请信息豁免		
公司 C	公司 C	具体情况已申请信息豁免		
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1993 年	2017 年	无锡市太极实业股份有限公司 99.6751%，其他股东 0.3249%。
公司 D	公司 D	具体情况已申请信息豁免		
公司 E	公司 E-1	具体情况已申请信息豁免		
	公司 E-2	具体情况已申请信息豁免		
	公司 E-3	具体情况已申请信息豁免		
	公司 E-4	具体情况已申请信息豁免		
杭州积海半导体有限公司	杭州积海半导体有限公司	2019 年	2023 年	杭州储邦汉望信息科技合伙企业（有限合伙）54.2663%，杭州和达金智创业投资合伙企业（有限合伙）45.7337%。
SCES Pte. Ltd.	SCES Pte. Ltd.	2010 年	2012 年	JFE PLANT TECHNOLOGY CO., LTD.100.00%。
深圳市新凯来技术有限公司	深圳市新凯来工业机器有限公司	2022 年	2024 年	深圳市新凯来技术有限公司 95.6522%，其他股东 4.3478%。
	珠海基石科技有限公司	2022 年	2023 年	深圳市新凯来技术有限公司 100.00%。

报告期内，公司不存在向单个客户销售金额超过销售总额的 50%或严重依赖少数客户的情形；公司董事、取消监事会前任职监事、高级管理人员和核心技术人员及其主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中未占有权益。

四、发行人采购情况及主要供应商

（一）主要原材料、劳务分包采购情况

报告期内，公司采购内容主要包括原材料及劳务分包。原材料种类繁多，包括专用部件（如过滤器、泵浦、桶槽等）、管件类、阀件类、仪器仪表类、电气控制类、结构类及其他；劳务分包主要为设备及管件的安装。

报告期各期，公司原材料及劳务分包的采购情况如下：

单位：万元

采购类别	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	**28,202.76**	**71.61%**	**63,124.17**	**79.08%**	**87,474.38**	**90.51%**
专用部件	9,961.15	25.29%	23,189.67	29.05%	31,416.98	32.51%
管件类	5,810.56	14.75%	14,063.82	17.62%	18,679.53	19.33%
阀件类	3,303.59	8.39%	9,555.56	11.97%	14,636.96	15.15%
仪器仪表类	3,708.83	9.42%	6,899.48	8.64%	7,843.45	8.12%
电气控制类	1,577.44	4.01%	4,100.43	5.14%	8,162.97	8.45%
结构类	1,518.74	3.86%	2,395.46	3.00%	3,223.16	3.34%
其他	2,322.45	5.90%	2,919.74	3.66%	3,511.34	3.63%
劳务分包	**11,179.88**	**28.39%**	**16,704.00**	**20.92%**	**9,170.53**	**9.49%**
合计	**39,382.64**	**100.00%**	**79,828.18**	**100.00%**	**96,644.91**	**100.00%**

公司主要产品为高纯工艺介质系统与高阶湿制程工艺设备，其生产过程具备显著的非标准化特征，因此公司采用以产定购为主、策略储备为辅的混合采购模式匹配生产所需。2023 年度及 2024 年度，公司采购金额相对较高，主要系受前期原材料到货周期变长、交期不确定性变高等因素影响，为保障在手订单及预期意向订单的顺利执行与交付，进行了策略性备货。

报告期各期，公司主要原材料类别如专用部件、管件类的采购占比保持相对稳定，其他原材料类别的占比存在小幅波动，主要系公司基于备货类型及下游客户差异化需求对采购结构进行动态调整。公司所采购各类原材料根据其品牌、功能、材质、尺寸等因素分为多种型号，不同型号间价格差异较大，加总统计单类

平均价格难以体现报告期内的变动趋势。

（二）主要能源采购情况

公司主要耗用能源为电、水，报告期内能源采购情况如下：

单位：万元、元/度、元/吨

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	单价	金额	单价	金额	单价
电	83.16	0.95	93.79	0.94	76.81	0.92
水	1.62	6.99	2.03	12.94	1.46	10.16

报告期内，公司电力采购单价相对稳定；2025 年度公司用水单价有所下降，主要系当期与污水处理相关的固定水费有所下降。

（三）报告期内前五名供应商

报告期内，公司主要采购内容包括原材料采购及劳务分包采购，向前五名供应商的采购情况如下：

单位：万元

年度	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占采购总额的比例
2025 年度	1	上海天德建设（集团）有限公司	安装工程服务	3,734.04	9.48%
	2	应特格（上海）微电子贸易有限公司	管件类、阀件类、专用部件（过滤器）	3,264.24	8.29%
	3	上品兴业氟塑料（嘉兴）有限公司	专用部件（桶槽）	3,121.21	7.93%
	4	上海德清建设集团有限公司	安装工程服务	2,929.61	7.44%
	5	苏州敏之熠	安装工程服务、管件类	1,114.07	2.83%
	合计			**14,163.17**	**35.96%**
2024 年度	1	上品兴业氟塑料（嘉兴）有限公司	专用部件（桶槽）	8,375.14	10.49%
	2	应特格（上海）微电子贸易有限公司	管件类、阀件类、专用部件（过滤器）	6,707.25	8.40%
	3	上海宇灿国际贸易有限公司	专用部件（泵浦）	5,463.52	6.84%
	4	上海德清建设集团有限公司	安装工程服务	5,229.56	6.55%
	5	苏州敏之熠	安装工程服务、管件类	4,086.67	5.12%
	合计			**29,862.14**	**37.41%**
2023 年度	1	上海宇灿国际贸易有限公司	专用部件（泵浦）	10,126.56	10.48%

	2	应特格（上海）微电子贸易有限公司	管件类、阀件类、专用部件（过滤器）	9,460.80	9.79%
	3	上品兴业氟塑料（嘉兴）有限公司	专用部件（桶槽）	8,929.21	9.24%
	4	益章自动化科技（上海）有限公司	电气控制类	3,820.04	3.95%
	5	喜开理（上海）机器有限公司	阀件类	3,506.76	3.63%
	合计			**35,843.36**	**37.09%**

注：苏州敏之熠包括苏州敏之熠系统集成有限公司、马鞍山柘和科技工程有限公司。

2024 年度，公司新增前五大供应商为上海德清建设集团有限公司与苏州敏之熠；2025 年度，公司新增前五大供应商为上海天德建设（集团）有限公司。前述供应商的简要情况如下：

供应商名称	成立时间	开始合作时间	股权结构
上海天德建设（集团）有限公司	1999 年	2018 年	戴腊生 99.50%，孙建伟 0.50%
上海德清建设集团有限公司	2005 年	2014 年	夏小清 38.14%，夏艳 32.37%，施兰芬 29.49%
苏州敏之熠系统集成有限公司	2020 年	2022 年	马鞍山柘和科技工程有限公司 95.00%，冯乐 5.00%
马鞍山柘和科技工程有限公司	2013 年	2014 年	JH INTERNATIONAL CO.,LTD.100.00%

报告期内，公司不存在对单个供应商的采购比例超过采购总额 50%的情形；公司的董事、取消监事会前任职监事、高级管理人员、核心技术人员及其主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中亦不占有任何权益。

（四）委外加工情况

公司委外加工的主要内容为外壳组装，该工序属于生产环节中的辅助工序，不涉及公司核心技术或生产工艺。目前，行业内具备对应加工能力的厂商众多，市场竞争充分，可替代性较强。报告期内，公司委外加工的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
委外加工费	109.16	363.25	274.76
主营业务成本	93,685.19	86,492.60	63,553.60
占比	**0.12%**	**0.42%**	**0.43%**

报告期各期，公司委外加工金额分别为 274.76 万元、363.25 万元和 109.16 万元，占主营业务成本比例较低。

五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产

（一）固定资产总体情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司固定资产总体情况如下所示：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
机器设备	2,655.69	1,405.33	1,250.36	47.08%
运输设备	109.77	76.43	33.35	30.38%
办公设备	172.83	112.02	60.82	35.19%
电子设备	649.84	414.44	235.40	36.22%
合计	**3,588.14**	**2,008.21**	**1,579.93**	**44.03%**

（二）主要生产设备

公司主要生产设备可分为原材料预处理设备、设备外壳与管路组装用机具、电气装配与辅助加工、测试用工具以及质量检测设备等。截至 2025 年 12 月 31 日，公司机器设备原值总计 2,655.69 万元，账面价值 1,250.36 万元，成新率 47.08%。

（三）土地使用权

截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有自有土地使用权 1 处，具体情况如下：

使用权人	权证号	坐落位置	面积（㎡）	用途	取得方式	使用终止期限	权利限制
冠礼科技	苏（2024）苏州市不动产权第 5015067 号	高新区浒墅关经开区文昌路东、312 国道绿化地北	16,586.70	工业用地	出让	2074 年 6 月 6 日	无

（四）房屋建筑物

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司无自有房屋建筑物，承租用于生产经营的主要房屋建筑物具体情况如下：

序号	承租方	出租方	地址	租赁用途	租赁面积（㎡）	租赁期限
1	冠礼科技	圣晖系统集成集团股份有限公司	苏州市浒关经济开发区石林路 189 号一期厂房	生产、办公	4,182.00	2023 年 5 月 1 日至 2028 年 4 月 30 日
2	冠礼科技	圣晖系统集成集团股份有限公司	苏州市浒关经济开发区石林路 189 号 4 幢一层	仓储	2,192.00	2025 年 7 月 16 日至 2026 年 7 月 15 日
3	冠礼科技	苏州高新区国	苏州市高新区浒关	仓储	5,120.00	2024 年 7 月 16

		华工贸有限公司	经开区观山路 9 号 1 幢一楼			日至 2026 年 7 月 15 日
4	冠礼科技	苏州富达机械有限公司	苏州市吴中区光福工业园北区 10，20 幢	仓储	960.00	2025 年 12 月 25 日至 2026 年.6 月 24 日
5	上海冠礼	上海外高桥保税区联合发展有限公司	中国（上海）自由贸易试验区荷丹路 126 号一层	仓储	1,247.30	2024 年 4 月 1 日至 2029 年 3 月 31 日
6	上海冠礼	上海华虹置业有限公司	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 34 号 10 层	办公	1,215.03	2025 年 5 月 1 日至 2028 年 4 月 30 日
7	新加坡冠礼	Wiz Investment Pte. Ltd.	1 Pemimpin Drive #08-09 One Pemimpin Singapore 576151	仓储、办公	106.00	2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
8	新加坡冠礼	Aero Technology Pte. Ltd.	280 Woodlands Industrial Park E5 #08-37 Harvest @Woodlands Singapore 757322	办公	177.00	2024 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日

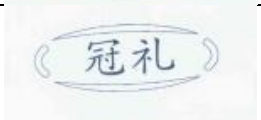
（五）专利

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有发明专利 64 项，实用新型专利 112 项，外观设计专利 18 项，具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件八：专利清单”。公司所拥有专利权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

（六）商标

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有商标情况如下：

序号	申请人	商标名称	注册号	分类	有效期	取得方式
1	冠礼科技	冠礼科技	76252059	7	2024 年 6 月 28 日至 2034 年 6 月 27 日	继受取得
2	冠礼科技	冠礼科技	76245173	40	2024 年 6 月 28 日至 2034 年 6 月 27 日	继受取得
3	冠礼科技	冠礼科技	76261732	42	2024 年 6 月 28 日至 2034 年 6 月 27 日	继受取得
4	冠礼科技	冠礼 科技	76247010	7	2024 年 6 月 28 日至 2034 年 6 月 27 日	继受取得
5	冠礼科技	冠礼 科技	76240973	40	2024 年 6 月 28 日至 2034 年 6 月 27 日	继受取得
6	冠礼科技	冠礼 科技	76261811	42	2024 年 6 月 28 日至 2034 年 6 月 27 日	继受取得
7	冠礼科技	Winmax	76252445	7	2024 年 9 月 7 日至 2034 年 9 月 6 日	继受取得

8	冠礼科技		76260287	7	2024 年 9 月 7 日至 2034 年 9 月 6 日	继受取得
9	冠礼科技		11703127	7	2014 年 7 月 28 日至 2034 年 7 月 27 日	继受取得
10	冠礼科技		11703131	7	2014 年 4 月 14 日至 2034 年 4 月 13 日	继受取得
11	冠礼科技		11703123	7	2014 年 7 月 14 日至 2034 年 7 月 13 日	继受取得
12	上海冠礼		11703132	6	2014 年 4 月 14 日至 2034 年 4 月 13 日	原始取得
13	上海冠礼		11703130	9	2014 年 5 月 14 日至 2034 年 5 月 13 日	原始取得
14	上海冠礼		11824232	39	2014 年 5 月 14 日至 2034 年 5 月 13 日	原始取得
15	上海冠礼		11703128	6	2014 年 4 月 14 日至 2034 年 4 月 13 日	原始取得
16	上海冠礼		11703125	39	2014 年 4 月 14 日至 2034 年 4 月 13 日	原始取得
17	上海冠礼		11703124	6	2014 年 4 月 7 日至 2034 年 4 月 6 日	原始取得
18	上海冠礼		11824231	39	2014 年 5 月 14 日至 2034 年 5 月 13 日	原始取得
19	新加坡冠礼		40202125581P	37,42	2021 年 10 月 25 日至 2031 年 10 月 25 日	原始取得

以上商标不存在他项权利。

（七）软件著作权

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有软件著作权 51 项，具体情况如下：

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
1	冠礼科技	冠博研磨液供应系统 S088 设备控制系统应用软件 V1-0	2021SR0095547	2021 年 1 月 18 日	原始取得
2	冠礼科技	冠博交替式纯水高压喷雾清洗设备控制软件 V1-0	2021SR1939634	2021 年 11 月 30 日	原始取得

3	冠礼科技	冠博阵列显影液浓度控制系统应用软件 V1.0	2021SR1939726	2021 年 11 月 30 日	原始取得
4	冠礼科技	冠博阵列显影液浓度稀释系统应用软件 V1-0	2021SR1939633	2021 年 11 月 30 日	原始取得
5	冠礼科技	冠博全自动单片去胶清洗设备控制系统应用软件	2022SR1197155	2022 年 8 月 19 日	原始取得
6	冠礼科技	冠礼科技基于自研 MarangoniDryer 机台的控制软件 V1.033	2023SR1226299	2023 年 10 月 12 日	原始取得
7	冠礼科技	冠礼科技槽式自动清洗机控制软件 V1.03	2023SR1221696	2023 年 10 月 12 日	原始取得
8	冠礼科技	冠礼科技 Socket 机械手控制软件 V1.0	2023SR1216118	2023 年 10 月 11 日	原始取得
9	冠礼科技	冠礼科技 PA/Chiller 远程控制软件 V1.0	2024SR0126286	2024 年 1 月 18 日	原始取得
10	冠礼科技	冠礼科技监控机台模拟量数据软件 V1.03	2024SR0364313	2024 年 3 月 7 日	原始取得
11	冠礼科技	冠礼科技自研 UBM 单腔测试平台控制系统应用软件 V1.01	2024SR0360542	2024 年 3 月 7 日	原始取得
12	冠礼科技	冠礼科技单片清洗机图表数据监测软件 V1.37	2024SR0778818	2024 年 6 月 7 日	原始取得
13	冠礼科技	冠礼科技基于自研 SPM 机台的控制系统应用软件 V1.03	2024SR0931340	2024 年 7 月 4 日	原始取得
14	冠礼科技	冠礼科技高压单片清洗机 PC 控制软件 V1.0	2024SR0989572	2024 年 7 月 12 日	原始取得
15	冠礼科技	冠礼科技自研图表自动化系统应用软件 V1.03	2024SR1281348	2024 年 8 月 30 日	原始取得
16	冠礼科技	冠礼科技手动 6 腔酸洗机台控制系统应用软件 V1.01	2024SR1251904	2024 年 8 月 27 日	原始取得
17	冠礼科技	冠礼科技 4 腔双 Robot 晶圆清洗机控制软件 V1.00	2024SR1278998	2024 年 8 月 30 日	原始取得
18	冠礼科技	冠礼科技冷水机智能控制软件【简称：冷机智控】V1.00	2025SR0071913	2025 年 1 月 13 日	原始取得
19	冠礼科技	冠礼科技全自动 4C 铜钛刻蚀设备控制软件 V1.00	2025SR0717672	2025 年 4 月 30 日	原始取得
20	冠礼科技	冠礼科技全自动单腔钯金刻蚀设备控制软件 V1.00	2025SR0728495	2025 年 5 月 6 日	原始取得
21	冠礼科技	冠礼科技关于 Single 机型配方变更系统应用软件 V1.01	2025SR0819538	2025 年 5 月 20 日	原始取得
22	冠礼科技	冠礼科技多组双槽半自动机台控制软件 V1.0	2025SR0815616	2025 年 5 月 19 日	原始取得
23	冠礼科技	冠礼科技基于自研 RCA-1 机台的控制系统应用软件 V1.03	2025SR0809894	2025 年 5 月 19 日	原始取得
24	冠礼科技	冠礼科技基于自研 RCA-2 机台的控制系统应用软件 V1.03	2025SR0808597	2025 年 5 月 19 日	原始取得
25	冠礼科技	冠礼科技 UBM 工艺数据可视化分析软件 V1.0	2025SR0808579	2025 年 5 月 19 日	原始取得
26	冠礼科技	冠礼科技基于 SECS/GEM 标准的单片清洗机控制程序和监视系统应用软件 V1.0	2025SR0831243	2025 年 5 月 21 日	原始取得
27	冠礼科技	冠礼科技自研金属有机蚀刻机台的控制系统应用软件 V1.04	2025SR0842206	2025 年 5 月 22 日	原始取得
28	冠礼科技	冠礼科技半自动湿法蚀刻和清洗整机控制系统应用软件	2025SR1242015	2025 年 7 月 14 日	原始取得

		V1.01			
29	冠礼科技	冠礼科技全自动槽式去胶系统应用软件 V1.0.0	2025SR1538476	2025 年 8 月 14 日	原始取得
30	苏州冠礼	冠礼科技 FortrendSMIF 控制软件 V1.00	2025SR2546292	2025 年 12 月 31 日	原始取得
31	苏州冠礼	冠礼科技 FortrendRobot 控制软件 V1.00	2025SR2546338	2025 年 12 月 31 日	原始取得
32	上海冠礼	化学品供应系统 H2SO4 设备控制系统	2012SR059743	2012 年 7 月 5 日	原始取得
33	上海冠礼	气瓶柜控制系统	2012SR059443	2012 年 7 月 4 日	原始取得
34	上海冠礼	化学品供应系统 HCL 设备控制系统	2012SR060511	2012 年 7 月 6 日	原始取得
35	上海冠礼	化学品供应系统 Oxide 设备控制系统	2012SR059917	2012 年 7 月 5 日	原始取得
36	上海冠礼	化学品供应系统 W2000 设备控制系统	2012SR059376	2012 年 7 月 4 日	原始取得
37	上海冠礼	清洗机设备控制系统	2012SR059388	2012 年 7 月 4 日	原始取得
38	上海冠礼	冠礼湿制程设备条形码管理系统应用软件 V1-0	2019SR1100539	2019 年 3 月 19 日	原始取得
39	上海冠礼	冠礼槽式清洗设备控制系统应用软件 V1-0	2021SR1625164	2021 年 11 月 3 日	原始取得
40	上海冠礼	冠礼高纯度气体灌装系统应用软件 V1-0	2022SR1232308	2022 年 8 月 23 日	原始取得
41	上海冠礼	冠礼高洁净度清洗及干燥一体汲管自动清洗设备控制软件 V1-0	2022SR1097829	2022 年 8 月 11 日	原始取得
42	上海冠礼	冠礼无人值守全自动充填设备控制系统应用软件 V1-0	2022SR1232309	2022 年 8 月 23 日	原始取得
43	上海冠礼	冠礼 PLC 标签数据通信控制软件 V1.00	2024SR1280850	2024 年 8 月 30 日	原始取得
44	上海冠礼	冠礼 CDS 设备输送管路中药液品质（微粒子）监控系统应用软件 V1.0	2024SR2093287	2024 年 12 月 16 日	原始取得
45	上海冠礼	冠礼多秤心静态重量测量及失效自诊断系统应用软件【简称：电子秤配置软件】V1.0	2025SR0120398	2025 年 1 月 17 日	原始取得
46	上海冠礼	冠礼 Develop 显影设备控制软件 V1.00	2025SR0063218	2025 年 1 月 10 日	原始取得
47	上海冠礼	冠礼 WireSaw 切磨液砂浆收集系统应用软件 V1.0	2025SR0180719	2025 年 1 月 26 日	原始取得
48	上海冠礼	冠礼物料自动识别系统应用软件 V1.0	2025SR0185264	2025 年 1 月 27 日	原始取得
49	上海冠礼	冠礼四腔湿法显影机台控制系统应用软件 V1.01	2025SR0752068	2025 年 5 月 9 日	原始取得
50	上海冠礼	冠礼 CMP 研磨液原液桶翻转摇匀控制系统应用软件 V1.0	2025SR1489632	2025 年 8 月 8 日	原始取得
51	上海冠礼	冠礼基于数据处理的智能化报表系统应用软件 V1.0	2025SR1857332	2025 年 9 月 24 日	原始取得

以上软件著作权不存在他项权利。

（八）域名

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有域名 3 项，具体情况如下：

域名	域名所有人	注册时间	到期时间
winmaxtech.com	上海冠礼	2005 年 2 月 23 日	2034 年 2 月 23 日
winmaxhub.com	冠礼科技	2023 年 9 月 5 日	2033 年 9 月 5 日
winmaxsystem.com	冠礼科技	2023 年 9 月 5 日	2033 年 9 月 5 日

（九）资质及认证

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有的主要资质及认证情况如下：

1、生产经营资质

序号	持证主体	资质证书名称	编号	发证机关	有效期
1	冠礼科技	建筑业企业资质证书（施工劳务）	DW332200648	苏州市数据局	2025 年 10 月 30 日至 2026 年 10 月 9 日
2	冠礼科技	建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程）	D232654452	江苏省住房和城乡建设厅	2025 年 10 月 30 日至 2030 年 6 月 11 日
3	冠礼科技	安全生产许可证	（苏）JZ 安许证字[2023]008063	江苏省住房和城乡建设厅	2023 年 8 月 23 日至 2026 年 8 月 22 日
4	冠礼科技	特种设备生产许可证（GC2）	TS3832B87-2027	江苏省市场监督管理局	2023 年 9 月 26 日至 2027 年 9 月 25 日
5	冠礼科技	防爆合格证	GYB22.3923X	上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司、国家级仪器仪表防爆安全监督检查站	2022 年 12 月 21 日至 2027 年 12 月 20 日
6	冠礼科技	固定污染源排污登记回执	91320505MA1MLNJ23W001W	全国排污许可证管理信息平台（环境资源部）	2026 年 1 月 19 日至 2031 年 1 月 18 日
7	冠礼科技	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3205343463	苏州海关	2018 年 4 月 20 日至长期
8	上海冠礼	建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程、施工劳务）	D231851468	上海市住房和城乡建设管理委员会	2024 年 6 月 14 日至 2029 年 6 月 3 日
9	上海冠礼	安全生产许可证	（沪）JZ 安许证字[2024]021923	上海市住房和城乡建设管理委员会	2024 年 8 月 8 日至 2027 年 8 月 7 日
10	上海冠礼	特种设备生产许可证（GC2）	TS3831074-2028	上海市市场监督管理局	2024 年 6 月 12 日至 2028 年 6 月 11 日
11	上海冠礼	防爆合格证	GYB22.1757X	上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司、国家级仪器仪表防爆安全监督检验站	2022 年 3 月 7 日至 2027 年 3 月 6 日
12	上海冠礼	固定污染源排污登记回执	91310115739778806 8001X	全国排污许可证管理信息平台（环境资源部）	2024 年 5 月 11 日至 2029 年 5 月 10 日

13	上海冠礼	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3122443609	外高海关	2017 年 2 月 16 日至长期
14	新加坡冠礼	ME11-Mechanical Engineering（机械工程类注册承包商资质）	/	Building and Construction Authority（新加坡建设局）	有效期至 2027 年 5 月 1 日
15	新加坡冠礼	BizSAFE Level 3（新加坡企业安全认证 3 级）	No. E26321	Workplace Safety and Health Council（新加坡工作场所安全与健康委员会）	有效期至 2028 年 12 月 10 日
16	马来西亚冠礼	Contractor Registration Grade G7（承包商注册 G7）	0320241223-CN000286	Construction Industry Development Board Malaysia（马来西亚）建筑工业发展局	2024 年 12 月 23 日至 2026 年 12 月 22 日

2、主要荣誉

序号	主体	名称	编号	颁发机构	有效期/颁发日期
1	冠礼科技	高新技术企业	GR202532002557	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2025 年 11 月 18 日至 2028 年 11 月 18 日
2	冠礼科技	专精特新“小巨人”企业	-	工业和信息化部	2024 年 9 月至 2027 年 9 月
3	冠礼科技	企业技术中心	-	江苏省工业和信息化厅	2025 年 12 月 26 日
4	冠礼科技	专精特新中小企业	-	江苏省工业和信息化厅	2025 年 12 月至 2028 年 12 月
5	冠礼科技	瞪羚企业	-	江苏省新质生产力促进中心	2025 年 9 月 11 日
6	冠礼科技	“三首两新”认定技术产品企业	-	江苏省工业和信息化厅	2025 年 7 月 16 日
7	冠礼科技	创新型中小企业	-	苏州市工业和信息化局	2025 年 6 月 6 日
8	冠礼科技	企业知识产权管理贯标备案单位	-	江苏省知识产权局	2024 年 5 月 31 日
9	冠礼科技	上云企业	-	江苏省工业和信息化厅	2024 年 1 月 15 日
10	冠礼科技	三星级上云企业	-	江苏省工业和信息化厅	2023 年 12 月 27 日
11	冠礼科技	民营科技企业	-	江苏省民营科技企业协会	2023 年 10 月 30 日
12	冠礼科技	首台（套）重大装备	-	苏州市工业和信息化局、无锡市工业和信息化局、常州市工业和信息化局	2025 年 11 月 25 日
13	冠礼科技	市级企业技术中心	-	苏州市人民政府	2023 年 12 月 28 日
14	冠礼科技	苏州市高阶湿制程清洗设备工程技术研究中心	-	苏州市科学技术局	2023 年 12 月 22 日
15	上海冠礼	高新技术企业	GR202431002024	全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室	2024 年 12 月 4 日至 2027 年 12 月 4 日
16	上海冠礼	专精特新中小企业	-	上海市人民政府办公厅	2026 年 3 月 10 日

17	上海冠礼	创新型中小企业	-	上海市经济和信息化委员会	2023 年 3 月 17 日

3、重要认证

序号	主体	名称	编号	颁发机构	有效期/颁发日期
1	冠礼科技	知识产权合规管理体系认证证书	165IP190085R2M	中知（北京）认证有限公司	2025 年 12 月 24 日至 2028 年 1 月 14 日
2	冠礼科技	企业信用等级证书（AAA 级）	苏安信评字 3200252834 号	江苏安博尔信用评估有限公司	2025 年 10 月 22 日至 2026 年 6 月 1 日
3	冠礼科技	质量管理体系认证证书（ISO 9001:2015）	679694-2024-AQ-RGC-RvA	DNV-Business Assurance	2025 年 12 月 3 日至 2027 年 6 月 25 日
4	冠礼科技	环境管理体系认证证书（ISO 14001:2015）	679693-2024-AE-RGC-RvA	DNV-Business Assurance	2025 年 12 月 3 日至 2027 年 6 月 25 日
5	冠礼科技	职业健康安全管理体系认证证书（ISO 45001:2018）	679692-2024-ASA-RGC-RvA	DNV-Business Assurance	2025 年 12 月 3 日至 2027 年 6 月 25 日
6	冠礼科技	SEMI 证书（CDS）S2	SEMI 10618	ECMG Electronic Technical Testing Corp（Shenzhen）	2022 年 7 月 12 日
7	冠礼科技	SEMI 证书（SDS）S2	SEMI 10619	ECMG Electronic Technical Testing Corp（Shenzhen）	2022 年 7 月 12 日
8	冠礼科技	两化融合管理体系评定证书	AIITRE-00724IIIMS0377101	北京赛昇科技有限公司	2024 年 7 月 12 日至 2027 年 7 月 11 日
9	上海冠礼	知识产权合规管理体系认证证书	165IP183221R2M	中知（北京）认证有限公司	2024 年 10 月 8 日至 2027 年 10 月 8 日
10	上海冠礼	企业信用等级证书（AAA 级）	苏安信评字 3200252833 号	江苏安博尔信用评估有限公司	2025 年 5 月 30 日至 2026 年 5 月 29 日
11	上海冠礼	质量管理体系认证证书（ISO 9001:2015）	679694CC1-2024-AQ-RGC-RvA	DNV-Business Assurance	2025 年 12 月 3 日至 2027 年 6 月 25 日
12	上海冠礼	环境管理体系认证证书（ISO 14001:2015）	679693CC1-2024-AE-RGC-RvA	DNV-Business Assurance	2025 年 12 月 3 日至 2027 年 6 月 25 日
13	上海冠礼	职业健康安全管理体系认证证书（ISO 45001:2018）	679692CC1-2024-ASA-RGC-RvA	DNV-Business Assurance	2025 年 12 月 3 日至 2027 年 6 月 25 日
14	上海冠礼	SEMI 证书（CDS）S2	SEMI 10573	ECMG Electronic Technical Testing Corp（Shenzhen）	2022 年 1 月 7 日
15	上海冠礼	SEMI 证书（SDS）S2	SEMI 10538	ECMG Electronic Technical Testing Corp（Shenzhen）	2022 年 1 月 7 日

六、发行人技术与研发情况

（一）发行人核心技术情况

1、核心技术、技术来源及所处阶段

平台名称	序号	核心技术名称	核心技术特点及先进性表征	技术来源	所处阶段

先进制程工艺适配技术	1	介质输送过程微污染防控技术	聚焦于研磨液、化学品等核心介质在输送全流程中的微污染风险，围绕先进制程对粒径、金属离子及溶出物高度敏感的特性，构建了从源头到末端的全链条洁净输送体系。通过前端制造管控与供液装置结构优化，提升密封性与耐腐蚀性，降低渗漏、积液及死角沉积风险；同时搭配化学品快速过滤装置，优化过滤结构与滤材选择，在不改变介质原有特性的前提下，高效去除微颗粒及微量杂质。系统采用自动化清洗接头与防呆型快速连接结构，减少误操作引入空气与污染物的可能。研磨液系统进一步整合原液桶吸管自动清洗与排空机制，避免残留与交叉污染。整体方案实现高稳态、高洁净度的输送环境，满足先进制程对微污染“零容忍”的要求。	自主研发	量产阶段
	2	化学品精准混配与稳定供应控制技术	针对先进制程对化学品配比精度、参数稳定性及连续供给一致性的高标准要求，构建了一体化混配与稳定供给技术体系。系统依托高精度流量计量与闭环控制算法，实现酸、碱、水及功能性添加剂的比例精准调控，将浓度波动控制在微尺度范围内；同时通过优化搅拌结构与流体动力学设计，提升混配均匀性。在供给环节，系统整合温度、压力、流量及 pH 值的动态调节机制，并且结合气液分离结构设计，有效减少气泡干扰及物化特性波动风险，全面提升供液过程的稳定性与可靠性，确保下游关键工艺的持续稳定运行。	自主研发	量产阶段
	3	在线混酸技术	与传统桶槽批量混酸模式相比，在线混酸设备采用连续动态配比方式，对流量控制稳定性及管路结构设计提出更高技术要求，需确保系统内流体无滞留、无死角流动，以保障混配过程的稳定性与一致性。与此同时，在线混酸系统结构更为紧凑，可显著减少设备占地面积，提升空间利用效率，在厂务规划与产线布局优化方面展现出更高的灵活性与适配能力。	自主研发	量产阶段
介质特性分析与流体仿真设计技术	1	介质特性分析技术	随着泛半导体工艺持续升级，化学介质能力日益复杂。公司构建了系统化的介质特性分析体系，对腐蚀性、黏度、密度、挥发性、反应性及气液平衡等关键参数进行综合评估，并结合温度、压力与浓度变化开展动态物性分析。 依托长期积累的化学应用与高纯设备制造经验，公司在设计阶段前置识别材料兼容性、腐蚀失效及流体稳定性等关键风险，科学指导管路选材与结构优化，实现由经验判断向数据化、工程化决策转型。	自主研发	量产阶段
	2	流体动力学仿真技术	针对半导体供液系统及研磨液混合输送等关键场景，公司运用计算流体动力学技术对介质输送与混合过程进行建模分析，模拟不同工况下的流动、温度、浓度与压力变化，研究运行参数对介质特性的影响规律。 基于仿真结果，公司优化结构设计与混合方式，实现输送过程的稳定控制；同时通过模型预判异常并前置修正关键参数，提升系统效率与风险识别能力，缩短新设备设计与验证周期。	自主研发	量产阶段
高效自动化控制技术	1	电子级化学品自动灌充技术	高纯化学品灌充是保障产品洁净度与品质一致性的关键环节。公司围绕高效自动化与洁净控制理念，构建涵盖清洗、充填、锁盖、输送、贴标及码垛等环节的一体化自动洁净灌充系统，实现少人化连续运行、精准计量控制与全过程可追溯管理。系统融合自动视觉识别技术，可实时识别桶槽状态并精准判断残液情况，对灌充及清洗过程进行动态优化，减少残留量、提升原料利用率，全面提升灌充作业的自动化水平、运行效率与安全稳定性。	自主研发	量产阶段
	2	化学品在线监控与分析技术	化学品纯度与参数稳定性直接影响晶圆良率及制程可靠性，微量杂质或浓度波动均可能引发产品缺陷。	自主研发	量产阶段

			公司全系设备均搭载关键参数闭环调控能力，其中灌充系统配套自动补液功能，可精准管控每桶化学品充装量与浓度，从源头保障产品品质均一性与供液安全。 同时，公司各类系统均可选配自动取样、在线检测模块，实现化学品品质实时分析与即时判定，既能规避人工取样带来的操作风险与化学品暴露隐患，也大幅提升检测效率与数据精准度。		
	3	生产数据自动分析技术	系统基于设备元件信息及专业技术参数，构建统一的标准化数据库体系，围绕设备运行状态、关键工艺参数及环境监测指标，建立覆盖数据采集、分析、存储与预警在内的全流程管理机制。当相关参数接近或超出设定阈值时，系统可自动触发提示与分级预警响应；同时，对化学品使用量、更换周期及厂务运行数据进行持续记录与归档，为运行管理、参数优化及成本控制提供量化支撑。 该数据驱动型管理体系实现了全过程数字化留痕与可追溯管理，支持运行状态回溯分析及问题根因定位，有效降低人为判断差异带来的波动风险，进一步提升设备运行的稳定性、一致性以及生产管理的透明度与可控水平。	自主研发	量产阶段
湿法工艺高效控制技术	1	单片药液高效回收与循环再生系统	采用特殊腔体结构设计与介质分层回流装置，通过风压自动调节系统精准控制药液扩散路径，实现液态与气态介质流场的有效分隔，降低交叉干扰与污染风险。系统同时配置稳定的化学药液温控机制，确保工艺参数持续稳定运行。在此基础上，优化介质循环与回收路径，使介质回收率可达 95%以上，并实现零交叉污染的过程控制目标。	自主研发	量产阶段
	2	精密喷洗控制与稳定输出技术	基于半导体对工艺处理均匀性与压力稳定性的高要求，系统采用高精度运动控制与闭环调节机制，实现喷洗过程的平稳启停与动态参数匹配，有效降低瞬时压力波动对晶圆表面的影响。通过稳压输出设计与无级工艺调节控制技术，确保喷洗压力、流量与作用时间在设定区间内连续稳定运行，提升工艺重复性与一致性。 同时，在喷嘴结构与介质输送路径方面进行耐久优化与流场匹配设计，有效改善液体雾化分布与冲击均匀性，降低局部应力集中与偏流风险，使工艺处理均匀性稳定控制在 3%以内，适配 12 英寸及以上晶圆制程要求。通过对独立供液单元的精细化控制设计，进一步抑制残液滞留与滴漏问题，提升喷洗过程的精度与稳定性。	自主研发	量产阶段
	3	光学检测模块集成技术	将原本分散在不同工序间的宏观与微观光学检测与识别模块整合进主设备系统，实现工艺、检测与控制的一体化架构。通过重构信号与控制链路，减少数据延迟与干扰，提升系统响应效率与整体稳定性，同时优化设备空间利用与运维流程。检测模块与故障检测系统形成闭环联动，在工艺执行过程中同步完成对位与缺陷识别，并根据分析结果即时修正工艺参数，从源头降低不良率与返工损耗。在工艺能力方面，系统具备高精度蚀刻控制与稳定的尺寸管理能力，可支撑高密度、小型化封装对一致性与可靠性的要求。	自主研发	量产阶段
绿色化学品循环再生技术	1	金属电解回收技术	电子制造业在电镀、蚀刻等制程中会产生大量含金属废水。传统处理方式通常通过化学沉淀生成金属污泥后外运处置，不仅增加处理成本，也难以实现资源回收利用。本技术采用电化学金属离子回收工艺，通过可控电解反应将废水中的金属离子直接还原为高纯度金属，实现由“末端处置”向“源头资源化”的转变，显著减少污泥产生与后续处理负担。	自主研发	小试阶段

			系统可根据不同废水中的金属成分与浓度特性进行模块化整合设计，并结合分离与纯化技术优化金属回收效率与纯度，提升整体运行稳定性与适应能力。该技术具备向多种金属离子资源化回收扩展的能力，在降低环保处理成本的同时，实现资源循环利用，兼具经济价值与环境效益。		
	2	电子级溶剂回收与纯化再利用	针对光电及半导体制程中产生的高浓度剥离液与有机废液，通过高效分离与精制技术，将废液中的有效成分提纯后重新回到生产流程，实现厂内循环使用。系统在架构上优化传统多单元配置，通过结构整合与热能回收设计，提高分离效率与回收率，同时降低能耗与设备占地。设备支持自动化启停与稳定运行，可适应不同废液条件，减少操作负担并提升运行可靠性。回收后的溶剂可根据制程需求进行在线调配，达到电子级使用标准。该技术不仅降低原料采购与废弃处理成本，也有效减少废弃物外运风险，推动绿色制造与循环经济实践。	自主研发	量产阶段
结构设计与数据安全防护技术	1	结构安全与可靠性工程技术	化学系统涉及高危介质的输送与处理，其运行安全性直接关系到生产连续性与系统稳定性。公司以“安全驱动设计”为核心理念，在系统架构层面将安全锁止、密封隔离（符合 SEMI 相关防爆规范）、防误操作及风险分级控制等关键机制融入整体结构设计，实现对高危介质的风险管控，从源头降低误操作与泄漏风险。同时，系统在工程设计阶段充分考虑结构载重能力、设备受力分布及长期运行稳定性要求，通过强化承载结构与支撑体系设计，确保在复杂工况与长期运行条件下仍保持结构安全与性能稳定，进一步提升整体可靠性与运行能力。	自主研发	量产阶段
	2	数据安全与分级防护设计技术	围绕化学系统运行数据的完整性与保密性，建立分级权限管理与数据隔离机制，对关键工艺参数、设备运行数据及操作记录进行分层存储与访问控制，防止未授权篡改与误操作风险。系统通过日志留痕与异常操作识别机制，确保数据全过程可追溯与可核查。同时在控制层采用工业级 PLC 架构，并配置通信链路冗余与光纤双回路设计，在断电、网络中断或突发异常情况下，系统可维持关键控制功能或安全停机状态，避免数据丢失及设备失控风险。通过强化控制单元稳定性与通讯可靠性，提升系统在复杂工业环境下的连续运行能力，保障生产数据与工艺过程的真实、完整与可控。	自主研发	量产阶段

截至报告期末，公司已形成多项自主可控的核心技术，通过深度整合化工工艺、流体力学、精密机械、自动控制及材料科学等领域技术，全面覆盖化学品的精准配比输送、工艺反应控制、纯化复用的生命周期，形成了坚实的技术壁垒，助力集成电路、显示面板等下游高端制造行业实现安全可控与绿色可持续发展。

2、发行人核心技术取得的专利或其他技术保护措施

公司高度重视核心技术的保护，通过与核心技术人员签署《保密及竞业限制协议》明确权责，有效防范技术泄密风险。同时，公司制定了知识产权相关管理制度，保障研发成果及时受到知识产权保护。截至 2025 年 12 月 31 日，公司核心技术取得的专利情况如下：

序号	核心技术名称	专利号/申请号	专利名称	专利类型
1	介质输送过程微污染防控技术	2024SR2093287	冠礼 CDS 设备输送管路中药液品质（微粒子）监控系统应用软件 V1.0	软件著作权
		ZL202421758764.2	液体颗粒物检测装置	实用新型
		ZL202411355751.5	一种半导体用化学品快速过滤装置	发明
		ZL202410530676.5	一种半导体用高纯化学品自动取样分析方法及系统	发明
2	化学品精准混配与稳定供应控制技术	ZL201721263351.7	一种研磨液混合供应设备	实用新型
		ZL201921536611.2	铜酸溶液混合系统	实用新型
		ZL202122546543.1	一种光刻胶混配过滤供应设备	实用新型
3	在线混酸技术	ZL202423012105.7	一种可调式定量加液容器及研磨液混合装置	实用新型
		ZL201621054965.X	研磨液混酸稀释系统	实用新型
		ZL201821790617.8	一种改进型滴定分析容器	实用新型
		ZL201821790663.8	一种多用途高负载高精滴定仪	实用新型
		ZL202021829391.5	一种风囊定容器微量可调系统	实用新型
4	介质特性分析技术	ZL202310660273.8	抗气泡高稳定性折光计	发明
		ZL201610821080.6	一种电子式 HF 升降温系统	发明
		ZL201721263152.6	一种有机溶剂清洗槽	实用新型
		ZL201621053371.7	酮酸供应温度控制系统	实用新型
5	流体动力学仿真技术	ZL202311186494.2	一种半导体供液设备及供液方法	发明
		ZL202222357775.7	一种制程槽体流场测试装置	实用新型
6	电子级化学品自动灌充技术	ZL202310441191.4	一种全自动化学品灌装设备	发明
		ZL202411024960.1	一种半导体化学品药液桶清洗装置	发明
		ZL202310338728.4	一种全自动化学品桶清洗设备	发明
		ZL202222641145.2	一种新型全自动电子级化学品灌充流水线系统	实用新型
		ZL201822011871.X	电子级化学药液槽罐车充填设备	实用新型
		2022SR1232309	冠礼无人值守全自动充填设备控制系统应用软件 V1-0	软件著作权
7	化学品在线监控与分析技术	ZL202122480752.0	一种新型在线式化学品浓度测量装置	实用新型
		ZL202122447746.5	一种可调型气泡检测装置	实用新型
		ZL201821790632.2	一种滴定仪用试样气泡检测系统	实用新型
		2025SR0120398	冠礼多秤心静态重量测量及失效自诊断系统应用软件【简称：电子秤配置软件】V1.0	软件著作权

8	生产数据自动分析技术	2025SR0808579	冠礼科技 UBM 工艺数据可视化分析软件 V1.0	软件著作权
		2024SR1281348	冠礼科技自研图表自动化系统应用软件 V1.03	软件著作权
		2024SR0364313	冠礼科技监控机台模拟量数据软件 V1.03	软件著作权
		2025SR1857332	冠礼基于数据处理的智能化报表系统应用软件 V1.0	软件著作权
		2025SR0185264	冠礼物料自动识别系统应用软件 V1.0	软件著作权
9	单片药液高效回收与循环再生系统	ZL202511293236.3	一种用于半导体制程的湿法循环管路脱泡装置及方法	发明
		ZL202411838441.9	一种用于晶圆蚀刻的药液循环系统及蚀刻设备	发明
		ZL202411757358.9	一种基于半导体加工的蚀刻设备	发明
		2025SR0842206	冠礼科技自研金属有机蚀刻机台的控制系统应用软件 V1.04	软件著作权
10	精密喷洗控制与稳定输出技术	ZL202311213207.2	一种半导体晶圆清洗机摆臂机构	发明
		ZL202420554535.2	一种光刻胶温控系统	实用新型
		ZL202122496976.0	一种交替式纯水高压喷雾清洗系统	实用新型
		2025SR0717672	冠礼科技全自动 4C 铜钛刻蚀设备控制软件 V1.00	软件著作权
		2021SR1939634	冠博交替式纯水高压喷雾清洗设备控制软件 V1-0	软件著作权
11	光学检测模块集成技术	ZL202411678641.2	一种晶圆校正装置及控制方法	发明
		ZL202510217095.0	一种半导体晶圆的定位装置	发明
		ZL202411077126.9	一种涂胶显影机晶圆定位装置	发明
		ZL201921535869.0	一种三步夹持晶圆定位机构	实用新型
		2025SR0831243	冠礼科技基于 SECS/GEM 标准的单片清洗机控制程序和监视系统应用软件 V1.0	软件著作权
12	金属电解回收技术	ZL202310370613.3	一种废弃剥离液回收再利用设备	发明
		ZL202021821167.1	一种研磨液回收再利用系统	实用新型
13	电子级溶剂回收与纯化再利用	ZL202410750305.8	一种剥离液分离监控系统及控制方法	发明
		ZL201921535868.6	二甲基乙酰胺回收系统	实用新型
		ZL202222116728.3	一种新型 TMAH 显影液再生及浓度管理系统	实用新型
14	结构安全与可靠性工程技术	ZL201921728720.4	一体式门锁安全装置	实用新型
		ZL201921771935.4	一种改进型防呆酸桶快速连接系统	实用新型
		ZL201721263373.3	一种高精度管道防电磁波干扰装置	实用新型
		ZL201821919890.6	防呆型化学桶快速连接接头	实用新型
15	数据安全与分级防护设计技术	2024SR0778818	冠礼科技单片清洗机图表数据监测软件 V1.37	软件著作权

		2024SR0126286	冠礼科技 PA/Chiller 远程控制软件 V1.0	软件著作权
		2025SR0063218	冠礼 Develop 显影设备控制软件 V1.00	软件著作权
		2024SR1280850	冠礼 PLC 标签数据通信控制软件 V1.00	软件著作权
		2019SR1100539	冠礼湿制程设备条形码管理系统应用软件 V1-0	软件著作权

（二）在研项目情况

为巩固和提升公司的技术优势，公司根据客户需求和行业技术发展趋势，持续进行研发活动。截至本招股说明书签署日，公司主要在研项目情况如下：

序号	项目名称	研发目标	研发进展
1	关于光刻胶加仓瓶自动灌装机的研发	光刻胶具备强光敏特性，灌装全过程必须避光防护。现有半自动加仓瓶灌装设备缺少密闭避光结构，加之人工操作占比高，存在作业安全隐患、灌装精度差、洁净度不达标等问题，光刻胶极易受光照变质，无法满足高端半导体制程生产标准，为此开展光刻胶加仓瓶自动灌装机研发。 项目核心目标是通过设备全域密闭避光设计，从源头减少光刻胶光照变质问题，同时设备内部增设 FFU 送风系统，优化内部洁净环境，杜绝杂质引入影响成品品质；通过 PLC 自动程序控制，实现自动进桶、开盖锁盖、桶口对位、充填作业的全流程自动化，替代传统人工操作模式，规避人为操作带来的安全风险；通过夹紧限位机构搭配视觉判断系统实现桶口精准定位，联动电子秤联锁控制灌装启停，保障灌装精度与稳定性；实现设备高度集成化设计，集多工序于一体协同控制，大幅提升光刻胶灌装良率、灌装标准化水平和效率、有效降低人工成本。	方案设计
2	高真空低温干燥技术的研发	针对半导体晶圆湿法清洗后传统干燥工艺的核心痛点，包括 Spin Dry、IPA Vapor Dry、Marangoni Dry 等现有方式普遍存在的晶圆水迹残留、高深宽比结构干燥不彻底、微结构损伤、凝胶缺陷、颗粒污染、试剂毒性与环保成本高、晶圆边缘干燥不充分导致生产良率下降等问题，开展高真空低温干燥技术的研发。 项目核心目标为研发高效真空发生系统与密封结构，实现真空度精准调控，构建稳定高真空环境，依托低温真空环境实现晶圆表面水分直接升华，从源头规避热损伤与结构缺陷；开发晶圆表面水分预处理工艺，提升水分去除的彻底性；优化适配晶圆的真空干燥腔体结构，通过模块化设计减少腔体死角，满足晶圆批量工业化干燥需求；搭建干燥过程多参数实时监测与闭环调控系统，保障干燥效果稳定性；研发高洁净腔体防护技术，确保干燥全程处于高洁净状态。最终实现晶圆表面及界面水分的彻底去除，大幅提升晶圆制造良率。	方案设计
3	化学品充填产线全流程自动化控制系统的研发	针对半导体高纯电子级化学品分装环节，现有半自动/人工操作模式存在的安全隐患高、洁净度难以满足制程要求、人工成本高昂、易出现交叉污染与物料错配事故，且全流程自动化方案缺失、相关设备多依赖进口的行业痛点，开展化学品充填产线全流程自动化控制系统研发。 项目目标聚焦于开发一套集成新型全自动化学品分装设备、AGV 调度系统、工业以太网网络及核心管理系统的整体解决方案，实现从空桶搬运、充填、封盖锁盖、后端贴码打包到仓储管理的全程无人化自动运行。其中，新型分装设备将满足超洁净环境（Class 100）及 SEMI 安全规范，实现全自动充填与封盖；管理系统作为核心程序，通过网络统筹调度 AGV 复合机器人完成空桶搬运、满桶入库等任务。项目侧重于 AGV 系统的二次改造，配备视觉系统与机器人手臂，以实现桶的精准识别与搬运，并解决不同规	样机试制

		格桶的兼容问题。	
4	显示面板行业TMAH显影废液成分多维度分析与回收工艺研究	显示面板行业 TMAH 显影液用量大、原液成本高，废液直接排放环保压力大、处理成本高，而现有膜过滤回收技术普遍存在膜污染严重、在线清洗困难、系统膜通量下降、清洗失效等问题，同时进口相关设备价格高昂。 项目核心目标为建立 TMAH 显影废液关键污染物高精度检测方法，开发 TMAH 高效回收工艺及装置，攻克现有纳滤系统污染严重、运行稳定性不足的行业瓶颈，开发新型抗污染药剂与清洗路线，设计以电渗析为核心的 TMAH 回收工艺，优化运行参数，实现废液中 TMAH 的高效回收与高纯产品获取；同时研发可 24 小时自动运行、适配洁净环境要求、具备高可靠性的显影液再生及浓度管理系统。	方案设计
5	关于UBM etch蚀刻清洗机的研发	面向半导体封装覆晶（FlipChip）技术中的 UBM 蚀刻关键制程，针对该制程对蚀刻均匀性、高选择性的严苛要求，需精准蚀刻去除 UBM 金属层且不损伤锡铅凸块，避免出现电路短路、底切缺陷等影响芯片可靠性的问题，同时为填补公司在半导体先进封装设备领域的布局缺口、拓展产品线，开展单晶片旋转式 UBM 蚀刻机台研发。 项目核心目标为设计结构简单合理、性能可靠、保养维修便捷的 UBM 蚀刻机台，实现芯片精准蚀刻与高效清洗；开发自动化芯片搬运系统，全程杜绝芯片二次污染；通过精密电机实现喷洒药液摆臂的精准速度与定位控制，搭配高阶电机保障芯片旋转的稳定性与批次间重现性；采用模块化结构设计，适配不同客户的工艺需求；搭建管路精准药液混酸系统与控温系统，优化蚀刻与清洗工艺效率；通过先进时程规划技术与软件编程实现产能最大化。	测试验证
6	研磨液自动稀释混合供应系统的研发	面向集成电路制造领域 CMP 关键制程，针对半导体制程升级对晶圆表面平坦度要求持续提升，而研磨液自动稀释混合供应系统的性能直接决定 CMP 制程效果，现有方案中研磨液易因接触空气产生结晶、沉淀、絮凝、分层，进而导致硅片研磨不平整、产品良率不达标的行业痛点，开展研磨液自动稀释混合供应系统研发。 项目核心目标为打造具备超高运行可靠性的供应系统，满足 365 天*24 小时不间断自动供应的量产需求；实现高精度的混合溶液配比控制，通过自动在线检测功能完成混合配比的自动纠正与动态调整，保障研磨液性能稳定；完成适配集成电路制造要求的高洁净度机械部件设计，杜绝制程污染；同时研发高性能氮气加湿装置，制备符合制程要求的高湿度氮气，从源头消除研磨液结晶风险，最终保障 CMP 制程稳定性，提升硅片加工品质与生产良率。	样机试制
7	自走式辊筒清洗系统的研发	半导体制造中涂布、显影、清洗等高精度设备的传输滚轮在长期运行中易吸附颗粒污染物，传统清洁方式可能因材质摩擦或操作不当易引发二次污染，影响工艺环境洁净度。随着制程节点持续微缩，生产环境颗粒管控要求日趋严苛，现有滚轮清洁方法存在清洁不彻底、操作繁琐等不足。公司为进一步满足产业升级需求，依托技术积累开发滚轮系统专项清洁方案，进行系统性优化，为客户提供更高标准的洁净维护方案，保障制程稳定性与产品良率。 项目旨在完成对低析出材质的物理特性分析与数字化建模，研究其与滚轮表面接触时的摩擦、吸附与颗粒释放机制；通过计算流体动力学，仿真吸尘设备的流场分布，优化吸尘口位置与参数；将清洁材质模型、运动机构模型与吸尘流场模型整合为完整的数字孪生清洁系统，并模拟实际清洁作业过程；结合实测数据与仿真对比结果，迭代优化核心参数，形成标准化清洁工艺。	方案设计
8	化学品废液处理系统的研发	无机化学废液处理用回收装置旨在将废液中的有害物质去除或转化为无害物质，同时实现资源的回收和再利用。现有回收装置存在明显不足，如预处理时去除废液中的悬浮物过程中，需加入明矾并经静置完成过滤，难以保证无机化学废液的快速过滤与高	方案设计

		效处理，整体处理效率偏低。为克服现有技术缺陷，亟需开发新型回收装置，优化预处理工艺，提升废液处理效率，保障后续处理工序顺畅开展。 项目采用进液漏斗、多级过滤介质、锥形过滤介质、导流斜槽及收集组件等结构设计，预处理过程无需加入明矾和静置步骤，即可完全去除废液中的悬浮物，提升废液预处理效率，便于后续处理。	

（三）研发费用占比

报告期内，研发费用占营业收入的比例如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发费用	5,939.14	4,887.57	3,964.56
研发费用占营业收入比例	4.46%	3.81%	4.70%

（四）合作研发情况

公司自设立以来持续深化与高校科研人员的技术合作，通过理论与实践融合、资源优势互补，不断实现业务领域的技术创新与突破。报告期内，公司合作研发情况如下：

合作单位	合作项目	合作主要内容	技术成果权属	保密措施
苏州大学	工厂自动化与智能化提升与改造技术服务	甲方委托乙方就工厂自动化、智能化改造与提升进行专项技术服务。乙方负责协助解决甲方在技术开发、新产品研发、生产工艺方面的问题。	在合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有；乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归乙方所有。	乙方项目参与人员在合同期满 3 年内不得向其他第三方透露双方研发成果的技术细节，泄密责任由双方协商。

注：甲方指发行人，乙方指合作单位。

（五）技术创新机制、创新安排及技术储备

1、技术持续创新的机制与保障

创新是企业的发展动力，技术是企业的核心竞争力。一直以来，公司重视技术创新、研发能力的培养。公司保持技术不断创新的机制及安排体现在以下几方面：

（1）完善的研发机制

公司围绕化学品全生命周期，构建了以市场需求牵引与行业趋势洞察相结合的研发模式。公司设立技术研发中心，建立完善的研发立项、过程管控及成果转

化流程。技术研发中心与各业务部门高效联动，针对下游集成电路、显示面板及电子化学品等领域的差异化需求，协同开展从前瞻性技术储备到定制化方案开发的系统性研究。同时，公司组建了涵盖多学科背景的专业人才团队，并通过产学研合作持续增强技术攻关能力，确保核心技术持续迭代并高效转化为满足先进制程需求的产品，为业务拓展提供坚实支撑。

（2）持续增加研发投入

报告期各期，公司研发费用分别为 3,964.56 万元、4,887.57 万元和 5,939.14 万元，占营业收入的比例分别为 4.70%、3.81%和 4.46%。公司重视研发投入，报告期内研发费用金额稳步上升，研发投入强度整体保持稳定，有效保障研发活动的顺利进行。

（3）完善人才发展与激励机制

公司高度重视研发人才队伍建设，坚持引育并举、激励赋能，通过内外部多渠道精准吸引行业优秀人才，并结合业务需求开展针对性、阶段性专业技能培训，持续提升研发人员创新能力与综合素养。公司已建立完善的研发创新激励机制，通过职位晋升体系、创新成果考核、股权激励等多元化措施，同时配备具有竞争力的薪酬福利与清晰的职业发展路径，充分激发研发人员的潜能与积极性，有效稳定核心人才队伍并持续吸纳行业优秀人才，为技术创新提供坚实的人才保障。

（4）构建开放式创新与知识产权保护体系

公司在坚持自主研发的基础上，积极借力浙江大学、天津大学、苏州大学等高校的科研资源，形成产学研协同的创新格局。通过与外部科研力量的优势互补，有效支撑核心技术与生产工艺的持续进步，同时也为高校研究成果提供产业化验证平台。公司高度重视对创新成果的保护，通过专利布局、核心技术保密等措施构建自主知识产权体系，将技术优势转化为可持续的竞争壁垒，实现创新输入与成果固化的良性循环。

2、技术储备

公司的技术储备参见本招股说明书本节之“六、发行人技术与研发情况”之“（一）发行人核心技术情况”、“（二）在研项目情况”相关内容。

（六）研发人员情况

1、研发人员认定口径

研发人员的认定以员工所属部门及岗位职责为基础，并结合研发工时记录综合判定。具体而言，公司将隶属于研发部门从事研发工作，且报告期内研发工时占总工时比例不低于 50%的员工，认定为研发人员。

2、报告期各期末研发人员数量、占比和学历分布情况

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
研发人员数量（人）	99	103	83
占员工数量的比例	18.27%	19.14%	16.40%
研究生及以上（人）	3	3	3
本科（人）	67	68	55
专科（人）	29	32	25

报告期各期末，公司研发人员数量分别为 83 人、103 人和 99 人，占员工总数的比例分别为 16.40%、19.14%和 18.27%，公司研发人员以本科学历为主，学历分布合理。

3、核心技术人员情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有 4 名核心技术人员。核心技术人员简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”。

报告期内，公司核心技术人员未发生变动，参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十七、最近三年董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况”。

核心技术人员对公司研发的具体贡献如下：

姓名	具体情况
简建至	系《电子工厂化学品系统工程技术规范》（GB 50781-2012）的主要起草人，公司多项专利发明人，包括发明专利单轴回转式机械手臂（ZL201210080910.6）、一种单批次四花篮同步运行的全自动湿制程设备（ZL201810351122.3），实用新型专利一种研磨液供应系统用快速连接装置（ZL202322527535.1）等。
林裕哲	公司多项专利发明人，包括实用新型专利一种超声波清洗装置（ZL202422847362.6）、一种槽车充填装置（ZL202422350493.3）、研磨液原液桶吸管清洗机构

	（ZL202420122988.8）、一种改进型研磨液系统循环机构（ZL202322869241.7）等。
陈祖胜	公司多项专利发明人，包括发明专利一种半导体研磨液供给输送装置（ZL202411176154.6），软件著作权冠博研磨液供应系统 S088 设备控制系统应用软件 V1-0（ZL2021SR009554.7）等。
黄自柯	公司多项专利发明人，包括发明专利反应槽内晶圆组分离装置（ZL202011298981.4）、一种半导体晶圆清洗机摆臂机构（ZL202311213207.2）、一种晶圆翘曲度的测量方法和装置（ZL202410136829.8），实用新型专利一种定角度选择顺应性晶圆输送机械臂的定位结构（ZL202122512018.8）、一种同轴嵌套软管（ZL202420554845.4）等。

4、发行人对核心技术人员实施的约束激励措施

公司建立了较为完善的创新激励机制，给予核心技术人员合理的回报，公司定期对薪酬体系与薪资待遇水平进行市场化调整，保持公司对先进人才的持续吸引。

在劳动协议之外，公司与核心技术人员签署《保密及竞业限制协议》，就核心技术人员在任职期间及离职以后保守公司商业秘密和竞业限制的有关事项进行了约定，对核心技术人员进行约束，保护公司知识产权、商业秘密及股东利益。

七、安全生产和环境保护情况

（一）安全生产情况

公司自成立以来，积极落实各项安全生产防护措施，高度重视安全生产管理，为保障生产过程中的安全及员工的健康，公司严格遵照安全生产相关法律法规，并制定了安全生产管理制度，监督落实事故防范整改措施，提高员工的安全生产意识。

报告期内，公司及其子公司不存在因安全生产违法违规行为而受到行政处罚的情况，参见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“三、公司报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况”。

（二）环境保护情况

1、主要污染物及处理情况

公司所处行业为半导体器件专用设备制造业，不存在高危险、重污染情况。公司生产经营中涉及的主要污染物包括废气、废水、噪声及一般固废，产生环节主要为生产环节。

废气主要包括生产过程中产生的焊接烟尘、VOCs 等，由管道引至建筑物顶

的废气处理设施净化处理达标后，再通过排气筒高空排放；废水主要为职工食堂及职工生活污水以及少量的车间清洗废水等，经化粪池预处理后接入城镇污水管网，入污水处理厂集中处理；噪声主要由空调、焊接设备、组装设备等运行时产生，噪声声级大多小于 75dB（A），通过减振、隔声等措施处理；一般固废来源于员工生活产生的生活垃圾以及生产活动中产生的废包装箱袋、废边角料等，主要处理措施包括回收或委托环卫部门清运。公司环保相关主要处理设施运行良好，处理能力充足，根据第三方检测机构的检测结果，公司主要污染物排放量均符合国家或地方标准。

2、环保投入情况

报告期内，公司主要生产环节不涉及高危险、重污染工序，生产经营过程中产生的废气、废水及一般固体废物排放量较少，环保投入主要用于一般废物的合规处置。报告期各期，公司环保投入金额分别为 8.39 万元、6.91 万元及 10.58 万元，相关投入能够充分满足生产经营产生的污染物治理需求，生产活动符合国家及地方环保相关法律法规要求。

3、环保合规情况

报告期内，公司不存在因环保违法违规行为而受到行政处罚的情况，具体参见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“三、公司报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况”。

八、境外经营情况

公司境外子公司具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、发行人子公司、分公司情况”之“（二）其他子公司及分公司情况”、“第十二节 附件”之“附件七：子公司、参股公司简要情况”。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节财务会计数据及相关财务信息，非经特别说明，均依据信永中和审计的财务报表及其附注得出。

本节对财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲对公司的财务状况、经营成果和现金流量等进行更详细的了解，公司提醒投资者关注财务报表和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、财务报表、会计师事务所的审计意见类型和关键审计事项

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	34,061.30	37,445.96	26,135.98
应收票据	146.42	1,861.27	369.28
应收账款	30,131.29	24,082.29	17,543.84
应收款项融资	6,441.99	7,518.80	285.89
预付款项	1,705.60	1,557.65	2,823.84
其他应收款	756.49	538.99	700.24
存货	90,448.07	134,954.15	133,819.98
合同资产	3,588.94	4,167.14	1,906.92
其他流动资产	1,236.76	617.01	274.49
流动资产合计	**168,516.87**	**212,743.27**	**183,860.46**
非流动资产：			
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,579.93	1,009.64	983.88
在建工程	1,289.65	457.60	3.26
使用权资产	1,481.64	1,748.46	1,814.79

无形资产	1,126.93	1,110.30	113.97
商誉	-	-	-
长期待摊费用	146.29	180.18	125.84
递延所得税资产	3,425.00	5,438.52	4,317.26
其他非流动资产	4,942.26	4,287.33	2,976.90
非流动资产合计	**13,991.68**	**14,232.03**	**10,335.91**
资产总计	**182,508.55**	**226,975.30**	**194,196.36**
流动负债：			
短期借款	-	-	10,200.47
应付票据	-	-	-
应付账款	12,094.59	18,782.09	21,954.09
预收款项	-	-	-
合同负债	80,624.84	133,530.64	112,394.79
应付职工薪酬	4,081.47	5,535.07	2,972.21
应交税费	3,823.98	6,287.10	2,223.38
其他应付款	320.45	392.69	8,440.48
一年内到期的非流动负债	706.81	738.03	700.82
其他流动负债	8.20	264.60	59.05
流动负债合计	**101,660.35**	**165,530.23**	**158,945.28**
非流动负债：			
租赁负债	784.76	1,036.12	1,105.71
预计负债	6,475.35	4,558.59	1,760.23
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	652.75	256.72	265.09
非流动负债合计	**7,912.86**	**5,851.43**	**3,131.02**
负债合计	**109,573.20**	**171,381.66**	**162,076.31**
所有者权益：			
股本	21,000.00	16,663.25	14,441.03
资本公积	10,842.51	5,250.89	11.19

其他综合收益	182.81	39.75	73.37
盈余公积	6,498.27	8,108.62	6,913.66
未分配利润	34,411.75	25,531.14	10,680.81
归属于母公司所有者权益合计	72,935.34	55,593.64	32,120.06
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	**72,935.34**	**55,593.64**	**32,120.06**
负债和所有者权益总计	**182,508.55**	**226,975.30**	**194,196.36**

2、合并利润表

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	**133,030.71**	**128,170.26**	**84,304.79**
二、营业总成本	**110,762.68**	**102,917.69**	**74,896.85**
其中：营业成本	94,579.15	86,944.69	63,704.67
税金及附加	435.94	929.05	496.06
销售费用	4,224.30	3,947.93	3,193.74
管理费用	5,973.67	6,253.46	3,468.82
研发费用	5,939.14	4,887.57	3,964.56
财务费用	-389.51	-45.02	69.00
其中：利息费用	62.38	337.95	377.41
利息收入	482.48	381.12	315.06
加：其他收益	1,472.71	1,384.05	1,142.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	191.97	-999.35	-744.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17.78	-2,283.41	248.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3.13	1.83	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**23,918.06**	**23,355.70**	**10,054.26**
加：营业外收入	31.65	6.07	6.78
减：营业外支出	126.97	15.35	9.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**23,822.74**	**23,346.41**	**10,051.68**

减：所得税费用	2,975.47	3,301.13	1,040.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**20,847.27**	**20,045.28**	**9,011.42**
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,847.27	20,045.28	9,011.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	20,847.27	20,045.28	9,011.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	**143.07**	**-33.62**	**73.37**
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	143.07	-33.62	73.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	**20,990.33**	**20,011.66**	**9,084.79**
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	20,990.33	20,011.66	9,084.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	0.99	1.26	2.17
（二）稀释每股收益（元/股）	0.99	1.26	2.17

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	78,032.55	138,197.20	131,538.57
收到的税费返还	386.40	336.28	128.50
收到其他与经营活动有关的现金	3,859.10	7,050.18	1,543.83
经营活动现金流入小计	**82,278.05**	**145,583.66**	**133,210.90**
购买商品、接受劳务支付的现金	45,160.14	80,733.98	100,065.46
支付给职工以及为职工支付的现金	19,155.81	16,023.12	14,555.79

支付的各项税费	8,522.01	10,739.67	7,986.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,754.47	2,152.53	7,600.34
经营活动现金流出小计	**75,592.42**	**109,649.31**	**130,208.58**
经营活动产生的现金流量净额	**6,685.62**	**35,934.35**	**3,002.32**
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.78	2.70	0.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	**6.78**	**2.70**	**0.46**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,248.31	1,664.97	663.65
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	**2,248.31**	**1,664.97**	**663.65**
投资活动产生的现金流量净额	**-2,241.53**	**-1,662.27**	**-663.19**
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	6,218.96	-
取得借款收到的现金	-	4,865.47	10,691.58
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	8,000.00
筹资活动现金流入小计	**-**	**11,084.43**	**18,691.58**
偿还债务支付的现金	-	15,058.05	5,329.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,000.00	4,377.61	11,240.79
支付其他与筹资活动有关的现金	925.17	8,930.89	2,363.10
筹资活动现金流出小计	**5,925.17**	**28,366.55**	**18,933.24**
筹资活动产生的现金流量净额	**-5,925.17**	**-17,282.12**	**-241.66**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**133.83**	**-16.44**	**64.66**
五、现金及现金等价物净增加额	**-1,347.25**	**16,973.51**	**2,162.13**

加：期初现金及现金等价物余额	35,066.03	18,092.51	15,930.39
六、期末现金及现金等价物余额	**33,718.78**	**35,066.03**	**18,092.51**

（二）审计意见类型

信永中和接受公司委托，审计了公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度和 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。

信永中和认为：发行人的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度、2024 年度和 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（三）关键审计事项

关键审计事项是申报会计师根据职业判断，认为对 2023 年度、2024 年度和 2025 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，申报会计师不对这些事项单独发表意见。

1、收入确认事项

相关会计期间 2023 年度、2024 年度、2025 年度。

（1）事项描述

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，冠礼科技分别实现营业收入 84,304.79 万元、128,170.26 万元和 133,030.71 万元。收入确认是否恰当对冠礼科技财务数据有重大影响，从而存在冠礼科技管理层（以下简称“管理层”）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此，将收入确认确定为关键审计事项。

（2）审计应对

对收入确认执行的相关程序包括：

①获取销售与收入环节相关的内部控制制度，了解和评价内部控制设计，并对关键节点实施检查，评估这些内部控制设计和运行的有效性；

②对营业收入和毛利率的波动实施实质性分析程序，向管理层了解波动的原因，并判断收入和毛利率波动的合理性；

③抽样检查与营业收入相关的销售合同、销售发票、销售回款、签收单或验收单等资料，结合管理层访谈，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定，并评估收入确认的真实性及完整性；

④结合应收账款审计，对重要客户的销售收入和期末应收账款余额执行函证，并对整个函证过程进行控制，确认收入交易和期末应收账款余额的真实性和完整性；

⑤查询客户的工商资料及涉诉情况，并对重要客户进行实地走访，了解重要客户的经营状况及持续经营能力，与公司是否存在关联关系，核实主要客户的背景信息及双方的交易信息；

⑥抽样检查公司资产负债表日前后确认的营业收入，核对销售合同、销售发票、销售回款、签收单或验收单及签字日期等资料，评估收入确认是否在恰当的会计期间。

2、应收账款坏账准备

相关会计期间 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日。

（1）事项描述

截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 20,346.46 万元、27,893.06 万元和 33,759.58 万元；坏账准备余额分别为 2,802.63 万元、3,810.77 万元和 3,628.29 万元，由于管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且若应收账款不能按期收回或者无法收回，对财务报表的影响较为重大，因此将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。

（2）审计应对

对应收账款的坏账准备执行的相关程序包括：

①了解和评估管理层关于应收款项和减值准备相关内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；

②通过检查销售合同及管理层访谈，了解和评估公司的应收账款坏账准备计提政策；

③对重要客户的销售收入和期末应收账款余额执行函证，并对整个函证过程进行控制，确认收入交易和期末应收账款余额的真实性和完整性；

④获取管理层评估应收账款是否发生减值所依据的基础资料，包括客户信用记录、违约或延迟付款记录以及期后实际还款情况等，评价应收账款坏账准备计提的充分性；

⑤针对管理层按照组合计算预期信用损失的模型，评估了预期信用损失模型计量方法的合理性；对模型中相关历史信用损失数据的准确性进行了测试，评估历史违约损失百分比，根据对公司所在行业的了解及参考外部数据源，评估管理层对前瞻性信息调整的合理性；按照考虑前瞻性信息调整后的违约损失百分比，重新计算了预期信用损失；

⑥对以账龄组合为基础评估预期信用损失的应收款项，我们评估了管理层对应收款项信用风险组合的划分，检查了应收款项账龄并结合期后回款实际情况，重新计算预期信用损失计提金额的准确性。

（四）重要性标准确定方法和选择依据

本公司编制和披露财务报表遵循重要性原则。本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

涉及重要性标准判断的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单个项目的金额超过期末资产总额 0.5%且信用风险状况发生显著变化
重要的在建工程	单个项目的金额超过期末资产总额的 0.5%
账龄超过 1 年的重要合同负债	金额大于 2,000 万元
账龄超过 1 年的重要应付账款	金额大于 500 万元
账龄超过 1 年的重要其他应付款	金额大于 500 万元

二、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况

（一）财务报表编制基础

1、编制基础

本公司财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本公司对自 2025 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、合并范围的确定

公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司如下表：

子公司名称	主要经营地	合并/设立时间	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海冠礼	上海市	2023 年 10 月	高纯工艺介质系统与高阶湿制程工艺设备的研发、设计、生产和销售	100.00	-	同一控制下企业合并取得
新加坡冠礼	新加坡	2023 年 11 月	高纯工艺介质系统安装及配套服务	100.00	-	同一控制下企业合并取得
马来西亚冠礼	马来西亚	2024 年 11 月	高纯工艺介质系统安装及配套服务	-	100.00	通过设立方式取得

2、合并财务报表范围变化情况

（1）2023 年 10 月和 11 月，公司通过同一控制下企业合并方式分别取得上海冠礼和新加坡冠礼，之后将其纳入合并报表范围。

（2）2024 年 11 月，新加坡冠礼新设子公司马来西亚冠礼，之后将其纳入

合并报表范围。

三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）主要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本公司于 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

若公司营业周期不同于 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，马来西亚冠礼以马来西亚林吉特为记账本位币；新加坡冠礼以新加坡元为记账本位币。本公司在编制财务报表时按照本节之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）主要会计政策及会计估计”之“8、外币业务和外币报表折算”所述方法折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日

按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本公司作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本公司判断控制的标准为本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；除合同负债/预付账款外的历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

（2）外币财务报表的折算

本公司在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：①收取金融资产现金流量的权利届满；②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本公司需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本公司需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金

融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：A.管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。B.该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：A.管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。B.该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本公司该分

类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

（3）金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（4）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产等进行减值处理并确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平

均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

②按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债

务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

A.应收账款（包括合同资产）的组合类别及确定依据

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司根据应收账款（包括合同资产）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款，本公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本公司以账龄组合为基础评估其预期信用损失，根据收入确认日期确定账龄，确定的组合如下：

确定组合的依据	
组合 1：非合并范围内客户	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2：合并范围内关联方客户组合	以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1 ：非合并范围内客户	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合 2：合并范围内关联方客户组合	除非有证据表明存在减值，一般不计提坏账准备

对于合同资产，本公司以账龄组合为基础评估其预期信用损失，确定的组合如下：

确定组合的依据	
组合 1：未到期质保金	以合同资产的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2：已完工未结算资产	以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：未到期质保金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合 2：已完工未结算资产	参考历史信用损失经验按预计信用损失率 5%计提坏账准备

B.应收票据的组合类别及确定依据

本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策。应收票据确定的组合如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1	银行承兑汇票	除有确定依据表明无法收回全额计提坏账准备外，参考历史信用损失经验不计提坏账准备
组合 2	商业承兑汇票	参考历史信用损失经验计提坏账准备

应收商业承兑汇票，预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。

C. 其他应收款的组合类别及确定依据

本公司根据其他应收款的账龄、款项性质、信用风险敞口等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组，确定的组合如下：

确定组合的依据	
组合 1：账龄组合	以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2：押金及保证金组合	以其他应收款的款项性质为信用风险特征划分组合
组合 3：合并范围内关联方往来组合	以其他应收款与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合 2：押金及保证金组合	参考历史信用损失经验按预计信用损失率 5%计提坏账准备
组合 3：合并范围内关联方往来组合	除非有证据表明存在减值，一般不计提坏账准备

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条

款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

（7）衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、货币互换。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

（8）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10、存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品、合同履约成本等，按成本与可变现

净值孰低列示。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，本公司存货发出时采用加权平均法计价。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

11、合同资产及合同负债

（1）合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见本节之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）主要会计政策及会计估计”之“9、金融工具”。

（2）合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

12．与合同成本有关的资产

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本公司选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本公司与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

13、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大

影响，是指本公司对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本公司不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

（2）会计处理方法

本公司按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本公司对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等

的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本公司的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期投资收益。

因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处

置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、固定资产

本公司固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括机器设备、电子设备、运输设备、办公设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	3-10	0-10	9.00-33.33
运输设备	年限平均法	4-10	0-10	9.00-25.00
办公设备	年限平均法	3-5	0-10	18.00-33.33
电子设备	年限平均法	3	0-10	30.00-33.33

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

类别	转固标准和时点
房屋及建筑物	完工验收或实际投入使用孰早

16、借款费用

本公司将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本公司确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本公司按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件使用权按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会

计估计变更处理。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、设备及房屋折旧费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本公司根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化。

①形成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

本公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本公司以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

19、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用为本公司已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是由于辞退员工产生的，本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬，并计入当期损益。

21、预计负债

如果与或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本公司于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

22、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付：

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付：

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲

减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

23、收入确认原则和计量方法

（1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。本公司的履约义务在满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。本公司在判断客户是否已取得商品控制权时，综合考虑下列迹象：①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义

务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户款项。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在重大融资成分等因素的影响。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

（2）具体方法

①按时点确认的收入

本公司销售产品及销售产品与设计、安装、调试一起签订的合同属于在某一时点履行的履约义务。

收入确认的方法为：对于没有安装调试要求的产品销售，以货物签收作为收入确认的依据；对于有安装调试验收要求的产品销售，以客户验收作为收入确认的依据。

②按履约进度确认的收入

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含承诺在合同约定期限内提供服务的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

公司根据业务类型的不同，存在以下收入确认方式：

收入确认方式	适用业务类型	收入确认时点	收入确认依据
时点法	包含设计、安装、调试等服务的定制化系统及设备合同	客户完成最终验收的时点一次性确认收入	验收报告/验收单
	无需安装调试或仅需简单安装的标准化产品、配件及材料销售	客户签收货物的时点一次性确认收入	签收单/送货单
履约进度法	系统配套安装	在履约时段内按照履约进度分期确认收入	履约进度
	TCM		服务确认单

注：TCM 系全面质量管理协议。

24、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外

的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的（暂时性差异）计算确认。

本公司对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额

（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

26、租赁

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

（2）本公司作为承租人

①租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；C.发生的初始直接费用；D.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本公司根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：A.固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本公司确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

②短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（3）本公司为出租人

本公司作为出租人， 如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本公司将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

①融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②经营租赁

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

27、公允价值计量

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量投资性房地产、衍生金融工具和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

28、重大会计判断和会计估计

编制财务报表时，管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

（1）金融资产减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。因此应收款项及合同资产减值准备的金额可能会随上述估计的变化而发生变动，对应收款项及合同资产减值准备的调整将影响估计变更当期的损益。

（2）存货减值准备

公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认

存货跌价损失。公司在估计存货的可变现净值时，库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

（3）固定资产减值准备的会计估计

公司在资产负债表日对存在减值迹象的机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

（4）固定资产、无形资产的可使用年限

公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

（5）递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税

所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（6）所得税费用

公司在正常的经营活动中，有部分交易最终的税务处理和计算存在一定的不确定性，部分项目是否能够在税前列支需要税务主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（7）预计负债的会计估计

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

（8）租赁期

租赁期，是指承租人有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

承租人有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还应当包含续租选择权涵盖的期间。

承租人有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期应当包含终止租赁选择权涵盖的期间。

发生承租人可控范围内的重大事件或变化，且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的，承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估，因此租赁期可能会随上述原因而发生变化。

（二）重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。公司根据规定执行，上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

（2）执行《企业会计准则解释第17号》

2023年10月15日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）：“一、关于流动负债与非流动负债的划分，二、关于供应商融资安排的披露，三、关于售后租回交易的会计处理”。自2024年1月1日起施行。本公司根据规定执行，上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

（3）保证类质保费用重分类

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18号》（财会[2024]24号）：“一、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地的后续计量，二、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。自2024年12月31日起施行。本公司根据规定执行，上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、重要会计估计变更

本报告期内，公司无重大会计估计变更。

四、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表

依据经会计师鉴证的非经常性损益明细表，公司报告期内非经常性损益的具体内容、金额及对当期经营成果的影响如下：

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-28.28	-12.85	-8.56
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	969.06	483.23	546.62
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	5,060.82
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-101.68		-11.19

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63.91	5.40	5.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
非经常性损益总额	775.20	475.78	5,593.67
减：非经常性损益的所得税影响数	145.63	71.87	81.97
非经常性损益净额	**629.57**	**403.91**	**5,511.71**
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	**629.57**	**403.91**	**5,511.71**

五、主要税项及享受的税收优惠政策

（一）报告期主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
商品及服务税（GST）	按新加坡《商品及服务税法》规定，在本地提供的应税货物及劳务的交易对价（不含 GST）为基础计算销项税额，在扣除当期用于经营且符合规定的进项税额后，差额部分为应纳 GST 税额	9%、8%
销售及服务税（SST）	按马来西亚《2018 年服务税法》规定，以注册服务提供方收取的应税服务总价款（含税价）为基础计算服务税额，该税额即为应纳税额	10%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	24%、17%、15%
城建税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

报告期内，不同纳税主体企业所得税税率说明如下：

纳税主体名称	所得税税率		
	2025 年度	2024 年度	2023 年度
冠礼科技	15%	15%	15%
上海冠礼	15%	15%	15%
新加坡冠礼	17%	17%	17%
马来西亚冠礼	24%	24%	/

（二）报告期内税收优惠政策及批文

1、高新技术企业税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税实施条例》的相关规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

发行人于 2022 年 10 月 12 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202232000792），有效期为三年。根据 2025 年高新技术资格复审结果，发行人于 2025 年 11 月 18 日取得换发的高新技术企业证书（证书编号：GR202532002557），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，发行人 2023 年度、2024 年度和 2025 年度适用的企业所得税税率为 15%。

上海冠礼于 2021 年 10 月 9 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202131000813），有效期为三年。根据 2024 年高新技术资格复审结果，上海冠礼于 2024 年 12 月 4 日取得换发的高新技术企业证书（证书编号：GR202431002024），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，上海冠礼 2023 年度、2024 年度和 2025 年度适用的企业所得税税率为 15%。

2、加计抵减增值税优惠

根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。2023 年度和 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，发行人申报上述政策优惠，且符合上述政策规定，享受上述增值税优惠；报告期内，上海冠礼符合上述政策规定，享受上述增值税优惠。

根据《财政部 税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装

备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。2024 年度及 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日，发行人申请上述政策优惠，且符合上述政策规定，享受上述增值税优惠。

六、发行人报告期内主要财务指标

（一）主要财务指标

报告期内，公司主要财务指标如下表所示：

财务指标	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.66	1.29	1.16
速动比率（倍）	0.74	0.46	0.30
资产负债率（母公司）	42.11%	48.80%	53.90%
资产负债率（合并）	60.04%	75.51%	83.46%
财务指标	**2025 年度**	**2024 年度**	**2023 年度**
应收账款周转率（次/年）	4.32	5.31	4.76
存货周转率（次/年）	0.82	0.64	0.57
息税折旧摊销前利润（万元）	25,204.75	24,990.91	11,703.75
利息保障倍数（倍）	404.03	73.95	31.01
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.32	2.16	0.21
每股净现金流量（元/股）	-0.06	1.02	0.15
每股净资产（元/股）	3.47	3.34	2.22
归属于发行人股东的净利润（万元）	20,847.27	20,045.28	9,011.42
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	20,217.70	19,641.38	3,499.71
研发投入占营业收入的比例	4.46%	3.81%	4.70%

注：财务指标计算如下：
（1）流动比率＝流动资产/流动负债；
（2）速动比率＝速动资产/流动负债=（流动资产-预付款项 -存货-其他流动资产）/流动负债；
（3）资产负债率＝总负债 / 总资产；
（4）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额；
（5）存货周转率＝营业成本/存货平均余额；
（6）息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋本期计提的折旧费用＋本期无形资产摊销+本期长期待摊费用摊销；
（7）利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（计入财务费用的利息支出+计入在建工程资本化的利息支出）；
（8）每股经营活动现金净流量＝经营活动产生的现金流量净额 / 期末总股本；
（9）每股净现金流量（元/股）＝现金及现金等价物净增加（减少）额 / 期末总股本；
（10）每股净资产=所有者权益/期末总股本；
（11）归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润=归属于发行人股东的净利润非经常性损益；

（12）研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入。

（二）净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》（2010 年修订）要求计算的发行人报告期内的净资产收益率和每股收益如下：

项目	期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2025 年度	32.44%	0.99	0.99
	2024 年度	44.65%	1.26	1.26
	2023 年度	42.98%	2.17	2.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2025 年度	31.46%	0.96	0.96
	2024 年度	43.75%	1.23	1.23
	2023 年度	31.90%	0.84	0.84

注：净资产收益和每股收益计算方法如下：

净资产收益率（加权平均）＝P÷（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产的增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益＝P÷S

S＝S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益＝[P＋（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1－所得税率）]÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk＋认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

七、经营成果分析

报告期内，公司经营成果情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	133,030.71	128,170.26	84,304.79
营业成本	94,579.15	86,944.69	63,704.67

营业利润	23,918.06	23,355.70	10,054.26
利润总额	23,822.74	23,346.41	10,051.68
净利润	20,847.27	20,045.28	9,011.42
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	20,217.70	19,641.38	3,499.71

得益于国内半导体产业的政策支持及快速发展，晶圆制造产能持续扩张，带动上游关键制程及配套设备需求稳步增长。公司作为高纯工艺介质系统的供应商，核心产品市场需求持续提升。报告期内，公司营业收入和净利润复合增长率分别为 25.62%和 52.10%，经营业绩呈现持续增长态势，盈利能力稳步提升。

（一）营业收入分析

1、营业收入构成及变动分析

报告期内，公司营业收入构成如下所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	131,776.76	99.06%	126,921.76	99.03%	83,968.39	99.60%
其他业务收入	1,253.94	0.94%	1,248.50	0.97%	336.41	0.40%
合计	**133,030.71**	**100.00%**	**128,170.26**	**100.00%**	**84,304.79**	**100.00%**

报告期内，公司营业收入分别为 84,304.79 万元、128,170.26 万元及 133,030.71 万元，2024 年度营业收入同比增长 52.03%，增速较高，2025 年度营业收入同比增长 3.79%，增速放缓。

公司主营业务收入主要来源于高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备的销售。报告期内，主营业务收入分别为 83,968.39 万元、126,921.76 万元及 131,776.76 万元，占营业收入比例分别为 99.60%、99.03%及 99.06%，主营业务突出。公司其他业务收入占比较小，主要为材料销售收入。

公司营业收入规模受承接项目数量、项目规模、项目执行及验收节奏、下游晶圆厂扩产投资周期等因素综合影响。2023 年度及 2024 年度，受国内晶圆厂集中扩产带动，公司执行订单规模逐步上升；同时，随着项目执行效率的提升，相关订单于 2024 年度验收，带动当期营业收入大幅增长；2025 年受全球新建晶圆

厂开工数量阶段性回落、下游客户产线建设及设备招标节奏放缓、项目验收及订单转化周期错配等因素影响，收入增速有所收窄，但仍保持增长态势。

2、主营业务收入分析

（1）主营业务收入按产品构成分析

报告期内，公司主营业务收入分产品构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
高纯工艺介质系统	123,148.90	93.45%	123,561.78	97.35%	80,085.06	95.38%
高阶湿制程工艺设备	6,808.41	5.17%	1,543.05	1.22%	2,680.93	3.19%
其他	1,819.45	1.38%	1,816.93	1.43%	1,202.39	1.43%
合计	**131,776.76**	**100.00%**	**126,921.76**	**100.00%**	**83,968.39**	**100.00%**

注：其他主要系相关设备的维保及全面质量管理协议服务。

高纯工艺介质系统作为公司的核心收入来源，报告期各期，该业务收入金额分别为 80,085.06 万元、123,561.78 万元及 123,148.90 万元，年均复合增长率达 24.01%，占主营业务收入比例分别为 95.38%、97.35%及 93.45%，比例始终保持在 90%以上，占据主导地位，该产品主要应用于集成电路、显示面板等下游行业，为生产环节所需的高纯工艺介质提供稳定精确的输送保障。

（2）主营业务收入按销售地区分析

报告期内，公司主营业务收入按区域分布情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	124,855.19	94.75%	116,530.56	91.81%	78,315.82	93.27%
境外	6,921.57	5.25%	10,391.19	8.19%	5,652.57	6.73%
合计	**131,776.76**	**100.00%**	**126,921.76**	**100.00%**	**83,968.39**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务收入以境内市场为主，整体销售地区结构保持稳定。报告期内，公司境内销售收入分别为 78,315.82 万元、116,530.56 万元及 124,855.19 万元，占主营业务收入比例分别为 93.27%、91.81%及 94.75%，公司境内收入稳

步增长主要得益于国内集成电路、显示面板等泛半导体产业的快速发展与产能扩张，公司凭借本土化服务优势与中芯国际、华虹半导体等国内龙头企业保持长期合作关系。公司境外收入主要来自新加坡住友化学等国际知名客户。

（3）主营业务收入的季节性分析

报告期内，公司主营业务收入按季度划分如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	30,522.11	23.16%	11,316.97	8.92%	12,338.38	14.69%
第二季度	5,258.88	3.99%	32,518.99	25.62%	28,574.14	34.03%
第三季度	67,684.81	51.36%	33,748.32	26.59%	15,283.18	18.20%
第四季度	28,310.96	21.48%	49,337.48	38.87%	27,772.69	33.08%
合计	**131,776.76**	**100.00%**	**126,921.76**	**100.00%**	**83,968.39**	**100.00%**

整体来看，公司各季度主营业务收入波动较为明显，未呈现显著季节性特征，该现象主要由半导体设备行业特性及公司产品验收周期较长的特点共同决定，具体如下：①公司下游客户主要为泛半导体产业链核心厂商，其设备采购需求直接取决于自身产线扩张计划，而产线扩张计划主要受行业发展趋势、技术迭代需求及企业自身战略规划主导，不存在明显的季节性波动，进而导致公司订单获取及交付需求无固定季节性特征；②产品验收周期长导致收入确认分布不均，公司产品以定制化高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备为主，从接单、生产、发货到现场安装调试、客户终验，整个业务周期跨度较长，一般 1-2 年，收入确认需以客户终验完成为节点，而终验时间受项目规模、现场安装进度、客户验收流程等多种因素影响，无固定季度规律，因此收入确认分散在各季度，导致季度收入波动。

2025 年三季度，公司主营业务收入占比达 51.36%，主要系“WT524023CR-化学品集中供应系统”、“WT123009CR-化学品供应系统”两大核心项目验收，合计确认收入 44,113.23 万元，导致该季度收入占比显著高于其他季度，该波动符合公司项目制经营特点，具有合理业务背景。

（4）主营业务收入按下游应用行业分析

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
集成电路	113,011.65	85.76%	95,579.77	75.31%	52,776.32	62.85%
电子化学品	11,932.19	9.05%	18,431.00	14.52%	14,431.67	17.19%
显示面板	6,739.80	5.11%	9,499.69	7.48%	16,517.80	19.67%
其他	93.13	0.07%	3,411.30	2.69%	242.60	0.29%
合计	**131,776.76**	**100.00%**	**126,921.76**	**100.00%**	**83,968.39**	**100.00%**

报告期内，公司下游应用行业集中度逐步提升，核心聚焦集成电路领域，2023 年至 2025 年，该行业主营业务收入从 52,776.32 万元增长至 113,011.65 万元，年复合增长率达 46.33%，这一表现得益于全球集成电路产业技术迭代加速、国内晶圆厂产能扩张及半导体设备国产替代进程深化。

作为国内高纯工艺介质系统领域的先行者，公司凭借二十余年技术积淀与工程化经验，其自动化化学品与研磨液供应系统，已成功适配 12 英寸晶圆代工先进制程产线，可为 28nm 以下节点的稳定量产提供可靠支撑，深度契合了集成电路行业对高纯介质控制、工艺稳定性的严苛需求，从而与下游客户建立了长期稳固的业务合作关系。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成分析

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	93,685.19	99.05%	86,492.60	99.48%	63,553.60	99.76%
其他业务成本	893.96	0.95%	452.09	0.52%	151.07	0.24%
合计	**94,579.15**	**100.00%**	**86,944.69**	**100.00%**	**63,704.67**	**100.00%**

报告期内，公司营业成本分别为 63,704.67 万元、86,944.69 万元及 94,579.15 万元，营业成本随公司业务规模的扩大而增长，其中主营业务成本占比分别为

99.76%、99.48%和 99.05%，与营业收入变动趋势和结构相匹配。

2、主营业务成本分产品构成分析

报告期内，公司主营业务成本分产品构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
高纯工艺介质系统	86,442.21	92.27%	84,059.89	97.19%	60,714.51	95.53%
高阶湿制程工艺设备	6,090.67	6.50%	1,150.95	1.33%	2,154.07	3.39%
其他	1,152.30	1.23%	1,281.76	1.48%	685.02	1.08%
合计	**93,685.19**	**100.00%**	**86,492.60**	**100.00%**	**63,553.60**	**100.00%**

注：其他主要系相关设备的维保及全面质量管理协议服务。

报告期内，公司高纯工艺介质系统主营业务成本分别为 60,714.51 万元、84,059.89 万元及 86,442.21 万元，占公司主营业务成本的比例分别为 95.53%、97.19%及 92.27%，是公司主营业务成本的主要构成部分。公司主营业务成本按产品分类的结构和变动趋势与主营业务收入相匹配。

3、主营业务成本构成分析

报告期内，公司主营业务成本构成及占比具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	65,444.63	69.86%	55,790.81	64.50%	39,089.48	61.51%
直接人工	8,830.99	9.43%	5,912.18	6.84%	4,441.41	6.99%
劳务分包	9,864.29	10.53%	17,396.49	20.11%	12,923.03	20.33%
制造费用及其他	9,545.28	10.19%	7,393.12	8.55%	7,099.68	11.17%
合计	**93,685.19**	**100.00%**	**86,492.60**	**100.00%**	**63,553.60**	**100.00%**

公司主营业务成本由直接材料、直接人工、劳务分包、制造费用及其他构成。报告期内，公司主营业务成本规模随收入增长同步扩大，从 2023 年 63,553.60 万元增长至 2025 年 93,685.19 万元，年复合增长率 21.41%，主营业务成本与收入规模增长相适配。其中，直接材料和劳务分包是主营业务成本的主要构成项目。

报告期内，发行人产品存在高度定制化的特点，并非标准化的产品，不同项目因合同签订方式及服务内容、项目执行周期以及系统的复杂程度等因素影响，在配套设备数量、现场管道等原材料的使用量以及现场安装工作量等方面有所不同，导致主营业务成本结构在报告期内存在一定波动。

报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 61.51%、64.50%和69.86%，占比逐年提升，直接材料主要包括专用部件、管件、阀件、仪器仪表及电气控制等核心部件。

劳务分包主要系将与设备主体无关的现场管路安装和劳务工作交由分包商实施。报告期内，劳务分包占主营业务成本比例分别为 20.33%、20.11%及 10.53%，2025 年度，发行人劳务分包占比较低，主要系部分项目客户将现场管路安装及相关劳务作业独立对外发包，导致发行人当期劳务分包工作量减少，相应分包成本降低所致，亦导致其他成本占比相应提高。

（三）毛利及毛利率分析

1、毛利构成

报告期内，公司的综合毛利总体构成及变化的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务毛利	38,091.58	99.06%	40,429.15	98.07%	20,414.79	99.10%
其他业务毛利	359.99	0.94%	796.41	1.93%	185.34	0.90%
合计	**38,451.56**	**100.00%**	**41,225.56**	**100.00%**	**20,600.12**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务毛利分别为 20,414.79 万元、40,429.15 万元及38,091.58 万元，占综合毛利比重分别为 99.10%、98.07%及 99.06%，占比稳定，是公司利润的主要来源。

2、主营业务毛利构成

报告期内，公司主营业务毛利按产品类别构成及占比情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
高纯工艺介质系统	36,706.69	96.36%	39,501.89	97.71%	19,370.55	94.88%
高阶湿制程工艺设备	717.74	1.88%	392.10	0.97%	526.86	2.58%
其他	667.15	1.75%	535.17	1.32%	517.37	2.53%
合计	**38,091.58**	**100.00%**	**40,429.15**	**100.00%**	**20,414.79**	**100.00%**

注：其他主要系相关设备的维保及全面质量管理协议服务。

高纯工艺介质系统作为公司核心盈利来源，毛利规模与占比均呈现显著增长态势。2023 年到 2025 年，该业务毛利从 19,370.55 万元增长至 36,706.69 万元，年均复合增长率达 37.66%；毛利占比从 94.88%提升至 96.36%，成为支撑公司主营业务盈利的核心。

高阶湿制程工艺设备毛利规模较小，这一情况与该产品处于前期市场拓展阶段的发展现状相符，目前该产品收入规模相对有限，导致毛利贡献较低。

3、综合毛利率分析

报告期内，公司综合毛利率的总体构成及变化情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
主营业务毛利率	28.91%	31.85%	24.31%
其他业务毛利率	28.71%	63.79%	55.09%
综合毛利率	**28.90%**	**32.16%**	**24.44%**

报告期内，公司综合毛利率分别为 24.44%、32.16%及 28.90%，公司综合毛利率波动主要系主营业务毛利率变动所致。

4、主营业务毛利率分析

报告期内，公司主营业务毛利率按产品类别的构成情况如下：

类别	2025 年度			2024 年度			2023 年度		
	毛利率	主营业务收入占比	对毛利率贡献	毛利率	主营业务收入占比	对毛利率贡献	毛利率	主营业务收入占比	对毛利率贡献
高纯工艺介质系统	29.81%	93.45%	27.86%	31.97%	97.35%	31.12%	24.19%	95.38%	23.07%

高阶湿制程工艺设备	10.54%	5.17%	0.54%	25.41%	1.22%	0.31%	19.65%	3.19%	0.63%
其他	36.67%	1.38%	0.51%	29.45%	1.43%	0.42%	43.03%	1.43%	0.62%
合计	**28.91%**	**100.00%**	**28.91%**	**31.85%**	**100.00%**	**31.85%**	**24.31%**	**100.00%**	**24.31%**

注：其他主要系相关设备的维保及全面质量管理协议服务。

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 24.31%、31.85%及 28.91%。鉴于高纯工艺介质系统业务收入占主营业务收入的比例分别为 95.38%、97.35%及 93.45%，公司主营业务毛利率的变动主要系该业务毛利率波动所致。报告期内，高纯工艺介质系统业务毛利率分别为 24.19%、31.97%及 29.81%，整体呈先升后降趋势，主要受下游行业景气度周期波动、阶段性供应链扰动、市场竞争格局及公司项目执行策略等多重因素综合影响，具体分析如下：

（1）2023 年度

2021 年下半年至 2022 年，受全球半导体行业资本开支高增带动，核心零部件供应商产能优先向国际头部半导体设备企业倾斜，导致国内市场部分高纯材料供应趋紧；同时，国内物流管控进一步延长了交付周期、推高了材料采购与运输成本。

2023 年度验收的部分特定项目，合同定价周期与成本执行周期存在错配影响，其招投标及商务谈判主要发生于 2021 年，彼时原材料价格及物流成本尚未出现大幅波动，相关合同均采用固定总价模式。同时，部分项目下游客户所属领域彼时正处于产业周期调整阶段，价格敏感度较高，项目报价市场竞争激烈，导致发行人定价策略相对激进。在合同后续执行过程中，尽管项目执行成本大幅上涨，但受限于已锁定的合同条款及下游客户较强的议价地位，相关成本上涨难以通过合同变更向下游传导。

为保障项目按期交付，公司部分采用替代渠道采购或承担较高物流费用，同时项目执行周期延长亦推高了劳务成本，导致项目执行成本上涨。因此，成本端的上升与收入端的固定定价形成挤压，导致该年度项目毛利率阶段性承压。

（2）2024 年度

2024 年度，发行人高纯工艺介质系统产品毛利率为 31.97%，较 2023 年度上升 7.78 个百分点，主要系原材料供应趋稳及高毛利项目确认收入等多重因素共

同作用所致。

一方面，2024 年度，发行人部分技术门槛较高、溢价能力较强的高纯工艺介质系统项目确认收入，该等项目合同签订时点为 2022 年下半年，当时半导体行业资本开支处于高位，核心材料供应出现明显紧缺，发行人基于对原材料价格波动的前瞻性判断，在报价中合理纳入成本风险溢价。

另一方面，受益于半导体行业快速发展，部分特定项目对关键技术指标、系统交付周期提出了严格要求。发行人作为国内高纯工艺介质系统领域的领先企业，具备较强的综合技术实力，依托成熟的模块化设计体系与高效的供应链管理机制，能够保障项目在紧迫交期内实现高质量交付；同时，凭借对客户工艺需求的深度理解，发行人在市场竞争中具备显著优势，进而拥有较强的产品溢价能力。

在项目执行过程中，随着 2023 年以来供应链紧张局面缓解，加之发行人提前布局备货，项目执行成本得到有效控制；同时，发行人通过优化系统管路布局等技术措施，进一步降低了项目成本。收入端的合理溢价与成本端的有效管控共同推动该等项目毛利率处于较高水平，进而带动 2024 年度高纯工艺介质系统整体毛利率大幅上涨。

（3）2025 年度

2025 年度，受全球贸易摩擦、半导体产业周期性调整影响，国内下游晶圆厂扩产节奏放缓，行业整体市场竞争加剧。中低端市场价格竞争尤为激烈，但高端集成电路市场客户为保障产线良率及交付质量，更注重工艺系统的可靠性、稳定性及供应商的技术实力，对产品价格的敏感度相对较低。

发行人凭借多年在高纯工艺介质系统领域的技术积累，具备雄厚的技术实力、稳定的高质量交付能力及完善的产品售后保障体系，成功获取国内头部半导体厂商的项目订单，得以维持相对较高的产品溢价。因此，尽管受行业周期性调整影响，高纯工艺介质系统毛利率略有下滑，但仍维持在较高水平。

综上，报告期内发行人高纯工艺介质系统业务毛利率的变动趋势，是下游行业景气度、阶段性供应链波动及经营策略等多重因素共同作用的结果，毛利率变动具有合理性，盈利能力未发生重大不利变化，核心业务盈利能力保持稳定。

5、与同行业可比公司对比分析

（1）主要业务毛利率与可比公司的比较

报告期内，发行人专注于高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备业务。同行业可比公司中，正帆科技的制程关键系统业务、至纯科技的高纯系统集成业务与发行人上述业务具有相似性，故选取该两项业务作为可比业务进行毛利率对比分析，具体情况如下：

公司名称	业务名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
正帆科技	制程关键系统	20.87%	25.84%	25.82%
至纯科技	高纯系统集成	23.67%	33.86%	37.06%
平均值	/	**22.27%**	**29.85%**	**31.44%**
发行人	高纯工艺介质系统	**29.81%**	**31.97%**	**24.19%**

报告期内，发行人高纯工艺介质系统业务毛利率分别为 24.19%、31.97%及29.81%，整体处于同行业可比公司同类业务毛利率区间内，具备可比性。但受产品结构、材料供应链波动、行业竞争环境及企业自身经营策略差异等因素影响，发行人毛利率变动趋势与行业均值存在一定差异。其中，2023 年度低于行业均值，2024 年度基本持平，2025 年度则显著高于行业平均水平，具体分析如下：

①2023 年度及 2024 年度

在高纯工艺介质系统细分产品领域，发行人与可比公司的核心产品侧重点存在差异。发行人该业务的核心产品为自动化化学品与研磨液供应系统；而根据公开披露信息，正帆科技、至纯科技在相似业务中，高纯特气系统产品占比较高：正帆科技 2023 年前十大项目中高纯特气系统产品占比在 38.75%至 57.73%范围之间；至纯科技 2025 年年报披露，其在中国大陆主流 12 寸晶圆厂特气设备及系统中标项目市占率达 46.9%，化学品设备及系统市占率为 29.0%。二者均与发行人产品结构存在显著差异。

鉴于高纯特气系统与自动化化学品与研磨液供应系统因气态与液态介质的性质差异，两者在技术特点、设计逻辑、核心材料选用等方面存在区别，进而导致毛利率水平及变动趋势存在差异。具体而言，高纯特气系统核心侧重点在于泄漏防护、流量与压力的精准控制及尾气处理，其所用的高纯不锈钢材料的国产化

替代进度较快，成熟制程所用材料国产化率较高，高端制程所用材料虽仍有进口依赖，但整体材料采购成本相对可控。化学品及研磨液供应系统因输送介质为强腐蚀性液态物质，核心侧重点在于杂质析出控制、多组分精准配比及无间断稳定供液，核心管路、阀门材料主要为 PTFE、PFA 等防腐洁净材料，其中适配先进制程的高端材料国产化率较低，进口占比较高，导致材料采购价格较高且受供应链波动影响较大。

2023 年度，受 2022 年度全球供应链紧张因素影响，发行人生产所需进口核心材料（阀门、泵浦、PFA 管路等）供应紧张，价格出现明显上涨，导致产品生产成本上升，毛利率承压。而可比公司相似业务中，高纯特气系统占比较高，其核心材料（高纯不锈钢等）受进口材料价格波动的扰动较小，因此毛利率维持在较高水平。

2024 年度，受益于供应链供应缓解、项目执行效率提升，以及个别高毛利项目影响，发行人毛利率提升至 31.97%，与可比公司平均水平差异较小，产品盈利水平恢复明显。

②2025 年度

2025 年度，受全球贸易摩擦持续、半导体产业周期性调整影响，国内下游晶圆厂扩产节奏放缓，行业整体市场竞争加剧。正帆科技自 2024 年起采取激进的定价策略，通过降低产品报价以获取订单，导致其制程关键系统业务毛利率持续下滑；至纯科技则被美国商务部工业与安全局列入实体清单的影响，对公司的供应链安全和部分客户的采购决策产生了一定程度的扰动，同时为抢占市场份额承接部分低毛利战略性订单，导致其高纯系统集成业务毛利率大幅下滑至 23.67%，进而拉低了可比公司整体平均毛利率。

在行业竞争加剧的背景下，中低端市场呈现激烈的价格竞争，但高端集成电路市场客户为保障产线良率、交付质量，更注重工艺系统的可靠性、稳定性及供应商的技术实力，对产品价格的敏感度相对较低。发行人凭借多年在高纯工艺介质系统领域的技术积累，具备技术实力、高质量交付能力及产品售后保障能力，成功获取国内头部半导体厂商的项目订单，获得相对较高的产品溢价，因此尽管受行业周期影响毛利率略有下滑，但仍显著高于可比公司平均水平。

综上，报告期内发行人高纯工艺介质系统业务毛利率与同行业可比公司的差异及变动趋势，主要系产品结构差异、阶段性供应链波动、行业竞争情况及企业自身经营策略等多重因素共同作用所致，符合半导体高纯介质系统行业的发展特性及企业自身业务发展定位，具有合理性。

（四）期间费用

报告期内，公司期间费用及占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	4,224.30	3.18%	3,947.93	3.08%	3,193.74	3.79%
管理费用	5,973.67	4.49%	6,253.46	4.88%	3,468.82	4.11%
研发费用	5,939.14	4.46%	4,887.57	3.81%	3,964.56	4.70%
财务费用	-389.51	-0.29%	-45.02	-0.04%	69.00	0.08%
合计	**15,747.59**	**11.84%**	**15,043.94**	**11.74%**	**10,696.12**	**12.69%**

报告期内，公司期间费用分别为 10,696.12 万元、15,043.94 万元、15,747.59 万元，占营业收入的比例分别为 12.69%、11.74%、11.84%。随着公司业务规模扩大，期间费用总额持续增长，期间费用总额占营业收入的比例基本稳定。

1、销售费用

（1）销售费用构成和变动情况

报告期内，公司销售费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	3,305.86	78.26%	3,123.63	79.12%	2,543.46	79.64%
折旧与摊销	175.90	4.16%	174.98	4.43%	159.35	4.99%
股份支付	203.78	4.82%	185.84	4.71%	-	-
业务招待费	170.67	4.04%	89.23	2.26%	91.32	2.86%
租金支出	146.34	3.46%	155.42	3.94%	146.50	4.59%

差旅费	88.43	2.09%	75.40	1.91%	105.40	3.30%
其他	133.31	3.16%	143.43	3.63%	147.70	4.62%
合计	**4,224.30**	**100.00%**	**3,947.93**	**100.00%**	**3,193.74**	**100.00%**

公司发生的销售费用主要由职工薪酬、折旧与摊销和股份支付等构成。报告期内，公司销售费用分别为 3,193.74 万元、3,947.93 万元、4,224.30 万元，占当期营业收入的比重分别为 3.79%、3.08%、3.18%。

报告期各期，公司销售费用中的业务招待费分别为 91.32 万元、89.23 万元、170.67 万元。2025 年度业务招待费有所增加，主要系公司业务规模持续拓展、客户合作深度不断加强，公司相应增加了客户维护、商务洽谈及市场拓展等相关活动支出。公司业务招待费支出整体规模较小，与业务发展情况相匹配，具备商业合理性。

（2）销售费用率与可比公司对比情况

公司与同行业可比公司销售费用率比较情况如下：

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
正帆科技	1.99%	1.50%	1.49%
至纯科技	4.55%	3.60%	3.28%
平均值	**3.27%**	**2.55%**	**2.38%**
发行人	**3.18%**	**3.08%**	**3.79%**

2023 年和 2024 年，发行人销售费用率与至纯科技较为接近，2025 年，发行人销售费用率较至纯科技较低，相比正帆科技较高，主要系：（1）正帆科技营业收入规模显著高于发行人，规模效应更为突出，且由于其大力发展电子材料业务，与发行人业务差异显著，其销售费用率相对偏低；（2）发行人与至纯科技在业务类型、客户结构等具有一定相似性，2025 年，至纯科技销售费用金额保持稳定，但营业收入有所下降，导致当期至纯科技销售费用率有所上升，因此，2023 年和 2024 年发行人销售费用率与至纯科技较为接近，2025 年，发行人销售费用率较至纯科技较低，具有合理性。

2、管理费用

（1）管理费用构成和变动情况

报告期内，公司管理费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	3,467.78	58.05%	3,919.31	62.67%	2,235.55	64.45%
折旧与摊销	363.87	6.09%	255.33	4.08%	260.53	7.51%
股份支付	1,055.15	17.66%	937.51	14.99%	11.19	0.32%
专业服务费	399.78	6.69%	354.69	5.67%	334.75	9.65%
租金支出	171.97	2.88%	170.07	2.72%	149.52	4.31%
业务招待费	80.29	1.34%	61.52	0.98%	81.61	2.35%
保险费	69.70	1.17%	72.51	1.16%	52.80	1.52%
交通费	44.40	0.74%	50.96	0.81%	50.90	1.47%
差旅费	38.65	0.65%	41.19	0.66%	41.31	1.19%
办公费	34.32	0.57%	47.12	0.75%	50.83	1.47%
其他	247.75	4.15%	343.25	5.49%	199.83	5.76%
合计	**5,973.67**	**100.00%**	**6,253.46**	**100.00%**	**3,468.82**	**100.00%**

公司管理费用主要由职工薪酬、股份支付、折旧与摊销和专业服务费等构成。报告期各期，公司管理费用分别为 3,468.82 万元、6,253.46 万元、5,973.67 万元，增长后有所回落。管理费用占当期营业收入的比重分别为 4.11%、4.88%、4.49%，整体保持稳定，波动较小。

报告期各期，发行人管理费用-职工薪酬分别为 2,235.55 万元、3,919.31 万元、3,467.78 万元，整体呈增长后有所回落的趋势，变动与公司业务发展、管理需求及激励政策匹配，具备合理性，具体分析如下：

2024 年，发行人管理费用-职工薪酬较上年增长较多，主要系：为适配业务扩张及规范化管理需求，2024 年公司针对性招聘行政管理人员，补充团队力量、提升管理效率，导致管理人员薪酬基数增加；2024 年，公司整体净利润水平较上期大幅上涨，公司效益明显改善，为激励管理人员，发放较上年显著增加的业绩奖金，该等发放符合公司既定薪酬激励政策，系对当年工作成果的合理奖励。

2025 年，发行人管理费用-职工薪酬较上年有所减少，主要受 2025 年国际贸

易摩擦及宏观环境不确定性影响，下游半导体厂商资本开支趋于谨慎，扩产节奏阶段性放缓所致，公司当年在手订单规模有所下降且当期净利润无明显增长，管理人员业绩奖金较 2024 年有所下降，系正常合理调整。

（2）管理费用率与可比公司对比情况

公司与同行业可比公司管理费用率比较情况如下：

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
正帆科技	6.97%	5.89%	7.44%
至纯科技	16.09%	11.34%	11.52%
平均值	**11.53%**	**8.61%**	**9.48%**
发行人	**4.49%**	**4.88%**	**4.11%**

报告期内，公司管理费用率低于同行业可比公司平均值，差异具有合理性，主要原因如下：①至纯科技业务板块多元化，分子公司数量众多，管理链条较长且组织复杂度较高，相应管理费用投入较大，且 2025 年其营业收入有所下降，进一步导致其管理费用率上升；相比之下，公司组织架构相对精简，管理效率较高；②公司生产经营场所主要采用租赁方式，相比可比公司自建厂房的模式，公司固定资产规模较小，当期计提的折旧与摊销费用较低，从而降低了管理费用率；③同行业可比公司作为已上市公司，报告期内实施了股权激励计划，确认了较大金额的股份支付费用并计入管理费用，公司报告期内股份支付费用金额相对较小，进一步拉低了管理费用率水平。

综上，发行人管理费用率低于同行业可比公司平均水平具有合理性。

3、研发费用

（1）研发费用构成

报告期内，公司研发费用的具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	2,726.26	45.90%	2,533.39	51.83%	2,416.40	60.95%

直接投入	2,653.27	44.67%	1,858.11	38.02%	1,257.60	31.72%
折旧及摊销	239.10	4.03%	246.53	5.04%	186.92	4.71%
委外研发费	56.87	0.96%	87.38	1.79%	-	-
股份支付	47.25	0.80%	58.07	1.19%	-	-
其他	216.39	3.64%	104.09	2.13%	103.64	2.61%
合计	**5,939.14**	**100.00%**	**4,887.57**	**100.00%**	**3,964.56**	**100.00%**

报告期各期，公司研发费用分别为 3,964.56 万元、4,887.57 万元和 5,939.14 万元，占营业收入的比例分别为 4.70%、3.81%和 4.46%，报告期内累计研发投入金额为 14,791.27 万元，累计研发投入金额占累计营业收入的比例为 4.28%。报告期内，公司研发费用金额稳步上升，2024 年度，受营业收入大幅增长影响，致使研发费用率出现波动，但研发投入强度整体保持稳定，与公司经营规模相匹配。

公司研发费用主要由职工薪酬和直接投入组成，报告期各期职工薪酬和直接投入占研发费用总额的比重分别为 92.67%、89.85%及 90.58%。职工薪酬主要为公司研发人员的薪酬，研发人员薪酬按所属研发项目进行归集。直接投入系研发活动领用的材料费用。报告期内，随着公司业务领域的拓展，积极推进高阶湿制程工艺设备业务，加之高纯工艺介质系统业务技术研发不断深入，公司研发项目数量与技术复杂度双重提升。2023 年至 2025 年，研发项目数量由 14 个增至 29 个，研发资源投入相应扩大，带动直接投入金额呈逐年上升趋势。

报告期内，公司不存在研发费用资本化的情形。

（2）研发项目情况

报告期内，公司主要的研发项目及其对应的研发费用支出情况如下：

单位：万元

序号	研发项目	整体预算	费用支出			截至 2025 年 12 月 31 日实施进度
			2025 年度	2024 年度	2023 年度	
1	关于 200L 桶外桶自动清洗设备的研发	395.00	400.78	-	-	进行中
2	研磨液供应系统用温度调节控制系统的研发	500.00	495.10	-	-	已完成
3	关于 UBMetch 蚀刻清洗机的研发	1,160.00	123.83	139.17	280.10	进行中

4	关于新型研磨液系统循环机构的研发	300.00	98.21	109.16	136.35	已完成
5	高阶模组化湿制程系统的研发	1,172.80	-	393.83	284.58	已完成
6	具有漏液感应的化学品集中供液系统及其应用的研发	480.00	374.46	-	-	已完成
7	化学品设备零部件自动维修平台的研发	420.00	445.31	-	-	已完成
8	化学品容器微型开关盖机构的研发	380.00	428.70	-	-	已完成
9	研磨液自动稀释混合供应系统的研发	800.00	352.96	159.52	-	进行中
10	半导体 CDS 系统设计对输送药液品控影响的研发	660.00	168.16	194.61	-	进行中
11	多称心静态重量测量及失效自诊断系统的研发	350.00	85.26	254.33	-	已完成
12	一种物料自动识别系统的研发	350.00	-	315.84	-	已完成
13	一种晶圆尺寸兼容型单片式定显影系统的研发	800.00	81.58	638.49	-	进行中
14	一种变角度旋转控制的上下摇摆机构的研发	650.00	-	-	615.67	已完成
15	抗气泡高稳定折光计的研发	600.00	-	-	516.16	已完成
16	一种研磨液供应系统用阀箱的研发	350.00	-	-	439.34	已完成
17	一种研磨液供应系统用快速连接装置的研发	500.00	-	-	437.33	已完成
18	全自动 4L 桶清洗系统的研发	350.00	-	-	327.44	已完成
	合计	/	**3,054.34**	**2,204.95**	**3,036.96**	

（3）与可比公司的研发费用率比较情况

报告期内，公司研发费用率与同行业可比公司比较情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
正帆科技	6.68%	6.39%	6.55%
至纯科技	11.69%	7.41%	7.11%
平均值	**9.18%**	**6.90%**	**6.83%**
发行人	**4.46%**	**3.81%**	**4.70%**

报告期内，同行业可比公司研发费用率整体高于公司，主要系产品类型及研发方向存在差异所致。具体而言，正帆科技积极拓展电子气体材料等新业务领域，至纯科技则加大先进制程的湿法设备研发投入力度，两者均因新业务线的前期高投入导致研发费用率相对较高。综上，同行业可比公司较高的研发费用率系其特定发展阶段及产品类型差异所致，公司与同行业可比公司研发费用率的差异具有

合理性。

4、财务费用

（1）财务费用构成和变动情况

报告期内，公司财务费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息费用	62.38	337.95	377.41
减：利息收入	482.48	381.12	315.06
汇兑损益	27.31	-6.74	-5.69
手续费及其他	3.27	4.89	12.33
合计	**-389.51**	**-45.02**	**69.00**

报告期内，公司财务费用分别为 69.00 万元、-45.02 万元、-389.51 万元，主要由利息费用和利息收入构成。2025 年度，公司利息费用有所下降，主要系当期未发生贷款。

（2）财务费用率与可比公司对比情况

公司与同行业可比公司财务费用率比较情况如下：

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
正帆科技	1.67%	0.44%	0.37%
至纯科技	9.37%	7.32%	7.48%
平均值	**5.52%**	**3.88%**	**3.92%**
发行人	**-0.29%**	**-0.04%**	**0.08%**

报告期内，公司财务费用率较低，公司财务状况良好，借款较少，因此财务费用率低于同行业可比公司平均水平。

（五）其他项目分析

1、其他收益

报告期内，公司其他收益的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、计入其他收益的政府补助	**996.62**	**529.01**	**558.28**
其中：直接计入当期损益的政府补助	996.62	529.01	558.28
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	**476.09**	**855.04**	**584.14**
其中：手续费返还	19.62	7.56	5.22
进项税加计扣除等	456.47	847.47	578.92
合计	**1,472.71**	**1,384.05**	**1,142.42**

报告期内，公司计入当期损益金额 10 万元以上主要政府补助明细如下表所示：

单位：万元

2025 年度				
序号	**补贴对象**	**收益类别**	**补贴项目**	**计入其他收益金额**
1	冠礼有限	与收益相关	稳岗返还	27.56
2	上海冠礼	与收益相关	“十四五”战略新兴发展财政补贴	920.00
3	上海冠礼	与收益相关	制造业企业产业规模升级奖励	20.00
2024 年度				
序号	**补贴对象**	**收益类别**	**补贴项目**	**计入其他收益金额**
1	冠礼有限	与收益相关	稳岗返还	20.07
2	冠礼有限	与收益相关	2022 年江苏省“专精特新”中小企业评定奖补	15.00
3	上海冠礼	与收益相关	2023 年浦东新区安商育商专项补贴	383.00
4	上海冠礼	与收益相关	张江示范区 2024 年度专项发展资金	30.70
5	上海冠礼	与收益相关	2023 年稳岗补贴（浦东新区）	25.71
6	上海冠礼	与收益相关	2024 年科技发展基金奖补	15.00
7	新加坡冠礼	与收益相关	渐进式加薪补贴计划	10.51
2023 年度				
序号	**补贴对象**	**收益类别**	**补贴项目**	**计入其他收益金额**
1	冠礼有限	与收益相关	稳岗补贴	11.61
2	上海冠礼	与收益相关	2022 年浦东新区安商育商专项补贴	255.50
3	上海冠礼	与收益相关	2021 年浦东新区安商育商专项补贴	236.50

4	上海冠礼	与收益相关	2023 年科技发展基金奖补	30.00

2、投资收益

报告期内，公司不存在投资收益。

3、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款坏账损失	195.52	-1,016.36	-757.38
其他应收款坏账损失	-13.20	26.66	12.52
应收票据坏账损失	9.65	-9.65	
合计	**191.97**	**-999.35**	**-744.86**

公司信用减值损失主要为应收账款和应收票据计提的坏账损失，具体情况参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“八、资产质量分析”之“（二）流动资产构成及变动分析”之“2、应收票据及应收款项融资”、“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“八、资产质量分析”之“（二）流动资产构成及变动分析”之“3、应收账款及合同资产”。

4、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合同资产减值损失	-126.43	-132.55	-50.59
存货跌价损失	166.00	-2,055.55	381.47
其他非流动资产减值损失	-57.35	-95.31	-82.13
合计	**-17.78**	**-2,283.41**	**248.75**

报告期内，公司资产减值损失分别为 248.75 万元、-2,283.41 万元及-17.78 万元，主要为存货跌价损失，具体情况参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“八、资产质量分析”之“（二）流动资产构成及变动分析”之“6、存货”。

5、资产处置收益

2024 年度和 2025 年度，公司资产处置收益分别为 1.83 万元及 3.13 万元，金额较小，主要为处置固定资产损益。

6、营业外收入

报告期内，公司营业外收入金额分别为 6.78 万元、6.07 万元、31.65 万元，金额较小，主要为无需支付的款项。

7、营业外支出

报告期内，公司营业外支出的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
资产报废损失	31.41	14.69	8.56
滞纳金	92.98	0.04	0.07
其他	2.58	0.63	0.73
合计	**126.97**	**15.35**	**9.36**

报告期内，公司营业外支出分别为 9.36 万元、15.35 万元、126.97 万元，金额较小，主要为资产报废损失和滞纳金等。

8、所得税费用

报告期内，公司所得税费用情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
当期所得税费用	563.59	4,431.66	2,651.75
递延所得税费用	2,411.88	-1,130.53	-1,611.49
合计	**2,975.47**	**3,301.13**	**1,040.26**

报告期内，公司所得税费用分别为 1,040.26 万元、3,301.13 万元、2,975.47 万元。

（六）非经常性损益分析

报告期各期，归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为 5,511.71 万元、

403.91 万元、629.57 万元，占归属于母公司股东净利润的比例分别为 61.16%、2.01%、3.02%。2023 年度，受公司重大资产重组的影响，占比较高；2024 年度和 2025 年度占比较小，发行人未对非经常性损益产生依赖。

（七）主要税种纳税情况

公司主要税种为增值税和企业所得税，具体缴纳情况如下：

1、增值税

报告期内，公司增值税缴纳情况如下：

单位：万元

项目	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2025 年度	1,996.67	3,930.79	2,842.04	3,085.43
2024 年度	211.16	8,755.72	6,970.20	1,996.67
2023 年度	434.48	4,689.89	4,913.20	211.16

注：此处增值税包含商品及服务税（GST）。

2、企业所得税

报告期内，公司企业所得税缴纳情况如下：

单位：万元

项目	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2025 年度	3,522.23	583.41	4,957.68	-852.04
2024 年度	1,766.79	4,428.08	2,672.65	3,522.23
2023 年度	1,554.04	2,657.86	2,445.10	1,766.79

八、资产质量分析

（一）资产构成分析

报告期各期末，公司的资产构成及其变化情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	金额	占比	金额
流动资产	168,516.87	92.33%	212,743.27	93.73%	183,860.46	94.68%
非流动资产	13,991.68	7.67%	14,232.03	6.27%	10,335.91	5.32%

资产总额	**182,508.55**	**100.00%**	**226,975.30**	**100.00%**	**194,196.36**	**100.00%**

报告期各期末，公司资产总额分别为 194,196.36 万元、226,975.30 万元、182,508.55 万元。2025 年末，公司资产总额较上期末有所下降，主要系存货余额下降所致。

（二）流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	34,061.30	20.21%	37,445.96	17.60%	26,135.98	14.22%
应收票据	146.42	0.09%	1,861.27	0.87%	369.28	0.20%
应收账款	30,131.29	17.88%	24,082.29	11.32%	17,543.84	9.54%
应收款项融资	6,441.99	3.82%	7,518.80	3.53%	285.89	0.16%
预付款项	1,705.60	1.01%	1,557.65	0.73%	2,823.84	1.54%
其他应收款	756.49	0.45%	538.99	0.25%	700.24	0.38%
存货	90,448.07	53.67%	134,954.15	63.44%	133,819.98	72.78%
合同资产	3,588.94	2.13%	4,167.14	1.96%	1,906.92	1.04%
其他流动资产	1,236.76	0.73%	617.01	0.29%	274.49	0.15%
流动资产合计	**168,516.87**	**100.00%**	**212,743.27**	**100.00%**	**183,860.46**	**100.00%**

报告期各期末，公司流动资产余额分别为 183,860.46 万元、212,743.27 万元、168,516.87 万元。公司流动资产以货币资金、应收账款和存货为主，报告期各期末的上述资产合计占流动资产的比例分别为 96.54%、92.36%、91.77%。

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 26,135.98 万元、37,445.96 万元、34,061.30 万元，占流动资产的比例分别为 14.22%、17.60%、20.21%，具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
库存现金	-	-	-
银行存款	33,879.91	35,171.74	18,270.53
其他货币资金	181.38	2,274.21	7,865.45
合计	**34,061.30**	**37,445.96**	**26,135.98**

报告期各期末，公司货币资金主要为银行存款和其他货币资金，其中，其他货币资金主要是保函保证金。

2、应收票据及应收款项融资

（1）应收票据

①应收票据明细

报告期各期末，公司应收票据情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	146.42	1,677.92	369.28
商业承兑汇票	-	193.00	-
小计	**146.42**	**1,870.92**	**369.28**
坏账准备	-	9.65	-
合计	**146.42**	**1,861.27**	**369.28**

报告期各期末，公司应收票据金额为 369.28 万元、1,861.27 万元及 146.42 万元，占各期末流动资产的比例分别为 0.20%、0.87%及 0.09%，主要为银行承兑汇票。

报告期各期末，公司不存在已质押的应收票据。

②票据背书或贴现情况

报告期各期末，公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	-	8.20	-	264.60	-	59.05
商业承兑汇票	-	-	-	-	-	-
合计	**-**	**8.20**	**-**	**264.60**	**-**	**59.05**

报告期内，公司收到的承兑汇票到期均足额兑付，公司不存在因出票人未履约而将其转入应收账款的票据，亦不存在因出票人未履约而被追索的情况。

（2）应收款项融资

根据新金融工具准则，公司将既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票划分为应收款项融资。

①应收款项融资明细

报告期各期末，公司应收款项融资情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	6,441.99	7,518.80	285.89
合计	**6,441.99**	**7,518.80**	**285.89**

报告期各期末，公司应收款项融资金额分别为 285.89 万元、7,518.80 万元和 6,441.99 万元。

②应收款项融资背书或贴现情况

报告期各期末，公司已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	2,487.84	-	4,296.95	-	2,584.47	-
商业承兑汇票	-	-	-	-	-	-
合计	**2,487.84**	**-**	**4,296.95**	**-**	**2,584.47**	**-**

3、应收账款及合同资产

报告期各期末，公司应收账款及合同资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款账面余额	33,759.58	27,893.06	20,346.46
应收账款坏账准备	3,628.29	3,810.77	2,802.63
应收账款账面价值	**30,131.29**	**24,082.29**	**17,543.84**
合同资产账面余额	4,019.82	4,471.00	2,078.34
合同资产坏账准备	430.88	303.86	171.42
合同资产账面价值	**3,588.94**	**4,167.14**	**1,906.92**

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 17,543.84 万元、24,082.29 万元及 30,131.29 万元，应收账款账面价值整体呈增长趋势，与营业收入变化趋势基本一致。

（1）应收账款及合同资产变动情况

报告期各期末，公司应收账款及合同资产余额及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
应收账款余额	33,759.58	27,893.06	20,346.46
合同资产余额	4,019.82	4,471.00	2,078.34
应收账款及合同资产余额	**37,779.40**	**32,364.06**	**22,424.81**
应收账款及合同资产余额增长率	16.73%	44.32%	-
营业收入	133,030.71	128,170.26	84,304.79
应收账款及合同资产余额占营业收入比例	**28.40%**	**25.25%**	**26.60%**

报告期各期末，公司应收账款及合同资产的账面余额分别为 22,424.81 万元、32,364.06 万元及 37,779.40 万元，占营业收入的比例分别为 26.60%、25.25%及 28.40%。报告期内，随着经营规模的不断扩大，公司应收账款及合同资产余额随之增加。

（2）应收账款坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款按类别计提坏账准备情况如下：

单位：万元

2025 年 12 月 31 日					
项目	**账面余额**		**坏账准备**		**账面价值**
	金额	**占比**	**金额**	**计提比例**	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	33,759.58	100.00%	3,628.29	10.75%	30,131.29
其中：账龄组合	33,759.58	100.00%	3,628.29	10.75%	30,131.29
合计	**33,759.58**	**100.00%**	**3,628.29**	**10.75%**	**30,131.29**
2024 年 12 月 31 日					
项目	**账面余额**		**坏账准备**		**账面价值**
	金额	**占比**	**金额**	**计提比例**	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	27,893.06	100.00%	3,810.77	13.66%	24,082.29
其中：账龄组合	27,893.06	100.00%	3,810.77	13.66%	24,082.29
合计	**27,893.06**	**100.00%**	**3,810.77**	**13.66%**	**24,082.29**
2023 年 12 月 31 日					
项目	**账面余额**		**坏账准备**		**账面价值**
	金额	**占比**	**金额**	**计提比例**	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	20,346.46	100.00%	2,802.63	13.77%	17,543.84
其中：账龄组合	20,346.46	100.00%	2,802.63	13.77%	17,543.84
合计	**20,346.46**	**100.00%**	**2,802.63**	**13.77%**	**17,543.84**

①应收账款按账龄组合计提坏账准备

对于按信用风险特征组合计提坏账的应收账款，公司采用账龄分析法计提坏账，账龄 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上应收账款坏账准备计提比例分别为 5%、10%、30%、50%、80%和 100%。

报告期各期末，公司应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备情况如下：

单位：万元

账龄	2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	占比	坏账准备	账面余额	占比	坏账准备	账面余额	占比	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	22,801.47	67.54%	1,140.07	19,006.79	68.14%	950.34	13,873.32	68.19%	693.67
1-2 年（含 2 年）	6,247.51	18.51%	624.75	4,162.92	14.92%	416.29	2,194.88	10.79%	219.49
2 至 3 年（含 3 年）	3,678.48	10.90%	1,103.54	1,586.67	5.69%	476.00	2,569.58	12.63%	770.88
3 至 4 年（含 4 年）	296.18	0.88%	148.09	2,204.75	7.90%	1,102.37	1,103.30	5.42%	551.65
4 至 5 年（含 5 年）	620.60	1.84%	496.48	330.84	1.19%	264.67	192.16	0.94%	153.73
5 年以上	115.35	0.34%	115.35	601.09	2.15%	601.09	413.22	2.03%	413.22
合计	**33,759.58**	**100.00%**	**3,628.29**	**27,893.06**	**100.00%**	**3,810.77**	**20,346.46**	**100.00%**	**2,802.63**

报告期各期，公司应收账款账龄主要集中在 1 年以内，占比分别为 68.19%、68.14%和 67.54%。公司主要客户均是行业内知名企业或上市公司，资金实力较强，发生坏账的风险较小。公司已按谨慎的原则，对不同账龄的应收账款计提了坏账准备，计提方式和比例均符合公司实际情况。

②应收账款坏账准备计提政策与可比公司对比

账龄	正帆科技	至纯科技		发行人
		高纯工艺集成系统及半导体设备客户	光传感器及光电子元器件业务客户	
1 年以内	5.00%	5.48%	3.58%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.07%	10.36%	10.00%
2-3 年	30.00%	25.01%	24.88%	30.00%
3-4 年	50.00%	45.85%	37.11%	50.00%
4-5 年	80.00%	68.89%	56.93%	80.00%
5 年以上	100.00%	96.86%	86.63%	100.00%

注：同行业公司数据来源于公开披露的定期报告或招股说明书；
注：至纯科技按照预期信用损失计提比例，上表计提比例来源于 2025 年年度报告数据。

从上表可见，公司坏账准备的计提标准较为谨慎，与同行业上市公司不存在显著差异。

（3）合同资产坏账准备计提情况

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期质保金	3,324.18	396.10	2,928.07	3,866.60	273.64	3,592.97	1,979.41	166.48	1,812.94
安装合同形成的已完工未结算资产	695.64	34.78	660.86	604.39	30.22	574.17	98.93	4.95	93.98
合计	**4,019.82**	**430.88**	**3,588.94**	**4,471.00**	**303.86**	**4,167.14**	**2,078.34**	**171.42**	**1,906.92**

报告期各期末，公司合同资产账面价值分别为 1,906.92 万元、4,167.14 万元及 3,588.94 万元，合同资产主要为未到期质保金和安装合同形成的已完工未结算资产。公司主要采用“预收款-发货款-验收款-质保金”的销售结算模式，产品在完成客户验收后确认收入，按照合同约定收取验收款，并在质保期届满后收取质保金。

（4）应收账款和合同资产主要客户分析

报告期各期末，公司应收账款和合同资产前五名客户情况如下：

单位：万元

2025 年 12 月 31 日						
序号	**公司名称**	**应收账款**	**合同资产**	**小计**	**占比**	**坏账准备**
1	公司 E	3,918.64	213.50	4,132.14	10.94%	373.99
2	公司 B	4,042.43	-	4,042.43	10.70%	202.12
3	中国电子工程设计院股份有限公司	2,679.37	498.55	3,177.92	8.41%	1,054.86
4	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2,712.35	-	2,712.35	7.18%	147.53
5	公司 D	2,650.46	-	2,650.46	7.02%	132.52
合计		**16,003.25**	**712.05**	**16,715.30**	**44.24%**	**1,911.03**
2024 年 12 月 31 日						
序号	**公司名称**	**应收账款**	**合同资产**	**小计**	**占比**	**坏账准备**
1	公司 E	7,156.67	-	7,156.67	22.11%	357.83
2	中国电子工程设计院股份有限公司	4,437.38	510.76	4,948.14	15.29%	615.98

3	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2,689.87	155.86	2,845.74	8.79%	1,281.83
4	德尔科技	1,858.04	702.80	2,560.84	7.91%	140.43
5	TCL 科技	1,451.50	463.42	1,914.92	5.92%	334.03
合计		**17,593.46**	**1,832.84**	**19,426.31**	**60.02%**	**2,730.10**
2023 年 12 月 31 日						
序号	**公司名称**	**应收账款**	**合同资产**	**小计**	**占比**	**坏账准备**
1	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	3,313.42	732.86	4,046.28	18.04%	1,135.36
2	中国电子工程设计院股份有限公司	3,190.82	63.43	3,254.25	14.51%	306.63
3	TCL 科技	2,417.66	37.72	2,455.38	10.95%	270.09
4	SCES Pte. Ltd.	2,175.80	98.93	2,274.73	10.14%	113.74
5	德尔科技	1,435.76	216.89	1,652.66	7.37%	85.67
合计		**12,533.46**	**1,149.84**	**13,683.30**	**61.02%**	**1,911.48**

注 1：受同一实际控制人控制的客户，已合并计算；
注 2：占比系占应收账款和合同资产余额的比例。

报告期各期末，公司应收账款和合同资产前五大客户金额分别为 13,683.30 万元、19,426.31 万元和 16,715.30 万元，占期末应收账款和合同资产余额的比例分别为 61.02%、60.02%和 44.24%。

（5）应收账款期后回款情况

报告期各期末，公司应收账款期后回款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款余额	33,759.58	27,893.06	20,346.46
期后回款金额	9,816.54	20,826.21	18,232.56
期后回款比例	**29.08%**	**74.66%**	**89.61%**

注：期后回款截至 2026 年 4 月 30 日。

截至 2026 年 4 月 30 日，公司报告期各期末应收账款期后回款比例分别为 89.61%、74.66%及 29.08%，回款情况良好。

4、预付款项

报告期各期末，公司预付账款账龄情况如下：

单位：万元

账龄	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	占比（%）	账面余额	占比（%）	账面余额	占比（%）
1 年以内（含 1 年）	1,528.04	89.59	1,543.39	99.08	2,804.83	99.33
1-2 年（含 2 年）	177.56	10.41	8.56	0.55	12.65	0.45
2-3 年（含 3 年）	-	-	-	-	5.70	0.20
3 年以上	-	-	5.70	0.37	0.67	0.02
合计	**1,705.60**	**100.00**	**1,557.66**	**100.00**	**2,823.84**	**100.00**

报告期各期末，公司预付款项余额分别为 2,823.84 万元、1,557.66 万元和 1,705.60 万元，占流动资产比例分别为 1.54%、0.73%和 1.01%，公司预付款项主要系日常生产经营所需的预付原材料采购款，预付款项的账龄主要在 1 年以内。

报告期各期，公司预付款项前五大情况如下：

单位：万元

2025 年 12 月 31 日			
供应商名称	**期末余额**	**账龄**	**占预付款项期末余额（%）**
亚硕工程股份有限公司	611.51	1 年以内	35.85
安徽致艾林工程科技有限公司	168.08	1-2 年	9.85
上品兴业氟塑料（嘉兴）有限公司	139.87	1 年以内	8.20
杭州润乾科技有限公司	82.85	1 年以内	4.86
乐孜芯创半导体设备（上海）有限公司	48.45	1 年以内	2.84
合计	**1,050.76**		**61.61**
2024 年 12 月 31 日			
供应商名称	**期末余额**	**账龄**	**占预付款项期末余额（%）**
安徽致艾林工程科技有限公司	867.68	1 年以内、1-2 年	55.70
仪鉴科技（深圳）有限公司	111.49	1 年以内	7.16
厦门顺工实业有限公司	64.19	1 年以内	4.12
矽美科软件（上海）有限公司	56.00	1 年以内	3.60
崇翌微电子技术（上海）有限公司	54.24	1 年以内	3.48
合计	**1,153.60**		**74.06**
2023 年 12 月 31 日			

供应商名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额（%）
安徽致艾林工程科技有限公司	620.72	1 年以内	21.98
上品兴业氟塑料（嘉兴）有限公司	496.44	1 年以内	17.58
苏州敏之熠建筑工程有限公司	406.07	1 年以内	14.38
吉庆康（上海）电子科技有限公司	185.13	1 年以内	6.56
源芯塑（上海）材料有限公司	93.60	1 年以内	3.31
合计	**1,801.96**		**63.81**

报告期各期末，公司预付款项余额前五大合计余额分别为 1,801.96 万元、1,153.60 万元和 1,050.76 万元，占各期末预付款项余额的比例分别为 63.81%、74.06%和 61.61%，主要为预付材料款。

5、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	756.49	538.99	700.24
合计	**756.49**	**538.99**	**700.24**

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 700.24 万元、538.99 万元和 756.49 万元，占当期流动资产的比例分别为 0.38%、0.25%和 0.45%，公司其他应收款中不存在应收利息和应收股利。

报告期各期末，公司其他应收款按性质构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
押金及保证金	781.84	555.83	668.65
备用金	12.60	7.73	59.86
其他	1.87	4.73	27.70
小计	**796.31**	**568.29**	**756.21**

减：坏账准备	39.82	29.30	55.97
合计	**756.49**	**538.99**	**700.24**

报告期各期末，公司其他应收款中押金及保证金主要为公司房租押金和投标保证金。

6、存货

（1）存货总体情况

报告期各期末，公司存货账面价值占流动资产和营业成本的比例如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
存货的账面余额	92,355.87	137,282.01	134,092.29
存货跌价准备	1,907.80	2,327.86	272.30
存货的账面价值	90,448.07	134,954.15	133,819.98
占流动资产比重	53.67%	63.44%	72.78%
占当年营业成本比重	95.63%	155.22%	210.06%

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 133,819.98 万元、134,954.15 万元和 90,448.07 万元，存货的账面价值占当年营业成本比重的比例分别为 210.06%、155.22%和 95.63%，报告期期初，受宏观环境及供应链不确定性影响，公司为保障项目交付安全，适当增加了库存储备，导致存货规模及占比较高。报告期内，随着外部制约因素消除，公司加强存货精细化管理，前期备货逐步消化，材料采购规模回归正常水平。同时，随着在手订单项目的顺利实施及收入确认，相关合同履约成本相应结转，带动存货规模呈下降趋势，存货结构持续优化。

（2）存货构成情况

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	15,702.81	17.00%	29,615.87	21.57%	40,191.18	29.97%
库存商品	747.29	0.81%	803.35	0.59%	-	-

合同履约成本	75,905.77	82.19%	106,862.79	77.84%	93,901.11	70.03%
合计	**92,355.87**	**100.00%**	**137,282.01**	**100.00%**	**134,092.29**	**100.00%**

报告期各期末，公司存货主要为原材料和合同履约成本，合计占比超过 95%。

（3）主要存货变动分析

原材料主要包括专用部件、阀件、管件以及仪器仪表等。报告期各期末，公司原材料的账面余额分别为 40,191.18 万元、29,615.87 万元和 15,702.81 万元，占存货的比例分别为 29.97%、21.57%和 17.00%。报告期期初，受宏观环境及供应链不确定性影响，公司为保障项目交付安全，适当增加了库存储备，导致存货规模及占比较高。报告期内，随着外部制约因素消除，公司加强存货精细化管理，前期备货逐步消化，材料采购规模回归正常水平。

报告期各期末，公司合同履约成本账面余额分别为 93,901.11 万元、106,862.79 万元及 75,905.77 万元，占存货总额的比例分别为 70.03%、77.84%及 82.19%。合同履约成本系公司未完工项目已发生但尚未结转的成本投入，其规模变动与项目执行进度及收入确认节奏密切相关。随着在手订单项目的顺利实施及阶段性验收，相关合同履约成本按履约进度结转至营业成本，2025 年末，合同履约成本有所下降。

（4）公司存货跌价准备

报告期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

日期	项目	账面余额	存货跌价准备	账面价值
2025 年 12 月 31 日	原材料	15,702.81	1,392.67	14,310.13
	库存商品	747.29	281.83	465.46
	合同履约成本	75,905.77	233.30	75,672.47
	合计	**92,355.87**	**1,907.80**	**90,448.07**
2024 年 12 月 31 日	原材料	29,615.87	1,567.58	28,048.29
	库存商品	803.35	321.34	482.01
	合同履约成本	106,862.79	438.93	106,423.86
	合计	**137,282.01**	**2,327.86**	**134,954.15**

2023 年 12 月 31 日	原材料	40,191.18	265.05	39,926.12
	库存商品	-	-	-
	合同履约成本	93,901.11	7.25	93,893.86
	合计	**134,092.29**	**272.30**	**133,819.98**

公司主要对原材料、库存商品和合同履约成本计提存货跌价准备，对于有订单支持的存货，按照成本与可变现净值孰低确定存货跌价准备金额，其中可变现净值确定依据为预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费。对于无订单支持存货，结合存货库龄、实物状态等因素综合判断存货可变现净值，对预期不能使用或销售可能性较低的存货，全额计提存货跌价准备。

报告期各期末，发行人存货跌价准备分别为 272.30 万元、2,327.86 万元和 1,907.80 万元，占各期期末存货账面余额的比例为 0.20%、1.70%和 2.07%，公司已按照存货的可变现净值对具有减值迹象的存货足额计提了存货跌价准备。

7、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
预缴税费	936.05	21.10	43.04
待摊费用	226.62	206.27	205.39
留抵及待抵扣进项税	74.09	389.64	26.06
合计	**1,236.76**	**617.01**	**274.49**

报告期内，公司其他流动资产分别为 274.49 万元、617.01 万元、1,236.76 万元，占各期末流动资产的比例分别为 0.15%、0.29%、0.73%，金额和占比均较小。

（三）非流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	1,579.93	11.29%	1,009.64	7.09%	983.88	9.52%
在建工程	1,289.65	9.22%	457.60	3.22%	3.26	0.03%
使用权资产	1,481.64	10.59%	1,748.46	12.29%	1,814.79	17.56%
无形资产	1,126.93	8.05%	1,110.30	7.80%	113.97	1.10%
长期待摊费用	146.29	1.05%	180.18	1.27%	125.84	1.22%
递延所得税资产	3,425.00	24.48%	5,438.52	38.21%	4,317.26	41.77%
其他非流动资产	4,942.26	35.32%	4,287.33	30.12%	2,976.90	28.80%
非流动资产合计	**13,991.68**	**100.00%**	**14,232.03**	**100.00%**	**10,335.91**	**100.00%**

1、固定资产

（1）固定资产变动分析

报告期各期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	**3,588.14**	**2,933.70**	**2,696.86**
机器设备	2,655.69	1,970.50	1,823.51
运输设备	109.77	96.46	101.11
办公设备	172.83	239.25	254.49
电子设备	649.84	627.49	517.74
二、累计折旧合计	**2,008.21**	**1,924.06**	**1,712.97**
机器设备	1,405.33	1,361.54	1,249.24
运输设备	76.43	62.18	51.92
办公设备	112.02	151.13	143.95
电子设备	414.44	349.22	267.86
三、账面价值合计	**1,579.93**	**1,009.64**	**983.88**
机器设备	1,250.36	608.96	574.27
运输设备	33.35	34.28	49.18

办公设备	60.82	88.13	110.54
电子设备	235.40	278.27	249.88

报告期各期末，固定资产主要由机器设备及电子设备构成。公司固定资产增加主要系机器设备增加影响。

（2）固定资产折旧政策与同行业可比公司对比情况

公司固定资产折旧采用年限平均法计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧，与同行业可比公司折旧计提政策对比如下：

单位：年

项目	正帆科技	至纯科技	发行人
机器设备	5-20	5-10	3-10
运输工具	4	4-7	4-10
办公设备	3-5	3-5	3-5
电子设备	3-5	3-5	3

注：数据来源于同行业公司公开披露文件。

报告期内，公司与同行业可比公司固定资产折旧政策基本一致，公司固定资产折旧计提合理谨慎。

（3）固定资产减值情况

报告期内，公司拥有的固定资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。

2、在建工程

报告期各期末，公司在建工程明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
冠礼科技总部基地建设项目	1,289.65	457.60	3.26
合计	**1,289.65**	**457.60**	**3.26**

报告期各期末，公司在建工程分别为 3.26 万元、457.60 万元和 1,289.65 万元，在建工程余额逐年增加，主要系公司由于下游需求提升，公司投入资金用于冠礼科技总部基地建设项目以提升核心产品产能。

报告期各期末，未发现在建工程存在减值迹象，故未计提减值准备。

3、使用权资产

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号—租赁》，租赁的办公楼及厂房等确认使用权资产，报告期各期末，公司使用权资产分别为 1,814.79 万元、1,748.46 万元和 1,481.64 万元。

4、无形资产

报告期各期末，公司无形资产明细如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
土地使用权	795.74	812.17	-
软件使用权	331.19	298.13	113.97
合计	**1,126.93**	**1,110.30**	**113.97**

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 113.97 万元、1,110.30 万元和 1,126.93 万元。无形资产主要为土地使用权，2024 年末，公司无形资产相较上年末大幅增长，主要系当年公司取得了冠礼科技总部基地建设项目用地的土地使用权。

5、长期待摊费用

报告期内，公司长期待摊费用明细如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
软件服务费	114.92	146.37	96.73
装修费	29.65	31.67	29.11
其他	1.72	2.15	-
合计	**146.29**	**180.18**	**125.84**

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 125.84 万元、180.18 万元和 146.29 万元，主要是软件服务费和装修费。

6、递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 4,317.26 万元、5,438.52 万元、3,425.00 万元，系坏账准备及跌价准备、产品质量保证（预计负债）和已计提未

支付的工资等可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产。

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
坏账准备及跌价准备	948.63	27.70%	1,018.86	18.73%	528.70	12.25%
产品质量保证（预计负债）	971.30	28.36%	683.79	12.57%	264.03	6.12%
已计提未支付的工资	143.88	4.20%	130.65	2.40%		0.00%
租赁负债	224.49	6.55%	267.79	4.92%	272.65	6.32%
税务与会计口径申报差异	-	0.00%	2,258.47	41.53%	2,352.20	54.48%
未到票费用	1,014.04	29.61%	982.95	18.07%	886.53	20.53%
内部交易形成的暂时性差异	122.65	3.58%	96.01	1.77%	13.15	0.30%
合计	**3,425.00**	**100.00%**	**5,438.52**	**100.00%**	**4,317.26**	**100.00%**

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产

单位：万元

项目	递延所得税资产和负债于 2025 年 12 月 31 日互抵金额	抵销后递延所得税资产/负债于 2025 年 12 月 31 日余额	递延所得税资产和负债于 2024 年 12 月 31 日互抵金额	抵销后递延所得税资产/负债于 2024 年 12 月 31 日余额	递延所得税资产和负债于 2023 年 12 月 31 日互抵金额	抵销后递延所得税资产/负债于 2023 年 12 月 31 日余额
递延所得税资产	-	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-	-

7、其他非流动资产

报告期内，公司其他非流动资产明细如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一年以上未到期质保金	4,898.32	4,253.21	2,890.04
预付设备款	43.94	31.72	48.42
预付工程款	-	2.41	38.44
合计	**4,942.26**	**4,287.33**	**2,976.90**

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 2,976.90 万元、4,287.33 万元、

4,942.26 万元，主要是一年以上未到期质保金。

（四）资产周转能力分析

1、资产周转能力指标

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次/年）	4.32	5.31	4.76
存货周转率（次/年）	0.82	0.64	0.57

注：上述财务指标计算公式如下：
（1）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额；
（2）存货周转率＝营业成本/存货平均余额。

2、与可比公司资产周转能力指标比较

报告期内，公司资产周转能力指标与可比公司的比较情况如下：

财务指标	同行业公司	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款周转率（次/年）	正帆科技	2.11	2.99	2.93
	至纯科技	0.82	1.11	1.18
	均值	**1.46**	**2.05**	**2.06**
	公司	**4.32**	**5.31**	**4.76**
	同行业公司	**2025 年 12 月 31 日**	**2024 年 12 月 31 日**	**2023 年 12 月 31 日**
存货周转率（次/年）	正帆科技	1.30	1.27	1.04
	至纯科技	0.66	0.85	0.95
	均值	**0.98**	**1.06**	**1.00**
	公司	**0.82**	**0.64**	**0.57**

报告期内，公司应收账款周转率分别为 4.76、5.31 和 4.32，整体周转效率保持在较高水平。公司主要采用“预收款-发货款-验收款-质保金”的销售结算模式。具体而言，合同签订后客户支付预付款；设备发货后，累计回款比例达 60%左右；客户验收合格并确认收入后，累计回款比例达 90%左右；剩余款项作为质保金，于质保期届满后收取。得益于上述结算政策，公司在收入确认时点已收回大部分合同款项，应收账款余额主要由已验收未支付的货款构成，因此应收账款周转率较高，回款情况良好，与公司业务模式及信用政策相匹配。

此外，报告期内公司应收账款周转率高于同行业可比公司平均水平，体现了

公司较强的应收账款管理能力及优质客户的回款能力。

报告期各期，公司存货周转率分别为 0.57、0.64 和 0.82，整体呈稳步上升趋势。公司存货周转速度主要受业务模式及阶段性经营策略两方面因素影响：从业务模式来看，公司产品需经历方案设计、原材料采购、工厂生产、现场安装、调试运行及最终验收等多个环节，项目从合同签订至最终验收通常需 1-2 年，整体履约周期较长。受此影响，公司产品在验收前持续计入存货核算，导致存货周转速度相对较慢，与项目实施周期特征相匹配。从经营策略来看，报告期初，受宏观环境及供应链不确定性影响，公司为保障项目交付安全，适当增加了库存储备，导致期初存货规模较大。报告期内，随着外部制约因素消除，公司持续推进存货精细化管理，加强库存去化及项目交付节奏，前期备货逐步消化，存货周转效率持续提升。综上，公司存货周转率水平及变动趋势与业务模式及存货管理策略基本相符。

与同行业可比公司相比，公司存货周转率与至纯科技处于相近水平，整体略低于行业平均值。正帆科技近年来积极拓展电子材料业务，该类产品具有标准化程度高、交付周期短的特点，存货周转速度显著快于项目制业务，存货周转速度较高，因此，公司存货周转率与同行业可比公司平均值存在一定差异具有合理性。

九、偿债能力分析、流动性与持续经营能力分析

（一）负债构成分析

1、负债总体构成分析

报告期各期末，公司的负债构成及其变化情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	101,660.35	92.78%	165,530.23	96.59%	158,945.28	98.07%
非流动负债	7,912.86	7.22%	5,851.43	3.41%	3,131.02	1.93%
负债总额	**109,573.20**	**100.00%**	**171,381.66**	**100.00%**	**162,076.31**	**100.00%**

报告期各期末，公司负债总额分别为 162,076.31 万元、171,381.66 万元、109,573.20 万元，公司负债上升后有所下降。

报告期各期末，公司负债结构未发生重大变化，流动负债占负债总额的比重保持较高水平，主要原因是公司主要依靠商业信用支持业务经营，应付账款和合同负债余额较高。

2、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债主要结构如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	-	-	-	-	10,200.47	6.42%
应付账款	12,094.59	11.90%	18,782.09	11.35%	21,954.09	13.81%
合同负债	80,624.84	79.31%	133,530.64	80.67%	112,394.79	70.71%
应付职工薪酬	4,081.47	4.01%	5,535.07	3.34%	2,972.21	1.87%
应交税费	3,823.98	3.76%	6,287.10	3.80%	2,223.38	1.40%
其他应付款	320.45	0.32%	392.69	0.24%	8,440.48	5.31%
一年内到期的非流动负债	706.81	0.70%	738.03	0.45%	700.82	0.44%
其他流动负债	8.20	0.01%	264.60	0.16%	59.05	0.04%
流动负债合计	**101,660.35**	**100.00%**	**165,530.23**	**100.00%**	**158,945.28**	**100.00%**

公司流动负债主要由合同负债和应付账款构成。

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
抵押借款	-	-	-
保证借款	-	-	10,192.58
信用借款	-	-	-
质押借款	-	-	-
应计利息	-	-	7.89
合计	**-**	**-**	**10,200.47**

公司短期借款主要包括保证担保借款，主要为满足公司生产经营过程的资金

流转需要。2023 年末，公司短期借款余额为 10,200.47 万元。

公司短期借款均已按期兑付本金和利息，未出现逾期未还情况，截至报告期末，公司不存在短期借款。

（2）应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 21,954.09 万元、18,782.09 万元、12,094.59 万元，占各期末流动负债总额的比例分别为 13.81%、11.35%、11.90%。

报告期各期末，公司应付账款构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货款	12,067.22	99.77%	18,474.69	98.36%	21,937.38	99.92%
设备及工程款	27.37	0.23%	307.39	1.64%	16.70	0.08%
合计	**12,094.59**	**100.00%**	**18,782.09**	**100.00%**	**21,954.09**	**100.00%**

公司应付账款主要为应付货款。报告期各期末，公司应付账款金额逐年下降，主要系公司报告期内公司采购规模有所下降。

（3）合同负债

报告期各期末，公司合同负债情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
预收货款	79,950.89	132,729.46	111,736.65
安装合同形成的已结算尚未完工款	673.95	801.18	658.14
合计	**80,624.84**	**133,530.64**	**112,394.79**

报告期各期末，公司合同负债主要为销售设备预收的货款及进度款。由于公司所处设备制造行业具有生产周期较长、定制化程度较高的特点，根据行业惯例及合同约定，客户通常在合同签订后预付部分款项，公司在收到款项但设备尚未验收时，确认为合同负债。

报告期各期末，公司合同负债余额分别为 112,394.79 万元、133,530.64 万元、80,624.84 万元，占各期末流动负债总额的比例分别为 70.71%、80.67%、79.31%，

占比较高。2025 年末，公司合同负债下降 39.62%，主要系：1）前期在手订单在 2024 年及 2025 年完成验收，对应合同负债已结转至营业收入，而新承接项目尚处于执行早期，未产生大额预收款项；2）2025 年度受下游半导体行业投资节奏阶段性调整影响，2025 年全球新建晶圆厂开工数量大幅减少，叠加中美关税政策不确定性等因素，客户设备采购节奏放缓，导致发行人 2025 年新增订单金额下降，新订单带来的预收款项相应减少，进而导致合同负债下降。

（4）应付职工薪酬

单位：万元

项目	期初金额	本期增加	本期减少	汇兑损益影响	期末金额
2025 年度					
短期薪酬	5,375.31	16,063.45	17,371.55	14.26	4,081.47
离职后福利-设定提存计划	-	1,701.09	1,701.09	-	-
辞退福利	159.76	54.10	213.86	-	-
合计	**5,535.07**	**17,818.64**	**19,286.50**	**14.26**	**4,081.47**
2024 年度					
短期薪酬	2,972.21	16,801.98	14,396.17	-2.71	5,375.31
离职后福利-设定提存计划	-	1,560.26	1,560.26	-	-
辞退福利	-	235.52	75.76	-	159.76
合计	**2,972.21**	**18,597.76**	**16,032.19**	**-2.71**	**5,535.07**
2023 年度					
短期薪酬	2,506.71	13,695.42	13,234.73	4.82	2,972.21
离职后福利-设定提存计划	-	1,330.92	1,330.92	-	-
辞退福利	-	55.38	55.38	-	-
合计	**2,506.71**	**15,081.72**	**14,621.03**	**4.82**	**2,972.21**

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 2,972.21 万元、5,535.07 万元、4,081.47 万元，占各期末流动负债总额的比例分别为 1.87%、3.34%、4.01%。公司应付职工薪酬主要由应付工资、奖金、津贴、社保公积金等构成。

（5）应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
增值税	3,159.52	2,386.38	237.22
企业所得税	84.01	3,522.23	1,809.83
个人所得税	232.87	110.02	97.39
城市维护建设费	170.90	126.49	26.13
教育费附加	96.59	75.89	14.32
地方教育费附加	64.39	50.60	9.55
印花税	12.64	10.99	28.93
其他税费	3.06	4.51	
合计	**3,823.98**	**6,287.10**	**2,223.38**

注：此处增值税包含商品及服务税（GST）。

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 2,223.38 万元、6,287.10 万元、3,823.98 万元，占各期末流动负债总额的比例分别为 1.40%、3.80%、3.76%。公司应交税费主要由企业所得税、增值税构成。

（6）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
社保及公积金	211.16	203.33	206.89
关联方借款	-	-	8,103.17
其他	109.29	189.36	130.42
合计	**320.45**	**392.69**	**8,440.48**

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 8,440.48 万元、392.69 万元、320.45 万元，占各期末流动负债总额的比例分别为 5.31%、0.24%、0.32%。2023 年末，公司其他应付款金额较高，主要系公司因营运资金安排向控股股东台湾朋亿拆借部分资金，相关款项已于 2024 年结清。相关情况参见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联方与关联交易”之“（二）关联交易”之“4、重大关联交易”之“（2）重大偶发性关联交易”之“①关联方拆借”。

（7）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
租赁负债	706.81	738.03	700.82

公司一年内到期的非流动负债分别为 700.82 万元、738.03 万元、706.81 万元，占各期末流动负债总额的比例为 0.44%、0.45%、0.70%，占比较小，主要为一年内到期的租赁负债。

（8）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
已背书未终止确认应收票据	8.20	264.60	59.05

报告期各期末，公司其他流动负债由已背书未终止确认应收票据构成。报告期各期末，公司其他流动负债分别为 59.05 万元、264.60 万元和 8.20 万元，占各期末流动负债总额的比例分别为 0.04%、0.16%、0.01%。

3、非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
租赁负债	784.76	1,036.12	1,105.71
预计负债	6,475.35	4,558.59	1,760.23
递延所得税负债	652.75	256.72	265.09
合计	**7,912.86**	**5,851.43**	**3,131.02**

报告期各期末，公司非流动负债主要为租赁负责和预计负债。

（1）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
租赁付款额	1,555.96	1,867.01	1,922.95
减：未确认融资费用	64.38	92.86	116.43
小计	**1,491.58**	**1,774.15**	**1,806.52**
减：一年内到期的租赁负债	706.81	738.03	700.82
合计	**784.76**	**1,036.12**	**1,105.71**

报告期各期末，公司租赁负债分别为 1,105.71 万元、1,036.12 万元、784.76 万元，系公司租赁房产未来尚未支付的租金现值。

（2）预计负债

报告期各期末，公司预计负债余额分别为 1,760.23 万元、4,558.59 万元、6,475.35 万元。公司预计负债主要为产品质量保证形成的现时义务，系公司根据相关合同条款、历史经验等合理计提，相关会计估计谨慎、充分。

（3）递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
使用权资产	214.81	256.72	265.09
税务与会计口径申报差异	437.93	-	-
合计	**652.75**	**256.72**	**265.09**

报告期各期末，公司递延所得税负债余额分别为 265.09 万元、256.72 万元、652.75 万元，主要来源于使用权资产摊销。

（二）偿债能力分析

1、偿债能力指标分析

报告期内，公司偿债能力的主要财务指标如下：

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产负债率（合并）	60.04%	75.51%	83.46%

资产负债率（母公司）	42.11%	48.80%	53.90%
流动比率（倍）	1.66	1.29	1.16
速动比率（倍）	0.74	0.46	0.30
息税折旧摊销前利润（万元）	25,204.75	24,990.91	11,703.75
利息保障倍数（倍）	404.03	73.95	31.01

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.16 倍、1.29 倍、1.66 倍，速动比率分别为 0.30 倍、0.46 倍及 0.74 倍，各期末流动比率、速动比率逐年改善。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 83.46%、75.51%、60.04%，公司资产负债率（母公司）分别为 53.90%、48.80%、42.11%，公司资产负债率有所下降。

报告期内，公司经营状况良好，盈利能力较强，报告期各期末，公司息税折旧摊销前利润分别为 11,703.75 万元、24,990.91 万元、25,204.75 万元，利息保障倍数分别为 31.01、73.95、404.03，持续增长并保持较高水平，公司具有较强的偿债能力。

综上所述，公司资产负债结构合理，流动比率、速动比率、资产负债率、息税折旧摊销前利润等指标均保持较好水平，偿债能力较强，无已到期未偿还的债务，不存在重大偿债风险。

2、与可比公司偿债能力指标对比

项目	公司名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率	正帆科技	1.30	1.39	1.36
	至纯科技	1.23	1.20	1.49
	可比公司平均值	**1.27**	**1.29**	**1.43**
	公司	**1.66**	**1.29**	**1.16**
速动比率	正帆科技	0.74	0.72	0.59
	至纯科技	0.60	0.63	0.74
	可比公司平均值	**0.67**	**0.67**	**0.67**
	公司	**0.74**	**0.46**	**0.30**
资产负债率（合并）	正帆科技	68.19%	62.23%	62.13%

	至纯科技	72.68%	70.83%	64.53%
	可比公司平均值	**70.43%**	**66.53%**	**63.33%**
	公司	**60.04%**	**75.51%**	**83.46%**

2023 年末及 2024 年末，公司流动比率和速动比率低于或基本持平于可比公司平均值，资产负债率高于可比公司平均值。2025 年末，公司流动比率和速动比率显著提升并超过可比公司平均值，资产负债率下降至低于可比公司平均值的水平，短期偿债能力明显改善。

（三）报告期内股利分配实施情况

2024 年 6 月 27 日，发行人股东关于股利分配作出决议，根据各股东持股比例分配股利额共计 4,000.00 万元（含税）。

2025 年 6 月 30 日，发行人股东关于股利分配作出决议，根据各股东持股比例分配股利额共计 5,000.00 万元（含税）。

上述利润分配方案均已实施完毕，公司已根据税法要求履行了所得税代扣代缴义务。

（四）现金流量分析

1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	78,032.55	138,197.20	131,538.57
收到的税费返还	386.40	336.28	128.50
收到其他与经营活动有关的现金	3,859.10	7,050.18	1,543.83
经营活动现金流入小计	**82,278.05**	**145,583.66**	**133,210.90**
购买商品、接受劳务支付的现金	45,160.14	80,733.98	100,065.46
支付给职工以及为职工支付的现金	19,155.81	16,023.12	14,555.79
支付的各项税费	8,522.01	10,739.67	7,986.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,754.47	2,152.53	7,600.34

经营活动现金流出小计	**75,592.42**	**109,649.31**	**130,208.58**
经营活动产生的现金流量净额	**6,685.62**	**35,934.35**	**3,002.32**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,002.32 万元、35,934.35 万元和 6,685.62 万元，公司现金流量持续处于净流入状态。

报告期内，公司经营活动产生的现金流入分别为 133,210.90 万元、145,583.66 万元和 82,278.05 万元。公司经营活动产生的现金流入主要由销售商品、提供劳务收到的现金构成，2024 年度，随着公司执行订单规模持续上升，执行效率加快，合同进度及验收款项回款较多，带动为销售商品、提供劳务收到的现金快速增加。2025 年度，受下游半导体行业投资节奏阶段性调整影响，2025 年全球新建晶圆厂开工数量大幅减少，叠加中美关税政策不确定性等因素，客户设备采购节奏放缓，导致发行人 2025 年新增订单金额下降，预收款项相应减少，进而导致经营活动产生的现金流入下降。

报告期内，公司经营活动产生的现金流出分别为 130,208.58 万元、109,649.31 万元和 75,592.42 万元。经营活动产生的现金支出主要用于采购原材料、支付职工薪酬及支付税费。

2024 年，经营活动产生的现金流量净额较 2023 年度增加 32,932.03 万元，增长明显。上述增长主要源于以下因素：一方面，随着公司业务规模持续扩大，订单阶段收款增加，销售商品、提供劳务收到的现金相应增加，经营性现金流入能力增强；另一方面，报告期初，公司基于供应链安全考量适度增加原材料备货，2024 年度随着前期库存储备逐步消化，公司采购支出节奏有所放缓，购买商品、接受劳务支付的现金同比有所下降。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的勾稽关系情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
1．将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	20,847.27	20,045.28	9,011.42
加：资产减值准备	17.78	2,283.41	-248.75
信用减值准备	-191.97	999.35	744.86

固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	320.46	287.20	250.15
使用权资产折旧	847.40	893.46	888.67
无形资产摊销	53.54	36.64	12.35
长期待摊费用摊销	98.23	89.25	123.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-3.13	-1.83	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	31.41	14.69	8.56
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	89.69	331.21	371.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,013.52	-1,121.26	-1,602.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	396.02	-8.37	-12.19
存货的减少（增加以“－”号填列）	44,672.09	-3,189.72	-44,631.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,268.06	-13,378.31	-11,503.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-61,589.99	27,410.39	49,577.70
其他	1,351.37	1,242.96	11.19
经营活动产生的现金流量净额	6,685.62	35,934.35	3,002.32

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异为-6,009.10 万元、15,889.07 万元和-14,161.65 万元，差异变动主要是受资产减值、折旧、存货、经营性应收、应付项目的影响，与公司的业务发展实际情况相符。

2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.78	2.70	0.46
投资活动现金流入小计	**6.78**	**2.70**	**0.46**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,248.31	1,664.97	663.65
投资支付的现金	-	-	-

投资活动现金流出小计	**2,248.31**	**1,664.97**	**663.65**
投资活动产生的现金流量净额	**-2,241.53**	**-1,662.27**	**-663.19**

报告期内，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-663.19 万元、-1,662.27 万元和-2,241.53 万元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流入分别为 0.46 万元、2.70 万元和 6.78 万元。公司投资活动产生的现金流入主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额。

报告期内，公司投资活动产生的现金流出分别为 663.65 万元、1,664.97 万元和 2,248.31 万元。公司投资活动产生的现金流出主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

2024 年投资活动产生的现金流量净额较 2023 年减少 999.08 万元，其主要影响因素系公司增加长期资产投资，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

2025 年投资活动产生的现金流量净额较 2024 年变化较小。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	-	6,218.96	-
取得借款收到的现金	-	4,865.47	10,691.58
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	8,000.00
筹资活动现金流入小计	**-**	**11,084.43**	**18,691.58**
偿还债务支付的现金	-	15,058.05	5,329.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,000.00	4,377.61	11,240.79
支付其他与筹资活动有关的现金	925.17	8,930.89	2,363.10
筹资活动现金流出小计	**5,925.17**	**28,366.55**	**18,933.24**
筹资活动产生的现金流量净额	**-5,925.17**	**-17,282.12**	**-241.66**

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-241.66 万元、-17,282.12

万元和-5,925.17 万元。

2023 年度和 2024 年度，公司筹资活动产生的现金流入分别为 18,691.58 万元和 11,084.43 万元。公司筹资活动产生的现金流入主要系由吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金与收到其他与筹资活动有关的现金构成。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流出分别为 18,933.24 万元、28,366.55 万元和 5,925.17 万元。公司筹资活动产生的现金流出主要由偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金构成。

2024 年公司筹资活动产生的现金流量净额较 2023 年减少 17,040.46 万元，主要由于 2024 年公司银行借款到期还款，偿还债务支付的现金增加所致。

（五）重大资本性支出计划及资金需求量

1、报告期内重大资本性支出

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 663.65 万元、1,664.97 万元及 2,248.31 万元，主要是用于部分厂房和生产线等工程建设。

2、未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求量

截至本招股说明书签署日，除本次发行募集资金投资项目外，公司暂无未来可预见的重大资本性支出计划。本次发行募集资金投资项目的审议及资金需求量等情况，参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

（六）流动性情况分析

报告期内，公司净利润及经营活动现金流量净额逐年增长，公司盈利能力和流动性状况增强，公司流动比率和速动比率相应提高，偿债能力有所提升。报告期各期末，公司资产负债率分别为 83.46%、75.51%、60.04%，资产负债率保持在合理水平。未来通过首次公开发行并上市，公司将借助资本市场进一步夯实资本，降低财务杠杆，提升抗流动性风险能力。

（七）持续经营能力分析

公司经过多年的发展，凭借优异的产品性能和综合服务能力，在同行业中具备较强的竞争能力，与中芯国际、华虹半导体等国内半导体龙头企业建立了稳固

的合作关系，产品和服务获得了上述客户的高度认可。半导体行业继续保持高景气发展，为行业内企业的业务扩张提供了市场空间，也将带来市场对半导体设备的大量需求。

报告期内，公司营业收入分别为84,304.79万元、128,170.26万元及133,030.71万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 9,011.42 万元、20,045.28 万元及20,847.27 万元，营业收入和净利润呈增长趋势。公司主营业务收入主要为高纯工艺介质系统，主营业务收入占营业收入比重分别 99.60%、99.03%及 99.06%，主营业务突出。因此公司具备良好的市场空间和发展前景，持续经营能力良好。

十、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项

（一）报告期重大投资情况

报告期内，公司为了进一步发展主营业务，2023 年度通过同一控制下企业合并取得上海冠礼和新加坡冠礼，2024 年投资新设子公司马来西亚冠礼，以扩大公司产品加工、生产和销售的规模。子公司具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、发行人子公司、分公司情况”。

（二）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为663.65万元、1,664.97万元及2,248.31万元，主要是用于部分厂房和产线设备等工程建设。

（三）重大资产业务重组或股权收购合并情况

报告期内，公司重大资产业务重组或股权收购合并情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、公司报告期内重大资产重组情况”。

十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项对发行人的影响

（一）资产负债表日后事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在其他应披露的或有事项。

（三）重大诉讼、担保事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，公司及子公司不存在对外担保的情形。

（四）其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在应披露的其他重要事项。

十二、盈利预测

公司未编制盈利预测报告。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、本次募集资金运用概况

（一）募集资金拟投资项目

经公司第一届董事会第三次会议和 2026 年第一次临时股东会审议通过，本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于如下募集资金投资项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	半导体高端装备产能升级与智造基地建设项目	52,995.89	52,000.00
2	高端电子化学品智能供应产线及半导体核心工艺装备研发项目	23,473.96	23,300.00
3	电子溶剂绿色再生高效系统研发项目	6,768.34	6,600.00
4	营销总部及营销网络建设项目	32,283.72	32,100.00
5	补充流动资金	36,000.00	36,000.00
合计		**151,521.91**	**150,000.00**

在募集资金到位前，公司可根据实际情况以自有资金先期投入，待募集资金到达募集资金专项账户后 6 个月内，以募集资金置换先期投入的自有资金；本次募集资金到位后，公司将按照投资项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金不能满足上述投资项目资金需求，资金缺口将由公司通过银行贷款或其他自筹资金方式解决；若本次募集资金超过预计募集资金数额的，公司将严格按照国家法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定履行法定程序，用于主营业务发展。

（二）募集资金使用管理制度

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已制定《苏州冠礼科技股份有限公司募集资金管理制度》，并将严格遵照执行。《苏州冠礼科技股份有限公司募集资金管理制度》明确了募集资金专户存储制度，并对募集资金的使用、募集资金用途的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。公司募集资金到位后，将严格按照该制度对募集资金的专项使用进行监督和管理。

（三）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响

公司的主营业务为高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备的研发、设计、生产与销售。本次募集资金运用均围绕公司主营业务进行，将用于半导体高端装备产能升级与智造基地建设项目、高端电子化学品智能供应产线及半导体核心工艺装备研发项目、电子溶剂绿色再生高效系统研发项目、营销总部及营销网络建设项目及补充流动资金，上述募集资金投资项目的实施将对公司的主营业务产生积极影响，使公司核心竞争力得到进一步提升，有利于巩固公司在行业中的地位，做大做强主营业务，提升公司的业务能力、管理能力以及服务能力，符合公司未来战略发展规划。具体影响如下：

1、对资产负债率和净资产的影响

本次募集资金到位后，公司的净资产和流动资金将大幅增加，公司的资产负债率降低，资本结构更加稳健，有效改善公司的财务状况，缓解流动资金压力，进一步增强公司财务抗风险的能力。

2、对公司经营能力的影响

本次发行后，募集资金将严格围绕公司主营业务投入使用，重点用于核心产品产能扩建、关键技术研发、营销服务网络完善及补充流动资金。

通过半导体高端装备产能升级与智造基地建设项目扩大公司核心产品产线规模、提升智能制造水平；依托高端电子化学品智能供应产线、半导体核心工艺装备及电子溶剂绿色再生高效系统研发项目，深化核心技术攻关、完善产品与技术矩阵；借助营销总部及营销网络建设项目拓展市场覆盖与服务能力；同时通过补充流动资金进一步优化公司财务结构、增强资金实力与抗风险能力。本次募集资金的落地实施，将全面巩固并提升公司在行业内的竞争优势，为公司持续高质量发展提供有力保障。

（四）募集资金投资项目的确定依据

本次募集资金投资项目与公司现有主营业务、经营规模、财务状况、技术条件、管理能力及中长期发展目标高度适配。募投项目均紧密围绕公司半导体高端装备核心主营业务展开，项目实施后将进一步扩大公司核心产品产能规模，强化公司在高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备领域的核心竞争力，保障订单高

效履约，巩固并提升公司的行业地位，助力公司实现长期可持续发展。

募投项目的投资规模与公司现有资产、营收规模相匹配，项目顺利实施并达产后，将进一步推动公司营业收入与盈利水平的持续增长。募集资金到位后，将有效优化公司资本结构，降低负债水平与财务风险，增强公司资金实力与抗风险能力；经过多年持续的研发投入与技术积累，公司紧密围绕集成电路等泛半导体行业技术发展趋势，形成了多项自主可控的核心技术，具备为下游客户提供定制化解决方案的全流程服务能力。公司已建立覆盖研发设计、精密制造、整机调试到测试验证的全链条自主生产与技术体系，实现产品全流程的质量管控与可追溯，保障产品性能与品质的稳定性，为本次募投项目的实施奠定了坚实的技术基础；公司具备成熟高效的经营管理能力，已形成健全的研发管理体系、精细化的生产管控体系与完善的质量控制体系，可持续满足下游客户的严苛要求，为本次募集资金投资项目的顺利建设与高效运营提供了全方位的保障。

（五）募投项目实施后对同业竞争或者独立性的影响

1、对同业竞争的影响

截至本招股说明书签署日，公司与直接控股股东台湾朋亿存在从事相同或相似业务的情况，具体情况参见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“六、同业竞争”。本次募集资金投资项目的实施不会导致公司主营业务发生变化。

2、对独立性的影响

公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面与股东、其他关联方之间相互独立，具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。本次募集资金投资项目将由公司独立运营，公司目前已进行了必要的人员、技术及市场方面的储备。因此，本次募集资金投资项目的实施不会导致公司对公司股东、其他关联方的依赖，不会对独立性产生不利影响。

（六）募集资金投资项目审批情况

本次募集资金投资项目的备案及环评情况如下：

序号	项目名称	项目备案情况	项目环评情况
1	半导体高端装备产能升级与智造基地建设项目	苏浒管审项备〔2026〕44 号	苏高新管环审[2026]078 号
2	高端电子化学品智能供应产线及半导体核心工艺装备研发项目		
3	营销总部及营销网络建设项目		
4	电子溶剂绿色再生高效系统研发项目	苏浒管审项备〔2026〕73 号	发行人环境影响评价报告已送审
5	补充流动资金	不适用	不适用

截至本招股书签署日，半导体高端装备产能升级与智造基地建设项目、高端电子化学品智能供应产线及半导体核心工艺装备研发项目、营销总部及营销网络建设项目已取得项目用地、完成投资备案，已完成环境影响评价文件的备案；电子溶剂绿色再生高效系统研发项目已完成投资备案，环评手续正在办理中。

本次募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

二、本次募集资金具体用途的可行性及其与公司现有业务、核心技术的关系

（一）本次募集资金具体用途的必要性及可行性

1、半导体高端装备产能升级与智造基地建设项目

本募投项目的建设既是应对市场需求增长、突破现有产能交付瓶颈的迫切需求，也是适应产业技术升级、保障高端产品产业化与质量一致性的重要支撑，更是构建智能物流与物料流转体系、提升规模化生产协同效率的关键举措。当前，作为公司核心收入来源的自动化化学品与研磨液供应系统订单量持续保持在较高水平，电子级化学品纯化及分装系统等产品市场关注度的提升进一步增加了生产负荷，现有产能的紧张状态可能会对公司订单的及时交付与未来承接更大规模项目的能力形成一定制约，亟需通过项目实施新增生产场地、扩充设备与人力资源，缓解生产压力、提升交付保障能力。同时，面对 12 英寸以上大尺寸晶圆生产对装备的高洁净度、高稳定性等严苛要求，项目将通过建设高标准生产环境、引入精密自动化设备及升级检测体系，提升核心产品制造工艺与过程控制能力，推动研发优势转化为高品质供给，为进军高附加值市场奠定基础。此外，随着生产规模扩大与项目复杂度提升，传统人工物流模式已制约生产效率，项目将同步

构建智能物流与物料管理体系，实现物料流转全过程可视化、精细化管理，提升生产协同与资源周转效率，为产能提升后的高效稳定交付提供支撑，助力公司打造智能制造体系、实现稳健发展。

本募投项目建设符合国家产业政策支持方向，相关产品均属于高端装备制造业及集成电路关键装备范畴，契合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》等政策导向，项目实施具备良好的政策环境。公司在相关领域拥有超过二十年的研发制造经验，掌握全链条关键工艺技术，具备完善的管理体系与专业人才储备，可有效支撑项目建设、产能爬坡及稳定运营，降低项目实施与运营风险。从行业前景看，全球及中国半导体产业中长期投资活跃，相关产品市场需求稳定，且公司历经多年深耕已积累了丰富而优质的客户资源，具备较强的订单获取能力，产能规划与市场需求匹配度高，产能消化具备坚实的客户与市场基础。

2、高端电子化学品智能供应产线及半导体核心工艺装备研发项目

本募投项目契合半导体设备行业技术迭代快、下游工艺升级对上游装备提出更高要求的发展趋势，通过建设系统化与专业化的研发体系、整合研发资源，有效提升公司行业技术跟踪与转化能力，强化产品竞争力，提升产品与市场需求的匹配度。同时，项目搭建专业环境并引入先进仿真工具，通过工况模拟、专项测试、数据分析、虚拟实验等，加速设计迭代，降低试错成本，形成“设计-仿真-检测-优化”的闭环研发能力，以满足下游客户对设备性能与解决方案日益提升的要求。目前，公司技术知识的积累多与具体项目或产品关联，在跨项目复用、技术模块标准化及前瞻性探索方面存在提升空间。本项目建设将构建技术知识平台，通过规范研发流程、完善归档与跨部门协作，整合分散经验，形成可传承的技术资产，并以集中资源开展前瞻性共性技术研究，为产品线拓展升级储备技术，支撑可持续发展。

本募投项目聚焦高端装备与集成电路关键装备，契合国家“十五五”规划等政策导向，其实施具备良好的外部政策基础。公司拥有实施项目所需的业务基础与经验积累，项目依托现有业务与技术框架深化拓展，研发围绕现有产品性能提升、新功能开发及新兴市场需求展开，与主营业务及市场趋势密切相关，预期成果可与现有产品线协同，借助成熟市场渠道实现转化，具备清晰的成果导入路径和经营协同性。

3、电子溶剂绿色再生高效系统研发项目

本募投项目是公司应对绿色转型、强化研发能力、保持长期竞争力的关键举措。当前我国半导体制造业面临运营成本与绿色转型双重压力，晶圆厂对降本减排需求迫切，废液资源化可大幅降低经营成本并减少进口依赖，而传统无害化处置未形成资源循环，项目聚焦 TMAH、HF、剥离液等废液高效回收，助力客户实现紧迫需求。公司现有研发场地局促、缺乏危废试验合规条件及排污许可，专业设计及人才规模已逐渐无法满足进一步增长需求，项目将租赁合规场地、配置先进设备并引进人才，为技术升级提供支撑，进而在激烈的市场竞争中赢得更大的发展空间和优势。在绿色制造已成半导体产业链核心诉求的背景下，公司旨在通过主动性、前瞻性的自主研发，构筑系统性技术成果护城河，避免跟随竞争，巩固领先优势。

本募投项目的实施具备政策、技术、市场需求的三重可行性。项目直接服务于“碳达峰、碳中和”与“循环经济”发展战略，契合 2025 年《促进环保装备制造业高质量发展的若干意见》及“十五五”规划等政策导向，具备良好的政策支持环境。本项目依托公司在废化学品再生领域可迁移复用的核心技术体系与工程化能力，技术路线清晰、落地条件成熟，具备充分的技术可行性与工程保障。此外，公司已与众多行业头部企业建立起长期而稳固的合作关系，可为项目成果提供优先实测与工艺适配支持，缩短产业化周期；公司良好的品牌形象亦能有效降低新客户的前期导入门槛及信任构建成本，为产能消化筑牢市场基础。

4、营销总部及营销网络建设项目

当前半导体产业发展向好，公司主营产品市场需求持续扩大，对市场开拓能力、品牌影响力及项目转化效率提出了更高要求。为此，公司通过建设营销总部、完善全域营销网络，并配套产品展示中心与数字化交互系统，可有效强化市场覆盖与客户对接，加速技术成果产业化落地，提升行业品牌影响力。鉴于我国半导体产业呈现明显区域集聚特征，客户对本地化服务能力日益看重。公司现有营销服务网络需在区域覆盖、现场支持及备件保障等方面优化升级。基于此，公司将以苏州为总部统筹，在重点区域及海外布局建设服务网点，配套培训及技术支持平台，构建“总部统筹、区域协同”的服务体系，显著提升响应效率与客户黏性。同时，为满足海外业务对跨区域服务与协同响应的要求，公司将完善海外营销网

点布局，并依托信息化系统与协作平台，实现总部与各区域间信息互通与高效调度，加速全球化布局与资源统筹，助力业务规模持续扩大。

在市场、客户与管理三方面，本项目均具备实施可行性。当前，在 AI、新能源、物联网等长期趋势驱动下，全球及中国半导体设备市场空间广阔、增长韧性充足，为营销网络扩张提供坚实基础。公司与百余家知名企业深度合作，标杆客户可有效缩短新客户信任周期、降低导入阻力；同时，海外子公司的初步实践已为日本、马来西亚等地的网络布局积累经验，保障海外网点平稳落地。此外，公司建立了清晰的权责架构、标准化流程及与业绩挂钩的激励制度，并积累了跨国管理经验，确保多区域营销网络高效协同、风险可控。

5、补充流动资金

公司专注于为泛半导体行业提供高纯工艺介质系统与高阶湿制程工艺设备，未来将持续加大研发投入与业务拓展。随着下游泛半导体产业国产化替代进程加速，公司订单规模稳步扩容，对项目执行及技术升级所需的营运资金需求亦随之增加，使用募集资金补充流动资金可有效满足业务扩张对资金的刚性需求。同时，伴随业务规模的增长，日常经营的各类款项支出持续增加。适度补充流动资金有利于降低资产负债率，优化财务结构，增强公司应对外部不确定性风险的对抗能力。本次募集资金用于补充流动资金系基于公司主营业务发展需要和行业竞争环境审慎确定，有利于增强公司资本实力、优化资产负债结构，其规模系结合公司业务发展目标及实际经营情况测算得出，具有合理性与必要性。

（二）本次募集资金具体用途与公司现有业务、核心技术的关系

公司主要从事高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备的研发、设计、生产与销售。本次募集资金投资项目中，半导体高端装备产能升级与智造基地建设项目、高端电子化学品智能供应产线及半导体核心工艺装备研发项目、电子溶剂绿色再生高效系统研发项目将围绕公司高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备进行产能扩充与技术产业化落地，显著提升产线的自动化、智能化与精益化生产水平，增强产品核心竞争力，巩固公司的领先优势；营销总部及营销网络建设项目将立足现有营销基础与客户资源，搭建总部统筹、区域协同的一体化服务体系，通过完善覆盖、深化服务、提升效率、挖掘增量，为产能释放提供市场保障，促

进产品迭代与市场拓展的高效协同；补充流动资金项目有助于缓解公司因经营规模扩大而产生的营运资金需求，同时减少公司财务费用，降低资产负债率，优化财务结构，降低财务风险。

因此，本次募集资金用途与公司现有业务及核心技术紧密相关。

三、募集资金投资项目具体情况

募集资金投资项目具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件六、募集资金具体运用情况”。

四、募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响和对业务创新、创造、创意性的支持作用

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，聚焦于高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备的技术升级、产能扩充与市场拓展。项目建成后，将显著提升公司的智能制造水平、快速交付能力与运营管理效率，深化公司在泛半导体产业链中的核心配套优势。

半导体高端装备产能升级与智造基地建设项目通过引入自动化制造及高精度检测设备，推动生产流程向标准化、模块化转型，为工艺迭代和新兴应用拓展提供先进的支撑条件；高端电子化学品智能供应产线及半导体核心工艺装备研发项目及电子溶剂绿色再生高效系统研发项目将围绕精密流体控制、在线污染监测、复杂化学反应管理及智能化运行维护等关键技术开展前瞻性攻关，加速成果转化，为公司应对行业技术升级与市场格局变化储备创新动能；营销总部及营销网络建设项目依托公司现有营销基础与客户资源，构建总部统筹、区域协同的一体化服务体系。通过深化客户服务、优化区域覆盖、提升响应效率并拓展市场增量，推动产品迭代与市场拓展的高效协同，进一步巩固公司市场地位与品牌影响力；补充流动资金有助于优化资本结构，提升经营稳健性与抗风险能力，支撑公司中长期战略目标的实现。

综上，本次募投项目的实施，将全方位提升公司核心竞争力，保障主营业务的可持续高质量发展，并对业务创新、创造、创意性形成有力支撑。

五、未来发展规划

（一）公司战略规划、措施和目标

公司紧抓产业发展机遇，聚焦高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备，依托现有业务基础、技术积累及市场布局，统筹研发、生产、人才等各项资源，重点服务于集成电路、显示面板、电子化学品等行业客户，以期推动公司实现规模化、高质量、可持续发展。

为落实发展规划，公司将围绕规模增长、技术突破、产能落地、运营提效、合规风控的主线重点推进。一是稳步拓展市场，深耕半导体专用设备领域，以“华东核心、辐射全国、海外突破”的整体布局，分层推进区域、客户、品牌建设，构建全方位与多层次的市场发展体系，实现份额与规模双提升；二是持续做好研发创新，保持研发投入水平，完善研发管理架构，加强与高校、科研院所的技术交流，重点攻关先进制程中高纯工艺介质金属杂质控制、产品智能化改造、节能降耗等前沿技术，推动技术突破与成果转化，支撑业务发展与战略落地；三是优化生产管理，按照募投项目规划分阶段推进产线建设，引入先进生产设备与工艺，建立完善的质量检测体系，实现智能化、规模化、标准化生产，提高生产效率与订单交付能力；四是加强精益化管理，通过流程优化、技术升级及精益化管理，提升资源利用水平，降低运营成本，增强盈利能力；五是完善经营风险管控与合规体系建设，通过里程碑管理、阶梯式扩产、风险评级等机制保障规划平稳落地，同时将 ESG 理念全面融入战略制定、经营决策、研发生产、文化建设等全过程，助力泛半导体产业绿色低碳高质量发展。

未来，公司将进一步完善技术研发体系、市场服务网络覆盖与精细化运营管理能力，不断夯实核心竞争力，坚守永续经营的发展理念，追求基业长青的长期发展目标，致力于成为国内半导体专用设备领域高品质、高可靠性的行业标杆。

（二）报告期内已采取的措施及实施效果

报告期内，公司围绕既定发展规划，稳步推进各项工作，不断提升精益生产能力与客户拓展能力。面对半导体行业国产替代进程持续深化、产业支持政策密集落地、全球供应链格局深刻调整的行业发展态势，公司积极迎接挑战，在新时代采取卓越运营的新策略。在基本竞争战略方面，公司以“技术领先”和“客户

深耕”作为主导战略；在精益运营方面，公司严格把控产品生产全流程、供应商准入管理、订单与项目筛选、逾期货款回款等环节；在企业文化与人才建设方面，公司持续提升团队凝聚力，激励员工深耕技术、锐意进取、协同共进。

公司具备产品全流程自主研发、定制化设计与精益制造能力，并以此为基础构建起覆盖化学品全生命周期的产品矩阵，形成了从技术预研、方案设计、生产制造到终端运维服务的全链条业务闭环。同时，公司搭建了辐射国内主要泛半导体产业集群的营销与技术服务网络，实现对客户需求的深度覆盖与快速响应，不断夯实企业竞争力。报告期内，公司各项经营举措落地效果良好，主要产品市场份额稳步提升，经营业绩稳健增长，研发成果持续落地，产品与服务获得核心客户的广泛认可。

第八节 公司治理与独立性

一、报告期内公司治理方面存在的缺陷及改进情况

报告期内，公司治理结构不存在明显缺陷。公司按照《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等制度，建立了由股东会、董事会和高级管理人员组成的权责明确、运作规范的法人治理结构，并设立了董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会。

报告期内，股东会、董事会和经营管理层能够按照相关法律、法规和公司章程赋予的职权依法独立规范运作，履行各自的权利和义务，公司治理不存在重大缺陷。

二、关于内部控制完整性、合理性和有效性的评估意见

（一）管理层的自我评估意见

公司对截至 2025 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制进行了自我评价，公司董事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面保持了有效的与财务报告相关的内部控制。

（二）注册会计师的鉴证意见

信永中和出具了编号为 XYZH/2026SUAA1B0159 号《内部控制审计报告》，认为公司在 2025 年 12 月 31 日已经按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、公司报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况

报告期内，公司及其子公司不存在违法违规行为或受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况。

根据境外律师事务所 Shaun Wong LLC、Christopher Yeo & KP Chang.出具的法律意见书，报告期内，公司境外子公司新加坡冠礼、马来西亚冠礼未曾受到过当地政府部门或司法机关的处罚。

四、发行人报告期内资金占用或提供担保的情况

报告期内，公司及子公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情况，也不存在公司及子公司为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

五、发行人独立运营情况

发行人系由冠礼有限整体变更设立的股份有限公司。公司自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司股东及其控制的其他企业完全分开，具有完整的业务体系及独立面向市场自主经营的能力。

（一）资产完整情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等知识产权的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产完整，独立于控股股东。

（二）人员独立情况

公司董事及高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程等规定选举和聘任，不存在股东超越股东会和董事会权限做出人事任免决定的行为。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况，发行人财务人员专职在公司任职，未在其他企业兼职。

（三）财务独立情况

发行人已设立独立的财务部门，配备了专职的财务人员，发行人已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。发行人不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账号的情况。发行人独立进行纳税申报和独立履行缴税义务，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税的情况。

（四）机构独立情况

发行人已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立情况

发行人的业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间不存在构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（六）主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定性

发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近三年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，发行人无实际控制人，最近三年内控股股东未发生变更。

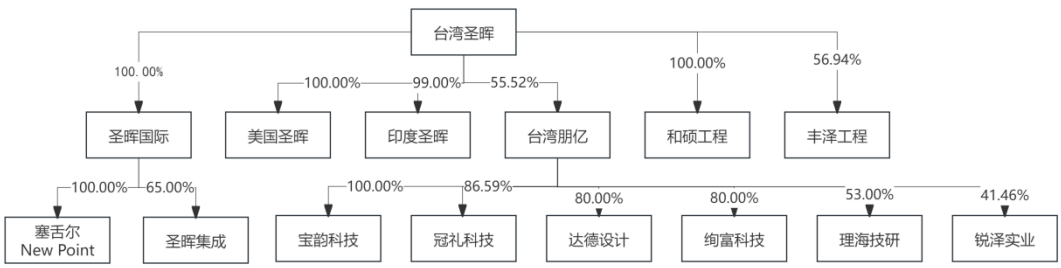
（七）其他重大事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在主要资产、核心技术、商标有重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

六、同业竞争

（一）发行人与控股股东及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

截至本招股说明书签署日，发行人直接控股股东为台湾朋亿，间接控股股东为台湾圣晖。公司控股股东控制的其他企业情况如下：



公司与控股股东及其控制的其他企业从事相同或相似业务的情形如下：

公司名称	身份	主要从事业务	与发行人从事业务是否相同或相似	是否存在同业竞争
台湾朋亿（单体）	直接控股股东	向中国台湾高科技产业客户提供化学品供应系统销售与整合工程服务	是	是[注]
台湾圣晖（单体）	间接控股股东	在中国台湾从事洁净室工程服务	否	否
宝韵科技	直接控股股东控制的其他企业	电子器材、设备批发与化工机械批发	否	否
锐泽实业及其子公司	直接控股股东控制的其他企业	半导体气体供应系统的设计及安装	否	否
达德设计	直接控股股东控制的其他企业	工程制图与设计业务	否	否
理海技研	直接控股股东控制的其他企业	环保业务设计服务	是	否
绚富科技	直接控股股东控制的其他企业	工程图面3D建模设计、软件信息服务	否	否
美国圣晖	间接控股股东控制的其他企业	在美国从事洁净室工程服务	否	否
印度圣晖	间接控股股东控制的其他企业	在印度从事洁净室工程服务	否	否
和硕工程	间接控股股东控制的其他企业	小型洁净室改装工程	否	否
丰泽工程	间接控股股东控制的其他企业	基建工程	否	否
圣晖国际	间接控股股东控制的其他企业	圣晖集成直接控股股东，无实际业务	否	否
圣晖集成及其子公司	间接控股股东控制的其他企业	从事洁净室工程服务	否	否
塞舌尔New Point	间接控股股东控制的其他企业	设备买卖	否	否

注：报告期内，公司与台湾朋亿存在不构成重大不利影响的同业竞争。截至报告期末，已不存在同业竞争。

公司作为台湾朋亿的控股子公司，主要经营高纯工艺介质系统和高阶湿制程工艺设备的销售及安装。根据《国民经济行业分类 GB/T4754-2017》，公司所处行业为“C35 专用设备制造业”中“C3562 半导体器件专用设备制造”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“1 新一代信息技术产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

发行人直接控股股东台湾朋亿的主营业务为向中国台湾高科技产业客户提供化学品供应系统销售与整合工程服务，与发行人业务相同或相似。

理海技研成立于 2025 年 1 月，2025 年度营业收入为新台币 141.18 万元（约合人民币 32.36 万元），其从事的主营业务为环保业务设计服务。发行人废化学品再生系统业务为面向泛半导体产业客户提供的一整套集系统设计、管路设计、设备制造、安装调试、售后维保为整体的一体化业务。双方在部分设计环节存在一定的相似性，但双方整体业务定位不同，不属于相同业务，故不存在同业竞争。

综上所述，除台湾朋亿外，公司与间接控股股东台湾圣晖及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。发行人与直接控股股东台湾朋亿间存在相同或相似业务的情形，但不存在构成重大不利影响的同业竞争。

（二）发行人与台湾朋亿不存在构成重大不利影响的同业竞争

1、公司与台湾朋亿同从事相同或相似业务的形成背景

在中国大陆泛半导体产业政策引导和规模化发展的背景下，冠礼科技作为本土厂务工程专业公司，专注于高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备领域，逐步发展为中国大陆泛半导体产业链的重要配套企业之一。冠礼科技总部位于长三角地区，是中国大陆泛半导体产业最重要的集聚区之一，晶圆厂及面板厂分布密集，为本地厂务系统服务商提供了稳定的市场需求。上海冠礼于 2002 年成立，2016 年冠礼科技成立，形成了覆盖研发、设计、生产安装及服务的完整产业链布局。2023 年 11 月，为进一步整合大陆业务资源、提升运营协同效率，台湾朋亿进行了同一控制下企业合并，上海冠礼成为冠礼科技子公司，进一步强化了集团内部资源统筹与业务协同。随着中国大陆晶圆厂及面板厂建设进入高峰期，冠礼科技聚焦集成电路、显示面板等泛半导体产业链客户，产品成功应用于多条 12 英寸晶圆代工先进制程产线及高世代面板产线。公司在中国大陆的业务以接受终端客户委托、进行化学品供应系统的工程设计与项目管理、自主完成设备制造及现场安装调试、再提供后续维护服务为主要经营模式，长期服务于中国大陆泛半导体产业。

专业分工模式下晶圆厂、面板厂等企业依赖本地厂务服务商提供就近的工程实施与售后运维。化学品供应系统作为泛半导体产业厂务基础设施的重要组成部分，其设计、安装、调试及后续维护需与客户的产线建设节奏紧密配合，工程服务的半径受限于准入政策、资质管理、贸易政策、供应链、客户资源、响应及时性等因素。台湾朋亿深耕中国台湾本地市场，冠礼科技作为独立运营的大陆子公司专注服务大陆本土客户群体，二者在各自市场的业务布局均具有独立性与不可替代性。双方在化学品供应系统领域的业务格局，系两岸产业发展阶段差异与地理分隔条件下的自然结果，并非以客户或市场交叉为目的主动竞争安排。

2、发行人与台湾朋亿在中国台湾市场不构成同业竞争

（1）化学品供应系统的客户依赖供应商一体化综合服务能力

泛半导体化学品供应系统属于个性化厂务系统，客户出于保障工艺介质洁净度、稳定性及制程良率的考虑，要求同一主体承担从系统设计、设备制造、现场安装调试到长期运维的全生命周期管理责任，以避免多方接口连接不当而导致的工艺介质污染及系统运行参数波动。

化学品供应系统从设计、制造到安装运维的全流程服务是不可分割的整体。设备原厂商掌握完整的专利设计图纸、性能曲线及工艺参数，能够在安装调试阶段准确匹配机台运行环境，以满足系统持续的超高纯度及稳定性要求。在运维阶段，原厂商依托历史故障数据库，能够快速定位故障并实施预防性维护，并基于长期积累的实证数据为客户提供定制化优化方案。第三方服务商因缺乏完整的技术参数，在服务过程中存在一定的局限性。因此，半导体行业客户通常选择设备原厂商提供一体化服务。

（2）冠礼科技在中国台湾展业的客观障碍

①工程资质与人员壁垒

根据中国台湾“两岸人民关系条例”及“大陆地区人民来台投资许可办法”等规定，中国大陆投资人赴中国台湾投资采取许可制与正面清单管理，同时对具备中国大陆背景的投资实施全面穿透式审查；半导体制程配套工程服务未列入开放行业清单。因此，冠礼科技客观上无法在中国台湾合规设立经营主体，亦无法申请相关工程资质，难以自身名义开展化学品供应系统配套工程服务。

同时，冠礼科技面临派遣人员赴台驻场作业的实质性障碍。向中国台湾派遣员工从事业务活动将面临严格的入境许可及长期驻场审批不确定性。依据相关规定，未在中国台湾取得许可设立分公司或办事处的中国大陆企业，不得以自身法人名义在中国台湾从事经营性业务活动。公司无在中国台湾合法登记的经营主体，无法为驻场人员依法办理劳健保，不满足工程作业的强制性合规要求。

②政策与合规壁垒

中国台湾对半导体先进制程相关技术及供应链实施严格监管。根据相关主管

部门公告，14 纳米及以下制程的集成电路制造技术及其关键化学品和设备技术已被列入核心关键技术清单。相关设备及系统进入先进制程应用领域时，需符合安全审查、合规评估及数据安全保护等监管要求，可能增加审批流程复杂度和商业落地难度。此外，以“资通安全管理法”为核心的网络安全法规体系，将半导体制造等关键基础设施纳入监管，对涉及制程数据交互的设备及运维服务提出严格的网络安全合规要求。两地在网络安全管理框架、数据处理及审查机制上存在制度差异，对设备销售及运维服务构成合规壁垒。

③供应链信任壁垒

中国台湾半导体产业已形成较为成熟且高度整合的供应链生态系统。终端客户在采购关键设备及系统时，通常基于长期合作关系、技术可靠性、供应稳定性及合规表现等因素，选择已通过严格资质审查并建立稳定供应关系的供应商。新进入或非传统供应商需面临较为严格的供应商资格审查及长期绩效评估，存在一定的路径依赖和进入门槛。上述供应链生态特点，凸显了在当地市场建立一体化供应与服务能力的重要性。

综上所述，因工程资质、政策合规限制及供应链信任等多重客观壁垒，冠礼科技在中国台湾不具备开展化学品供应系统一体化综合服务的事实条件与经营能力，与台湾朋亿在中国台湾市场不构成同业竞争。

3、发行人与台湾朋亿在中国台湾以外市场存在不构成重大不利影响的同业竞争

报告期内，台湾朋亿存在来自中国台湾以外其他市场的化学品供应系统销售业务收入，该部分收入构成与发行人的竞争性业务。报告期内，台湾朋亿来自中国台湾以外的化学品供应系统销售业务收入情况如下：

单位：人民币万元

项目	2025 年		2024 年		2023 年	
	金额	台湾朋亿收入占比	金额	台湾朋亿收入占比	金额	台湾朋亿收入占比
中国大陆	-	-	5,309.89	12.35%	9,286.37	20.24%
新加坡	-	-	13,205.88	30.71%	9,952.92	21.69%
台湾朋亿营业收入合计	**31,701.14**	**100.00%**	**43,001.85**	**100.00%**	**45,876.67**	**100.00%**

2023 年和 2024 年，台湾朋亿面向中国大陆、新加坡等中国台湾以外市场取得的化学品供应系统设备销售业务，主要为 2023 年 11 月冠礼科技完成对上海冠礼、新加坡冠礼同一控制下重大资产重组前承接的订单，该次重大资产重组完成后，台湾朋亿不在中国大陆及新加坡市场承接新的化学品供应系统订单。

直接控股股东台湾朋亿、间接控股股东台湾圣晖已出具《关于避免同业竞争的承诺》，承诺未来将不会以任何形式直接或间接从事与冠礼科技及其下属企业经营的业务构成重大不利影响的同业竞争的业务或活动，不会直接或间接控股、收购、兼并与冠礼科技及其下属企业经营的业务构成重大不利影响的同业竞争的企业或其他经济组织。

4、相关竞争性业务财务指标占比测算

由于冠礼科技无法进入中国台湾市场从事化学品供应系统的安装工程及调试维护服务，双方在中国台湾市场不构成同业竞争，双方在化学品供应系统领域有关的竞争性业务存在于中国台湾以外的市场区域。

根据《证券期货法律适用意见第 17 号》第一条，“竞争方的同类收入或者毛利占发行人主营业务收入或者毛利的比例达百分之三十以上的，如无充分相反证据，原则上应当认定为构成重大不利影响的同业竞争”。发行人同业竞争相关指标均未超过 30%，不构成重大不利影响的同业竞争。

报告期内各期，台湾朋亿从事的与发行人有关的竞争性业务产生的收入和毛利规模，与发行人主要财务指标的对比计算如下表所示：

单位：万元

项目		2025 年度	2024 年度	2023 年度
台湾朋亿	收入（A）	-	18,515.77	19,239.29
	毛利（B）	-	7,763.59	3,857.94
发行人	主营业务收入（C）	131,776.76	126,921.76	83,968.39
	主营业务毛利（D）	38,091.58	40,429.15	20,414.79
收入占比（E）=（A）/（C）		-	14.59%	22.91%
毛利占比（F）（B）/（D）		-	19.20%	18.90%

2023 年度，台湾朋亿的化学品供应系统销售相关收入及毛利占发行人主营

业务收入和主营业务毛利的比例分别为22.91%和18.90%，均未超过30%。2024年度，随着公司所在行业规模不断扩张及业务规模持续扩展，公司主营业务收入快速增长。同时，在发行人完成上海冠礼、新加坡冠礼的同一控制下重大资产重组后，台湾朋亿不在中国大陆及新加坡市场承接新增的化学品供应系统订单，2024 年度收入为前期承接项目产生，台湾朋亿从事的竞争性业务占公司的比例相对下降。2025年后台湾朋亿不再有与发行人存在竞争性的业务收入产生。

5、公司与台湾朋亿业务完全独立运行

（1）业务承揽模式和销售体系

台湾朋亿深耕中国台湾市场二十余年，与矽品精密、力积电等企业建立长期合作，具备区域先发优势。冠礼科技立足中国大陆，与半导体行业知名客户稳定合作，在高纯化学品供应系统、高阶湿制程工艺设备等领域具备本地化服务能力。2023 年上海冠礼、新加坡冠礼重大资产重组完成后，中国台湾以外市场的化学品供应系统业务转为由发行人及其子公司运营。冠礼科技拥有独立销售体系，依托上海及苏州基地实现全流程闭环服务，与台湾朋亿销售体系无依赖交叉，区域分工明确。

（2）资产独立

双方资产保持独立。冠礼科技拥有独立的固定资产、无形资产等，登记于自身名下。台湾朋亿资产集中于中国台湾。双方资产无交叉持有、共用或混同情形，权属清晰，账务分离。

（3）人员独立

发行人高级管理人员及财务人员未在控股股东及其控制的其他企业任职或领薪。双方销售体系及人员完全独立。台湾朋亿各职能部门负责人均未在发行人及其子公司担任管理职务。

（4）技术研发体系独立

发行人设有独立研发部门，具有完整、独立的技术研发体系，拥有4名核心技术人员，报告期内未发生变更。核心技术人员长期任职于发行人，不存在由台湾朋亿委托研发、代为研发或支付研发费用的情形。截至2025年12月31日，

发行人拥有专利 194 项。报告期内，发行人与台湾朋亿在专利、技术方面保持独立，不存在相互授权使用专利或非专利技术的情形，亦不存在共用情形，发行人的技术独立。

（5）财务独立

冠礼科技拥有独立银行账户、财务核算体系，按中国企业会计准则独立编制财务报表并审计；台湾朋亿按中国台湾会计准则独立核算。双方财务报表、账册互不混同，报告期末双方不存在资金拆借余额，报告期内无代收代付等情形。少量关联交易遵循市场化原则，财务独立清晰划分经营成果，实现风险隔离。

综上所述，公司与直接控股股东台湾朋亿在中国台湾市场不存在同业竞争，报告期内，双方在中国台湾以外市场存在竞争性业务，但不存在构成重大不利影响的同业竞争。截止报告期末，公司与台湾朋亿不存在同业竞争的情形。

（三）关于避免同业竞争的承诺

发行人控股股东台湾朋亿及台湾圣晖将出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺”之“（九）关于避免同业竞争的承诺”。

七、关联方与关联交易

（一）关联方与关联关系

根据《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及中国证监会等有关规定，公司的关联方及关联关系情况如下：

1、关联自然人

（1）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	梁进利	直接或间接持股 5%以上的自然人

（2）公司董事及高级管理人员

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	梁进利	董事长

2	简建至	董事、总经理
3	梁闵杰	董事、董事会秘书
4	宋玉宝	职工董事
5	薛伶伶	独立董事
6	雷丹丹	独立董事
7	许叶枚	独立董事
8	王駸典	财务负责人

（3）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员

编号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	杨炯棠	台湾朋亿董事、报告期内曾任台湾圣晖董事（2024 年 5 月离任）
2	马蔚	台湾朋亿董事和总经理、报告期内曾任发行人董事（2023 年 8 月离任）
3	许美丽	台湾朋亿独立董事（2025 年 5 月起担任）
4	杨千	台湾朋亿独立董事（2025 年 5 月起担任）、报告期内曾任台湾圣晖独立董事（2024 年 5 月离任）
5	叶惠心	台湾朋亿独立董事（2025 年 5 月起担任）、报告期内曾任台湾圣晖独立董事（2024 年 5 月离任）
6	龙凤娣	台湾朋亿独立董事（2025 年 5 月起担任）
7	苏敏郎	台湾朋亿副总经理
8	欧俊彦	台湾朋亿财会主管
9	胡台珍	台湾圣晖董事
10	巫碧蕙	台湾圣晖董事（2024 年 5 月起担任）、报告期内曾任台湾朋亿董事（2024 年 5 月离任）
11	黄姿裴	台湾圣晖独立董事
12	纪志毅	台湾圣晖独立董事（2024 年 5 月起担任）、报告期内曾任台湾朋亿独立董事（2025 年 5 月离任）
13	邱慧吟	台湾圣晖独立董事（2024 年 5 月起担任）、报告期内曾任台湾朋亿独立董事（2025 年 5 月离任）
14	梁连文	台湾圣晖独立董事（2024 年 5 月起担任）
15	王俊盛	台湾圣晖总经理
16	赖铭崑	台湾圣晖总经理
17	张日东	台湾圣晖副总经理
18	李明智	台湾圣晖副总经理
19	陈渊碧	台湾圣晖副总经理

20	陈忠生	台湾圣晖财务会计/公司治理主管

注：如关联方同时符合下列其他认定条件，不再重复列示，下同

（4）其他关联自然人

前三项关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

（5）历史关联自然人与潜在关联自然人

编号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	许宗政	报告期内曾任公司董事（2025 年 10 月离任），曾任台湾朋亿董事（2023 年 5 月离任）
2	胡亮	报告期内任公司独立董事（2025 年 10 月选任，2026 年 5 月离任）
3	赵晗	报告期内曾任公司监事（2025 年 10 月离任）
4	杨声勇	报告期内曾任台湾朋亿独立董事（2025 年 5 月离任）
5	李成	报告期内曾任台湾朋亿独立董事（2025 年 5 月离任）
6	王茂荣	报告期内曾任台湾圣晖独立董事（2024 年 5 月离任）
7	曹耘涵	报告期内曾任台湾圣晖财务主管（2023 年 11 月离任）
8	王金泉	曾任台湾圣晖副总经理（2022 年 12 月离任）

2、关联法人

（1）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织

编号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	台湾朋亿	截至报告期末持有公司 86.59%股份，公司直接控股股东
2	台湾圣晖	间接地控制上市公司的法人

（2）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织

编号	关联方名称	与本公司的关联关系
1-1	宝韵科技	台湾朋亿直接控制的公司，梁进利担任董事长、马蔚担任董事
1-2	达德设计	台湾朋亿直接控制的公司，马蔚担任董事长、苏敏郎担任董事
1-3	理海技研	台湾朋亿直接控制的公司，马蔚担任董事长、苏敏郎担任董事

1-4	锐泽实业	台湾朋亿直接控制的公司，梁进利担任董事长、马蔚担任董事
1-4-1	日本锐泽	锐泽实业直接控制的公司
1-4-2	新加坡锐泽	锐泽实业直接控制的公司
1-4-3	美国锐泽	锐泽实业直接控制的公司
1-4-4	锐泽投资	锐泽实业直接控制的公司
1-4-4-1	锐泽材料	锐泽投资直接控制的公司
1-4-5	德国锐泽	锐泽实业直接控制的公司
1-4-6	锐拓科技	锐泽实业直接控制的公司
1-5	绚富科技	台湾朋亿直接控制的公司，马蔚担任董事长、苏敏郎担任董事（2026年4月成为台湾朋亿子公司）
2-1	和硕工程	台湾圣晖直接控制的公司，梁进利担任董事长
2-2	印度圣晖	台湾圣晖直接控制的公司
2-3	丰泽工程	台湾圣晖直接控制的公司，梁进利担任董事、执行长
2-4	美国圣晖	台湾圣晖直接控制的公司
2-5	圣晖国际	台湾圣晖直接控制的公司，梁进利担任董事
2-5-1	塞舌尔 New Point	圣晖国际直接控制的公司，梁进利担任董事
2-5-2	圣晖集成	圣晖国际直接控制的公司，梁进利担任董事长
2-5-2-1	深圳鼎贸	圣晖集成直接控制的公司，梁进利担任董事
2-5-2-2	深圳圣晖	圣晖集成直接控制的公司，梁进利担任董事
2-5-2-3	越南圣晖	圣晖集成直接控制的公司，梁进利担任董事
2-5-2-4	香港 Acter	圣晖集成直接控制的公司，梁进利担任董事
2-5-2-5	新加坡 Acter	圣晖集成直接控制的公司，梁进利担任董事
2-5-2-5-1	印尼 Acter	新加坡 Acter 直接控制的公司
2-5-2-6	印尼合资	圣晖集成直接控制的公司，梁进利担任董事
2-5-2-7	马来西亚 Acter	圣晖集成直接控制的公司，梁进利担任董事
2-5-2-8	泰国 Acter	圣晖集成间接控制的公司，梁进利担任董事

（3）参控股子公司

编号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	上海冠礼	全资子公司
2	新加坡冠礼	全资子公司

3	马来西亚冠礼	全资子公司

（4）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人；

持有公司 5%以上股份的法人为台湾朋亿，除台湾朋亿控制的公司外，不存在其他法人或组织及其一致行动人。

（5）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的主要法人或其他组织

编号	关联方名称	与本公司的关联关系
1-1	苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	梁进利担任执行事务合伙人
1-2	卫司特科技股份有限公司	梁进利担任董事的公司
1-3	昇阳国际半导体股份有限公司	梁进利之子梁钧帎担任董事
1-4	弘业机械工业股份有限公司	梁进利之兄梁进忠担任董事
1-5	合丰钢模股份有限公司	梁进利之姐梁素卿担任董事长
1-6	九昌投资	梁进利及其配偶、成年子女合计持股 100%，且梁进利配偶王逸华担任董事长、子女梁乔茵和梁闵杰担任董事
2-1	上海竑圣晖	宋玉宝担任执行事务合伙人
2-2	上海庐昌电子工程有限公司	宋玉宝配偶之弟控制并担任执行董事
3	江阴市赛英电子股份有限公司	薛伶伶担任财务总监、董事会秘书
4	苏州吉曜	王駸典担任执行事务合伙人的企业
5-1	翔晖开发股份有限公司	杨炯棠及其配偶、成年子女合计持股 100%，且杨炯棠及其儿子杨昕皓担任董事
5-2	强晖企业股份有限公司	杨炯棠、其儿子杨昕皓及其兄弟杨俊修担任董事
5-3	财团法人台中市四季艺术教育基金会	杨炯棠担任董事
5-4	环渼节能科技股份有限公司	杨炯棠儿子杨昕皓担任董事长
5-5	达莉事业股份有限公司	杨炯棠儿子杨昕皓担任董事
5-6	莉芯国际股份有限公司	杨炯棠儿子杨昕皓担任董事
5-7	铃鹿化工股份有限公司	杨炯棠配偶杨魏和治担任董事、配偶的哥哥魏早亿担任董事长、配偶的弟弟魏早增担任董事
6-1	圣利投资有限公司	马蔚持股 80%，马蔚女儿担任董事长
6-2	扬博科技股份有限公司	马蔚担任董事的公司
6-3	广盛科技股份有限公司	马蔚妹妹的配偶担任董事长、总经理

7-1	竹堑量堂有限公司	许美丽持股 100%并担任董事
7-2	大众联合法律事务所	许美丽及其配偶共同持股100%
8	嘉彰股份有限公司	杨千担任董事
9-1	维勤会计师事务所	叶惠心担任负责人
9-2	唯心财务顾问有限公司	叶惠心担任董事
10-1	梨山宾馆股份有限公司	胡台珍担任董事
10-2	广龙投资有限公司	胡台珍配偶孙澄美担任董事、负责人
10-3	大安齿轮机械厂	胡台珍儿子配偶的父亲担任负责人
11-1	台中女中文教基金会	巫碧蕙担任董事、副理事长
11-2	弥雅公关营销有限公司	巫碧蕙女儿持股 100%并担任董事
12	佳鑫会计师事务所	纪志毅配偶的妹妹担任所长
13-1	维裕联合会计师事务所	邱慧吟担任所长
13-2	力容投资股份有限公司	邱慧吟担任董事长并持股 97.67%
14	山明科技工程有限公司	李明智弟弟持股 100%并担任负责人及董事
15	弘胜资源回收企业社	陈忠生配偶的弟弟持股 100%并担任负责人

前述其他关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的企业亦为公司的关联方。

（6）主要历史关联法人与潜在关联法人

编号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	恒吉建设股份有限公司	台湾圣晖直接或间接控制的公司，于 2024 年 8 月完成清算
2	杰能系统工程股份有限公司	王茂荣曾担任董事，已于 2022 年 4 月卸任
3	江苏典泽建设工程有限公司	圣晖集成曾持股 100%的子公司，于 2023 年 11 月注销
4	鑫意开发创新有限公司	许宗政之女担任董事的公司
5	茂荣能源服务管理顾问有限公司	王茂荣持股 100%并担任负责人
6	上海鼎振益	赵晗担任执行事务合伙人
7	浙江启尔机电技术有限公司	胡亮担任董事

（二）关联交易

1、重大关联交易的判断标准及依据

判断关联交易是否构成重大关联交易时，参考公司《关联交易管理制度》规定的股东会审议关联交易事项权限，将公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的交易，且超过 3,000 万元认定为重大关联交易。此外，关键管理人员薪酬为公司正常经营活动的必要支出，均为一般关联交易。

2、关联交易情况简要汇总表

报告期内，公司的关联交易汇总表如下：

单位：万元

重要程度	项目	性质	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一般关联交易	经常性关联交易	销售商品、提供劳务	164.35	-	-
		采购商品、接受劳务	10.71	285.98	141.96
		关键管理人员薪酬	691.66	649.57	484.76
		向关联方租入房产	343.42	343.14	330.09
		向关联方租出房产	12.36	3.93	3.86
重大关联交易	偶发性关联交易	购买资产	参见本招股说明书 “第四节 发行人基本情况”之“五、（一）重大资产重组情况”		
		关联方资金往来	参见本节之“七、（二）、4 重大关联交易”		
		关联担保			

3、一般关联交易

（1）一般经常性关联交易

报告期内，发行人发生的一般经常性关联交易情况如下：

①销售商品、提供劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
台湾朋亿	为台湾朋亿客户提供机台管路修正及安装服务	164.35	-	-
合计		**164.35**	-	-

2025 年度，发行人向关联方销售的金额分别为 164.35 万元，新加坡冠礼为

台湾朋亿已结案客户在新加坡的项目工厂提供机台管路修正及安装服务，上述交易均以市场价格定价，整体规模较小，不会对发行人报告期财务状况和经营成果产生重大影响。

②采购商品、接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
台湾朋亿	采购货物	-	285.98	141.96
上海庐昌电子工程有限公司	劳务分包	10.71	-	-
合计		**10.71**	**285.98**	**141.96**

报告期内，发行人向关联方采购金额分别为 141.96 万元、285.98 万元、10.71 万元，主要为采购零部件和劳务分包。上述交易均以市场价格定价，整体规模较小，不会对发行人报告期财务状况和经营成果产生重大影响。

③关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	691.66	649.57	484.76

④关联租赁情况

报告期内，发行人存在向关联方圣晖集成进行房屋场地租赁的情形。同时，新加坡冠礼向新加坡 Acter、新加坡锐泽出租办公室，具体情况如下：

单位：万元

出租方	承租方	交易内容	2025 年	2024 年	2023 年
圣晖集成	冠礼科技	房屋租赁	343.42	343.14	330.09
新加坡冠礼	新加坡Acter	房屋租赁	5.23	3.93	3.86
新加坡冠礼	新加坡锐泽	房屋租赁	7.12	-	-

（2）一般偶发性关联交易

报告期内，公司不存在一般偶发性关联交易。

4、重大关联交易

（1）重大经常性关联交易

报告期内，公司不存在重大经常性关联交易。

（2）重大偶发性关联交易

报告期内，公司的重大偶发性关联交易包括公司购买新加坡冠礼股权及接受台湾朋亿以上海冠礼股权作价出资构成的重大资产重组、关联方拆借及关联担保。具体情况如下：

①重大资产重组

参见本招股说明书 “第四节 发行人基本情况”之“五、（一）重大资产重组情况”。

②关联方拆借

报告期内，发行人与控股股东台湾朋亿之间的资金拆借事项如下：

单位：万元

期间	拆出方	拆入方	期初余额	本金拆入	本期利息	本期归还		期末余额
						本金	利息	
2025年	台湾朋亿	上海冠礼	-	-	-	-	-	-
2024年	台湾朋亿	上海冠礼	8,103.17	-	87.17	8,000.00	190.34	-
2023年	台湾朋亿	上海冠礼	-	8,000.00	103.17	-	-	8,103.17

2023 年 5 月和 2023 年 7 月，上海冠礼分别向台湾朋亿借入人民币 3,800.00 万元和 4,200.00 万元，期限均为 1 年，用于日常生产经营周转，该关联方拆借事项属于上海冠礼重组进入发行人前发生的事项，重组前上海冠礼系台湾朋亿全资子公司。相关拆借款项及利息已于 2024 年归还。

③关联担保

报告期内，发行人作为被担保方接受关联方担保的情况如下：

金额：万元

序号	担保方	被担保方	担保金额	担保方式	担保合同签订日	是否履行完毕
1	台湾朋亿	冠礼有限、上海冠礼	10,000.00	保证	2022/11/11	是
2	台湾朋亿	冠礼有限、上海冠礼	10,000.00	保证	2023/12/6	是
3	台湾朋亿	上海冠礼	4,000.00	保证	2023/2/23	是

4	台湾朋亿	上海冠礼	6,000.00	保证	2023/3/29	否
5	台湾朋亿	冠礼有限、上海冠礼	7,000.00	保证、本票担保	2021/8/25	是
6	台湾朋亿	冠礼有限、上海冠礼	12,000.00	保证、本票担保	2023/5/26	是
7	台湾朋亿	冠礼有限、上海冠礼	7,000.00	保证	2022/11/22	是
8	台湾朋亿	冠礼有限、上海冠礼	6,000.00	本票担保	2023/5/31	是
9	台湾朋亿	冠礼有限、上海冠礼	6,000.00	本票担保	2024/4/19	是
10	台湾朋亿	冠礼有限、上海冠礼	16,000.00	保证	2023/5/23	是

5、关联方应收应付款项

报告期各期末，公司与关联方应收应付款项情况如下：

（1）应收账款

报告期内，公司不存在与关联方的应收账款。

（2）应付账款

报告期各期末，公司应付关联方款项情况如下表所示：

单位：万元

关联方	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
台湾朋亿	-	-	20.73
合计	-	-	**20.73**

2023 年末，发行人对台湾朋亿的应付账款系向其采购原材料产生，整体金额较小。

（3）其他应收款

报告期各期末，公司对关联方的其他应收款项情况如下：

单位：万元

关联方	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
新加坡Acter	-	-	4.26	0.21	4.27	0.21
合计	-	-	**4.26**	**0.21**	**4.27**	**0.21**

报告期各期末，公司应收新加坡 Acter 款项，为应收新加坡 Acter 的租金。

（4）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款中，应付关联方款项情况如下：

单位：万元

关联方	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
台湾朋亿	-	-	8,103.17
王駿典	-	-	0.15
合计	-	-	**8,103.32**

2023年末，公司其他应付款主要为应付台湾朋亿的关联方借款本金及利息，相关借款已于 2024 年归还，其余为期末应付员工报销款，金额较小。

（三）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司关联交易主要因经营所需向关联方采购原材料、销售产品、接受关联方提供担保等，公司具有完整的生产经营体系，具备独立经营能力，不存在依赖关联方的情况。公司主要关联交易均系正常经营活动产生，按照市场原则定价，价格合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。公司报告期内发生的关联交易对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

（四）规范关联交易的制度安排

公司已在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等公司内部制度中明确规定了关联交易相关事项的管理规定，并建立了关联股东和关联董事在关联交易表决中的回避制度，确保关联交易的合法、公允，以保护发行人及其股东的利益不因关联交易而受到损害。

（五）报告期内关联交易履行的程序及独立董事对公司关联交易的评价意见

公司生产经营上不存在依赖关联方的情形；报告期内公司的关联交易履行了《公司章程》等有关制度的规定，不存在损害中小股东的利益的情形。

公司报告期内发生的全部关联交易已经 2025 年年度股东会进行审议，确认公司最近三年（即 2023 年、2024 年及 2025 年）与关联方发生的关联交易真实、准确、完整；相关关联交易均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格按照市场定价原则或者

使公司或非关联股东受益的原则确定，符合《公司法》和公司章程的相关规定，具备必要性、合理性和公允性；公司最近三年与关联方发生的关联交易不存在损害公司利益或非关联股东利益的情况。

公司独立董事对公司报告期内的关联交易情况发表了独立意见，认为：“公司最近三年所发生的关联交易符合发行人生产经营需要，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。”

（六）规范和减少关联交易的措施

为了规范和减少关联交易，公司章程对规范关联交易作出了规定，并专门制定了《关联交易管理制度》等规章制度，对关联交易的决策机构、决策权限和决策程序作出了明确规定。公司将严格遵守有关法律法规和规章制度，采取有效措施，严格履行关联交易决策程序，减少关联交易并确保关联交易的公平、公开和公正，从而保护公司和公司股东尤其是中小股东的利益。

发行人控股股东台湾圣晖、台湾朋亿出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺”之“（十）关于减少和规范关联交易的承诺”。

（七）关联方的变化情况及后续关联交易

公司报告期内关联方变化情况主要为关联自然人不再于相关方任职、关联法人注销所致，具体变化情况等内容请参见本招股说明书本节之“七、关联方与关联交易”之“（一）关联方与关联关系”。

上述关联关系变化后，截至本招股说明书签署日，发行人与该等原关联方未发生后续交易。

第九节 投资者保护

一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

根据公司召开的 2026 年第一次临时股东会，公司本次发行上市前所形成的未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东共同享有。

二、本次发行前后股利分配政策及差异情况

（一）报告期内公司的股利分配政策

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

3、公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。

（二）公司上市后的股利分配政策

根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《公司章程（草案）》，公司本次股票发行完成后的股利分配政策如下：

1、利润分配的原则

公司本着重视对股东合理的投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展的原则，实施持续、稳定的股利分配政策。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司股东会、董事会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分听取和考虑社会公众股股东的意见。

2、利润分配的具体政策

（1）公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展和维护股东权益为宗旨，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性。

（2）利润分配的形式：公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润。在具备现金分红条件的，优先采用现金分红的利润分配方式。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（3）利润分配的间隔时间：公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，公司原则上按年度进行利润分配，也可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。

（4）现金分红的条件：同时满足以下条件的，公司实施现金分红，若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%。

①公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②公司该年度资产负债率低于 70%；

③审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80%；

②当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40%；

③当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20%；

④当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照本款第三项规定处理。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。现金分红在本次利润分配中所占比例为：本次现金股利除以本次现金股利与股票股利之和。

（5）股票分红的条件：

①公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正。

②审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见审计报告。

③董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，实现股本扩张与业绩增长保持同步。

3、利润分配的决策程序

（1）利润分配预案由董事会结合本章程规定及公司财务状况拟定。董事会在利润分配预案论证过程中，应当与独立董事进行充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。

（2）利润分配预案须经出席董事会的董事过半数通过。独立董事应当召开专门会议对利润分配预案发表明确的意见。独立董事也可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（3）利润分配预案经董事会审议通过后，应提交股东会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、

邮件等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（4）公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（5）审计委员会对董事会与管理层执行利润分配政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。审计委员会应对利润分配预案进行审议。

4、利润分配政策调整的调整机制

（1）公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。利润分配政策调整应以保护股东利益为出发点，调整后的利润分配政策和股东回报规划不得违反相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。利润分配政策和股东回报规划调整方案需独立董事召开专门会议发表意见，经董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

①因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

②因出现战争、自然灾害、重大公共卫生事件等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

③因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%；

④中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

（2）公司审议利润分配调整方案时，应当通过多种渠道充分听取中小股东意见（包括但不限于提供网络投票、邀请中小股东参会），董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东会的投票权。

三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排。

四、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的公司关于依法落实保护投资者合法权益规定的各项措施

截至报告期末，公司不存在累计未弥补亏损，无需因尚未盈利或存在累计未弥补亏损的事项，做出保护投资者权益的特殊安排。

第十节 其他重要事项

一、重大合同

重大合同指对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的已履行、正在履行和将要履行的合同，具体如下：

（一）销售合同

公司重大销售合同的认定标准为报告期内执行的单笔金额在 8,000 万元（未税）以上的合同，合同情况及截至报告期末的履行情况如下：

单位：万元

序号	主体	客户名称	合同编号	销售标的	签订时间	合同金额	履行情况
1	上海冠礼	公司 A	42-22-21-5718	高纯工艺介质系统	2023 年 1 月	28,681.92	正在履行
2	上海冠礼	公司 E-4	PPA-20230613-0001、PPA-SA-000188	高纯工艺介质系统	2023 年 7 月	25,293.93	正在履行
3	上海冠礼	公司 B-1	PPA-20240530-0006	高纯工艺介质系统	2024 年 7 月	25,002.65	履行完毕
4	上海冠礼	公司 C	PPA-20230427-0001、PPA-SA-000193、PPA-SA-000303	高纯工艺介质系统	2023 年 6 月	22,417.91	履行完毕
5	上海冠礼	公司 E-4	SJ-009-01-PPA-000707、SJ-009-01-PPA-000707_B1	高纯工艺介质系统	2022 年 11 月	19,558.01	履行完毕
6	上海冠礼	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	HHZZ-006	高纯工艺介质系统	2023 年 10 月	15,202.63	履行完毕
7	上海冠礼	杭州积海半导体有限公司	5100000022	高纯工艺介质系统	2023 年 1 月	11,000.00	履行完毕
8	上海冠礼	公司 D	7700202401 健 CX0001、7700202412 建 CX0014	高纯工艺介质系统	2024 年 1 月	8,687.02	履行完毕
9	冠礼科技	福建天甫电子材料有限公司	2021031001、2023-TF-SZGL-001	高纯工艺介质系统	2021 年 3 月	8,665.87	正在履行
10	冠礼科技	苏州凯芯半导体材料有限公司	CD2024121700124282	高纯工艺介质系统	2024 年 12 月	8,053.10	履行完毕
11	新加坡冠礼	SCES Pte. Ltd.	22UM03-0626/22	高纯工艺介质系统	2022 年 8 月	SGD 2,290.00	正在履行

（二）采购合同

公司重大采购合同的认定标准为报告期内执行的单笔金额在 1,500 万元（未

税）以上的合同，合同情况及截至报告期末的履行情况如下：

单位：万元

序号	主体	供应商名称	合同编号	采购标的	签订时间	合同金额	履行情况
1	上海冠礼	上海宇灿国际贸易有限公司	WF21-2305000047	专用部件（泵浦）	2023 年 5 月	2,617.21	履行完毕
2	上海冠礼	上海宇灿国际贸易有限公司	WF21-2305000168	专用部件（泵浦）	2023 年 5 月	2,448.68	履行完毕
3	上海冠礼	上品兴业氟塑料（嘉兴）有限公司	WS21-2302000009	专用部件（桶槽）	2023 年 2 月	2,362.83	履行完毕
4	上海冠礼	上品兴业氟塑料（嘉兴）有限公司	WS21-2212000076	专用部件（桶槽）	2022 年 12 月	2,230.09	履行完毕
5	上海冠礼	应特格（上海）微电子贸易有限公司	WF21-2301000021	专用部件（过滤器）	2023 年 1 月	2,189.00	履行完毕
6	冠礼科技	上品兴业氟塑料（嘉兴）有限公司	SS21-2311000012	专用部件（桶槽）	2023 年 11 月	2,092.92	履行完毕
7	冠礼科技	上品兴业氟塑料（嘉兴）有限公司	SS21-2306000028	专用部件（桶槽）	2023 年 6 月	1,938.05	履行完毕
8	冠礼科技	上品兴业氟塑料（嘉兴）有限公司	SS21-2203000035	专用部件（桶槽）	2022 年 3 月	1,821.24	履行完毕
9	上海冠礼	上海宇灿国际贸易有限公司	WF21-2210000031	专用部件（泵浦）	2022 年 10 月	1,792.45	履行完毕
10	上海冠礼	上品兴业氟塑料（嘉兴）有限公司	WS21-2407000014	专用部件（桶槽）	2024 年 7 月	1,748.85	履行完毕
11	上海冠礼	上海均集仪表科技有限公司	WF21-2211000021	专用部件（过滤器）	2022 年 11 月	1,695.35	履行完毕
12	上海冠礼	应特格（上海）微电子贸易有限公司	WF21-2510000158	专用部件（过滤器）	2025 年 10 月	1,680.42	正在履行
13	上海冠礼	上海芯仪贸易有限公司	WS21-2302000042	管件类	2023 年 2 月	1,595.52	履行完毕
14	上海冠礼	应特格（上海）微电子贸易有限公司	WF21-2508000103	专用部件（过滤器）	2025 年 8 月	1,550.70	履行完毕
15	冠礼科技	亚硕工程股份有限公司	SS21-2512000035	蒸馏塔系统	2025 年 12 月	USD 290.00	正在履行

（三）借款合同

公司重大借款合同认定标准为报告期内执行的单笔金额在 1,000 万元及以上的借款合同，合同情况及截至报告期末的履行情况如下：

单位：万元

序号	借款人	贷款银行	合同编号	期限	合同金额	履行情况
1	冠礼科技	华夏银行股份有限公司苏州分行	NT0202101202 20279	2022 年 12 月 26 日至 2023 年 6 月 20 日	1,568.58	履行完毕
2	冠礼科技	富邦华一银行	CN5023001434 4	2023 年 8 月 30 日至 2023 年 10 月 25 日	1,499.52	履行完毕
3	冠礼科技	富邦华一银行	CN5023001617 4	2023 年 10 月 25 日至 2023 年 12 月 25 日		
4	冠礼科技	富邦华一银行	CN3101033000 0537	2023 年 12 月 25 日至 2024 年 2 月 23 日		
5	冠礼科技	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	HTZ322988600 LDZJ2023N0N D	2023 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日	1,583.08	履行完毕

6	上海冠礼	第一商业银行股份有限公司上海自贸试验区支行	230103101**[注]**	2023 年 8 月 25 日至 2024 年 2 月 25 日	4,000.00	履行完毕
7	上海冠礼	中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	M112023PK（GS）99	2023 年 8 月 25 日至 2024 年 8 月 25 日	3,000.00	履行完毕
8	上海冠礼	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98842024280510	2024 年 8 月 12 日至 2025 年 5 月 11 日	1,000.00	履行完毕
9	上海冠礼	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	M112024PK（GS）106	2024 年 8 月 26 日至 2025 年 8 月 26 日	2,000.00	履行完毕

注：该笔《流动资金借款合同》的实际借款金额为 3,500 万元。

（四）工程建设合同

报告期内，公司及子公司执行的单笔金额在 1,000 万元（未税）以上的工程建设合同情况及截至报告期末的履行情况如下：

单位：万元

合同编号	建设主体	建设单位	建设内容	合同金额	签订日期	履行情况
SS23-2408000008	冠礼科技	苏州中设建设集团有限公司	桩基工程	1,100.92	2024 年 9 月 14 日	正在履行

二、对外担保

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外提供担保的情形。

三、重大诉讼及仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。公司控股股东、董事、高级管理人员及公司子公司不存在作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

第十一节 声明

一、发行人及其全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：

梁进利　　简建至　　梁闵杰

宋玉宝　　薛伶伶　　雷丹丹

许叶枚

全体审计委员会委员签字：

许叶枚　　梁进利　　雷丹丹

全体高级管理人员签字：

简建至　　梁闵杰　　王骏典

苏州冠礼科技股份有限公司

2026 年 6 月 24 日

二、发行人控股股东声明

本公司承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

直接控股股东（盖章）：朋亿股份有限公司

直接控股股东授权代表（签名）：

梁进利

苏州冠礼科技股份有限公司

2020 年 6 月 24 日

二、发行人控股股东声明

本公司承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

间接控股股东（盖章）：圣晖工程科技股份有限公司

间接控股股东授权代表（签名）：

梁进利

苏州冠礼科技股份有限公司

2020 年 6 月 24 日

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

姜振兴

保荐代表人：

张博雄

夏建阳

法定代表人：

范 力

东吴证券股份有限公司

2026年 1月 24日

四、保荐人董事长、总经理声明

本人已认真阅读苏州冠礼科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

总裁签字：

薛 臻

董事长签字：

范 力

东吴证券股份有限公司

2026 年 6 月 24 日

五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

沈国权

经办律师：

鲍方舟 赵丽君 陈 炜

上海市锦天城律师事务所

2026 年 6 月 24 日

六、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的审计报告（报告号：XYZH/2026SUAA1B0140）、内部控制审计报告（报告号：XYZH/2026SUAA1B0159）及经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的上述审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师签字：

刘跃华　　王　萍　　罗来千

审计机构负责人签字：

谭小青

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 6 月 24 日

七、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资产评估师签字：

房春岩

倪嘉

资产评估机构负责人签字：

董松涛

中盛评估咨询有限公司

2016 年 6 月 24 日

八、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告（报告号：XYZH/2023SUAA1B0079、XYZH/2025SUAA1B0256）无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师签字：

刘跃华

王 萍

罗来千

审计机构负责人签字：

谭小青

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 6 月 24 日

九、验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资复核报告（报告号：XYZH/2026SUAA1B0170）无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师签字：

刘跃华



王 萍



罗来千



审计机构负责人签字：



谭小青

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 6 月 24 日

第十二节 附件

一、备查文件目录

（一）发行保荐书；

（二）上市保荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报表及审计报告；

（五）公司章程（草案）；

（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；

（七）与投资者保护相关的承诺；

（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；

（九）内部控制审计报告；

（十）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（十一）股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；

（十二）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；

（十三）募集资金具体运用情况；

（十四）子公司、参股公司简要情况；

（十五）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间和查阅地点

1、苏州冠礼科技股份有限公司

联系地址：苏州高新区浒墅关开发区石林路 189 号

电话：0512-88169099

联系人：梁闵杰

2、东吴证券股份有限公司

联系地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号

电话：0512-62938168

联系人：张博雄、夏建阳

附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

（一）落实投资者关系管理相关规定的安排

1、信息披露制度和流程

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，制订了《信息披露管理制度》。

《信息披露管理制度》对公司信息披露的基本原则和一般规定、定期报告、临时报告、监督管理与法律责任、信息披露的审核与程序、保密措施、信息沟通与制度、档案管理作出了明确规定。

2、投资者沟通渠道

为进一步规范和加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司了解和认识，强化公司与投资者之间的良性互动关系，提升公司形象，完善公司治理结构，形成良好的回报投资者的企业文化，切实保护投资者的利益，公司制定了《投资者关系管理制度》。

公司董事会秘书负责信息披露事务及投资者关系管理工作，董秘办为信息披露和投资者关系的负责部门。

3、未来开展投资者关系的相关规划

公司将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，认真履行信息披露义务，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护全体股东利益，特别是中小股东的利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（二）股利分配决策程序

本次发行后的股利分配政策参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、本次发行前后股利分配政策及差异情况”之“（二）公司上市后的股利分配政策”之“3、利润分配的决策程序”。

（三）发行人股东投票机制的建立情况

根据发行人《公司章程》《股东会议事规则》等制度，发行人已建立了完善的股东投票机制，保障投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策等事项的权利。

1、累积投票制度建立情况

根据《公司章程（草案）》规定，股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。涉及以下情形的，股东会在董事的选举中应当采用累积投票制：（1）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上；（2）股东会选举两名以上独立董事。

2、中小投资者单独计票机制

根据《公司章程（草案）》规定，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

3、对法定事项采取网络投票方式的相关机制

根据《公司章程（草案）》规定，公司召开股东会的地点为公司住所地或者股东会通知中指定的其他地点。股东会将设置会场，股东会以现场会议或电子通信方式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。

4、对征集投票权的相关机制

根据公司《公司章程（草案）》有关规定，公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

附件二：与投资者保护相关的承诺

（一）本次发行前股东所持股份的股份锁定、持股意向及股份减持的承诺

1、直接控股股东台湾朋亿承诺

台湾朋亿作为公司直接控股股东，就股份锁定、持股意向及股份减持有关事项承诺如下：

“1、自冠礼科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的冠礼科技首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“上市前股份”），也不由冠礼科技回购本企业直接或者间接持有的冠礼科技上市前股份。

2、在冠礼科技上市后 6 个月内，如冠礼科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，发行价格须按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有的冠礼科技上市前股份的上述锁定期自动延长 6 个月。

3、在上述锁定期届满后 2 年内本企业减持本企业持有的冠礼科技上市前股份的，减持价格不低于冠礼科技首次公开发行股票的发行价。减持方式符合届时适用的相关法律法规及深圳证券交易所规则。如本企业计划通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持冠礼科技股份的，在首次卖出前 15 个交易日向证券交易所报告并披露减持计划。若在本企业减持股份前，冠礼科技已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本企业的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

4、冠礼科技上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；冠礼科技上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；冠礼科技上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本企业届时所持股份锁定期 6 个月。

5、如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所对本企业持有的冠礼科技股份之锁定及减持另有要求的，本企业将按此等要求执行。

6、本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本企业将承担冠礼科技、冠礼科技其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，同时违规减持股票的收益将归公司所有。”

2、间接控股股东台湾圣晖承诺

台湾圣晖作为公司间接控股股东，就股份锁定、持股意向及股份减持有关事项承诺如下：

“1、自冠礼科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的冠礼科技首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“上市前股份”），也不由冠礼科技回购本企业直接或者间接持有的冠礼科技上市前股份。

2、在冠礼科技上市后 6 个月内，如冠礼科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，发行价格须按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有的冠礼科技上市前股份的上述锁定期自动延长 6 个月。

3、在上述锁定期届满后 2 年内本企业减持本企业持有的冠礼科技上市前股份的，减持价格不低于冠礼科技首次公开发行股票的发行价。减持方式符合届时适用的相关法律法规及深圳证券交易所规则。如本企业计划通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持冠礼科技股份的，在首次卖出前 15 个交易日向证券交易所报告并披露减持计划。若在本企业减持股份前，冠礼科技已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本企业的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

4、冠礼科技上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本企业届

时所持股份锁定期限 6 个月；冠礼科技上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；冠礼科技上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本企业届时所持股份锁定期 6 个月。

5、如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所对本企业持有的冠礼科技股份之锁定及减持另有要求的，本企业将按此等要求执行。

6、本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本企业将承担冠礼科技、冠礼科技其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，同时违规减持股票的收益将归公司所有。”

3、持股 5%以上股东、董事长梁进利承诺

梁进利作为公司持股 5%以上股东及董事长，就股份锁定、持股意向及股份减持有关事项承诺如下：

“1、自冠礼科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的冠礼科技首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“上市前股份”），也不由冠礼科技回购本人直接或者间接持有的冠礼科技上市前股份。

2、在冠礼科技上市后 6 个月内，如冠礼科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，发行价格须按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的冠礼科技上市前股份的上述锁定期自动延长 6 个月。

3、本人作为冠礼科技的董事，在上述锁定期届满后 2 年内本人减持本人持有的冠礼科技上市前股份的，减持价格不低于冠礼科技首次公开发行股票的发行价。如本人计划通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式转让冠礼科技股份的，在首次卖出前 15 个交易日向证券交易所报告并披露减持计划。

4、前述锁定期满后，在本人担任冠礼科技的董事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有冠礼科技股份总数的 25%；若本人在任期届满前离职的，在本人任职时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的冠礼科技股份总数的 25%；离职后半年内，不转让或委托他人管理本人直接或间接所持有的冠礼科技股份。

5、上述承诺均为本人的真实意思表示，本人拟减持所持有的冠礼科技股份时，应符合法律法规和规范性文件的规定，且不违背本人在冠礼科技首次公开发行股票时已做出的公开承诺。

6、如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所对本人持有的冠礼科技股份锁定另有要求的，本人将按此等要求执行。

7、本人将忠实履行上述承诺，保证不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本人将承担冠礼科技、冠礼科技其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，同时违规减持股票的收益将归公司所有。”

4、股东、董事、高级管理人员简建至、梁闵杰承诺

简建至、梁闵杰作为公司的股东、董事、高级管理人员，就股份锁定、持股意向及股份减持有关事项承诺如下：

“1、自冠礼科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的冠礼科技首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“上市前股份”），也不由冠礼科技回购本人直接或者间接持有的冠礼科技上市前股份。

2、在冠礼科技上市后 6 个月内，如冠礼科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，发行价格须按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的冠礼科技上市前股份的

上述锁定期自动延长 6 个月。

3、本人作为冠礼科技的董事、高级管理人员，在上述锁定期届满后 2 年内本人减持本人持有的冠礼科技上市前股份的，减持价格不低于冠礼科技首次公开发行股票的发行价。如本人计划通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式转让冠礼科技股份的，在首次卖出前 15 个交易日向证券交易所报告并披露减持计划。

4、前述锁定期满后，在本人担任冠礼科技的董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有冠礼科技股份总数的 25%；若本人在任期届满前离职的，在本人任职时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的冠礼科技股份总数的 25%；离职后半年内，不转让或委托他人管理本人直接或间接所持有的冠礼科技股份。

5、上述承诺均为本人的真实意思表示，本人拟减持所持有的冠礼科技股份时，应符合法律法规和规范性文件的规定，且不违背本人在冠礼科技首次公开发行股票时已做出的公开承诺。

6、如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所对本人持有的冠礼科技股份锁定另有要求的，本人将按此等要求执行。

7、本人将忠实履行上述承诺，保证不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本人将承担冠礼科技、冠礼科技其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，同时违规减持股票的收益将归公司所有。”

5、其他机构股东承诺

其他机构股东上海竑圣晖、上海鼎振益、苏州吉曜、苏州百吉就股份锁定有关事项承诺如下：

“1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的冠礼科技首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“上市前股份”），也不由公司回购本企业持有的上述股份。

2、如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业持有的冠礼科技股份锁定另有要求的，本企业将按此等要求执行。

3、本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本企业将承担冠礼科技、冠礼科技其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，同时违规减持股票的收益将归公司所有。”

6、董事、高级管理人员承诺

宋玉宝、王駸典作为冠礼科技的间接股东及董事/高级管理人员承诺如下：

“1、自冠礼科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的冠礼科技首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“上市前股份”），也不由冠礼科技回购本人直接或者间接持有的冠礼科技上市前股份。

2、在冠礼科技上市后 6 个月内，如冠礼科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，发行价格须按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的冠礼科技上市前股份的上述锁定期自动延长 6 个月。

3、本人作为冠礼科技的董事/高级管理人员，在上述锁定期届满后 2 年内本人减持本人持有的冠礼科技上市前股份的，减持价格不低于冠礼科技首次公开发行股票的发行价。如本人计划通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式转让冠礼科技股份的，在首次卖出前 15 个交易日向证券交易所报告并披露减持计划。

4、前述锁定期满后，在本人担任冠礼科技的董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有冠礼科技股份总数的 25%；若本人在任期届满前离职的，在本人任职时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的冠礼科技股份总数的 25%；离职后半

年内，不转让或委托他人管理本人直接或间接所持有的冠礼科技股份。

5、上述承诺均为本人的真实意思表示，本人拟减持所持有的冠礼科技股份时，应符合法律法规和规范性文件的规定，且不违背本人在冠礼科技首次公开发行股票时已做出的公开承诺。

6、如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所对本人持有的冠礼科技股份锁定另有要求的，本人将按此等要求执行。

7、本人将忠实履行上述承诺，保证不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本人将承担冠礼科技、冠礼科技其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，同时违规减持股票的收益将归公司所有。”

（二）稳定股价的措施和承诺

1、发行人承诺

发行人就首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的有关事项承诺如下：

“本公司将严格依照公司股东会审议通过的《苏州冠礼科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》中规定的相关程序启动股价稳定措施，若未履行上述承诺采取股价稳定措施，本公司承诺：1、在股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，在本公司股东会审议通过后实施补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。”

2、直接控股股东台湾朋亿承诺

直接控股股东台湾朋亿承诺如下：

“本企业将严格依照公司股东会审议通过的《苏州冠礼科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》中规定的相关程序启动股价稳定措施，若未履行上述承诺采取股价稳定措施，本企业承诺：1、在股东会及中国

证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，在公司股东会审议通过后实施补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。”

3、间接控股股东台湾圣晖承诺

直接控股股东台湾圣晖承诺如下：

“本企业将严格依照公司股东会审议通过的《苏州冠礼科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》中规定的相关程序启动股价稳定措施，若未履行上述承诺采取股价稳定措施，本企业承诺：1、在股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，在公司股东会审议通过后实施补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。”

4、董事（除独立董事）、高级管理人员的承诺

董事（不含独立董事）、高级管理人员梁进利、简建至、梁闵杰、宋玉宝、王駸典承诺如下：

“本人将严格依照公司股东会审议通过的《苏州冠礼科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》中规定的相关程序启动股价稳定措施，若未履行上述承诺采取股价稳定措施，本人承诺：1、在股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，在公司股东会审议通过后实施补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。”

（三）关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺

1、发行人承诺

发行人冠礼科技就欺诈发行上市的股份回购和股份买回事项承诺如下：

“1、公司本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形，本次发行上市的招股

说明书等证券发行文件不存在构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、如本次发行上市的招股说明书等证券发行文件存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏需回购股份情形，被监管机构认定为构成欺诈发行的，公司将在监管机构认定之日起 5 个工作日内启动股份回购程序，根据董事会及股东会审议批准的相关议案，购回公司本次公开发行的全部新股。”

2、直接控股股东台湾朋亿承诺

直接控股股东台湾朋亿承诺如下：

“1、公司本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形，本次发行上市的招股说明书等证券发行文件不存在构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、如本次发行上市的招股说明书等证券发行文件存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏需回购股份情形，被监管机构认定为构成欺诈发行的，本企业将督促公司在监管机构认定之日起 5 个工作日内启动股份买回程序，根据董事会及股东会审议批准的相关议案，购回本次发行上市的全部新股。”

3、间接控股股东台湾圣晖承诺

间接控股股东台湾圣晖承诺如下：

“1、公司本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形，本次发行上市的招股说明书等证券发行文件不存在构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、如本次发行上市的招股说明书等证券发行文件存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏需回购股份情形，被监管机构认定为构成欺诈发行的，本企业将督促公司在监管机构认定之日起 5 个工作日内启动股份买回程序，根据董事会及股东会审议批准的相关议案，购回本次发行上市的全部新股。”

（四）填补被摊薄即期回报的措施和承诺

1、发行人承诺

发行人冠礼科技关于填补被摊薄即期回报的措施承诺如下：

“一、持续提升公司整体实力，扩大公司业务规模

公司本次发行上市完成后，总资产将得到进一步提升，抗风险能力和综合实力明显增强。公司将借助资本市场和良好的行业发展机遇，不断拓展公司主营业务规模，充分发挥公司的行业市场地位，推动公司持续、健康、稳定的发展，从而稳步提升公司业绩，为股东带来良好回报。

二、保证募集资金规范、有效使用，积极稳妥地实施募集资金投资项目

为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行上市募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《苏州冠礼科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。

本次发行上市募集资金到账后，公司将开设募集资金专项账户，并与开户行、保荐人签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。公司将根据《募集资金管理制度》及其他相关规定的要求，加强募集资金管理，在进行募集资金项目投资时，履行资金支出审批手续，明确各控制环节的相关责任，按项目计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部考核与审计，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金规范、有效使用，合理防范募集资金使用风险。

本次发行上市募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，符合公司的发展战略，其实施有利于巩固和提升公司的市场地位和竞争能力，提升公司的生产能力和盈利能力，有利于公司可持续发展。公司已充分做好了募投项目前期的可行性研究工作，对募投项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量、技术水平及公司自身等基本情况，最终拟定了项目规划。公司将积极稳妥地推进募投项目实施，并加大市场开拓力度，使募集资金投资项目早日投产并实现预期效益。

三、全面提升公司管理水平，提高资金使用效率

公司将进一步完善企业内部控制，优化资金及预算管理并强化预算执行监督，设计更合理的资金使用方案，控制公司的各项费用支出，提升资金运营效率及资金回报，进一步提升公司管理水平，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升日常运营效率和盈利能力。此外，公司将完善薪酬和激励机制，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。

四、优化投资者回报机制，严格执行利润分配政策

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的利润分配政策和监督机制，积极有效地回报投资者，公司制定了上市后适用的《苏州冠礼科技股份有限公司章程（草案）》和《苏州冠礼科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》，进一步明确了公司利润分配的决策程序、机制和具体分红比例，既重视对社会公众股东的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保障利润分配政策的持续性和稳定性。公司将严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

五、其他合理可行的措施

公司未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，进一步继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。”

2、直接控股股东台湾朋亿承诺

台湾朋亿作为冠礼科技的直接控股股东承诺如下：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、本承诺函出具后至公司本次发行上市实施完毕前，若中国证监会出台关于填补回报措施及其承诺的新规定，且本企业上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、本企业承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能

够得到切实履行。如果本企业违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本企业将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；给公司或者股东造成损失的，本企业愿意依法承担相应补偿责任。”

3、间接控股股东台湾圣晖承诺

台湾圣晖作为冠礼科技的间接控股股东承诺如下：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、本承诺函出具后至公司本次发行上市实施完毕前，若中国证监会出台关于填补回报措施及其承诺的新规定，且本企业上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、本企业承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本企业违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本企业将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；给公司或者股东造成损失的，本企业愿意依法承担相应补偿责任。”

4、董事、高级管理人员承诺

梁进利、简建至、梁闵杰、宋玉宝、薛伶伶、雷丹丹、许叶枚、王駸典作为公司董事、高级管理人员承诺如下：

“1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法利益。

2、本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

3、对本人的职务消费行为进行约束。

4、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

5、将促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、若公司后续制定股权激励政策，本人将尽职促使拟公布的公司股权激励

的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

7、本承诺函出具后至公司本次发行上市实施完毕前，若中国证监会出台关于填补回报措施及其承诺的新规定，届时按照新规定执行。

8、本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。”

（五）利润分配政策的承诺

发行人冠礼科技承诺如下：

“1、本公司已制定适用于本公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后适用的《苏州冠礼科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）以及《苏州冠礼科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》（以下简称“《分红回报规划》”）中予以体现。本公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程（草案）》以及《分红回报规划》规定的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾本公司的可持续发展，保持本公司利润分配政策的连续性和稳定性。

2、本公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，并向本公司股东和社会公众投资者道歉（因不可抗力或其他非归属于本公司的原因除外）。同时，本公司将向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在股东会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。”

（六）依法承担赔偿责任的承诺

1、发行人承诺

发行人冠礼科技承诺如下：

“1、本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、若本公司向深圳证券交易所提交的本次发行上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。

3、若本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的直接经济损失。”

2、直接控股股东台湾朋亿承诺

台湾朋亿作为冠礼科技的直接控股股东承诺如下：

“1、本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本企业对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、若公司向深圳证券交易所提交的本次发行上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法购回已转让的原限售股份，同时督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东会对回购股份作出决议时，本企业将就该等回购事宜在股东会上投赞成票。

3、若本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本企业将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的直接经济损失。”

3、间接控股股东台湾圣晖承诺

台湾圣晖作为冠礼科技的间接控股股东承诺如下：

“1、本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本企业对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、若公司向深圳证券交易所提交的本次发行上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法购回已转让的原限售股份，同时督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东会对回购股份作出决议时，本企业将就该等回购事宜在股东会上投赞成票。

3、若本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本企业将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的直接经济损失。”

4、董事、高级管理人员承诺

梁进利、简建至、梁闵杰、宋玉宝、薛伶伶、雷丹丹、许叶枚、王駸典作为公司董事、高级管理人员承诺如下：

“1、本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、若本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门认定后依法赔偿投资者的直接经济损失。”

（七）未能履行承诺的约束措施

1、发行人承诺

发行人冠礼科技承诺如下：

“1、本公司将严格履行所作出的各项公开承诺。

2、若本公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行本公司在本次发行上

市过程中所作出的任何承诺（因相关法律法规、规范性文件、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外），且经监管机构认定，本公司将视具体情况采取以下一项或多项措施：

（1）及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

（3）因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者承担赔偿责任；

3、如因相关法律法规、规范性文件、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本公司将采取如下措施：

（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因及不可抗力的具体情况；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司和本公司投资者的利益，本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本公司应根据实际情况向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护投资者的权益。

4、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致本公司未履行已作出承诺的本公司股东、董事、高级管理人员，本公司将立即停止对其进行现金分红，和/或停发其应在本公司领取的薪酬、津贴，直至该等人士履行相关承诺。”

2、直接控股股东台湾朋亿承诺

台湾朋亿作为公司的直接控股股东，已通过本次发行上市的招股说明书等文件作出相关公开承诺，就前述承诺的约束措施作出如下补充承诺：

“1、本企业将严格履行所作出的各项公开承诺。

2、若本企业未能履行、确已无法履行或无法按期履行本企业在冠礼科技本次发行上市过程中所作出的任何承诺（因相关法律法规、规范性文件、政策变化、

自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外），本企业将视具体情况采取以下一项或多项措施：

（1）通过公司及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向公司的股东和社会公众投资者道歉；

（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

（3）如因本企业未履行相关承诺事项，致使公司或者其投资者遭受损失的，本企业将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任；

（4）如本企业未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本企业应获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度的现金分红中扣减；

（5）如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。

3、如因相关法律法规、规范性文件、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本企业将采取如下措施：

（1）通过公司及时、充分披露承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益，本企业将通过公司说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本企业将根据实际情况向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护投资者的权益。”

3、间接控股股东台湾圣晖承诺

台湾圣晖作为公司的间接控股股东，已通过本次发行上市的招股说明书等文件作出相关公开承诺，就前述承诺的约束措施作出如下补充承诺：

“1、本企业将严格履行所作出的各项公开承诺。

2、若本企业未能履行、确已无法履行或无法按期履行本企业在冠礼科技本

次发行上市过程中所作出的任何承诺（因相关法律法规、规范性文件、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外），本企业将视具体情况采取以下一项或多项措施：

（1）通过公司及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向公司的股东和社会公众投资者道歉；

（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

（3）如因本企业未履行相关承诺事项，致使公司或者其投资者遭受损失的，本企业将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任；

（4）如本企业未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本企业应获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度的现金分红中扣减；

（5）如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。

3、如因相关法律法规、规范性文件、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本企业将采取如下措施：

（1）通过公司及时、充分披露承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益，本企业将通过公司说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本企业将根据实际情况向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护投资者的权益。”

4、董事、高级管理人员承诺

梁进利、简建至、梁闵杰、宋玉宝、薛伶伶、雷丹丹、许叶枚、王駸典作为董事、高级管理人员，现就前述已作出的相关承诺补充承诺如下：

“1、本人将严格履行本人所作出的各项公开承诺。

2、若本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行本人在冠礼科技本次发行上市过程中所作出的任何承诺（因相关法律法规、规范性文件、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将视具体情况采取以下一项或多项措施：

（1）通过公司及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向公司的股东和社会公众投资者道歉；

（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

（3）如因本人未能履行相关承诺事项，致使公司或者其投资者遭受损失的，本人将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任；

（4）如本人未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本人应在公司领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺；若本人直接或间接持有公司股份，公司有权扣减本人从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减；

（5）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。

3、如因相关法律法规、规范性文件、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人将采取如下措施：

（1）通过公司及时、充分披露承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益，本人将通过公司说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人将根据实际情况向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护投资者的权益。”

5、持股 5%以上股东、董事长梁进利承诺

梁进利作为公司持股 5%以上股东及董事长，已通过本次发行上市的招股说

明书等文件作出相关公开承诺，就前述承诺的约束措施作出如下补充承诺：

“1、本人将严格履行所作出的各项公开承诺。

2、若本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行本人在冠礼科技本次发行上市过程中所作出的任何承诺（因相关法律法规、规范性文件、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将视具体情况采取以下一项或多项措施：

（1）通过公司及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向公司的股东和社会公众投资者道歉；

（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

（3）如因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者其投资者遭受损失的，本人将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任；

（4）如本人未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本人应从公司领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺，并有权扣减本人应获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度的现金分红中扣减；

（5）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。

3、如因相关法律法规、规范性文件、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人将采取如下措施：

（1）通过公司及时、充分披露承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益，本人将通过公司说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人将根据实际情况向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护投资者的权益。”

（八）关于股东信息披露的专项承诺

发行人冠礼科技承诺如下：

“1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息；

2、本公司股东持有的本公司股份权属清晰，不存在代持等未披露的股份安排，不存在权属纠纷及潜在纠纷，不存在影响或潜在影响本公司股权结构的事项或特殊安排；

3、直接或间接持有本公司股份的主体具备法律、法规规定的股东资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；

4、本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形；

5、本公司股东不存在以本公司股份进行不当利益输送的情形；

6、不存在《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》所规定的证监会系统离职人员及其父母、配偶、子女及其配偶入股本公司的情形；

7、本公司已及时向本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行上市的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行上市的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，并依法履行了信息披露义务。”

（九）关于避免同业竞争的承诺

1、直接控股股东台湾朋亿承诺

台湾朋亿作为冠礼科技的直接控股股东承诺如下：

“1、截止本承诺函出具之日，除投资冠礼科技外，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业未以任何方式直接或间接从事与冠礼科技及其下属企业存在同业竞争的业务。

2、本企业及本企业直接或间接控制的下属企业未来将不会以任何形式直接或间接从事与冠礼科技及其下属企业经营的业务构成重大不利影响的同业竞争的业务或活动，不会直接或间接控股、收购、兼并与冠礼科技及其下属企业经营

的业务构成重大不利影响的同业竞争的企业或其他经济组织。

3、如本企业及本企业直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可参与或入股任何可能会与冠礼科技及其下属企业经营的业务构成重大不利影响的同业竞争，本企业将立即通知冠礼科技，以适当方式将该等商业机会优先提供予冠礼科技及下属企业，由冠礼科技及其下属企业优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与冠礼科技及下属企业产生重大不利影响的同业竞争。

4、本承诺函自出具之日起生效，且在本企业为冠礼科技的直接控股股东期间持续有效。

5、若本企业违反上述承诺，本企业愿意依法承担因违反上述承诺而产生的相应赔偿责任。”

2、间接控股股东台湾圣晖承诺

台湾圣晖作为冠礼科技的间接控股股东承诺如下：

“1、截止本承诺函出具之日，除间接投资冠礼科技外，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业未以任何方式直接或间接从事与冠礼科技及其下属企业存在同业竞争的业务。

2、本企业及本企业直接或间接控制的下属企业未来将不会以任何形式直接或间接从事与冠礼科技及其下属企业经营的业务构成重大不利影响的同业竞争的业务或活动，不会直接或间接控股、收购、兼并与冠礼科技及其下属企业经营的业务构成重大不利影响的同业竞争的企业或其他经济组织。

3、如本企业及本企业直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可参与或入股任何可能会与冠礼科技及其下属企业经营的业务构成重大不利影响的同业竞争，本企业将立即通知冠礼科技，以适当方式将该等商业机会优先提供予冠礼科技及下属企业，由冠礼科技及其下属企业优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与冠礼科技及下属企业产生重大不利影响的同业竞争。

4、本承诺函自出具之日起生效，且在本企业为冠礼科技的间接控股股东期间持续有效。

5、若本企业违反上述承诺，本企业愿意依法承担因违反上述承诺而产生的

相应赔偿责任。”

（十）关于减少和规范关联交易的承诺

1、直接控股股东台湾朋亿承诺

直接控股股东台湾朋亿承诺如下：

“1、本企业及本企业控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业与公司及其控股子公司之间将尽量减少关联交易。

2、在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本企业保证将按照法律法规、规范性文件和公司章程的规定，在审议涉及公司的关联交易时，切实遵守回避程序，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。”

2、间接控股股东台湾圣晖承诺

间接控股股东台湾圣晖承诺如下：

“1、本企业及本企业控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业与公司及其控股子公司之间将尽量减少关联交易。

2、在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本企业保证将按照法律法规、规范性文件和公司章程的规定，在审议涉及公司的关联交易时，切实遵守回避程序，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。”

3、持股 5%以上股东、董事承诺

持股 5%以上股东、董事梁进利承诺如下：

“1、本人及本人控制的除公司及其控股子公司以外的企业或本人担任董事或高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的企业与公司及其控股子公司之间将尽量减少关联交易。

2、在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人保证将按照法律法规、规范性文件和公司章程的规定，在审议涉及公司的关联交易时，切实遵守回避程序，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，保证按市场化原则和公允价格进行

公平操作，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。”

4、董事、高级管理人员承诺

简建至、梁闵杰、宋玉宝、薛伶伶、雷丹丹、许叶枚、王駸典作为董事、高级管理人员，就减少和规范本人与冠礼科技之间的关联交易相关事宜承诺如下：

“1、本人及本人控制的除公司及其控股子公司以外的企业或本人担任董事或高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的企业与公司及其控股子公司之间将尽量减少关联交易。

2、在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人保证将按照法律法规、规范性文件和公司章程的规定，在审议涉及公司的关联交易时，切实遵守回避程序，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。”

附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项

（一）关于房产瑕疵的承诺

1、直接控股股东台湾朋亿承诺

台湾朋亿作为冠礼科技的直接控股股东承诺如下：

“若公司及其控股子公司因自有或租赁的场地和/或房产（包括任何地上建筑物/构筑物）不规范情形影响公司及其控股子公司使用该等场地和/或房产（包括任何地上建筑物/构筑物）以从事正常业务经营，本企业将及时采取有效措施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的场地和/或房产（包括任何地上建筑物/构筑物）供相关企业经营使用等，促使各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响。

若公司及其控股子公司因自有或租赁的场地和/或房产（包括任何地上建筑物/构筑物）不符合相关法律法规而被有关政府主管部门要求收回、拆除该等场地和/或房产（包括任何地上建筑物/构筑物）或以任何形式进行处罚或被要求承担任何形式的法律责任，或因该等场地和/或房产（包括任何地上建筑物/构筑物）瑕疵的整改而发生的任何损失或支出，本企业愿意承担公司及其控股子公司因该等场地和/或房产（包括任何地上建筑物/构筑物）收回、拆除、受处罚或承担任何形式的法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使公司及控股子公司的利益免受损害。

此外，本企业将支持公司及控股子公司向相关方积极主张权利，以在最大程度上维护及保障公司及控股子公司的利益。”

2、间接控股股东台湾圣晖承诺

台湾圣晖作为冠礼科技的间接控股股东承诺如下：

“若公司及其控股子公司因自有或租赁的场地和/或房产（包括任何地上建筑物/构筑物）不规范情形影响公司及其控股子公司使用该等场地和/或房产（包括任何地上建筑物/构筑物）以从事正常业务经营，本企业将及时采取有效措施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的场地和/或房产（包括任何地上建

筑物/构筑物）供相关企业经营使用等，促使各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响。

若公司及其控股子公司因自有或租赁的场地和/或房产（包括任何地上建筑物/构筑物）不符合相关法律法规而被有关政府主管部门要求收回、拆除该等场地和/或房产（包括任何地上建筑物/构筑物）或以任何形式进行处罚或被要求承担任何形式的法律责任，或因该等场地和/或房产（包括任何地上建筑物/构筑物）瑕疵的整改而发生的任何损失或支出，本企业愿意承担公司及其控股子公司因该等场地和/或房产（包括任何地上建筑物/构筑物）收回、拆除、受处罚或承担任何形式的法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使公司及控股子公司的利益免受损害。

此外，本企业将支持公司及控股子公司向相关方积极主张权利，以在最大程度上维护及保障公司及控股子公司的利益。”

附件四：股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

（一）股东会制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》及相关规定，公司制定了《公司章程》《股东会议事规则》。自股份有限公司设立至报告期末，公司共召开 1 次股东会（暨成立大会）。公司股东会按照《公司章程》《股东会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，出席会议的股东人数符合法律规定，相关决议内容合法、有效。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制定了《董事会议事规则》。截至报告期末，发行人董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。

自股份有限公司设立至本招股说明书签署日，发行人共召开 3 次董事会。公司历次董事会均按照《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，出席会议的董事人数符合法律规定，相关决议内容合法、有效。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

报告期初，公司未设立监事会，根据当时有效的《公司章程》规定，设 1 名监事。2025 年 10 月公司完成股改，未设立监事会。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

为进一步规范法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司建立了独立董事制度。

1、独立董事的设置情况

2025 年 10 月 14 日，公司召开成立大会暨 2025 年第一次临时股东会，为加强改善公司治理，选举胡亮、雷丹丹、许叶枚为公司独立董事，并审议通过了《独立董事工作制度》。

2026 年 5 月，原独立董事胡亮因个人原因辞任。2026 年 5 月 22 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，补选薛伶伶为公司独立董事。

公司独立董事薛伶伶、雷丹丹、许叶枚符合法律、法规、《公司章程》《独立董事工作制度》关于独立董事任职资格的要求。

《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职条件、选举和更换、权利和义务及工作保障等事项作出了详细的规定。

2、独立董事制度运行情况

公司自 2025 年 10 月 14 日设立独立董事，并通过《独立董事工作制度》，正式建立了独立董事制度，公司的独立董事依据有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务，参与了公司重大经营决策，对公司重大关联交易和重大投资项目均发表了公允的独立意见。独立董事制度对公司完善治理结构正发挥着重要的作用。

自公司设立以来，独立董事对聘任公司高级管理人员及本次募集资金投资项目、公司经营管理、发展方向及发展战略的选择提出了积极的建议，并对公司发生的关联交易进行了审核，发表了独立意见。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

1、董事会秘书制度的设置及职责

公司设董事会秘书，董事会秘书的主要工作是负责推动公司提升治理水平，做好公司信息披露工作。《董事会秘书工作细则》对董事会秘书的职责进行了详细的规定。

2、董事会秘书制度的运行情况

公司于 2025 年 10 月 14 日召开了第一届董事会第一次会议，审议通过了《董事会秘书工作细则》，完善了董事会秘书制度，公司董事会秘书依据有关法律、法规、《公司章程》和《董事会秘书工作细则》认真、审慎履行职责，确保了公司股东会和董事会会议顺利召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报了公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和股东会、董事会正常行使职权发挥了重要的作用。

附件五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《审计委员会工作细则》《战略与可持续发展委员会工作细则》《提名委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》。各专门委员会对董事会负责，为董事会决策提供咨询意见，协助董事会履行职责。

截至本招股说明书签署之日，公司各委员会的人员构成情况如下：

委员会	委员会委员	召集人
审计委员会	许叶枚、梁进利、雷丹丹	许叶枚
战略与可持续发展委员会	梁进利、简建至、薛伶伶	梁进利
提名委员会	薛伶伶、梁进利、雷丹丹	薛伶伶
薪酬与考核委员会	雷丹丹、梁进利、许叶枚	雷丹丹

（一）审计委员会

公司的审计委员会委员为许叶枚、梁进利、雷丹丹，其中许叶枚担任召集人。根据《公司章程》及《审计委员会工作细则》的规定，审计委员会的主要职责权限为：审核公司的财务信息；监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换承办公司审计业务的外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；监督及评估公司的内部控制；行使《公司法》规定的监事会的职权；法律法规及公司章程规定和公司董事会授权的其他事宜。

（二）战略与可持续发展委员会

公司战略与可持续发展委员会的委员为梁进利、简建至、薛伶伶，其中梁进利担任主任委员。根据《公司章程》及《战略与可持续发展委员会工作细则》的规定，战略与可持续发展委员会的主要职责权限为：对公司长期发展战略规划、可持续发展方向进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对公司可持续发展目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出可持续发展建议；审阅并向董事会提交年度可持续发展报告及其他可持续发展相关信息披露，确保披露信息的准确性及完整性；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事

项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

（三）提名委员会

公司提名委员会的委员为薛伶伶、梁进利、雷丹丹，其中薛伶伶担任主任委员。

根据《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定，提名委员会的主要职责权限为：研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

（四）薪酬与考核委员会

公司的薪酬与考核委员会委员为雷丹丹、梁进利、许叶枚，其中雷丹丹担任主任委员。根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，薪酬与考核委员会的主要职责权限为就下列事项向董事会提出建议：董事、高级管理人员的薪酬；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；董事、高级管理人员在拟拆分所属子公司安排持股计划；法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事宜。

（五）专门委员会运行情况

董事会各专门委员会自设立以来严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及各专门委员会工作细则等规定规范运作，运行情况良好。各位委员按照相关法律法规要求认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。专门委员会的建立和规范运行，为提高公司治理水平发挥了重要作用。

附件六：募集资金具体运用情况

（一）半导体高端装备产能升级与智造基地建设项目

1、项目概况

本项目建设期 3 年，计划总投资 52,995.89 万元，用于年产半导体高端装备 1000 套基地的建设，项目实施主体为冠礼科技，系在现有经营场地整体搬迁加扩产。

2、项目选址和土地取得方式

本项目建设地点位于江苏省苏州浒墅关经济技术开发区长浒立交北，文昌路东、312 国道绿化地北地块。截至本招股说明书签署日，公司已获得该处土地的《中华人民共和国不动产权证书》，土地权属性质为国有建设用地使用权，用地性质为工业用地，规划总用地面积为 16,586.7 平方米，土地证书号码为苏（2024）苏州市不动产权第 5015067 号。

3、项目备案情况

该项目已在苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会备案，项目编号为苏浒管审项备〔2026〕44 号。

4、项目投资概算情况

本项目计划总投资 52,995.89 万元，具体资金用途如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例
1	建筑工程费	19,167.59	36.17%
2	设备及软件购置费	16,414.41	30.97%
3	安装工程费	478.34	0.90%
4	项目建设其他费用	299.89	0.57%
5	预备费	1,818.01	3.43%
6	铺底流动资金	14,817.66	27.96%
项目总投资		**52,995.89**	**100.00%**

5、项目时间周期和时间进度

本项目建设期拟定为 3 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、土建施工与装修、设备采购、安装及调试、人员招聘与培训等。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月份											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	前期准备	■	■										
2	土建施工与装修		■	■	■	■	■	■	■				
3	设备采购、安装及调试					■	■	■	■	■	■	■	
4	人员招聘与培训	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	竣工验收												■

6、项目环保情况

本项目建成后，在生产过程中将会有噪声、废水、废气以及固废产生，需要加强环境管理监测工作，配置专业环保管理人员，负责全公司日常环境管理监测工作。该项目投资备案号为苏浒管审项备〔2026〕44 号，环保投资为 50 万元，资金来源为自有资金，符合国家和地方的环保要求。该项目已取得编号为苏高新管环审[2026]078 号的《关于对苏州冠礼科技股份有限公司总部基地建设项目环境影响报告表的批复》。

7、项目的经济效益分析

本项目建成达产后正常年预计可实现营业收入为 280,058.00 万元（不含税），年净利润为 32,136.45 万元，项目投资财务内部收益率为 17.54%（所得税后），投资回收期为 9.23 年（所得税后，含建设期 3 年）。

（二）高端电子化学品智能供应产线及半导体核心工艺装备研发项目

1、项目概况

本项目建设期 3 年，计划总投资 23,473.96 万元，拟完成高端电子化学品智能供应产线及半导体核心工艺装备相关研发课题，项目实施主体为冠礼科技。

2、项目选址和土地取得方式

本项目建设地点位于江苏省苏州浒墅关经济技术开发区长浒立交北，文昌路

东、312 国道绿化地北地块。截至本招股说明书签署日，公司已获得该处土地的《中华人民共和国不动产权证书》，土地权属性质为国有建设用地使用权，用地性质为工业用地，规划总用地面积为 16,586.7 平方米，土地证书号码为苏（2024）苏州市不动产权第 5015067 号。

3、项目备案情况

该项目已在苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会备案，项目编号为苏浒管审项备〔2026〕44 号。

4、项目投资概算情况

本项目计划总投资 23,473.96 万元，具体资金用途如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例
1	建筑工程费	1,969.44	8.39%
2	设备及软件购置费	10,877.42	46.34%
3	项目建设其他费用	9,983.25	42.53%
4	预备费	643.86	2.74%
项目总投资		**23,473.96**	**100.00%**

5、项目时间周期和时间进度

本项目建设期拟定为 3 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、工程施工与装修、设备采购、安装及调试、人员招聘与培训、课题开展等。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月份											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	项目前期准备	■	■										
2	勘察设计	■	■										
2	工程施工与装修		■	■	■	■	■	■	■				
3	设备采购、安装及调试								■	■	■	■	
4	人员招聘与培训	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	课题开展	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

6、项目环保情况

本项目建成后，在研发过程中将会有废水、废气以及固废产生，需要加强环境管理监测工作，配置专业环保管理人员，负责全公司日常环境管理监测工作。该项目投资备案号为苏浒管审项备〔2026〕44 号，环保投资为 50 万元，资金来源为自有资金，符合国家和地方的环保要求。该项目已取得编号为苏高新管环审[2026]078 号的《关于对苏州冠礼科技股份有限公司总部基地建设项目环境影响报告表的批复》。

（三）电子溶剂绿色再生高效系统研发项目

1、项目概况

本项目建设期 3 年，计划总投资 6,768.34 万元，本项目将进一步提升公司研发实力，助力公司完善产品矩阵，避免同质化竞争，保障长期的技术领先地位，项目实施主体为冠礼科技。

2、项目选址和土地取得方式

本项目建设地点位于江苏省苏州市高新区浒墅关道安路 22 号 5-1-101。

3、项目备案情况

该项目已在苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会备案，项目编号为苏浒管审项备〔2026〕73 号。

4、项目投资概算情况

本项目计划总投资 6,768.34 万元，具体资金用途如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例
1	建筑工程费	386.79	5.71%
2	设备及软件购置费	3,696.82	54.62%
3	项目建设其他费用	2,480.55	36.65%
4	预备费	204.18	3.02%
项目总投资		**6,768.34**	**100.00%**

5、项目时间周期和时间进度

本项目建设期拟定为 3 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、装修施工、设备采购、安装及调试、人员招聘与培训、课题开展。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月份											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	项目前期准备												
2	勘察设计												
2	装修施工												
3	设备采购、安装及调试												
4	人员招聘与培训												
5	课题开展												

6、项目环保情况

本项目建成后，后续在研发试验活动过程中将会有少量废气、废水、固废的产生，需加强环境管理监测工作。该项目投资备案号为苏浒管审项备〔2026〕73 号，预计环保投资为 80 万元，资金来源为自有资金，符合国家和地方的环保要求。

（四）营销总部及营销网络建设项目

1、项目概况

本项目建设期 3 年，计划总投资 32,283.72 万元，本项目是集营销中心、服务中心、区域备件库、品牌展示中心及总部办公于一体的多功能基地。项目拟使用苏州总部大楼的部分楼层建设营销总部，并拟在深圳、无锡、合肥、武汉、日本等国家或城市租赁场地拓展营销网络。该项目的建设将助力公司完善区域布局，提高公司品牌影响力，项目实施主体为冠礼科技。

2、项目选址和土地取得方式

本项目建设地点位于江苏省苏州浒墅关经济技术开发区长浒立交北，文昌路东、312 国道绿化地北地块。截至本招股说明书签署日，公司已获得该处土地的

《中华人民共和国不动产权证书》，土地权属性质为国有建设用地使用权，用地性质为工业用地，规划总用地面积为 16,586.7 平方米，土地证书号码为苏（2024）苏州市不动产权第 5015067 号。

3、项目备案情况

该项目已在苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会备案，项目编号为苏浒管审项备〔2026〕44 号。

4、项目投资概算情况

本项目计划总投资 32,283.72 万元，具体资金用途如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例
1	建筑工程费	21,522.33	66.67%
1.1	营销网点	690.00	2.14%
1.2	营销总部	20,832.34	64.53%
2	设备及软件购置费	3,473.40	10.76%
3	项目建设其他费用	6,022.38	18.65%
3.1	营销网点租赁费	708.72	2.20%
3.2	其他	5,313.65	16.46%
4	预备费	1,265.62	3.92%
项目总投资		**32,283.72**	**100.00%**

5、项目时间周期和时间进度

本项目建设期拟定为 3 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、工程施工与装修、设备采购、安装及调试、项目选址与租赁、人员招聘与培训等。具体进度如下表所示：

（1）营销总部项目实施进度表

序号	建设内容	月 份											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	前期准备	*	*										

2	土建施工与装修		*	*	*	*	*	*	*				
3	设备采购、安装及调试					*	*	*	*	*	*	*	
4	人员招聘与培训	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	竣工验收												*

（2）网点实施进度表

序号	建设内容	月 份										
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36
1	前期准备	*	*									
2	项目选址与租赁办公用房		*	*	*	*	*	*	*	*		
3	装修改造			*	*	*	*	*	*	*	*	
4	设备购置、安装及调试					*	*	*	*	*	*	*
5	人员招聘与培训			*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	竣工验收											*

6、项目环保情况

本项目建成后，营销总部、营销网点运营过程中将会产生废水和固废等污染物，需加强环境管理监测工作，配置专业环境保护管理人员，负责全公司日常运营过程中的环境管理监测工作。该项目投资备案号为苏浒管审项备〔2026〕44号，环保投资为 50 万元，资金来源为自有资金，符合国家和地方的环保要求。该项目已取得编号为苏高新管环审[2026]078 号的《关于对苏州冠礼科技股份有限公司总部基地建设项目环境影响报告表的批复》。

（五）补充流动资金

1、项目概况

公司综合考虑行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等具体情况，拟用 36,000 万元募集资金用于补充公司流动资金。

2、补充流动资金的管理安排

公司已制定《苏州冠礼科技股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金将存放于董事会决定的专项账户。公司董事会将负责建立健全公司募集资金管理制

度，并确保该制度的有效实施。在使用时，公司将严格按照相关法律法规和制度要求履行相应的审批程序，根据公司业务发展需要合理运用。

附件七：子公司、参股公司简要情况

公司子公司、参股公司简要情况如下：

（一）子公司

截至 2025 年 12 月 31 日，公司子公司情况如下：

1、上海冠礼

公司全称	冠礼控制科技（上海）有限公司			
成立时间	2002 年 06 月 13 日			
注册资本	3,317.4255 万元人民币			
实收资本	3,317.4255 万元人民币			
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区荷丹路 126 号一层			
主要生产经营场所	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 34 号 10 楼			
主营业务及其在发行人业务板块中定位	负责公司主要产品的研发、设计、生产和销售			
经营范围	许可项目：建筑智能化系统设计；特种设备制造；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；机械电气设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；专业设计服务；软件开发；机械电气设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；五金产品制造；阀门和旋塞销售；电子产品销售；电子专用材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；软件销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；贸易经纪；机械零件、零部件加工；环保咨询服务；节能管理服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
法定代表人	梁进利			
股东构成	**序号**	**股东**	**出资额（万元）**	**出资比例**
	1	冠礼科技	3,317.4255	100.00%
主要财务数据（单位：万元）	**项目**		**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**	
	总资产		123,022.55	
	净资产		45,606.22	
	营业收入		102,101.84	

	净利润	19,503.35
	审计情况	以上财务数据已经信永中和审计

2、新加坡冠礼

公司全称	NOVATECH ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD.			
成立时间	2016 年 6 月 28 日			
注册资本	1,000,000 新加坡元			
实收资本	1,000,000 新加坡元			
注册地址	1 PEMIMPIN DRIVE, #08-09, ONE PEMIMPIN, SINGAPORE 576151			
主要生产经营场所	1 PEMIMPIN DRIVE, #08-09, ONE PEMIMPIN, SINGAPORE 576151			
主营业务及其在发行人业务板块中定位	负责境外业务的承揽、实施与维护			
经营范围	半导体器件制造、其他专业建筑及相关活动			
股东构成	**序号**	**股东**	**出资额**	**出资比例**
	1	冠礼科技	1,000,000 新加坡元	100.00%
主要财务数据（单位：万元）	**项目**		**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**	
	总资产		7,455.21	
	净资产		5,920.95	
	营业收入		2,441.80	
	净利润		457.24	
	审计情况		以上财务数据已经信永中和审计	

3、马来西亚冠礼

公司全称	WINMAX TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.
成立时间	2024年11月5日
注册资本	1,000,000 马来西亚林吉特
实收资本	1,000,000 马来西亚林吉特
注册地址	SUITE D23, 2ND FLOOR, PLAZA PEKELILING, NO. 2 JALAN TUN RAZAK, KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN
主要生产经营场所	LEVEL 2, UNIT 12, TOWER A THE VERTICAL BUSINESS SUITE BANGSAR SOUTH CITY AVENUE 3, NO.8 JALAN KERINCHI, KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN
主营业务及其在发行人业务板块中定位	负责境外业务的承揽、实施，报告期内未实际开展业务
经营范围	其他专业设计活动

股东构成	**序号**	**股东**	**出资额**	**出资比例**
	1	新加坡冠礼	1,000,000 马来西亚林吉特	100.00%
主要财务数据（单位：万元）	**项目**		**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**	
	总资产		170.00	
	净资产		159.96	
	营业收入		-	
	净利润		-12.22	
	审计情况		以上财务数据已经信永中和审计	

（二）参股公司

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人不存在参股公司。

附件八：专利清单

序号	权利人	专利类别	专利号	专利名称	专利申请日	授权公告日	取得方式
1	上海冠礼	发明	ZL201210080910.6	单轴回转式机械手臂	2012/3/23	2014/3/19	原始取得
2	上海冠礼	发明	ZL201610821080.6	一种电子式 HF 升降温系统	2016/9/13	2019/3/22	原始取得
3	上海冠礼	发明	ZL201910435555.1	一种半导体晶圆电镀夹具	2019/5/23	2021/8/3	继受取得
4	上海冠礼	发明	ZL202010368977.4	一种半导体生产用温控设备	2020/5/3	2021/7/9	继受取得
5	上海冠礼	发明	ZL201910898790.2	一种化工制药用废液上环绕式回收设备	2019/9/23	2021/8/6	继受取得
6	上海冠礼	发明	ZL201810351122.3	一种单批次四花篮同步运行的全自动湿制程设备	2018/4/18	2023/9/8	原始取得
7	上海冠礼	发明	ZL202011298981.4	一种反应槽内晶圆组分离装置	2020/11/19	2024/8/27	原始取得
8	上海冠礼	发明	ZL202310415817.4	一种用于半导体化学品溶液的吸取装置	2023/4/18	2024/3/22	原始取得
9	上海冠礼	发明	ZL202310660273.8	抗气泡高稳定性折光计	2023/6/5	2023/12/8	原始取得
10	上海冠礼	发明	ZL202311186494.2	一种半导体供液设备及供液方法	2023/9/14	2024/3/1	原始取得
11	上海冠礼	发明	ZL202311186498.0	一种半导体研磨设备的研磨液供给输送装置	2023/9/14	2024/4/26	原始取得
12	上海冠礼	发明	ZL202410530676.5	一种半导体用高纯化学品自动取样分析方法及系统	2024/4/29	2025/1/7	原始取得
13	上海冠礼	发明	ZL202410534354.8	一种半导体研磨设备的研磨液供给输送装置	2024/4/30	2024/8/30	原始取得
14	上海冠礼	发明	ZL202410865458.7	一种晶圆棒多线切割工艺中的废液回收系统	2024/6/28	2025/1/28	原始取得
15	上海冠礼	发明	ZL202411077126.9	一种涂胶显影机晶圆定位装置	2024/8/7	2025/1/3	原始取得
16	上海冠礼	发明	ZL202411176154.6	一种半导体研磨液供给输送装置	2024/8/26	2024/12/13	原始取得
17	上海冠礼	发明	ZL202411355751.5	一种半导体用化学品快速过滤装置	2024/9/27	2025/3/7	原始取得
18	上海冠礼	发明	ZL202411467647.5	一种半导体化学品溶液吸取设备	2024/10/21	2025/7/4	原始取得
19	上海冠礼	发明	ZL202411673380.5	一种半导体加工用晶圆转换装置	2024/11/21	2025/7/4	原始取得
20	上海冠礼	发明	ZL202411749794.1	一种半导体晶圆的定位装置	2024/12/2	2025/5/13	原始取得
21	上海冠礼	发明	ZL202510217095.0	一种半导体晶圆的定位装置	2025/2/26	2025/7/29	原始取得
22	上海冠礼	发明	ZL202510521978.0	一种半导体加工用晶圆转换设备	2025/4/24	2025/9/16	原始取得
23	上海冠礼	发明	ZL202510605029.0	一种半导体加工用晶圆分离装置	2025/5/12	2025/9/19	原始取得
24	上海冠礼	发明	ZL202511076498.4	一种化学品设备零部件自动维修平台	2025/8/1	2025/11/7	原始取得
25	冠礼科技	发明	ZL201510779630.8	气体流量测试装置	2015/11/13	2018/11/20	继受取得
26	冠礼科技	发明	ZL201610629425.8	一种晶片盘推送装置	2014/10/17	2019/1/1	继受取得

27	冠礼科技	发明	ZL201911345793.X	一种链式晶圆清洗干燥机器人整机	2019/12/24	2021/7/6	继受取得
28	冠礼科技	发明	ZL201910790864.0	一种高精度晶圆研磨机	2019/8/26	2021/8/3	继受取得
29	冠礼科技	发明	ZL202011176698.4	一种化工原料反应塔催化物清除器	2020/10/28	2021/8/3	继受取得
30	冠礼科技	发明	ZL202111412751.0	一种 LED 用单晶硅片清洗设备及其使用方法	2021/11/25	2024/7/26	原始取得
31	冠礼科技	发明	ZL202310338728.4	一种全自动化学品桶清洗设备	2023/3/31	2023/10/3	原始取得
32	冠礼科技	发明	ZL202310322230.9	一种具有挥发性有毒有机化合物收集处理装置	2023/3/29	2023/9/8	原始取得
33	冠礼科技	发明	ZL202310370613.3	一种废弃剥离液回收再利用设备	2023/4/10	2023/9/26	原始取得
34	冠礼科技	发明	ZL202310441191.4	一种全自动化学品灌装设备	2023/4/23	2023/10/13	原始取得
35	冠礼科技	发明	ZL202310401524.0	一种晶圆蚀刻清洗后干燥设备	2023/4/16	2023/9/29	原始取得
36	冠礼科技	发明	ZL202310508195.X	用于半导体晶圆可实现翻转动作的上下摇摆机构	2023/5/8	2023/10/13	原始取得
37	冠礼科技	发明	ZL202310574981.X	一种智能化集成端子模块	2023/5/22	2023/10/10	原始取得
38	冠礼科技	发明	ZL202310715445.7	散热装置及分散式可视化智能控温系统	2023/6/16	2024/2/9	原始取得
39	冠礼科技	发明	ZL202311040891.9	一种自动对接系统及对接方法	2023/8/17	2024/2/27	原始取得
40	冠礼科技	发明	ZL202311016784.2	一种用于晶圆刷洗的同步旋转升降真空主轴系统	2023/8/14	2024/1/23	原始取得
41	冠礼科技	发明	ZL202311213207.2	一种半导体晶圆清洗机摆臂机构	2023/9/20	2024/2/9	原始取得
42	冠礼科技	发明	ZL202311214750.4	一种用于化学液供应系统的管料放料张紧装置	2023/9/20	2025/9/23	原始取得
43	冠礼科技	发明	ZL202410136829.8	一种晶圆翘曲度的测量方法和装置	2024/1/31	2024/6/14	原始取得
44	冠礼科技	发明	ZL202410158134.X	一种半导体用化学品过滤装置	2024/2/4	2024/8/16	原始取得
45	冠礼科技	发明	ZL202410375226.3	一种多尺寸半导体干燥装置	2024/3/29	2024/8/9	原始取得
46	冠礼科技	发明	ZL202410591774.X	一种半导体晶片清洗机	2024/5/14	2024/11/1	原始取得
47	冠礼科技	发明	ZL202410462118.X	一种半导体湿式制程设备	2024/4/17	2024/9/24	原始取得
48	冠礼科技	发明	ZL202410750305.8	一种剥离液分离监控系统及控制方法	2024/6/12	2024/10/1	原始取得
49	冠礼科技	发明	ZL202410772234.1	一种外延涂布半导体晶片的装置	2024/6/17	2024/11/8	原始取得
50	冠礼科技	发明	ZL202410756751.X	一种刻蚀清洗机硅片导向装置	2024/6/13	2024/12/10	原始取得
51	冠礼科技	发明	ZL202411019497.1	阀箱打包流水线	2024/7/29	2025/1/7	原始取得
52	冠礼科技	发明	ZL202411024960.1	一种半导体化学品药液桶清洗装置	2024/7/29	2025/11/18	原始取得
53	冠礼科技	发明	ZL202411207506.X	一种半导体芯片湿法刻蚀装置	2024/8/30	2025/2/21	原始取得
54	冠礼科技	发明	ZL202411299104.7	一种半导体芯片清洗机	2024/9/18	2025/6/10	原始取得
55	冠礼科技	发明	ZL202411329143.7	一种切割装置的控制方法及控制系统	2024/9/24	2024/12/17	原始取得

56	冠礼科技	发明	ZL202411467791.9	一种半导体晶圆清洗机上料设备	2024/10/21	2025/6/6	原始取得
57	冠礼科技	发明	ZL202411616692.2	一种自动化半导体晶圆清洗烘干设备	2024/11/13	2025/5/27	原始取得
58	冠礼科技	发明	ZL202411757358.9	一种基于半导体加工的蚀刻设备	2024/12/3	2025/6/13	原始取得
59	冠礼科技	发明	ZL202411678490.0	一种全自动半导体清洗设备	2024/11/22	2025/5/9	原始取得
60	冠礼科技	发明	ZL202411678641.2	一种晶圆校正装置及控制方法	2024/11/22	2025/11/11	原始取得
61	冠礼科技	发明	ZL202411827623.6	一种多尺寸晶圆清洗干燥用分离装置及方法	2024/12/12	2025/7/11	原始取得
62	冠礼科技	发明	ZL202411838441.9	一种用于晶圆蚀刻的药液循环系统及蚀刻设备	2024/12/13	2025/7/11	原始取得
63	冠礼科技	发明	ZL202510279981.6	一种多功能用半导体腔式处理设备	2025/3/11	2025/11/18	原始取得
64	冠礼科技	发明	ZL202511293236.3	一种用于半导体制程的湿法循环管路脱泡装置及方法	2025/9/11	2025/11/7	原始取得
65	上海冠礼	实用新型	ZL202422769243.3	一种储液桶输送锁紧装置	2024/11/13	2025/10/10	原始取得
66	上海冠礼	实用新型	ZL202422311041.4	一种容器翻转装置	2024/9/23	2025/9/19	原始取得
67	上海冠礼	实用新型	ZL202421758764.2	液体颗粒物检测装置	2024/7/23	2025/7/11	原始取得
68	上海冠礼	实用新型	ZL202322527535.1	一种研磨液供应系统用快速连接装置	2023/9/15	2024/6/14	原始取得
69	上海冠礼	实用新型	ZL202323334539.4	一种改进型手动球阀固定装置	2023/12/6	2024/6/14	原始取得
70	上海冠礼	实用新型	ZL202322381748.8	一种研磨液供应系统用阀箱	2023/9/1	2024/3/15	原始取得
71	上海冠礼	实用新型	ZL202321364049.6	ITO 草酸粉末除尘装置	2023/5/31	2023/10/20	原始取得
72	上海冠礼	实用新型	ZL202222641145.2	一种新型全自动电子级化学品灌充流水线系统	2022/10/9	2023/1/10	原始取得
73	上海冠礼	实用新型	ZL202222116728.3	一种新型 TMAH 显影液再生及浓度管理系统	2022/8/12	2022/11/29	原始取得
74	上海冠礼	实用新型	ZL202222075662.8	一种新型蝶形清洗槽盖板	2022/8/8	2022/11/25	原始取得
75	上海冠礼	实用新型	ZL202122511042.X	一种化学品自动充填设备	2021/10/19	2022/5/13	原始取得
76	上海冠礼	实用新型	ZL202122512018.8	一种定角度选择顺应性晶圆输送机械臂的定位结构	2021/10/19	2022/4/5	原始取得
77	上海冠礼	实用新型	ZL202122546543.1	一种光刻胶混配过滤供应设备	2021/10/22	2022/3/22	原始取得
78	上海冠礼	实用新型	ZL202122497747.0	200L 桶自动化输送线设备	2021/10/16	2022/3/8	原始取得
79	上海冠礼	实用新型	ZL202022819341.5	一种多尺寸晶圆干燥装置	2020/11/30	2021/7/20	原始取得
80	上海冠礼	实用新型	ZL202022819319.0	一种加速干燥晶圆槽体	2020/11/30	2021/6/8	原始取得
81	上海冠礼	实用新型	ZL202022694384.5	一种单晶圆搬运装置	2020/11/19	2021/5/25	原始取得
82	上海冠礼	实用新型	ZL202021821167.1	一种研磨液回收再利用系统	2020/8/27	2021/5/18	原始取得
83	上海冠礼	实用新型	ZL202021829391.5	一种风囊定容器微量可调系统	2020/8/27	2021/5/14	原始取得

84	上海冠礼	实用新型	ZL202021829477.8	一种通用性测试平台	2020/8/27	2021/4/9	原始取得
85	上海冠礼	实用新型	ZL202021829393.4	一种新型研磨液供应系统	2020/8/27	2021/4/9	原始取得
86	上海冠礼	实用新型	ZL201921536611.2	铜酸溶液混合系统	2019/9/16	2020/6/2	原始取得
87	上海冠礼	实用新型	ZL201921535868.6	二甲基乙酰胺回收系统	2019/9/16	2020/6/2	原始取得
88	上海冠礼	实用新型	ZL201921556650.9	一种高纯无水氢氟酸取样设备	2019/9/18	2020/6/2	原始取得
89	上海冠礼	实用新型	ZL201921721993.6	一种 200L 桶自动充填设备	2019/10/11	2020/6/2	原始取得
90	上海冠礼	实用新型	ZL201921535869.0	一种三步夹持晶圆定位机构	2019/9/16	2020/4/21	原始取得
91	上海冠礼	实用新型	ZL201921719827.2	一种双动力自动化晶圆搬运机构	2019/10/11	2020/4/21	原始取得
92	上海冠礼	实用新型	ZL201822040148.4	一种电子级化学品桶清洗设备	2018/12/5	2019/8/9	原始取得
93	上海冠礼	实用新型	ZL201821790663.8	一种多用途高负载高精滴定仪	2018/10/31	2019/6/25	原始取得
94	上海冠礼	实用新型	ZL201821790617.8	一种改进型滴定分析容器	2018/10/31	2019/6/25	原始取得
95	上海冠礼	实用新型	ZL201821790632.2	一种滴定仪用试样气泡检测系统	2018/10/31	2019/6/25	原始取得
96	上海冠礼	实用新型	ZL201821917749.2	一种用于湿制程设备的花篮及晶圆全自动转运传输机构	2018/11/20	2019/6/25	原始取得
97	上海冠礼	实用新型	ZL201822011871.X	电子级化学药液槽罐车充填设备	2018/12/3	2019/8/13	原始取得
98	上海冠礼	实用新型	ZL201821919890.6	防呆型化学桶快速连接接头	2018/11/20	2019/8/9	原始取得
99	上海冠礼	实用新型	ZL201721263351.7	一种研磨液混合供应设备	2017/9/28	2018/5/15	原始取得
100	上海冠礼	实用新型	ZL201721263405.X	一种三轴全自动机械手臂机构	2017/9/28	2018/5/15	原始取得
101	上海冠礼	实用新型	ZL201721336776.6	一种 NMP 废气回收系统	2017/10/17	2018/5/15	原始取得
102	上海冠礼	实用新型	ZL201721263373.3	一种高精度管道防电磁波干扰装置	2017/9/28	2018/5/15	原始取得
103	上海冠礼	实用新型	ZL201721263409.8	一种抽气式溶液桶开盖器	2017/9/28	2018/5/15	原始取得
104	上海冠礼	实用新型	ZL201721263152.6	一种有机溶剂清洗槽	2017/9/28	2018/5/15	原始取得
105	上海冠礼	实用新型	ZL201721255751.3	一种湿式尾气处理装置	2017/9/28	2018/5/15	原始取得
106	上海冠礼	实用新型	ZL201621053328.0	硅片研磨液小型氮气加湿装置	2016/9/13	2017/3/29	原始取得
107	上海冠礼	实用新型	ZL201621054929.3	改进型电子级化学品供应桶放置平台	2016/9/13	2017/3/29	原始取得
108	上海冠礼	实用新型	ZL201621053315.3	改进型硅片自旋转及振荡机构	2016/9/13	2017/3/29	原始取得
109	上海冠礼	实用新型	ZL201621056641.X	电子级化学品分装设备	2016/9/13	2017/3/29	原始取得
110	上海冠礼	实用新型	ZL201621054965.X	研磨液混酸稀释系统	2016/9/13	2017/3/29	原始取得
111	上海冠礼	实用新型	ZL201621053371.7	酮酸供应温度控制系统	2016/9/13	2017/3/29	原始取得

112	冠礼科技	实用新型	ZL201721133325.2	废水净化系统	2017/9/6	2018/10/2	继受取得
113	冠礼科技	实用新型	ZL201820293752.5	一种具有净化功能的供水设备	2018/3/2	2018/11/2	继受取得
114	冠礼科技	实用新型	ZL201721895802.9	一种空气净化装置	2017/12/29	2018/9/18	继受取得
115	冠礼科技	实用新型	ZL201721494845.6	一种化工废气处理检测装置	2017/11/10	2018/9/18	继受取得
116	冠礼科技	实用新型	ZL201721492231.4	一种焦化废水处理设备	2017/11/10	2018/10/16	继受取得
117	冠礼科技	实用新型	ZL201721153683.X	一种半导体芯片生产用化学品在线加热器	2017/9/9	2018/8/10	继受取得
118	冠礼科技	实用新型	ZL201820197691.2	一种一体化管道污水分流装置	2018/1/24	2018/10/12	继受取得
119	冠礼科技	实用新型	ZL201721759446.8	一种搬运码垛机器人	2017/12/16	2018/11/30	继受取得
120	冠礼科技	实用新型	ZL201820016234.9	一种高效率空气净化装置	2018/1/3	2018/11/6	继受取得
121	冠礼科技	实用新型	ZL201721831175.2	空气净化设备	2017/12/22	2018/11/13	继受取得
122	冠礼科技	实用新型	ZL201820040352.3	一种废气检测的收集装置	2018/1/10	2018/10/16	继受取得
123	冠礼科技	实用新型	ZL201820027301.7	一种智能高效一体化污水处理装置	2018/1/8	2018/10/19	继受取得
124	冠礼科技	实用新型	ZL201820225709.5	一种旋转式空气净化器	2018/2/8	2018/10/23	继受取得
125	冠礼科技	实用新型	ZL201820116646.X	一种高效空气净化器	2018/1/24	2018/11/20	继受取得
126	冠礼科技	实用新型	ZL201820143316.X	一种高效的废气过滤装置	2018/1/29	2018/11/13	继受取得
127	冠礼科技	实用新型	ZL201920011873.0	一种安全高效的金浸出槽	2019/1/2	2019/10/15	继受取得
128	冠礼科技	实用新型	ZL201921164968.2	一种用于半导体加工的均氧钝化炉	2019/7/24	2020/4/10	继受取得
129	冠礼科技	实用新型	ZL201920808737.4	一种半导体光刻板清洗机	2019/5/30	2020/8/11	继受取得
130	冠礼科技	实用新型	ZL201921728877.7	一种晶圆氮气干燥装置	2019/10/15	2020/6/2	原始取得
131	冠礼科技	实用新型	ZL201921771935.4	一种改进型防呆酸桶快速连接系统	2019/10/21	2020/8/4	原始取得
132	冠礼科技	实用新型	ZL201921728720.4	一体式门锁安全装置	2019/10/15	2020/8/4	原始取得
133	冠礼科技	实用新型	ZL202120076081.9	一种滤芯式化学品加热器	2021/1/12	2021/9/3	原始取得
134	冠礼科技	实用新型	ZL202120066255.3	选择性晶圆输送装置	2021/1/12	2021/7/20	原始取得
135	冠礼科技	实用新型	ZL202022737138.3	一种化学品汲取管清洗设备	2020/11/24	2021/8/3	原始取得
136	冠礼科技	实用新型	ZL202022692241.0	一种自动灌装设备用锁盖机构	2020/11/19	2021/8/3	原始取得
137	冠礼科技	实用新型	ZL202122496976.0	一种交替式纯水高压喷雾清洗系统	2021/10/18	2022/3/4	原始取得
138	冠礼科技	实用新型	ZL202122447746.5	一种可调型气泡检测装置	2021/10/12	2022/3/11	原始取得
139	冠礼科技	实用新型	ZL202122449310.X	一种新型前后振荡机构	2021/10/12	2022/3/15	原始取得
140	冠礼科技	实用新型	ZL202122480752.0	一种新型在线式化学品浓度测量装置	2021/10/14	2022/3/18	原始取得

141	冠礼科技	实用新型	ZL202122480753.5	一种 200L 自动码垛搬运设备	2021/10/14	2022/3/11	原始取得
142	冠礼科技	实用新型	ZL202122493850.8	一种新型阵列显影液浓度稀释及控制系统	2021/10/15	2022/3/11	原始取得
143	冠礼科技	实用新型	ZL202222357775.7	一种制程槽体流场测试装置	2022/9/5	2022/12/13	原始取得
144	冠礼科技	实用新型	ZL202222156607.1	一种防呆型载具自动上下货模组	2022/8/16	2022/12/13	原始取得
145	冠礼科技	实用新型	ZL202222539919.0	一种全自动更换化学品桶系统	2022/9/23	2023/1/6	原始取得
146	冠礼科技	实用新型	ZL202222076325.0	一种新型化学品回收系统酸桶接头装置	2022/8/8	2022/11/25	原始取得
147	冠礼科技	实用新型	ZL202222076322.7	一种新型全自动电子级化学品桶配件清洗设备	2022/8/8	2022/12/2	原始取得
148	冠礼科技	实用新型	ZL202322372485.4	端子排检测设备	2023/9/1	2024/4/19	原始取得
149	冠礼科技	实用新型	ZL202322556002.6	一种用于化学液供应系统的软管的送料装置	2023/9/20	2024/4/26	原始取得
150	冠礼科技	实用新型	ZL202322554956.3	一种用于化学液供应系统的软管的整形装置	2023/9/20	2024/5/7	原始取得
151	冠礼科技	实用新型	ZL202322555986.6	一种用于化学液供应系统的 PFA 软管的冷却装置	2023/9/20	2024/4/30	原始取得
152	冠礼科技	实用新型	ZL202322557022.5	一种用于化学液供应系统的 PFA 软管的切断装置	2023/9/20	2024/4/26	原始取得
153	冠礼科技	实用新型	ZL202322553873.2	一种用于化学液供应系统的 PFA 软管的直度检测装置	2023/9/20	2024/5/3	原始取得
154	冠礼科技	实用新型	ZL202322869241.7	一种改进型研磨液系统循环机构	2023/10/25	2024/6/18	原始取得
155	冠礼科技	实用新型	ZL202420122988.8	研磨液原液桶吸管清洗机构	2024/1/18	2024/12/3	原始取得
156	冠礼科技	实用新型	ZL202420017407.4	化学品集成式气体室	2024/1/4	2024/12/17	原始取得
157	冠礼科技	实用新型	ZL202420554845.4	一种同轴嵌套软管	2024/3/21	2024/12/17	原始取得
158	冠礼科技	实用新型	ZL202420554535.2	一种光刻胶温控系统	2024/3/21	2025/3/25	原始取得
159	冠礼科技	实用新型	ZL202421595150.7	一种阀管焊接治具	2024/7/8	2025/5/9	原始取得
160	冠礼科技	实用新型	ZL202421806277.9	水平缠绕机	2024/7/29	2025/7/11	原始取得
161	冠礼科技	实用新型	ZL202421806270.7	用于水平缠绕机的输送线	2024/7/29	2025/7/11	原始取得
162	冠礼科技	实用新型	ZL202421806258.6	套袋设备	2024/7/29	2025/6/20	原始取得
163	冠礼科技	实用新型	ZL202421806262.2	转向输送线	2024/7/29	2025/7/11	原始取得
164	冠礼科技	实用新型	ZL202422114324.X	一种废屑收集装置	2024/8/29	2025/7/11	原始取得
165	冠礼科技	实用新型	ZL202422115468.7	一种定位机构	2024/8/29	2025/6/20	原始取得
166	冠礼科技	实用新型	ZL202422114310.8	一种送料装置	2024/8/29	2025/7/11	原始取得
167	冠礼科技	实用新型	ZL202422115452.6	一种线槽裁切设备	2024/8/29	2025/6/20	原始取得
168	冠礼科技	实用新型	ZL202422141790.7	钢瓶接头保护系统及钢瓶供气系统	2024/9/2	2025/7/11	原始取得

169	冠礼科技	实用新型	ZL202422350493.3	一种槽车充填装置	2024/9/26	2025/7/11	原始取得
170	冠礼科技	实用新型	ZL202422847362.6	一种超声波清洗装置	2024/11/21	2025/10/24	原始取得
171	冠礼科技	实用新型	ZL202422859179.8	一种超声清洗设备	2024/11/22	2025/10/24	原始取得
172	冠礼科技	实用新型	ZL202422911436.8	一种新型吸附组件	2024/11/28	2025/10/24	原始取得
173	冠礼科技	实用新型	ZL202422901853.4	一种自适应真空吸盘	2024/11/27	2025/12/16	原始取得
174	冠礼科技	实用新型	ZL202423012105.7	一种可调式定量加液容器及研磨液混合装置	2024/12/6	2025/10/24	原始取得
175	冠礼科技	实用新型	ZL202423126490.8	一种全自动同步传输切管机	2024/12/18	2025/11/14	原始取得
176	冠礼科技	实用新型	ZL202423137656.6	一种卷状管材旋转张紧装置	2024/12/19	2025/11/21	原始取得
177	冠礼科技	外观设计	ZL202330479226.4	端子台（TR32C1AB）	2023/7/28	2024/1/16	原始取得
178	冠礼科技	外观设计	ZL202330479268.8	端子台（TB16）	2023/7/28	2024/2/6	原始取得
179	冠礼科技	外观设计	ZL202330479299.3	端子台（TB-32-V0-1808-32）	2023/7/28	2023/12/22	原始取得
180	冠礼科技	外观设计	ZL202430026939.X	化学品过滤器（防爆 A 款）	2024/1/16	2024/7/30	原始取得
181	冠礼科技	外观设计	ZL202430026899.9	上料机（IBC 桶）	2024/1/16	2024/11/15	原始取得
182	冠礼科技	外观设计	ZL202430026991.5	化学品过滤器（防爆 B 款）	2024/1/16	2024/7/30	原始取得
183	冠礼科技	外观设计	ZL202430027046.7	化学品充填机（A）	2024/1/16	2024/10/1	原始取得
184	冠礼科技	外观设计	ZL202430027063.0	化学品槽车充填机（A）	2024/1/16	2024/10/1	原始取得
185	冠礼科技	外观设计	ZL202430027080.4	化学品槽车充填机（B）	2024/1/16	2024/10/15	原始取得
186	冠礼科技	外观设计	ZL202430027086.1	化学品充填机（B）	2024/1/16	2024/10/1	原始取得
187	冠礼科技	外观设计	ZL202430027182.6	化学品桶清洗机（B）	2024/1/16	2024/10/25	原始取得
188	冠礼科技	外观设计	ZL202430027196.8	化学品桶清洗机（C）	2024/1/16	2024/10/29	原始取得
189	冠礼科技	外观设计	ZL202430027207.2	化学品输送机	2024/1/16	2024/10/25	原始取得
190	冠礼科技	外观设计	ZL202430027228.4	化学品取样机（A）	2024/1/16	2024/10/15	原始取得
191	冠礼科技	外观设计	ZL202430027237.3	化学品取样机（B）	2024/1/16	2024/10/25	原始取得
192	冠礼科技	外观设计	ZL202430027264.0	化学品桶清洗机（A）	2024/1/16	2024/10/11	原始取得
193	冠礼科技	外观设计	ZL202430155288.4	化学品临时供应柜	2024/3/25	2024/12/6	原始取得
194	冠礼科技	外观设计	ZL202530319929.X	全自动高压单片清洗机	2025/6/5	2025/12/23	原始取得